

GOODIX[®]

深圳市汇顶科技股份有限公司

(深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B 座 13 层)

首次公开发行股票招股说明书

(申报稿)

保荐人 (主承销商)



CICC
中金公司

(北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

声明

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	公司本次公开发行的全部为新股，不涉及公开发售老股，发行的新股数量不超过10,000万股
每股发行价格	【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所	上交所
发行后总股本	不超过50,000万股
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺	<p>公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张帆承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在其在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，自申报离职之日起6个月内不转让其在离职信息申报之日已直接或间接持有的公司股份以及离职信息申报之日起6个月内增持的公司股份，自申报离职之日起6个月后的12个月内通过上交所挂牌交易出售的其直接或间接持有的公司股份数量占前述锁定股份总数的比例不超过50%；（3）在股份锁定期限届满后2年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其直接、间接持有的公司公开发行股票前已发行股份总数的10%，减持价格不低于发行价（若公司在上市后至其减持期间发生除息、除权行为，减持公司股份的数量和减持价格下限将作相应调整，下同）；（4）若公司上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接、间接所持公司股份的锁定期在第（1）项和第（2）项之原有锁定期限的基础上自动延长6个月；（5）上述第（3）和第（4）项股份锁定承诺不会因其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行</p> <p>公司其他股东汇发国际、汇信科技、惠邦投资、朱星火、汇持科技、杨奇志承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份</p> <p>公司董事朱星火、杨奇志，高级管理人员龙华、邓耿淳、廖崇清、柳玉平，原副总经理赵书来承诺：（1）将遵守上述除张帆以外的股东的承诺期限；（2）在其在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%。如果其在公司首次公开发行股票上市之日起6个月内（含第6个月）申报离职的，自申报离职之日起6个月内不转让其在离职信息申报之日已直接或间接持有的公司股份以及离职信息申报之日起6个月内增持的公司股</p>

	<p>份,自申报离职之日起6个月后的12个月内不得通过上交所挂牌交易出售前述锁定股份;如果其在首次公开发行股票上市之日起第6个月之后(不含第6个月)申报离职的,自申报离职之日起6个月内不转让其在离职信息申报之日已直接或间接持有的公司股份以及离职信息申报之日起6个月内增持的公司股份,自申报离职之日起6个月后的12个月内通过上交所挂牌交易出售的其直接或间接持有的公司股份数量占前述锁定股份总数的比例不超过50%;(3)在股份锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行价;(4)若公司上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其直接、间接所持公司股份的锁定期在第(1)项和第(2)项之原有锁定期限的基础上自动延长6个月;(5)上述第(3)和第(4)项股份锁定承诺不会因其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行</p> <p>公司监事颜彦、王营,员工冉锐、陈小祥、叶金春、石钱松、袁啸、凌伟、吴飞、李华飞、钟华、陈尚平、熊晓亮、郝洁、陈伟、吴健毓、谢创伟、黄兴、胡术华、李蔚、张素艳、郁新华、杨孟达、皮涛、廖英杰、李文昱、田浩伦承诺:(1)将遵守上述除张帆以外的股东的承诺期限;(2)在其在公司任职期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%。如果其在公司首次公开发行股票上市之日起6个月内(含第6个月)申报离职的,自申报离职之日起6个月内不转让其在离职信息申报之日已直接或间接持有的公司股份以及离职信息申报之日起6个月内增持的公司股份,自申报离职之日起6个月后的12个月内不得通过上交所挂牌交易出售前述锁定股份;如果其在首次公开发行股票上市之日起第6个月之后(不含第6个月)申报离职的,自申报离职之日起6个月内不转让其在离职信息申报之日已直接或间接持有的公司股份以及离职信息申报之日起6个月内增持的公司股份,自申报离职之日起6个月后的12个月内通过上交所挂牌交易出售的其直接或间接持有的公司股份数量占前述锁定股份总数的比例不超过50%</p> <p>公司其他通过汇信科技、汇持科技间接持有公司股份的员工承诺:除满足汇信科技、汇持科技的股份锁定承诺外,自公司股票上市之日起24个月(含第24个月)内,可转让股份不超过其间接持有的公司股份总数(为间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份加上因权益分派增加的股份)的30%;自公司股票上市之日起36个月(含第36个月)内,可转让股份不超过其间接持有的公司股份总数(为间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份加上因权益分派增加的股份)的60%</p>
保荐人(主承销商)	中国国际金融股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

声明及承诺

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。

一、适用“股份支付”会计准则对公司经营业绩的影响

为实施股权激励，汇顶有限公司于2012年3月5日召开董事会并作出决议，同意张帆将其持有的汇顶有限12%的股权转让给员工持股公司汇信科技，同意张帆、朱星火、杨奇志将其持有的汇顶有限合计2%的股权转让给员工持股公司汇持科技，上述股权转让已于2012年4月完成工商变更登记。2012年度和2013年度，张帆已将其持有的汇信科技、汇持科技全部股权进一步转让给员工。

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的相关要求，本公司于2013年度就上述股权激励事项确认管理费用2,342.36万元，相应确认资本公积2,342.36万元，上述股权激励未对公司净资产造成影响，但减少2013年度的净利润，如不考虑股份支付，公司2013年度的净利润为28,006.05万元。

二、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张帆承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在其在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，自申报离职之日起6个月内不转让其在离职信息申报之日已直接或间接持有的公司股份以及离职信息申报之日起6个月内增持的公司股份，自申报离职之日起6个月后的12个月内通过上交所挂牌交易出售的其直接或间接持有的公司股份数量占前述锁定股份总数的比例不超过50%；（3）在股份锁定期限届满后2年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其直接、间接持有的公司公开发行股票前已发行股份总数的10%，减持价格不低于发行价；（4）若公司上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期

未收盘价低于发行价，其直接、间接所持公司股份的锁定期在第（1）项和第（2）项之原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；（5）上述第（3）和第（4）项股份锁定承诺不会因其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。

公司其他股东汇发国际、汇信科技、惠邦投资、朱星火、汇持科技、杨奇志承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

公司董事朱星火、杨奇志，高级管理人员龙华、邓耿淳、廖崇清、柳玉平，原副总经理赵书来承诺：（1）将遵守上述除张帆以外的股东的承诺期限；（2）在其在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%。如果其在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内（含第 6 个月）申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让其在离职信息申报之日已直接或间接持有的公司股份以及离职信息申报之日起 6 个月内增持的公司股份，自申报离职之日起 6 个月后的 12 个月内不得通过上交所挂牌交易出售前述锁定股份；如果其在首次公开发行股票上市之日起第 6 个月之后（不含第 6 个月）申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让其在离职信息申报之日已直接或间接持有的公司股份以及离职信息申报之日起 6 个月内增持的公司股份，自申报离职之日起 6 个月后的 12 个月内通过上交所挂牌交易出售的其直接或间接持有的公司股份数量占前述锁定股份总数的比例不超过 50%；（3）在股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；（4）若公司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接、间接所持公司股份的锁定期在第（1）项和第（2）项之原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；（5）上述第（3）和第（4）项股份锁定承诺不会因其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。

公司监事颜彦、王营，员工冉锐、陈小祥、叶金春、石钱松、袁啸、凌伟、吴飞、李华飞、钟华、陈尚平、熊晓亮、郝洁、陈伟、吴健毓、谢创伟、黄兴、胡术华、李蔚、张素艳、郁新华、杨孟达、皮涛、廖英杰、李文昱、田浩伦：（1）将遵守上述除张帆以外的股东的承诺期限；（2）在其在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%。如果其在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内（含第 6 个月）申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让其在离职信息申报之日已直接或间接持有的公司股份以及离职信息申报之日起 6 个月内增持的公司股份，自申

报离职之日起 6 个月后的 12 个月内不得通过上交所挂牌交易出售前述锁定股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第 6 个月之后（不含第 6 个月）申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让其在离职信息申报之日已直接或间接持有的公司股份以及离职信息申报之日起 6 个月内增持的公司股份，自申报离职之日起 6 个月后的 12 个月内通过上交所挂牌交易出售的其直接或间接持有的公司股份数量占前述锁定股份总数的比例不超过 50%。

公司其他通过汇信科技、汇持科技间接持有公司股份的员工承诺：除满足汇信科技、汇持科技的股份锁定承诺外，自公司股票上市之日起 24 个月（含第 24 个月）内，可转让股份不超过其间接持有的公司股份总数（为间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份加上因权益分派增加的股份）的 30%；自公司股票上市之日起 36 个月（含第 36 个月）内，可转让股份不超过其间接持有的公司股份总数（为间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份加上因权益分派增加的股份）的 60%。

三、公司发行上市后的股利分配政策及发行前滚存利润分配方案

1、股利分配的总原则：公司将牢固树立回报股东的意识，每年结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，选择有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的利润分配方案，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的一致性、合理性、连续性和稳定性。

2、利润的分配形式：公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

3、公司在该年度盈利且累计未分配利润为正，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，原则上每年至少进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司可以根据公司的盈利状况及资金状况进行中期现金分红，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

4、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程（草案）》

规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

6、为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，公司第一届董事会第十一次会议和 2013 年度股东大会审议通过了《深圳市汇顶科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划》和《深圳市汇顶科技股份有限公司长期股东分红回报规划》。

7、公司滚存利润分配政策：公司于 2014 年 4 月 12 日召开了 2014 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，同意本次发行上市前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。

关于公司股利分配政策的具体内容，请参见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。

四、特别风险因素

（一）市场竞争及利润空间缩小的风险

集成电路设计行业公司众多，市场竞争日益加剧。国际方面，Synaptics、Cypress、Atmel 等公司拥有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，本公司在整体实力和品牌知名度方面还存在差距；国内方面，本土竞争对手日渐加入，其技术水平也不断成熟，未来芯片产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减等状况。同时，随着智能手机、平板电脑出货量增速的放缓，集成电路设计行业部分下游企业的毛利率出现下降趋势，可能导致行业内设计企业利润空间随之缩小。

2013 年度、2014 年度和 2015 年度，本公司主要产品电容触控芯片平均单价分别为 4.95 元/颗、4.04 元/颗和 3.60 元/颗，产品价格呈持续下降趋势。未来随着市场竞争进一步加剧和下游企业毛利率下滑，公司将面临主要产品价格下降，导致盈利能力下滑和利润空间缩小的风险。

（二）技术创新风险

集成电路设计行业技术升级换代较快，特别是在智能人机交互领域，近年来先后出现了指纹识别、Force Touch 等多项创新技术，以及指纹识别和触控屏合二为一等技术发展趋势。未来若公司技术研发水平落后于行业升级换代水平，或本公司技术研发方向与市场发展趋势相偏离，将导致公司研发资源浪费并错失市场发展机会，对本公司产生不利影响。

（三）产品类型较为单一的风险

公司专注于智能人机交互技术的研究与开发。近年来，公司主导产品电容屏触控芯片市场需求旺盛，产品销售收入增长迅猛，2011 年以来已成为公司营业收入的主要来源。2013 年度、2014 年度和 2015 年度，电容触控芯片收入占公司营业收入的比重分别为 98.75%、98.29%和 76.31%。但集成电路下游客户需求丰富，现阶段公司产品类型仍然较为单一，存在无法满足客户的多样化需求的风险。

五、关于《股价稳定措施》的承诺

为稳定公司股价，公司上市后 3 年内，如公司股票收盘价格（如发生除息、除权行为，股票收盘价格将做相应调整，下同）连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（即“启动条件”），公司、公司控股股东、董事和高级管理人员（前述主体合称为“各方”）承诺启动《股价稳定措施》。

（一）股价稳定措施的实施顺序

如启动条件被触发，各方将按照如下实施顺序启动股价稳定措施：

1、在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件规定，不导致公司股权分布不符合上市条件，且经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二及以上同意实施股份回购的前提下，由公司回购公司股份。

2、在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定，且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，发生下述任一情形，由公司控股股东张帆增持公司股份：（1）公司无法实施股份回购；（2）股份回购未获得股东大会批准；（3）已经股东大会批准的股份回购方案未实施；（4）公司股份回购实施完毕后仍未使得公司股票收盘价格连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产；（5）公司股份回购实施完毕后启动条件再次被触发。

3、在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定，且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，发生下述任一情形，由除张帆外的非独立董事和高级管理人员增持公司股份：（1）控股股东无法实施增持；（2）控股股东已承诺的增持计划未实施；（3）控股股东的增持计划实施完毕后仍未使得公司股票收盘价格连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产；（4）控股股东的增持计划实施完毕后启动条件再次被触发。

4、如上述 1-3 项股价稳定措施均无法实施或未实施的，将通过降低在公司领取薪酬或津贴的董事、高级管理人员薪酬或津贴等方式提升公司业绩，稳定公司股价。

各方承诺：公司上市后 3 年内，在上述股价稳定措施依次实施后，如果启动条件再次被触发的，将再按照上述实施顺序启动股价稳定措施。各方对任一方履行《股价稳定措施》承诺的内容负有督促义务。公司承诺：如公司在上市后 3 年内新聘任董事和高级管理人员的，公司将确保该等人员按照《股价稳定措施》承诺函的内容出具股价稳定措施的承诺。持有公司股权和/或担任公司董事的《股价稳定措施》承诺函出具主体承诺：在持有公司股权和/或担任公司董事期间，如启动条件触发，将通过在董事会和/或股东大会投赞同票的方式促使相关各方履行已作出的承诺。

（二）股价稳定措施的具体操作

1、公司回购股份的具体操作

在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件规定且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司将在启动条件被触发之日起的 10 日内由公司董事会做出实施回购股份或不实施回购股份的决议，并在决议作出后的 2 个交易日内公告回购股份的预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的合理理由。

公司将在董事会决议作出之日起的 30 日内将同意或不同意股份回购的预案提交股东大会审议。经出席股东大会股东所持表决权的三分之二及以上同意实施回购的，公司将依法履行公告、备案、通知债权人等法定程序，实施股份回购。

公司承诺：（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；（2）公司单次用于回购股份的资金不得低于 1,000 万元；（3）公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%，如上述第（2）项与本项冲突的，按照本项执行。

上述回购将在履行完毕法律法规规定的程序后 60 日内实施完毕。若公司董事会公告回购股份预案后至回购实施完毕前，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施回购计划。

2、控股股东增持股份的具体操作

在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，控股股东张帆将在需由其增持股份的情形触发之日起 10 日内，就增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告，并在增持公告作出之日起的下一个交易日启动增持。

张帆承诺：（1）将通过自有资金履行增持义务；（2）用于增持公司股份的资金不少于其上一年度从公司取得的薪酬和现金分红总和（税后，下同）的 50%；（3）单次及/或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%，如上述第（2）项与本项冲突的，按照本项执行。

上述增持将在履行完毕法律法规规定的程序后的 60 日内实施完毕，但实施完毕前公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施增持计划。

3、除张帆外的非独立董事和高级管理人员增持股份的具体操作

在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，除张帆外的非独立董事和高级管理人员将在需由其增持股份的情形触发之日起 10 日内，就增持公司股票的具体计划（应

包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告,并在增持公告作出之日起的下一个交易日启动增持。

除张帆外的非独立董事和高级管理人员承诺:(1)将通过自有资金履行增持义务;(2)用于增持公司股份的资金不少于其各自上一年度从公司取得的薪酬和现金分红总和的 20%。

上述增持将在履行完毕法律法规规定的程序后的 60 日内实施完毕,但实施完毕前公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产,则可终止实施增持计划。

4、降低在公司领取薪酬或津贴的董事、高级管理人员薪酬或津贴的具体操作

如上述 1-3 项股价稳定措施均无法实施或未实施的,将通过降低在公司领取薪酬或津贴的董事、高级管理人员薪酬或津贴的 20% (扣除后的薪酬不得低于当地的最低工资标准)等方式提升公司业绩,稳定公司股价。

六、关于招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

(一) 公司承诺

公司承诺:(1)若有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司董事会将在行政处罚或有效司法裁决作出之日起 10 日内制定并公告回购公司首次公开发行全部新股的计划(回购价格按照发行价加计银行同期活期存款利息和行政处罚作出之日前 30 个交易日股票交易均价的孰高确定,回购价格和股数按除权除息事项相应调整),并提交公司股东大会审议通过后实施回购计划;(2)若有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,公司将依法赔偿投资者的损失。

(二) 控股股东(实际控制人)承诺

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张帆承诺:(1)若有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司的招股

说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将在行政处罚或有效司法裁决作出之日起 10 日内制定其首次公开发行股票时公开发售全部老股的购回计划（购回价格按照发行价加计银行同期活期存款利息和行政处罚作出之日前 30 个交易日股票交易均价的孰高确定，购回价格和股数按除权除息事项相应调整），并提请公司予以公告后实施；（2）若有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，其将依法对投资者在证券交易中遭受的损失与公司承担连带赔偿责任，但是能够证明其没有过错的除外；（3）在其持有公司股权和担任公司董事期间，如公司发生被有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，其将通过投赞同票的方式促使公司履行已作出的承诺。

（三）除张帆之外的董事、监事、高级管理人员承诺

公司除张帆之外的其他董事、监事和高级管理人员承诺：（1）若有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，其将依法对投资者在证券交易中遭受的损失与公司承担连带赔偿责任，但是能够证明其没有过错的除外；（2）在其担任公司董事期间，如公司发生被有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，其将通过投赞同票的方式促使公司履行已作出的承诺。

（四）证券服务机构承诺

保荐机构中国国际金融股份有限公司承诺：如因其未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，其将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，依法赔偿投资者损失。

申报会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。

发行人律师广东信达律师事务所承诺：如因其未能依照现行适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责，存在过错而导致其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，其依生效的司法判决或仲裁赔偿投资者损失。

七、公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向

公司控股股东、实际控制人张帆的股份锁定期限参见“重大事项提示”之“二、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。张帆承诺：在股份锁定期限届满后 2 年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其直接、间接持有的公司公开发行股票前已发行股份总数的 10%，减持价格不低于发行价。鉴于其在本次发行前持有公司股份的比例超过 5%，在满足上述减持条件的情况下，将通过合法合规的方式减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。

公司公开发行前持股 5% 以上的股东汇发国际的股份锁定期限参见“重大事项提示”之“二、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。汇发国际承诺：在股份锁定期限届满后 2 年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其持有的公司公开发行股票前已发行的股份总数的 30%，减持价格不低于发行价。鉴于其在本次发行前持有公司股份的比例超过 5%，在满足上述减持条件的情况下，将通过合法合规的方式减持公司股份，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。

公司公开发行前持股 5% 以上的股东汇信科技的股份锁定期限参见“重大事项提示”之“二、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。汇信科技承诺：在股份锁定期限届满后 2 年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其持有的公司公开发行股票前已发行的股份总数的 25%，减持价格不低于发行价。鉴于其在本次发行前持有公司股份的比例超过 5%，在满足上述减持条件的情况下，将通过合法合规的方式减持公司股份，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。

八、未能履行承诺时的约束措施

（一）关于股份锁定、减持价格及延长锁定承诺的约束措施

公开发行人前持股 5% 以上的股东张帆、汇发国际、汇信科技以及直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员承诺，如其违反承诺或法律强制性规定减持公司股份的，将在公司股东大会及中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行的原因并公开道歉，且其违规减持公司股份的所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。其将在获得违规减持所得之日起的 5 日内将该所得支付至公司指定的账户。如其未及时上缴的，则公司有权扣留应付其现金分红中与其应上缴的违规减持所得加自延期之日起至现金红利派发日止每日万分之三的滞纳金金额相等的现金分红，该等现金分红作为其应上缴公司的违规减持所得并归公司所有。

（二）股价稳定措施的约束措施

1、如公司出现已经股东大会批准的股份回购方案未实施的情形的，应在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉，同时按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。

2、如控股股东张帆未履行《股价稳定措施》承诺函中约定的增持义务，应在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉，同时公司有权责令张帆在限期内履行增持义务，仍不履行的，每违反一次，应向公司按如下公式支付现金补偿：其最低增持金额减去实际增持股票金额（如有）；张帆若未支付现金补偿的，公司有权扣减应向张帆支付的现金分红、薪酬，以作为前述现金补偿归公司所有。多次违反规定的，现金补偿金额累计计算。

3、如除张帆外的非独立董事和高级管理人员未履行《股价稳定措施》承诺函中约定的增持义务，应在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉，同时公司有权责令其在限期内履行增持义务，仍不履行的，每违反一次，应向公司按如下公式支付现金补偿：其各自的最低增持金额减去实际增持股票金额（如有）；若未支付现金补偿的，公司有权扣减应向其支付的现金分红、薪酬，以作为前述现金补偿归公司所有。连续两次以上违反规定的，除现金补偿金额需累计计算外，公司有权在履行相应的法定程序后解聘相关董事、高级管理人员。

4、如出具《股价稳定措施》承诺函的相关人员在持有公司股权和/或担任公司董事期间未对降低在公司领取薪酬或津贴的董事、高级管理人员之津贴或薪酬的议案在董事会和/或股东大会投赞同票的，应在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉，同时应当共同、连带向公司合计支付与应扣减薪酬、津贴相同金额的现金补偿。

（三）关于招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺的约束措施

1、公司承诺：如未履行该等承诺，应在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并向公开道歉，同时按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的法律责任。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张帆承诺：如其未履行该等承诺，将在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉，其同意公司自其违反承诺之日起有权扣减应向其发放的现金红利、工资、奖金和津贴等，以用于执行未履行的承诺，直至其履行承诺或弥补完应由其承担的公司、投资者的损失为止。同时，在此期间，其所持公司全部股份按照已承诺锁定期和至其履行完该承诺止的孰长进行锁定。

3、直接或间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员朱星火、杨奇志、颜彦、王营、龙华、邓耿淳、廖崇清、柳玉平承诺：如其未履行该等承诺，将在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉，其同意公司自其违反承诺之日起有权扣减应向其发放的现金红利、工资、奖金和津贴等，以用于执行未履行的承诺，直至其履行承诺或弥补完应由其承担的公司、投资者的损失为止。同时，在此期间，其所持公司全部股份按照已承诺锁定期和至其履行完该承诺止的孰长进行锁定。

4、未持有公司股份的董事、监事游人杰、郭磊明、王建新、张波和陈恒真承诺：若其未履行该等承诺，将在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉，其同意公司自其违反承诺之日起有权扣减应向其发放工资、奖金和津贴等，以用于执行未履行的承诺，直至其履行承诺或弥补完应由其承担的公司、投资者的损失为止。

（四）公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的约束措施

公开发行前持股 5%以上的股东张帆、汇发国际、汇信科技承诺：如其违反承诺或法律强制性规定减持公司股份的，将在公司股东大会及中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行的原因并公开道歉，且其违规减持公司股份的所得归公司所有。其将在获得违规减持所得之日起的 5 日内将该所得支付至公司指定的账户。如其未及时上缴的，则公司有权扣留应付其现金分红中与其应上缴的违规减持所得加自延期之日起至现金红利派发日止每日万分之三的滞纳金金额相等的现金分红，该等现金分红作为其应上缴公司的违规减持所得并归公司所有。

（五）其他承诺的约束措施

在本招股说明书中出具避免同业竞争承诺的主体张帆、汇发国际及其实际控制人联发科、汇信科技、惠邦投资以及出具补缴社会保险、住房公积金承诺的主体张帆承诺：如其违反已作出的相关承诺，将采取如下具体措施：（1）将在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉；（2）如所违反的承诺可以继续履行的，将在公司或有权监管部门要求的期限内继续履行承诺；（3）如所违反的承诺不可以继续履行的，将向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，并将补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；（4）对违反承诺，将依法承担法律责任。

（六）保荐机构和发行人律师的意见

保荐机构认为，上述公开承诺内容合法、合理，未能履行承诺时的约束措施及时有效，符合《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法规的规定。发行人律师认为，上述相关承诺经签署后构成相关责任主体的单方允诺，对相关责任主体具有法律约束力，相关承诺的内容与形式合法。

九、本次发行对即期回报的影响及发行人拟采取措施

（一）本次发行对发行人每股收益的影响

公司本次拟发行不超过 1 亿股新股，发行后总股本不超过 5 亿股。鉴于公司主营产品产品之一的电容触控芯片销量增速已经放缓，指纹识别芯片产品未来的市场竞争格局

存在一定的不确定性,根据公司的谨慎预估,不考虑指纹识别芯片产品可能的快速增长,公司2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2015年度增幅不超过5%。假定本次发行于2016年6月底之前实施完毕,则2016年度公司每股收益较2015年度将有所摊薄。(注:上述假设分析及关于本次发行前后公司即期回报指标的测算不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。)

(二) 本次发行的必要性和合理性

1、突出和提高公司的核心竞争力

公司募集资金投资项目投产后,将提升原有产品的技术含量和市场竞争力,开发电容式近场通信微控制器、指纹识别芯片和模组等新产品,从而进一步提升公司的研发能力,开拓新的利润增长点。本次发行将进一步突出和提高公司的核心业务竞争能力,为本公司在国内和国际市场进一步确立更加稳定的竞争地位奠定基础。

2、提高公司的经营规模和盈利能力

本次募集资金项目经过充分论证,具有良好的发展前景。在募集资金项目建设期,由于项目尚未达产,公司净资产收益率在短期内将有所下降,但随着项目陆续投产和业务规模的扩大,公司盈利水平将大幅提升,公司的经营规模和盈利能力将得到进一步的提升。

3、改善公司财务状况

本次发行完成后,公司的净资产规模将大幅提高,账面价值将显著上升。随着资产规模的提高,公司的资产负债率将得到进一步改善,有利于公司间接融资能力和抵御财务风险能力的提升。

(三) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金运用均围绕公司主营业务进行,符合公司的发展规划。募集资金投资项目是公司发展战略的具体实施步骤,募集资金项目的实施将巩固公司在触控芯片领域的技术和市场优势,实现在智能手机、平板电脑和超极本等高成长领域触控芯片的技术和产品升级;加强对 On-cell 触摸屏控制芯片、主动式电容触控笔芯片产品的开发能力

和公司技术研发能力；对电容式近场通信微控制器和指纹识别芯片产品进行开发，拓展产品线，从而进一步提高盈利水平，持续增强公司整体竞争能力。

（四）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

自 2007 年以来，公司始终致力于电容屏触控芯片产品的研发与设计，在该领域获得了深厚的技术积累：在业内较早实现了 10 点触控芯片、智能手机用单层多点触控芯片的量产，以及触摸屏上支持去除屏蔽层、将触控芯片放置在整机主板（COB）的新型生产工艺或设计方式；同时，公司的电容屏触控芯片产品在抗 TFT 显示器干扰、电磁干扰、水膜干扰、共模干扰和悬浮干扰等方面表现优异，为实施“大、中、小尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目”、“On-cell 触摸屏控制芯片开发项目”和“主动式电容触控笔芯片技术升级项目”提供了扎实的技术保障。此外，电容触控领域的很多核心技术，例如互电容检测技术、跳频技术、降噪处理算法同时也是实施“指纹识别芯片和模组开发及产业化项目”和“电容式近场通信微控制器开发及产业化项目”所需的核心技术，这些技术的积累也为公司实施上述三个新产品项目奠定了坚实的技术基础。

公司拥有一支优秀、高效的研发团队。截至 2015 年末，公司研发人员达到 544 人，占员工总人数的 82.55%，其中包括多名自国外引进的高层次技术人才。公司通过提供行业内有竞争力的薪酬以及员工持股计划对研发团队进行激励，极大地提高了研发团队的归属感和稳定性。稳定的技术团队为募集资金投资项目的实施提供了可靠的人才保证。

公司组建了市场营销部，该部门主要负责对市场信息的及时收集和营销策略的制定，跟踪了解市场竞争对手及产品价格走势情况，并利用直销和经销两种销售模式对公司产品进行有效的推广。公司还建立了完善的技术支持服务体系，致力于向下游客户提供高效、完善的技术支持和周到快捷的客户服务。公司的销售网络和技术服务体系有利于募集资金投资项目产品的市场推广、新客户的拓展和降低产品应用成本，有利于募集资金投资项目的顺利实施。

（五）公司对保证此次募集资金有效使用、防范本次发行摊薄即期回报拟采取的措施

1、公司现有业务板块运营状况

公司从事智能人机交互技术的研究与开发，主要向市场提供面向手机、平板电脑等智能终端的电容屏触控芯片和指纹识别芯片，通过卓越的科研技术、优质的产品逐渐发展成为中国电容屏触控芯片和指纹识别芯片两大市场的主要竞争者。

在电容屏触控芯片领域，公司在业内较早实现了 10 点触控芯片、智能手机用单层多点触控芯片的量产，以及触摸屏上支持去除屏蔽层、将触控芯片放置在整机主板（COB）的新型生产工艺或设计方式；同时，公司的电容屏触控芯片产品在抗 TFT 显示器干扰、电磁干扰、水膜干扰、共模干扰和悬浮干扰等方面表现优异。自 2010 年至 2014 年，公司向市场陆续推出了 GT80 系列、GT8 系列、GT9 系列、GT9P 系列等触控芯片产品。

在指纹识别芯片领域，公司于 2014 年推出了指纹传感器技术、指纹匹配算法两项核心技术，并利用这两项技术研发出业内领先的指纹芯片产品 GF9 系列，主要应用于智能手机等终端。

2、面临的主要风险

公司面临的主要风险主要包括行业风险、经营风险、财务和税收风险、募集资金投资项目相关风险，具体情况请参见本招股说明书“第四节 风险因素”。

3、改进措施

为保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力，公司将采取以下措施提高公司未来的盈利能力和回报能力：

（1）积极稳妥的实施募集资金投资项目。本次募集资金项目经过充分论证，从中长期来看，具有良好的发展前景，若募集资金项目能按时顺利实施，将进一步巩固公司在触控芯片和指纹芯片领域的技术和市场优势，实现现有产品的技术升级和推出新产品，显著提升中长期的盈利能力及对投资者的回报能力。

（2）提高营运资金规模和运营效率，提升公司经营业绩。公司将进一步提高资金运营效率，降低公司运营成本，通过加快新产品研发、市场推广提升公司经营业绩，应对行业波动给公司经营带来的风险，保证公司长期的竞争力和持续盈利能力。

（六）相关承诺

1、公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：

（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

2、公司控股股东、实际控制人张帆承诺：将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

上述填补摊薄即期回报的措施已经公司第二届董事会第四次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司提请投资者注意，公司制定的上述填补摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利润做出保证。公司将在未来上市后定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

目录

第一节 释义	1
一、一般用语	1
二、专业用语	4
第二节 概览	8
一、本公司及控股股东、实际控制人简要情况	8
二、主要财务数据和主要财务指标	8
三、本次发行的基本情况	10
四、募集资金运用	11
第三节 本次发行概况	12
一、本次发行的基本情况	12
二、本次发行的有关机构	13
三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况	15
四、发行日程安排	15
第四节 风险因素	16
一、行业风险	16
二、经营风险	17
三、财务和税收风险	18
四、募集资金投资项目相关风险	19
第五节 发行人基本情况	21
一、发行人基本情况	21
二、发行人改制重组情况	21
三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况	23
四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性	33
五、发行人组织结构情况	35
六、发行人子公司、参股公司基本情况	37
七、持有 5% 以上股份的主要股东及实际控制人基本情况	39

八、发行人股本情况.....	50
九、内部职工股、工会持股、职工持股会持股或股东数量超过二百人的情况.....	52
十、发行人委托、信托持股及其变化情况.....	52
十一、发行人员工及其社会保障情况.....	53
十二、持有 5% 以上股份的主要股东，作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺	56
第六节 业务和技术	57
一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况.....	57
二、发行人所处行业的基本情况.....	61
三、发行人的竞争地位.....	76
四、主营业务情况.....	81
五、产品质量控制情况.....	97
六、发行人的主要固定资产及无形资产	98
七、发行人技术情况.....	112
八、发行人名称冠名“科技”的依据.....	118
第七节 同业竞争与关联交易	119
一、发行人的独立性.....	119
二、同业竞争.....	122
三、关联方、关联关系及关联交易.....	127
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员	143
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介.....	143
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况.....	148
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.....	149
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年的薪酬情况.....	149
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.....	150
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系.....	152
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及做出的重要承诺.....	153
八、公司董事、监事、高级管理人员任职资格.....	153
九、董事、监事、高级管理人员最近三年变动情况.....	154

第九节 公司治理	155
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况	155
二、发行人近三年违法违规的情况.....	185
三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况.....	185
四、发行人内部控制制度的自我评估和鉴证报告.....	186
第十节 财务会计信息	187
一、会计报表.....	187
二、会计师事务所的审计意见.....	197
三、财务报表编制基础、合并财务报表的范围及变化情况.....	197
四、主要会计政策和会计估计.....	199
五、主要税项.....	208
六、最近一年及一期收购兼并情况.....	209
七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.....	210
八、最近一期末主要非流动资产情况.....	210
九、最近一期末主要债项.....	212
十、股东权益.....	215
十一、现金流量情况.....	217
十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	217
十三、财务指标.....	218
十四、资产评估情况.....	220
十五、历次验资情况.....	221
第十一节 管理层讨论与分析	222
一、财务状况分析.....	222
二、盈利能力分析.....	241
三、资本性支出.....	263
四、现金流量分析.....	264
五、财务状况和盈利能力的趋势.....	266
六、股东未来分红回报分析.....	267

七、本次发行对即期回报的影响及发行人拟采取措施.....	271
第十二节 业务发展目标	275
一、公司发展战略.....	275
二、公司发展目标.....	275
三、实现发展目标的计划与措施.....	276
四、拟定上述计划所依据的假设条件.....	280
五、实施上述计划面临的主要困难以及拟采用的措施.....	280
六、业务发展规划与现有业务的关系.....	281
七、本次募集资金运用对实现上述目标的作用.....	281
八、公司关于未来发展与规划的声明.....	281
第十三节 募集资金运用	282
一、募集资金运用概述.....	282
二、募集资金投资项目的必要性分析和市场前景.....	283
三、募集资金投资项目简介.....	288
四、募集资金运用对发行人未来财务状况及经营成果的影响.....	326
第十四节 股利分配政策	327
一、发行人报告期内股利分配政策及实际股利分配情况.....	327
二、本次发行上市后的股利分配政策.....	331
三、本次发行完成前滚存利润的分配政策.....	334
四、保荐机构的核查意见.....	335
第十五节 其他重要事项	336
一、信息披露及投资者关系管理.....	336
二、重大合同.....	336
三、对外担保情况.....	340
四、诉讼及仲裁事项.....	340
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	348
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	348
二、保荐机构（主承销商）声明.....	349

三、发行人律师声明.....	350
四、会计师事务所声明.....	351
五、验资机构声明.....	352
六、验资情况专项复核机构声明.....	353
七、资产评估机构声明.....	354
八、资产评估复核机构声明.....	355
第十七节 备查文件	356
一、本招股说明书的备查文件.....	356
二、查阅地点.....	356
三、查阅时间.....	356
四、查阅网址.....	356

第一节 释义

一、一般用语

发行人、股份公司、汇顶科技、本公司、公司	指	深圳市汇顶科技股份有限公司，或依文中所意，有时亦指本公司及合并范围内的子公司
汇顶有限	指	深圳市汇顶科技有限公司，本公司改制前的主体
汇芯科技	指	深圳市汇芯科技发展有限公司，本公司全资子公司
汇顶香港	指	汇顶科技（香港）有限公司，本公司全资子公司
汇顶美国	指	汇顶（美国）公司，英文名称 GOODIX TECHNOLOGY INC.，本公司全资子公司
金慧通	指	成都金慧通数据服务有限公司，本公司全资子公司
易易非凡	指	易易非凡有限公司，本公司控股子公司
汇发国际	指	汇发国际（香港）有限公司，英文名称 Gold Rich International (HK) Limited，本公司股东
汇信科技	指	深圳市汇信科技发展有限公司，本公司股东
汇持科技	指	深圳市汇持科技发展有限公司，本公司股东
汇恒源	指	深圳市汇恒源科技发展有限公司，汇信科技股东
汇恒创	指	深圳市汇恒创科技发展有限公司，汇信科技股东
汇恒智	指	深圳市汇恒智科技发展有限公司，汇信科技股东
惠邦投资	指	四川惠邦投资有限公司，本公司股东
Atmel	指	Atmel Corporation，本招股说明书中文简称“爱特梅尔”，国际知名的半导体集成电路企业，总部位于美国
Cypress	指	Cypress Semiconductor，本招股说明书中文简称“赛普拉斯”，国际知名的半导体集成电路企业，总部位于美国

Synaptics	指	Synaptics, Inc., 本招股说明书中文简称“新突思”, 业界知名的半导体集成电路企业, 总部位于美国
Focaltech	指	FocalTech Systems, 本招股说明书中文简称“敦泰科技”, 业界知名的半导体集成电路企业, 注册地位于美国
高通	指	Qualcomm Technologies, Inc., 国际知名的半导体集成电路企业, 总部位于美国
德州仪器	指	Texas Instruments Inc., 国际知名的半导体集成电路企业, 总部位于美国
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司, 全球最大的晶圆代工企业
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司, 中国大陆规模最大的晶圆代工企业
日月光	指	日月光集团 (ASE Group), 总部位于中国台湾, 全球最大的半导体集成电路封装及测试企业之一
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司, 国内知名的集成电路封装企业
X-FAB	指	X-FAB Silicon Foundries, 全球知名的晶圆代工企业, 总部位于德国, 下属 X-FAB Semiconductor、X-FAB Dresden GmbH&Co. KG、X-FAB Texas, Inc.、X-FAB Sarawak Sdn. Bhd.等子公司
联发科	指	联发科技股份有限公司, 总部位于中国台湾, 全球知名集成电路设计公司
晨星半导体	指	开曼晨星半导体公司, 曾在台湾证券交易所上市, 已于 2014 年 2 月被联发科通过吸收合并方式收购
晨星台湾、Mstar	指	晨星半导体股份有限公司, 总部位于中国台湾, 全球知名

名的集成电路设计公司。2014年2月之前为晨星半导体公司的子公司，现为联发科合并报表范围内行使有限股东权利的子公司

北京君正	指	北京君正集成电路股份有限公司
国民技术	指	国民技术股份有限公司
欧比特	指	珠海欧比特控制工程股份有限公司
中颖电子	指	中颖电子股份有限公司
全志科技	指	珠海全志科技股份有限公司
魅族科技	指	魅族科技（中国）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
商务部	指	中华人民共和国商务部
深圳经信委、深圳科信委	指	深圳市经济贸易和信息化委员会，原名为深圳市科技工贸和信息化委员会
深圳市监局	指	深圳市市场监督管理局
深圳市工商局	指	深圳市工商行政管理局
保荐机构、主承销商	指	中国国际金融股份有限公司
发行人律师	指	广东信达律师事务所
申报会计师、大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
CCID、赛迪顾问	指	赛迪顾问股份有限公司，国内信息产业领域的专业咨询公司，直属于工信部中国电子信息产业发展研究院
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《公司章程》	指	本公司现行章程
《公司章程（草案）》	指	公司本次发行上市后将适用的章程
《审计报告》	指	大华出具的《深圳市汇顶科技股份有限公司审计报告》 （大华审字[2016]001315号）
报告期，最近三年	指	2013年度、2014年度、2015年度
最近一年	指	2015年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、专业用语

集成电路、IC	指	Integrated Circuit，简称 IC，将大量元器件集成于一个单晶片上所制成的电子器件，俗称芯片
消费类电子产品	指	用于个人和家庭日常消费的电子产品，主要包括手机、计算机、电视机、移动多媒体设备、固定电话、影碟机、录像机、摄录机、收录机、数码相机等
移动智能终端	指	安装有智能操作系统，可由用户自行安装程序和应用来实现相应功能的便携设备，主要包括智能手机、平板电脑、超极本等
智能手机	指	具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序，通过此类程序来不断对手机的功能进行扩充，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的这样一类手机的总称
平板电脑	指	Tablet Personal Computer，简称 Tablet PC，是一种小型、无须翻盖、没有键盘、方便携带且功能完整的个人电脑，以触摸屏作为基本的输入设备
超极本	指	Ultrabook，又译为超级本，是英特尔定义的全新品类的

笔记本产品，拥有极强性能、极度纤薄、极其快捷、极长续航、极炫视觉五大特性

人机交互	指	人与电子产品之间传递、交换信息的媒介和对话接口，是电子产品操作系统的重要组成部分，也指实现这一目的的技术或过程
电容	指	Capacitance，又称电容量，用 C 表示，是指电容器在给定电位差下的电荷储藏量
触摸屏	指	又称为“触控屏”、“触控面板”，是一种可接收手指、触头等输入信号的感应式电子设备输入装置
电容式触摸屏	指	通过检测手指（或其他触头）接触触摸屏表面时引起的电容变化来确定触点坐标的触摸屏，分为自电容、互电容等类型
自电容触摸屏	指	电容式触摸屏的一种，通过检测自电容（电极对系统地的电容）的变化实现触摸控制
互电容触摸屏	指	电容式触摸屏的一种，通过检测互电容（两个电极之间的电容）的变化实现触摸控制，可实现多点触控
电容屏触控芯片	指	对电容式触摸屏的工作起到检测和控制作用的芯片
电容触摸按键芯片	指	对电容式触摸按键的工作起检测和控制作用的芯片，通过检测感应电极对地电容或两个电极之间的电容的变化来判断电子产品触摸按键状态的变化
固定电话芯片	指	安装在固定电话中，实现来电显示、振铃检测、键盘扫描、拨号控制、铃声播放等人机交互功能的检测和控制芯片
主动式电容触控笔	指	带有信号产生及发送装置、与电容式触摸屏配套实现人机交互的笔
模组厂	指	加工制造具备一定完整独立功能的电子产品部件（即

		模组) 的厂商, 在本文中通常特指电容触摸屏模组厂
方案商	指	通过向集成电路设计企业采购芯片, 经过二次开发, 完成整机系统、软件、硬件应用方案设计的厂商
COB	指	Chip on Board, 即芯片直接附着于整机主板之上的设计方案
COG	指	Chip on Glass, 即芯片直接绑定在显示屏玻璃上的设计方案
多点触控	指	Multi-Touch, 是指可以让使用者多个手指(或其他触头)对触摸屏同时进行操作、控制的输入技术
ITO 薄膜	指	氧化铟锡 (IndiumTinOxide), 一般简称为 ITO, 一种 n 型半导体材料, 具有较高的导电率和透光率, 是触摸屏和 LCD 最常用的薄膜材料
In-cell	指	将触摸面板功能嵌入到液晶像素中, 从而实现触摸面板与液晶面板一体化的技术
On-cell	指	将触摸面板功能嵌入到彩色滤光片基板和偏光板之间, 从而实现触摸面板与液晶面板一体化的技术
传感器	指	即 Sensor, 能感受规定的被测量的各种量并按照一定的规律(数学函数法则)转换成可用信号的器件或装置, 通常由敏感元件和转换元件组成
LCD	指	Liquid Crystal Display, 即液晶显示器, 一种平面超薄的显示设备, 是目前主流的显示技术
液晶显示模组	指	即 LCD Module, 简称 LCM, 是将液晶显示器件、连接件、控制与驱动等外围电路、PCB 电路板、背光源以及其他结构件等装配在一起形成的组件
MCU	指	Micro Control Unit, 即微控制单元, 又称单片微型计算机、单片机, 将中央处理器 CPU、随机存储器 RAM、

		只读存储器 ROM、多种 I/O 接口和中断系统、定时器/计时器等功能集成到一片芯片上，以实现不同的应用功能
RISC	指	Reduced Instruction Set Computing，精简指令集，它的指令系统相对简单，只要求硬件执行很有限且最常用的那部分指令，大部分复杂的操作则使用成熟的编译技术以简单指令合成
SoC	指	System on Chip，系统级芯片、片上系统，指可实现完整系统功能、并嵌入软件的芯片电路
晶圆	指	半导体集成电路制作所用的硅晶片，可加工制作成各种电路元件结构，由于其形状为圆形，故称为晶圆
烧录	指	烧录厂利用烧录器或烧录卡，将程序代码写入芯片的过程
芯片空片	指	尚未烧录程序的标准化芯片产品，具有通用性，可通过烧录不同程序以实现不同的功能应用
近场通信	指	Near Field Communication (NFC)，一种短距离的高频无线通信技术，允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输、在十厘米内交换数据
μm	指	微米，长度计量单位，1 微米=10 ⁻³ 毫米
nm	指	纳米，长度计量单位，1 纳米=10 ⁻³ 微米
吋	指	英制长度单位 (inch)，1 吋=25.4 毫米

本招股说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、本公司及控股股东、实际控制人简要情况

(一) 公司简介

中文名称:	深圳市汇顶科技股份有限公司
英文名称:	Shenzhen Huiding Technology Co., Ltd.
住所:	深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B 座 13 层
注册资本:	40,000 万元
法定代表人:	张帆
有限公司成立日期:	2002 年 5 月 31 日
股份公司整体变更日期:	2012 年 9 月 20 日

汇顶科技致力于智能人机交互技术的研究与开发，并通过卓越的科研技术、优质的产品，逐渐发展成为中国电容屏触控芯片、指纹识别芯片和固定电话芯片三大市场的主要竞争者，在业内树立起较强的品牌影响力。在电容屏触控芯片领域，2014 年公司电容屏触控芯片产品的出货量约占中国市场销售量的 28.23%，市场排名第二，是中国电容屏触控芯片市场前五大厂商中唯一一家国内企业。

(二) 控股股东、实际控制人简介

本次发行前，张帆持有公司 21,535.60 万股，持股比例为 53.8390%，为公司控股股东及实际控制人。张帆，男，1965 年生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 51010219651229XXXX，现任公司董事长兼总经理。

二、主要财务数据和主要财务指标

以下数据经大华审计：

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产	111,449.07	79,119.39	50,071.23
非流动资产	27,843.16	21,399.45	14,918.16
资产总计	139,292.23	100,518.84	64,989.39
流动负债	21,345.36	11,164.87	5,147.53
非流动负债	556.71	113.63	709.07
负债总计	21,902.07	11,278.50	5,856.60
股东权益	117,390.16	89,240.34	59,132.79
归属于母公司股东的所有者权益	117,201.71	89,240.34	59,132.79

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	111,960.13	85,369.36	68,562.09
营业利润	39,116.60	40,921.00	31,940.71
利润总额	43,570.10	44,452.55	30,470.88
归属于母公司股东的净利润	37,835.31	38,357.55	25,663.69

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	22,847.27	33,465.85	25,165.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,897.79	-7,296.44	-13,803.72
筹资活动产生的现金流量净额	-10,161.53	-8,307.74	-1,705.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,046.85	86.40	-321.31
现金及现金等价物净增加额	10,834.80	17,948.07	9,335.17

(四) 主要财务指标

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动比率	5.22	7.09	9.73

速动比率	4.56	6.15	8.48
资产负债率（母公司）	13.61%	11.48%	8.71%
资产负债率（合并报表）	15.72%	11.22%	9.01%
每股净资产（元）	2.93	2.23	1.48
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例	0.62%	0.44%	0.65%
项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）	7.32	10.69	13.34
存货周转率（次）	3.83	3.49	4.19
息税折旧摊销前利润（万元）	44,856.51	45,214.39	30,766.84
每股经营活动的现金流量（元）	0.57	0.84	0.63
每股净现金流量（元）	0.27	0.45	0.23
归属母公司股东净利润（万元）	37,835.31	38,357.55	25,663.69
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	37,585.63	37,637.65	29,431.53

三、本次发行的基本情况

（一）股票种类及面值

人民币普通股（“A 股”），每股面值 1.00 元。

（二）发行数量

公司本次公开发行的全部为新股，不涉及公开发售老股，发行的新股数量不超过 10,000 万股。

（三）发行对象

符合资格的网下投资者和在上交所开户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（四）定价方式及发行价格

授权董事会与承销商协商确定定价方式，具体发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定。

四、募集资金运用

本次股票发行募集资金净额依轻重缓急用于以下项目建设：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	项目核准情况
小尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目	13,893	13,893	深发改核准[2012]0423号
中尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目	11,748	11,748	深发改核准[2012]0420号
大尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目	12,004	12,004	深发改核准[2012]0422号
On-cell 触摸屏控制芯片开发项目	12,269	12,269	深发改核准[2013]0341号
主动式电容触控笔芯片技术升级项目	13,484	13,484	深发改核准[2013]0342号
电容式近场通信微控制器开发及产业化项目	23,203	23,203	深发改核准[2014]0080号
指纹识别芯片和模组开发及产业化项目	39,403	39,403	深发改核准[2014]0078号
研发中心建设项目	9,325	9,325	深发改核准[2012]0421号
合计	135,329	135,329	

在不改变拟投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际情况，对上述项目的投入顺序及拟投入募集资金金额进行适当调整。如本次新股发行募集资金净额（扣除对应的新股发行费用后）不能满足募投项目所需资金总额的，不足部分由公司自筹解决。为把握市场机遇，使项目更快建成产生效益，本次发行上市的募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况暂以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据募集资金使用的有关规定并经履行相关法定程序后予以置换。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类:	人民币普通股 (A 股)
每股面值:	1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例:	公司本次公开发行的全部为新股, 不涉及公开发售老股, 发行的新股数量不超过 10,000 万股
定价方式:	授权董事会与承销商协商确定定价方式, 具体发行价格由发行人与承销商协商确定
每股发行价格:	【】元
发行后每股收益:	【】元 (按照 2015 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率:	【】倍 (按发行价格除以发行后每股收益计算)
本次发行前每股净资产:	2.93 元 (按截至 2015 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益除以发行前总股本计算)
本次发行后每股净资产:	【】元 (按截至 2015 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益与本次新股募集资金净额之和, 除以发行后总股本计算)
发行市净率:	【】倍 (按发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式:	采用网下向网下投资者询价配售与网上按市值资金申购定价发行相结合的方式
发行对象:	符合资格的网下投资者和在上交所开户的合格投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式:	由保荐机构 (主承销商) 组织承销团以余额包销的方式承销
募集资金总额和净额:	【】元; 扣除发行费用后, 募集资金净额【】元

发行费用概算： 本次发行费用总额为【】万元，其中：保荐承销费【】万元；审计及验资费【】万元；律师费【】万元；评估费【】万元；股份登记费及上市费【】万元；其他费用【】万元

二、本次发行的有关机构

（一）发行人：深圳市汇顶科技股份有限公司

法定代表人： 张帆
联系地址： 深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B 座 13 层
联系电话： 0755-33338828
传真： 0755-33338830
联系人： 廖崇清、潘彬

（二）保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人： 丁学东
联系地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系电话： 010-65051166
传真： 010-65051156
保荐代表人： 黄钦、章志皓
项目协办人： 周玉
项目经办人： 赵言、陈曦、张雯茜、邱晔

（三）发行人律师：广东信达律师事务所

负责人： 张炯
联系地址： 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼
联系电话： 0755-88265288

传真： 0755-83243108

经办律师： 韦少辉、胡云云

(四) 承销商律师：北京市天元律师事务所

负责人： 朱小辉

联系地址： 深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场写字楼 3401

联系电话： 0755-82550700

传真： 0755-82567211

经办律师： 牟奎霖、周陈义

(五) 会计师事务所： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人： 梁春

联系地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

联系电话： 010- 58350011

传真： 010- 58350006

经办注册会计师： 周珊珊、程纯

(六) 资产评估机构： 国众联资产评估土地房地产估价有限公司

法定代表人： 黄西勤

联系地址： 深圳市罗湖区深南东路 2019 号东乐大厦 10 楼

联系电话： 0755-25132297

传真： 0755-25132275

经办注册评估师： 王文涛、邢贵祥

(七) 资产评估复核机构： 广东中广信资产评估有限公司

法定代表人： 汤锦东

联系地址： 广州市越秀区东风中路 300 号金安商务大厦 11 楼 A4 室

联系电话： 020-83637844

传真： 020-83637840

经办注册评估师： 林巧萍、肖浩

(八) 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址： 上海市陆家嘴东路 166 号

联系电话： 021-38874800

传真： 021-58754185

(九) 收款银行： 【】

三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况

发行人与本次发行有关的保荐机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、发行日程安排

刊登发行公告日期： 【】年【】月【】日

询价推介日期： 【】年【】月【】日-【】年【】月【】日

定价公告刊登日期： 【】年【】月【】日

申购日期和缴款日期： 【】年【】月【】日

股票上市日期： 【】年【】月【】日

第四节 风险因素

投资者在评价本公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、行业风险

（一）行业波动风险

集成电路设计行业隶属于半导体产业，伴随全球半导体产业从产能不足、产能扩充到产能过剩的发展循环，集成电路设计行业也存在周期性波动。如果未来宏观经济形势发生剧烈波动，导致下游消费类电子产品等市场对芯片需求减少，或者国家针对集成电路设计行业的产业政策发生重大不利变化，集成电路设计行业增长势头将逐渐放缓，使包括本公司在内的集成电路设计企业面临一定的行业波动风险。

（二）市场竞争及利润空间缩小的风险

集成电路设计行业公司众多，市场竞争日益加剧。国际方面，Synaptics、Cypress、Atmel 等公司拥有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，本公司在整体实力和品牌知名度方面还存在差距；国内方面，本土竞争对手日渐加入，其技术水平也不断成熟，未来芯片产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减等状况。同时，随着智能手机、平板电脑出货量增速的放缓，集成电路设计行业部分下游企业的毛利率出现下降趋势，可能导致行业内设计企业利润空间随之缩小。

2013 年度、2014 年度和 2015 年度，本公司主要产品电容触控芯片平均单价分别为 4.95 元/颗、4.04 元/颗和 3.60 元/颗，产品价格呈持续下降趋势。未来随着市场竞争进一步加剧和下游企业毛利率下滑，公司将面临主要产品价格下降，导致盈利能力下滑和利润空间缩小的风险。

二、经营风险

（一）技术创新风险

集成电路设计行业技术升级换代较快，特别是在智能人机交互领域，近年来先后出现了指纹识别、Force Touch 等多项创新技术，以及指纹识别和触控屏合二为一等技术发展趋势。未来若公司技术研发水平落后于行业升级换代水平，或本公司技术研发方向与市场发展趋势相偏离，将导致公司研发资源浪费并错失市场发展机会，对本公司产生不利影响。

（二）产品类型较为单一的风险

公司专注于智能人机交互技术的研究与开发。近年来，公司主导产品电容屏触控芯片市场需求旺盛，产品销售收入增长迅猛，2011 年以来已成为公司营业收入的主要来源。2013 年度、2014 年度和 2015 年度，电容触控芯片收入占公司营业收入的比重分别为 98.75% 和 98.29% 和 76.31%。但集成电路下游客户需求丰富，现阶段公司产品类型仍然较为单一，存在无法满足客户的多样化需求的风险。

（三）公司业绩无法保持高速增长的风险

报告期内，伴随下游市场需求的快速增长，公司适时推出性能优异的电容屏触控芯片，触控芯片的市场占有率逐步提升，经营业绩呈高速增长态势，营业收入从 2013 年度的 68,562.09 万元增长至 2015 年度的 111,960.13 万元；净利润从 2013 年度的 25,663.69 万元增长至 2015 年度的 37,807.77 万元。未来，随着公司业务规模的不断扩大，营业收入和净利润继续维持高速增长的难度较大，公司将面临经营业绩无法保持高速增长的风险。

（四）原材料供应及外协加工风险

本公司作为集成电路设计企业，专注于芯片的研发、设计环节，而生产环节主要采取 Fabless 运营模式。公司采购的主要原材料为晶圆，而芯片的封装、烧录、测试等生产环节主要通过外协厂商完成。若晶圆市场价格、外协加工费价格大幅上涨，或由于晶圆供货短缺，外协厂商产能不足、生产管理水准欠佳等原因影响公司的产品生产，将会对公司的盈利能力、产品出货造成不利影响。因此，公司面临一定程度的原材料供应及外协加工的风险。

（五）核心技术泄密风险

通过不断创新及自主研发，公司已在电容触控芯片、指纹识别芯片和固定电话芯片领域积累了多项核心技术，这些核心技术是公司产品竞争优势的有力保障。未来如果因核心技术信息保管不善、核心技术人员流失等原因导致公司核心技术泄露，将对公司造成重大不利影响。

（六）人力资源不足风险

集成电路设计行业属于智力密集型产业，人力资源是企业的核心竞争力之一。截至2015年12月31日，公司人员已达到659人，其中研发人员达到544人。然而，从公司本身的发展需要和市场竞争环境来看，公司仍需要不断吸引优秀人才的加盟，尤其是募集资金投资项目开始实施后，公司对优秀人才的需求将愈加迫切，而国内集成电路设计专业优秀人才相对国际总体较为匮乏，因而专业人才数量可能难以满足公司发展的需求。同时，公司若发生人才流失，将进一步加剧人力资源不足的风险。

（七）高速增长带来的管理风险

近几年公司业务规模实现快速增长，2013年度、2014年度和2015年度，公司的主营业务收入分别为68,562.09万元、85,369.36万元和111,575.99万元，2013年末、2014年末和2015年末的总资产分别为64,989.39万元、100,518.84万元和139,292.23万元。与此同时，公司人员数量也从2002年成立时的30余人增加至2015年末的659人。收入、资产和人员规模扩张对公司的经营管理方式和水平都提出了更高要求，如果公司未能根据业务规模的发展状况及时改进企业管理方式、提升管理水平，将对公司生产经营造成不利影响。

三、财务和税收风险

（一）净资产收益率下降的风险

2013年度、2014年度和2015年度，本公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）分别为66.95%、50.27%和35.28%。本次募集资金到位后，公司净资产将有大幅度的增长，但募集资金投资项目的实施以及最终经济效益的产生尚需一定时间，预计将导致公司发行当年净资产收益率大幅下滑，因此存在净资产收益率下降的风险。

（二）税收优惠政策变动风险

本公司分别于 2009 年 6 月 27 日、2012 年 9 月 12 日和 2015 年 11 月 2 日被认定为高新技术企业，自 2009 年 1 月 1 日起享受高新技术企业所得税税收优惠，即 2009 年至 2017 年按照 15% 企业所得税税率计算缴纳企业所得税。此外，根据《关于〈鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题〉的通知》、《关于软件产品增值税政策的通知》等规定，公司销售自行开发生生产的软件产品享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的税收优惠政策。

2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司享受税收优惠占当期净利润的比例分别为 12.49%、15.86% 和 18.41%，税收优惠占当期净利润的比例较为稳定。如果上述税收优惠政策发生变动，或者本公司不再具备享受相应税收优惠的资质，则公司可能面临因税收优惠取消或减少而降低盈利的风险。

（三）汇兑损失风险

本公司有部分产品出口，并且以外币进行结算。2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司境外销售收入分别为 27,916.80 万元、34,942.52 万元和 36,454.25 万元，分别占当期主营业务收入的 40.72%、40.93% 和 32.67%，同期产生汇兑损失 257.85 万元、-18.16 万元和 -777.38 万元，汇率因素对本公司业绩影响较小。但是，随着人民币汇率形成机制改革的不断推进，人民币汇率弹性将进一步增强，如果人民币大幅升值，在公司营业规模不断扩大的情况下，公司可能产生较大的汇兑损失，从而对本公司业绩的稳定性带来不利影响。

四、募集资金投资项目相关风险

（一）募集资金投资项目市场前景风险

公司本次募集资金投资项目分别针对触控芯片产品线、电容式近场通信产品线、指纹识别产品线及其他新品研发，如果未来市场的发展方向偏离公司的预期，则上述募集资金投资项目研发的新产品和新技术将面临一定的市场风险。

（二）募集资金投资项目的管理和组织实施风险

多个募集资金投资项目的同时实施对公司的组织和管理水平提出了较高要求，公司的资产及业务规模将进一步扩大，研发、运营和管理团队将相应增加，公司在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不断提高，任何环节的疏漏或不到位都会对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称： 深圳市汇顶科技股份有限公司

英文名称： Shenzhen Huiding Technology Co., Ltd.

住所： 深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B 座 13 层

注册资本： 40,000 万元

法定代表人： 张帆

有限公司成立日期： 2002 年 5 月 31 日

股份公司整体变更日期： 2012 年 9 月 20 日

邮政编码： 518045

联系电话： 0755-33338828

传真： 0755-33338830

互联网网址： <http://www.goodix.com>

电子信箱： ir@goodix.com

二、发行人改制重组情况

（一）设立方式

公司系由汇顶有限以整体变更方式设立。2012 年 7 月 31 日，汇顶有限召开董事会，同意根据大华出具的《审计报告》（大华审字[2012]4787 号），以汇顶有限截至 2012 年 6 月 30 日经审计的净资产 186,674,305.32 元按 2.48899: 1 的折股比例折为股份公司的股本 7,500 万股，每股面值 1 元，剩余 111,674,305.32 元计入股份公司的资本公积，汇顶有限全体股东以在公司注册资本中的出资额所代表的净资产作为出资，认购股份公司的全部股份。同日，汇顶有限全体股东作为股份公司发起人签署《发起人协议》。

2012年8月16日，深圳经信委出具了《关于同意深圳市汇顶科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（深经贸信息资字[2012]1225号），同意汇顶有限整体变更为外商投资股份有限公司。2012年8月17日，深圳市人民政府核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深股资证字[2012]0009号），批准本次变更。

2012年9月18日，大华出具《验资报告》（大华验字[2012]100号），验证截至2012年9月18日，公司已将汇顶有限截至2012年6月30日经审计的所有者权益（净资产）186,674,305.32元按2.48899:1的折股比例折合股份总额7,500万股，共计股本7,500万元，大于股本部分111,674,305.32元计入资本公积。

2012年9月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。2012年9月20日，公司取得了注册号为440301103095560的《企业法人营业执照》。

（二）发起人

汇顶有限整体变更设立股份公司时在册的全体股东为公司的发起人，股份公司设立时的股本结构如下表所示：

序号	发起人	持股数（万股）	持股比例（%）
1	张帆	4,037.9250	53.8390
2	汇发国际	1,780.6125	23.7415
3	汇信科技	855.0375	11.4005
4	惠邦投资	374.7000	4.9960
5	朱星火	224.7675	2.9969
6	汇持科技	142.5075	1.9001
7	杨奇志	84.4500	1.1260
合计		7,500.0000	100.0000

（三）发行人改制设立前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司的主要发起人为张帆。公司改制设立前，张帆主要拥有汇顶有限的股权并从事其经营管理，其除直接持有汇顶有限股权和通过汇信科技间接持有汇顶有限股权外，无其他对外投资情况。

（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司系由汇顶有限整体变更设立，承继了汇顶有限的全部资产、负债及业务。公司成立时拥有的主要资产为变更设立股份公司时承继的汇顶有限的整体资产，主要为货币资金、应收账款、预付款项、存货、电子设备、运输工具、知识产权等与集成电路设计开发有关的经营性资产。

本公司从事智能人机交互技术的研究与开发，主要向市场提供面向手机、平板电脑等智能终端的电容屏触控芯片。公司拥有的主要资产和实际从事的主要业务在公司整体变更前后未发生变化。

（五）发行人成立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司改制设立后，主要发起人张帆拥有的主要资产为其持有的公司股份，主要发起人实际从事的主要业务与发行人成立之前从事的主要业务未发生变化。

（六）改制设立前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程之间的联系

公司系由汇顶有限整体变更设立，整体变更前后发行人的业务流程未发生变化。发行人的具体业务流程参见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、主营业务情况”之“（二）主要产品工艺流程”。

（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

公司成立以来，拥有独立完整的生产经营体系，自主研发，独立运营，在生产经营方面未与主要发起人及其控制的其他企业有重大关联关系。

（八）发行人出资资产的产权变更手续办理情况

公司系由汇顶有限整体变更设立，汇顶有限的全部资产、负债及权益由公司承继，截至本招股说明书签署之日，相关资产已全部办理完毕产权变更手续。

三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况

（一）发行人股本形成及其变化概览

1、有限责任公司阶段

（1）2002年5月汇顶有限设立

公司前身汇顶有限系由张帆、朱星火与杨奇志共同出资设立，设立时的注册资本为300万元，住所为深圳市福田区天安数码城创新科技广场A801室，经营范围为“电子产品软、硬件技术开发与销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）”。

2002年5月20日，深圳一飞致远会计师事务所出具《验资报告》（深飞验字[2002]第153号），验证截至2002年5月15日，公司已收到其股东投入的注册资本300万元，均以货币出资。

2002年5月30日，深圳市工商局向汇顶有限核发了《企业法人营业执照》（注册号4403012089381）。

汇顶有限成立时的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	张帆	210.00	70.0000
2	朱星火	60.00	20.0000
3	杨奇志	30.00	10.0000
合计		300.00	100.0000

(2) 2007年12月增资至4,249万元

2007年11月19日，汇顶有限召开股东会并作出决议，同意将注册资本由300万元增加至4,249万元，其中货币增资3,000万元（张帆出资2,400万元，朱星火出资500万元，杨奇志出资100万元）；各股东以其按份共有的位于深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座十三层的房产增资949万元。

2007年11月28日，深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司出具《资产评估报告》（深同诚评字[2007A]11QC第025号）确认上述用于增资房产于估价时点2007年11月27日的公开市场价值为949.6305万元，全体股东确认其价值为949万元，即张帆将其拥有的70%的房产产权评估作价出资664.3万元；朱星火将其拥有的20%的房产产权评估作价出资189.8万元；杨奇志将其拥有的10%的房产产权评估作价出资94.9万元。

2007年12月24日，深圳永德会计师事务所出具《验资报告》（深永德验字[2007]67号），验证截至2007年12月24日，汇顶有限已收到张帆、朱星火、杨奇志缴纳的新

增注册资本合计 3,949 万元，其中以货币出资 3,000 万元，以实物出资 949 万元。前述用于出资房产已于 2007 年 12 月 19 日登记至汇顶有限名下。

2007 年 12 月 28 日，深圳市工商局向汇顶有限换发了《企业法人营业执照》（注册号 440301103095560）。

本次增资完成后，汇顶有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	张帆	3,274.30	77.0605
2	朱星火	749.80	17.6465
3	杨奇志	224.90	5.2930
合计		4,249.00	100.0000

（3）2011 年 10 月股权转让

2011 年 3 月 6 日和 2011 年 10 月 28 日，汇顶有限分别召开股东会并作出决议，同意股东朱星火将其持有汇顶有限 12.4565% 的股权（对应 529.2767 万元出资额）以 529.2767 万元的价格转让给股东张帆，同意股东杨奇志将其持有汇顶有限 3.343% 的股权（对应 142.0441 万元出资额）以 142.0441 万元的价格转让给股东张帆。2011 年 10 月 28 日，股东朱星火、杨奇志作为转让方与受让方张帆签署了《股权转让协议书》，约定上述股权转让事宜。同日，中华人民共和国广东省深圳市深圳公证处对前述《股权转让协议书》进行了公证。

2011 年 10 月 31 日，深圳市监局向汇顶有限换发了《企业法人营业执照》（注册号 440301103095560）。

本次股权转让完成后，汇顶有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	张帆	3,945.622	92.8600
2	朱星火	220.523	5.1900
3	杨奇志	82.855	1.9500
合计		4,249.000	100.0000

（4）2011 年 11 月增资至 5,208 万元

2011年8月6日，张帆、朱星火、杨奇志与汇发国际签署《合资经营深圳市汇顶科技有限公司合同》，约定合资经营汇顶有限事宜。

2011年8月11日，汇顶有限召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本增加至5,208万元，新增注册资本959万元由新股东汇发国际缴纳，公司性质变更为中外合资经营企业。本次增资参考汇顶有限截至2011年4月30日的净资产评估值1.47元/单位注册资本以及汇顶有限2010年的经营业绩，协商确定由汇发国际对汇顶有限增资200万美元，取得汇顶有限18.414%的股权（按照缴款日2011年10月19日中国人民银行公布的人民币基准汇率折算，增资价格为1.329元/单位注册资本）。根据2011年6月21日深圳市鹏盛星辉资产评估事务所出具的《关于深圳市汇顶科技有限公司的整体资产评估报告书》（深鹏盛评估报字2011-C-028号），确认截至评估基准日2011年4月30日，汇顶有限的股东权益评估值为62,461,800元（折合1.47元/单位注册资本）。2013年9月9日，广东中广信资产评估有限公司对该评估报告进行了复核，出具了《关于<深圳市汇顶科技有限公司的整体资产评估报告书>（深鹏盛评估报字2011-C-028号）复核报告》（中广信评复报字[2013]第005号），认为该评估报告的评估方法基本符合相关规范要求，评估结论基本公允。

2011年9月19日，深圳科信委出具《关于深圳市汇顶科技有限公司股权并购变更设立为中外合资企业的批复》（深科工贸信字[2011]1625号），同意汇顶有限变更设立为中外合资企业及增加注册资本。2011年9月20日，汇顶有限就本次变更取得深圳市人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深合资证字[2011]0054号）。

2011年11月2日，深圳市湘信会计师事务所出具《验资报告》（深湘信所验外字[2011]37号），验证截至2011年10月19日，汇顶有限已收到汇发国际缴纳的货币出资200万美元，按照中国人民银行2011年10月19日公布的基准汇率6.3727折合1,274.54万元，其中959万元计入注册资本。2012年11月15日，大华对前述验资报告进行了复核，并出具《关于对深圳市汇顶科技股份有限公司申报期内非证券从业资格会计师事务所出具的验资报告股东出资到位情况的专项复核报告》（大华核字[2012]3594号），经复核，大华认为前述验资报告相应股东出资已经全部到位。

2011年11月3日，深圳市监局向汇顶有限换发了《企业法人营业执照》（注册号440301103095560）。

本次增资完成后，汇顶有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	张帆	3,945.622	75.7608
2	汇发国际	959.000	18.4140
3	朱星火	220.523	4.2343
4	杨奇志	82.855	1.5909
合计		5,208.000	100.0000

（5）2012年4月股权转让

2012年3月5日，汇顶有限召开董事会并作出决议，同意张帆将其持有汇顶有限6.576%的股权（对应342.4792万元出资额）以190.037万美元的价格转让给汇发国际，将其持有汇顶有限12%的股权（对应624.96万元出资额）以999.936万元的价格转让给汇信科技，将其持有汇顶有限0.514%的股权（对应26.795万元出资额）以42.872万元的价格转让给汇持科技；同意朱星火将其持有汇顶有限1.080%的股权（对应56.236万元出资额）以89.9776万元的价格转让给汇持科技；同意杨奇志将其持有汇顶有限0.406%的股权（对应21.129万元出资额）以33.8064万元的价格转让给汇持科技。本次股权转让给汇发国际的价格为3.5元/单位注册资本，定价由各方依据汇顶有限2011年的经营业绩协商确定；本次股权转让给汇信科技及汇持科技两家员工持股公司的价格系参考汇顶有限截至2012年2月29日的净资产值（1.68元/单位注册资本）确定为1.6元/单位注册资本。

2012年3月5日，转让方与受让方分别签署《股权转让协议书》，约定上述股权转让事宜。2012年3月30日，中华人民共和国广东省深圳市深圳公证处对前述《股权转让协议书》进行了公证。

2012年4月20日，深圳经信委出具《关于中外合资企业深圳市汇顶科技有限公司投资者股权变更的批复》（深经贸信息资字[2012]0363号），同意本次股权转让。2012年4月23日，深圳市人民政府换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深合资证字[2011]0054号），批准本次股权转让。

2012年4月25日，深圳市监局向汇顶有限换发了《企业法人营业执照》（注册号440301103095560）。

本次股权转让完成后，汇顶有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	张帆	2,951.3878	56.6703
2	汇发国际	1,301.4792	24.9900
3	汇信科技	624.9600	12.0000
4	朱星火	164.2870	3.1545
5	汇持科技	104.1600	2.0000
6	杨奇志	61.7260	1.1852
合计		5,208.0000	100.0000

（6）2012年5月增资至5,481.8744万元

2012年5月15日，汇顶有限召开董事会并作出决议，同意将汇顶有限注册资本增加至5,481.8744万元，新增注册资本由新股东惠邦投资认缴。本次增资的价格为7.5元/单位注册资本，定价参考汇顶有限2011年度的经营业绩，以及公司未来发展和上市规划，由各方共同协商确定。

2012年5月25日，深圳经信委出具《关于中外合资企业深圳市汇顶科技有限公司增资的批复》（深经贸信息资字[2012]0586号），同意汇顶有限本次增资。同日，深圳市人民政府换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深合资证字[2011]0054号），批准本次增资。

2012年5月28日，大华深圳分所出具《验资报告》（大华（深）验字[2012]025号），验证截至2012年5月24日，汇顶有限已收到惠邦投资缴纳的出资额20,540,580元，其中注册资本2,738,744元，资本公积17,801,836元，均以货币出资，变更后累计注册资本54,818,744元，实收资本54,818,744元。2012年11月15日，大华对前述验资报告进行了复核，并出具《关于对深圳市汇顶科技股份有限公司申报期内非证券从业资格会计师事务所出具的验资报告股东出资到位情况的专项复核报告》（大华核字[2012]3594号），经复核，大华认为前述验资报告相应股东出资已经全部到位。

2012年5月28日，深圳市监局向汇顶有限换发了《企业法人营业执照》（注册号440301103095560）。

本次增资完成后，汇顶有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	张帆	2,951.3878	53.8390
2	汇发国际	1,301.4792	23.7415
3	汇信科技	624.9600	11.4005
4	惠邦投资	273.8744	4.9960
5	朱星火	164.2870	2.9969
6	汇持科技	104.1600	1.9001
7	杨奇志	61.7260	1.1260
合计		5,481.8744	100.0000

上述 2012 年 4 月股权转让中，张帆将其持有的汇顶有限 12% 的股权转让给员工持股公司汇信科技，以及张帆、朱星火、杨奇志将其持有的汇顶有限合计 2% 的股权转让给员工持股公司汇持科技系为向员工实施股权激励。按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关要求，公司已于 2012 年度就上述股权激励事项进行股份支付的会计处理，确认管理费用 3,909.69 万元，相应确认资本公积 3,909.69 万元。具体而言，员工持股公司受让股权的转让价格为 1.6 元/单位注册资本，公司公允价值的认定依据是 2012 年 5 月惠邦投资对公司增资的认购价格 7.5 元/单位注册资本。惠邦投资作为 PE 股东，其投资公司的时间与员工入股时间间隔少于 6 个月，作为公司公允价值的参照物比较合理。

2、股份有限公司阶段

(1) 2012 年 9 月，汇顶有限整体变更为股份有限公司

2012 年 7 月 31 日，汇顶有限召开董事会，同意根据大华出具的《审计报告》（大华审字[2012]4787 号），以汇顶有限截至 2012 年 6 月 30 日经审计的净资产 186,674,305.32 元按 2.48899: 1 的折股比例折为股份公司的股本 7,500 万股，每股面值 1 元，剩余 111,674,305.32 元计入股份公司的资本公积，汇顶有限全体股东以在公司注册资本中的出资额所代表的净资产作为出资，认购股份公司的全部股份。同日，汇顶有限全体股东作为股份公司发起人签署《发起人协议》。

2012 年 8 月 16 日，深圳经信委出具了《关于同意深圳市汇顶科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（深经贸信息资字[2012]1225 号），同意汇顶有限整体

变更为外商投资股份有限公司。2012年8月17日，深圳市人民政府核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深股资证字[2012]0009号），批准本次变更。

2012年9月18日，大华出具《验资报告》（大华验字[2012]100号），验证截至2012年9月18日，公司已将汇顶有限截至2012年6月30日经审计的所有者权益（净资产）186,674,305.32元按2.48899:1的折股比例折合股份总额7,500万股，共计股本7,500万元，大于股本部分111,674,305.32元计入资本公积。

2012年9月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。2012年9月20日，公司取得了深圳市监局核发的《企业法人营业执照》（注册号：440301103095560）。

股份公司成立时的股本结构如下表所示：

序号	发起人	持股数（万股）	持股比例（%）
1	张帆	4,037.9250	53.8390
2	汇发国际	1,780.6125	23.7415
3	汇信科技	855.0375	11.4005
4	惠邦投资	374.7000	4.9960
5	朱星火	224.7675	2.9969
6	汇持科技	142.5075	1.9001
7	杨奇志	84.4500	1.1260
	合计	7,500.0000	100.0000

（2）2013年7月增资至16,500万元

2013年3月22日，公司召开2012年度股东大会并作出决议，同意用资本公积金9,000万元将公司注册资本增加至16,500万元。

2013年4月27日，深圳经信委出具《关于外商投资股份制深圳市汇顶科技股份有限公司增资的批复》（深经贸信息资字[2013]0658号），同意本次增资。2013年5月2日，深圳市人民政府换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深股资证字[2012]0009号）批准本次增资。

2013年7月4日，大华出具《验资报告》（大华验字[2013]000164号），验证截至2013年5月28日，公司已将资本公积9,000万元转增实收资本，变更后累计注册资本为16,500万元。

2013年7月8日，公司完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股本结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	张帆	8,883.4350	53.8390
2	汇发国际	3,917.3475	23.7415
3	汇信科技	1,881.0825	11.4005
4	惠邦投资	824.3400	4.9960
5	朱星火	494.4885	2.9969
6	汇持科技	313.5165	1.9001
7	杨奇志	185.7900	1.1260
合计		16,500.0000	100.0000

(3) 2015年6月增资至40,000万元

2015年4月18日，公司召开2014年度股东大会并做出决议，同意向全体股东每10股送红股13股，共计送红股21,450万股，并以资本公积转增股本2,050万股，前述送、转股完成后，公司注册资本增加至40,000万元。

2015年4月21日，深圳经信委出具《关于深圳市汇顶科技股份有限公司增资的批复》（深经贸信息资字[2015]244号），同意本次增资。2015年4月22日，深圳市人民政府换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深股资证字[2012]0009号）批准本次增资。

2015年6月1日，大华出具《验资报告》（大华验字[2015]000397号），验证截至2015年5月13日，汇顶科技已将资本公积金2,050万元，未分配利润21,450万元，合计人民币23,500万元转增公司实收资本，变更后累计注册资本为40,000万元。

2015年6月3日，公司完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股本结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	张帆	21,535.60	53.8390
2	汇发国际	9,496.60	23.7415
3	汇信科技	4,560.20	11.4005
4	惠邦投资	1,998.40	4.9960

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
5	朱星火	1,198.76	2.9969
6	汇持科技	760.04	1.9001
7	杨奇志	450.40	1.1260
合计		40,000.00	100.0000

（二）重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生重大资产重组情况。报告期内，公司收购了易易非凡控股股权及金慧通全部股权，具体情况如下：

1、收购易易非凡控股权

2015年1月4日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司收购易易非凡有限公司股权的议案》，会议决议公司择机签署《易易非凡有限公司股权转让及增资扩股协议》，并在履行相应法律程序及取得相应审批后，公司分别受让曾子懿及 Perfect Win Investments Limited 所持有的易易非凡 64.6576 万港元及 47.5424 万港元股本；同时决议以现金货币出资方式对易易非凡进行增资，增资金额共计 217.80 万港元。增资完成后，发行人取得易易非凡 330 万港元股本，占易易非凡总股本 52.8%。

2015年1月21日，公司取得深圳经信委核发的证号为“N4403201500081”号《企业境外投资证书》，核准公司并购易易非凡。

2015年4月8日，公司取得国家外汇管理局深圳市分局核发的《业务登记凭证》。

2015年5月21日，公司分别与曾子懿、Perfect Win Investments Limited 签署《股权转让及增资扩股协议》。

2015年5月26日，易易非凡股东等比例增资，注册资本由 212.50 万港元增至 625.00 万港元，其中公司增资金额为 217.80 万港元。股权转让和增资完成后，易易非凡总股本 625.00 万港元，公司持股 52.80%。

2、收购金慧通全部股权

2015年11月6日，深圳市鹏盛星辉资产评估事务所（普通合伙）出具“深鹏盛评估报字 20151145 号《深圳市汇顶科技股份有限公司拟进行股权收购所涉及成都金慧通

数据服务有限公司的股东全部权益资产评估报告》，确定在持续经营假设前提下，金慧通于评估基准日 2015 年 10 月 31 日的股东全部权益价值为 1,392.26 万元。

2015 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于收购成都金慧通数据服务有限公司 100% 股权的议案》，同意公司出资 1,386.612 万元收购深圳市金慧融智数据服务有限公司持有的金慧通 99.9% 的股权（对应出资额 799.2 万元）、出资 1.388 万元收购王剑锋持有的金慧通 0.1% 的股权（对应出资额 0.8 万元）。

2015 年 11 月 13 日，公司分别与深圳市金慧融智数据服务有限公司、王剑锋签署《股权转让协议书》。

2015 年 11 月 13 日，深圳市金慧融智数据服务有限公司、王剑锋与公司共同签署《合作协议》，就上述股权转让涉及的转让标的、转让对价及支付、金慧通盈亏分担、负债限制、金慧通的管理交接、各方的权利义务等进行详细约定。

2015 年 11 月 16 日，成都市工商行政管理局核准上述股权转让。股权转让完成后，金慧通成为公司全资子公司。截至本招股说明书签署之日，发行人已按照上述合同相关约定支付受让金慧通 100% 股权的全部转让价款。

四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性

（一）2002 年 5 月汇顶有限设立

2002 年 5 月 20 日，深圳一飞致远会计师事务所出具《验资报告》（深飞验字[2002]第 153 号），验证截至 2002 年 5 月 15 日，汇顶有限已收到其股东投入的注册资本 300 万元，均以货币出资。

（二）2007 年 12 月增资至 4,249 万元

2007 年 12 月 24 日，深圳永德会计师事务所出具《验资报告》（深永德验字[2007]67 号），验证截至 2007 年 12 月 24 日，汇顶有限已收到张帆、朱星火、杨奇志缴纳的新增注册资本合计 3,949 万元，其中以货币出资 3,000 万元，以实物出资 949 万元。前述出资房产已于 2007 年 12 月 19 日登记至汇顶有限名下。

（三）2011 年 11 月增资至 5,208 万元

2011年11月2日，深圳市湘信会计师事务所出具《验资报告》（深湘信所验外字[2011]37号），验证截至2011年10月19日，汇顶有限已收到汇发国际缴纳的货币出资200万美元，按照中国人民银行2011年10月19日公布的基准汇率6.3727折合1,274.54万元，其中959万元计入注册资本。

（四）2012年5月增资至5,481.8744万元

2012年5月28日，大华深圳分所出具《验资报告》（大华（深）验字[2012]025号），验证截至2012年5月24日，汇顶有限已收到惠邦投资缴纳的出资额20,540,580元，其中注册资本2,738,744元，资本公积17,801,836元，均以货币出资，变更后累计注册资本54,818,744元，实收资本54,818,744元。

（五）2012年9月整体变更

2012年9月18日，大华出具《验资报告》（大华验字[2012]100号），验证截至2012年9月18日，汇顶有限已将汇顶有限截至2012年6月30日经审计的所有者权益（净资产）186,674,305.32元按2.48899:1的折股比例折合股份总额7,500万股，共计股本7,500万元，大于股本部分111,674,305.32元计入资本公积。

（六）验资复核

2012年11月15日，大华出具《关于对深圳市汇顶科技股份有限公司申报期内非证券从业资格会计师事务所出具的验资报告股东出资到位情况的专项复核报告》（大华核字[2012]3594号），对汇顶有限报告期内由非证券从业资格会计师事务所出具的验资报告（《验资报告》（深湘信所验外字[2011]37号）和《验资报告》（大华（深）验字[2012]025号）进行验资复核。经复核，大华认为申报期内非证券从业资格会计师事务所出具的验资报告相应股东出资已经全部到位。

（七）2013年增资至16,500万元

2013年7月4日，大华出具《验资报告》（大华验字[2013]000164号），验证截至2013年5月28日，汇顶有限已将资本公积9,000万元转增实收资本，变更后累计注册资本为16,500万元。

（八）2015年增资至40,000万元

2015年6月1日，大华出具《验资报告》（大华验字[2015]000397号），验证截至2015年5月13日，汇顶科技已将资本公积金2,050万元，未分配利润21,450万元，合计人民币23,500万元转增公司实收资本，变更后累计注册资本为40,000万元。

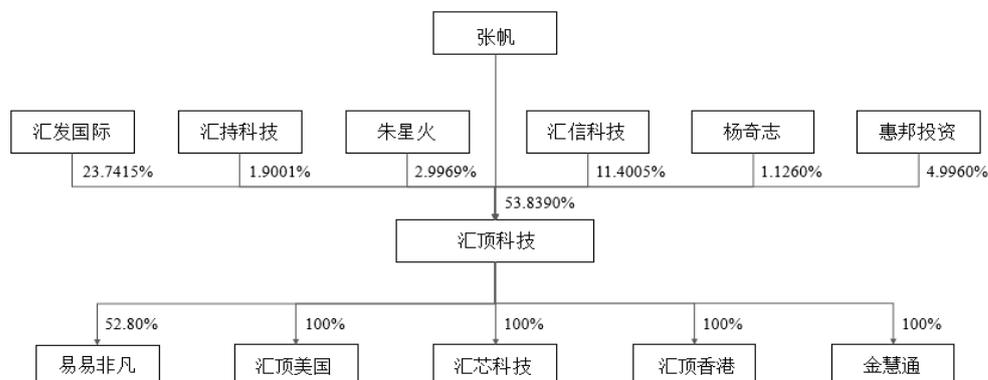
（九）发行人设立时发起人投入资产的计量属性

大华就发起人投入公司的资本情况进行了审验，并于2012年9月18日出具《验资报告》（大华验字[2012]100号），验证截至2012年9月18日，发行人已收到全体股东缴纳的注册资本合计7,500万元，各股东均以汇顶有限截至2012年6月30日之净资产出资。

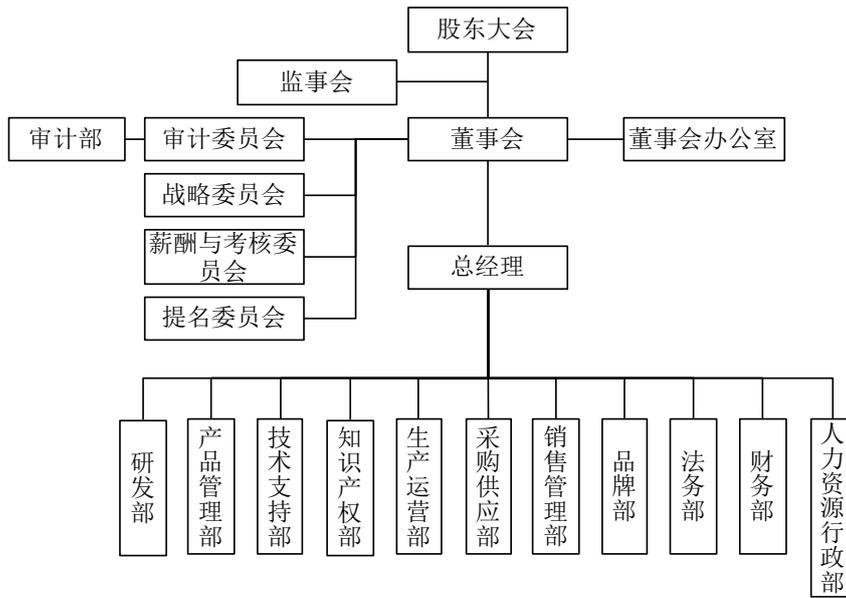
五、发行人组织结构情况

（一）股权结构图

截至本招股说明书签署之日，公司股权结构图如下：



（二）内部组织结构图



(三) 主要职能部门的职责情况

主要职能部门	主要职责
研发部	下设芯片设计一部、芯片设计二部、硬件开发部、触控产品开发部、指纹系统开发部、测试开发部等子部门，负责对软件、芯片产品进行策划、设计及测试；协助生产运营部下设的工程开发部量产工具的策划、设计和实施；协助技术支持部及其他相关部门解决与产品软件相关的疑难问题；负责对新一代技术方向的探索和确认，为公司战略方向发展提供可行性研究工作
财务部	负责公司财务管理体系的建立完善，公司会计核算和报告，公司全面预算的规划，对成本和费用进行监督，财务风险控制
产品管理部	包含产品管理部和产品拓展部，其中（1）产品管理部：对新技术、客户需求、市场情况进行跟踪研究，规划产品的特性、卖点，牵引研发的资源投入。产品立项后跟踪研发的进度，输出上市前的产品技术资料、测试工具、厂商合作资料等。对产品的市场竞争力和盈利能力负责 （2）产品拓展部：对产品的营销资料体系建设、关键客户产品拓展、产品品牌、产品定价、客户新需求分析负责。平台商、软件商、模组厂等产品生态链厂家的接口建设产品生态圈。制定渠道体系产品架构、产品渠道支撑体系、产品渠道政策
技术支持部	下设指纹技术支持、触控技术支持、模组设计支持、客户项目管理等部门，负责公司客户服务工作，解决客户项目进程中的技术问题，负责公司对外业务的技术跟踪服务，对外技术推广及交流；负责公司内部模组设计及协助调试
生产运营部	下设生产制造部、工程开发部、质量体系、设计质量管理、代工质量管理、质量工程部、IT 部。负责产品的量产工艺研究、IC 测试平台开发、导入验证和维护；公司质量体系建设与完善、开发设计到生产制造、量产的质量管理及外包供应商评估与管理；IT 部负责公司信息化平台和业务支撑系统的规划、开发、建设和维护，以及信息安全建设和管理
采购供应部	负责生产、采购计划的制定和实施，负责仓存管理及进出口物流，负责仪器、设备的采购和招投标工作，负责供应商关系维护、采购的商业谈判等工作
销售管理部	主要负责代表公司与客户建立伙伴关系，并深化长期战略合作的商务价值；作为公司与客户之间所有形式沟通的关键渠道，全方面提升双方交流的工作效率；带领公司透过不断进步的服务品质，树立公司在行业中优良企业形象；

主要职能部门	主要职责
	有系统性提供公司内部各种客户期待与市场需求，使其成为企业未来发展策略的重要依据；日常基本工作还包含管理与可往来的进销存的流程，代理商业业务，与例行性的产品推广
品牌部	负责公司品牌建设、品牌营销传播和品牌资产管理；通过品牌营销规划与整合营销传播提升 Goodix 品牌在全球客户中的认知度与信任度；打造 Goodix 在人机交互领域的全球领导者形象，帮助拓展全球潜在市场；提升公司产品的溢价空间；提升公司的品牌资产价值
知识产权部	负责公司的专利挖掘、国内外专利布局和申请、全球的商标注册、集成电路布图设计申请；处理知识产权纠纷，进行侵权分析；支持产品管理和市场销售的对外工作；负责对公司员工在知识产权方面的培训；负责管理对外和对内与知识产权有关的保密协议
法务部	为公司运营、管理提供法律支持，实现公司合规化管理，规避公司法律风险，维护公司合法权益
人力资源行政部	下设人力资源部及行政部，（1）人力资源部：根据企业整体发展战略，建立科学完善的人力资源管理与开发体系，负责人力资源的规划、管理与服务，创造良好的选用育留的平台及组织氛围，实现公司人力资源的有效提升和合理配置，确保满足企业发展的人才需求 （2）行政部：公司的后勤保障管理与服务，包含环境管理、员工餐饮管理、宿舍管理、固定资产管理、办公用品采购、公司资质及员工证照办理等
审计部	向董事会审计委员会负责，负责监督检查公司各部门经营活动和财务情况，监督、检查和评价公司内控制度，评估其执行的效果和效率
董事会办公室	协助董事会秘书处理董事会日常工作；负责公司证券事务、信息披露等相关工作及公司与投资者、中介机构和监管部门等的沟通和联络

六、发行人子公司、参股公司基本情况

截至本招股说明书签署之日，本公司拥有 4 家全资子公司汇芯科技、汇顶香港、汇顶美国、金慧通和 1 家控股子公司易易非凡。

（一）汇芯科技

汇芯科技成立于 2013 年 3 月 6 日，法定代表人为张帆，注册资本为 2,000 万元，实收资本为 2,000 万元，注册地址为深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B 座 2 层整层，经营范围为“电子产品软硬件的技术开发及转让自行开发的技术成果；电子产品、集成电路模块、电子设备、机器设备的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配套许可证管理及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）”。

公司持有汇芯科技 100% 股权，汇芯科技自设立至今股权未发生变更。

经大华审计，截至 2015 年 12 月 31 日，汇芯科技总资产为 3,443.62 万元，净资产为 1,678.45 万元，2015 年度营业收入为 561.77 万元，净利润为 31.68 万元。

（二）汇顶香港

汇顶香港成立于 2013 年 1 月 9 日，注册资本为港币 1,100 万元，注册地址为香港九龙旺角道 33 号凯途发展大厦 7 字楼 04 室，经营范围为“所有合法的任何业务及生意，包括电子信息产品贸易及研发”。

公司持有汇顶香港 100% 股权，汇顶香港成立时注册资本为港币 100 万元，2014 年 1 月注册资本增加至港币 1,100 万元。

经大华审计，截至 2015 年 12 月 31 日，汇顶香港总资产为 683.03 万元，净资产为 -1,868.30 元，2015 年度营业收入为 1,823.22 万元，，净利润为-662.29 万元。

（三）汇顶美国

汇顶美国成立于 2014 年 9 月 30 日，法定股本为 5 万股普通股，截至本招股说明书签署之日，汇顶美国已发行、流通 2 万股普通股，注册地址为美国加利福尼亚州圣地亚哥拉斯克大道 6370 号，F204 室，经营业务为“技术设计、开发和销售”。

公司持有汇顶美国 100% 股权，汇顶美国自设立至今股权未发生变更。

经大华审计，截至 2015 年 12 月 31 日，汇顶美国总资产为 716.36 万元，净资产为 655.49 万元，2015 年度营业收入为 218.18 万元，净利润为-617.50 万元。

（四）金慧通

金慧通成立于 2011 年 6 月 9 日，法定代表人为张帆，注册资本为 800 万元，实收资本为 800 万元，注册地址为成都高新区天顺北街 39 号 1 楼，经营范围为“数据处理；研发、销售计算机软硬件及外围设备并提供技术咨询；销售电子产品、通讯器材（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、机械设备。”

公司持有金慧通 100% 股权。金慧通成立时的注册资本为 800 万元，成立时深圳市金慧融智数据服务有限公司、王剑锋分别持有其 99.9% 股权（对应 799.2 万元出资额）、0.1% 股权（对应 0.8 万元出资额），依据四川华诚会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 18 日出具的“川华诚所验字[2011]第 5-105 号”《验资报告》，上述深圳市金慧融智数据服务有限公司、王剑锋对金慧通的货币出资均到位；公司于 2015 年 11 月分别受让上述深圳市金慧融智数据服务有限公司、王剑锋持有的金慧通全部股权，此次股权转让完成后，金慧通成为公司的全资子公司。

经大华审计，截至 2015 年 12 月 31 日，金慧通总资产为 6014.34 万元，净资产为 668.87 万元，2015 年度营业收入为 0.00 万元，净利润为-18.17 万元。

（五）易易非凡

易易非凡成立于 2014 年 4 月 3 日，注册资本为 625 万港元，注册地址为香港九龙旺角道 33 号凯途发展大厦 7 字楼 04 室，经营范围为“各类产品的研发生产、推广销售、进出口及国际贸易”。

公司持有易易非凡 52.80% 股权，曾子懿、Perfect Win Investments Limited 分别持有 27.2% 和 20% 股权。

易易非凡成立时注册资本为 1 万港元，后于 2014 年 8 月 8 日注册资本增加至 212.5 万港元。公司于 2015 年 5 月 21 日受让曾子懿、Perfect Win Investments Limited 所持有的易易非凡股本 64.6576 万港元、47.5424 万港元（合计股本 112.2 万港元），此次转让完成后，易易非凡于 2015 年 5 月 26 日注册资本增加至 625 万港元，由公司、曾子懿、Perfect Win Investments Limited 分别增加注册资本 217.80 万港元、112.20 万港元、82.50 万港元。

经大华审计，截至 2015 年 12 月 31 日，易易非凡总资产为 400.17 万元，净资产为 399.24 万元，2015 年度营业收入为 0.00 万元，净利润为-58.35 万元。

七、持有 5% 以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

（一）控股股东和实际控制人

本次发行前，张帆直接持有公司 21,535.60 万股，持股比例为 53.8390%，为公司控股股东及实际控制人。张帆，男，1965 年生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 51010219651229XXXX，现任公司董事长兼总经理。张帆的基本情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“（一）董事”。

（二）持有 5% 以上股份的其他股东情况

1、汇发国际

本次发行前，汇发国际持有公司 9,496.60 万股，持股比例为 23.7415%。汇发国际成立于 2011 年 3 月 23 日，注册资本为 419 万美元，注册地址为香港北角英皇道 338 号华懋交易广场 2 期 20 字楼 2006-8 室，主营业务为投资。

截至 2015 年 12 月 31 日，汇发国际的股权结构如下图所示：



汇发国际系台湾上市公司联发科下属公司投资设立的全资子公司，该公司主要从事投资业务，目前除持有汇顶科技股份外，未有其他对外投资。联发科总部位于台湾，系台湾证券交易所上市公司（股票代码：2454），该公司是全球知名的集成电路设计公司，主要从事手机主控芯片及无线通讯芯片组的研发、设计。MediaTek Investment Singapore Pte.Ltd、讯发有限公司（英属开曼群岛）、Gold Rich International (Samoa) Limited 均为联发科下属投资平台，主要从事对外股权投资业务。

截至本招股说明书签署之日，汇发国际总资产为 4,886.06 万美元，净资产为 4,886.06 万美元，2015 年度净利润为 1,380.80 万美元（以上数据未经审计）。

汇发国际与公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在涉及公司经营业绩、发行上市、影响董事会及股东大会表决或股份变动的任何特殊协议安排。汇发国际、其股东及其他关联方与公司本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、签字人员、经办人员之间均不存在任何直接或间接的股权关系、其他权益关系或关联关系，均不存在影响公司股权稳定的协议安排。

2、汇信科技

汇信科技是公司员工持股公司之一，本次发行前持有公司 4,560.20 万股，持股比例为 11.4005%。汇信科技成立于 2012 年 1 月 17 日，目前持有注册号为 440301105964874 的《企业法人营业执照》，企业类型为“有限责任公司（中外合资）外资比例低于 25%”，法定代表人为邓耿淳，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，注册地址为深圳市福田区福田保税区帝港海湾豪园——城市 3 米 6 公寓 2317，经营范围为“电器技术开发；经济信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）”。

截至本招股说明书签署之日，汇信科技的股权结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例	在发行人的任职
1	汇恒源	117.6130	11.7613%	—
2	汇恒创	107.3370	10.7337%	—
3	邓耿淳	67.3520	6.7352%	副总经理
4	廖崇清	67.3520	6.7352%	副总经理、财务负责人、 董事会秘书
5	柳玉平	50.0000	5.0000%	副总经理兼生产制造部经理
6	赵书来	37.5000	3.7500%	已离职
7	冉锐	33.3000	3.3300%	技术总监
8	颜彦	33.3000	3.3300%	项目管理部总监、监事会 主席
9	陈小祥	33.3000	3.3300%	软件开发组经理兼算法设计 组经理
10	叶金春	33.3000	3.3300%	指纹系统开发部总监兼算 法设计组经理
11	熊晓亮	27.4700	2.7470%	销售副总监
12	石钱松	25.0000	2.5000%	项目经理
13	陈尚平	25.0000	2.5000%	销售总监
14	汇恒智	23.6140	2.3614%	—
15	陈伟	23.3000	2.3300%	资深业务经理
16	龙华	23.0530	2.3053%	副总经理
17	袁啸	20.8000	2.0800%	产品测试部经理
18	凌伟	20.8000	2.0800%	硬件开发部总监
19	李蔚	20.0000	2.0000%	采购供应部总监
20	蒋利	18.3000	1.8300%	已离职
21	郝洁	16.7000	1.6700%	高级客户经理
22	王营	16.7000	1.6700%	技术支持部总监兼客户项 目管理部经理、监事

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例	在发行人的任职
23	朱阿兰	16.7000	1.6700%	销售总监特助
24	吴飞	12.5000	1.2500%	测试工程师
25	李亮	12.5000	1.2500%	工程开发部经理兼工程开发项目主管
26	李华飞	12.5000	1.2500%	软件技术经理
27	胡术华	12.5000	1.2500%	技术经理
28	钟华	8.3000	0.8300%	系统验证组经理
29	黄兴	8.3000	0.8300%	产品应用开发组经理
30	吴健毓	6.9850	0.6985%	资深业务经理
31	喻新飞	6.7000	0.6700%	硬件 FAE 组经理
32	王晶	6.2000	0.6200%	客户经理
33	王浩雷	6.2000	0.6200%	高级软件工程师
34	程思球	6.2000	0.6200%	产品开发组经理
35	张素艳	5.3850	0.5385%	人力行政经理
36	吴杰英	5.0000	0.5000%	客户经理
37	缪丽华	5.0000	0.5000%	销售助理主管
38	夏金民	4.2000	0.4200%	硬件助理工程师
39	刘武	4.2000	0.4200%	SENSOR 设计组经理
40	卓光明	4.2000	0.4200%	资深系统工程师
41	余音	3.3000	0.3300%	税务会计
42	霍蕊	3.3000	0.3300%	行政主管
43	杨秋香	3.3000	0.3300%	资产采购
44	李健	2.3390	0.2339%	模组设计支持经理
45	刘庆文	2.1000	0.2100%	模组设计工程师
46	黄乐	1.0000	0.1000%	质量文档工程师
合计		1,000.000	100.0000%	

截至 2015 年 12 月 31 日，汇信科技总资产为 1,395.20 万元，净资产为 1,393.66 万元，2015 年度净利润为 1,124.37 万元（以上数据未经审计）。

汇信科技的股东中有 3 位法人股东，该 3 位法人股东均为公司员工持股公司，其基本情况如下：

(1) 汇恒源

汇恒源成立于 2013 年 11 月 15 日，目前持有注册号为 440301108334801 的《企业法人营业执照》，企业类型为“有限责任公司（中外合资）”，法定代表人为邓耿淳，注册资本为 420.3563 万元，实收资本为 386.8210 万元，注册地址为深圳市福田区沙头街道车公庙天祥大厦 9A1-76，经营范围为“电器技术开发；经济信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）”。

截至本招股说明书签署之日，汇恒源的股权结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例	在发行人的任职
1	郁新华	101.4314	24.1299%	芯片设计一部总设计师
2	杨孟达	72.2002	17.1759%	芯片设计二部总监兼 Athens 开发部总监
3	田浩伦	38.0003	9.0400%	总经理助理
4	廖英杰	33.4400	7.9552%	云平台开发部总监
5	杨富强	13.5850	3.2318%	模拟设计技术经理
6	文亚南	13.3760	3.1821%	芯片设计二部副总监兼系统开发组经理
7	赵国豪	13.3001	3.1640%	模拟设计技术经理
8	阙滨城	10.4500	2.4860%	高级系统工程师
9	许绩耀	10.0320	2.3866%	数字设计副理
10	陈圣凯	9.5000	2.2600%	市场营销经理
11	史彦芪	9.1960	2.1877%	高级数字设计工程师
12	邓耿淳	7.6749	1.8258%	副总经理
13	陈科	6.2700	1.4916%	资深模拟 IC 设计工程师
14	林宏毅	4.7501	1.1300%	资深项目经理
15	阙圣峻	4.7501	1.1300%	研发副总监
16	刘毅成	4.7501	1.1300%	像素设计技术经理
17	胡社琴	4.1800	0.9944%	版图设计工程师
18	陈登红	4.1800	0.9944%	IT 技术经理
19	周怡君	4.1800	0.9944%	业务经理
20	曾千鉴	3.8000	0.9040%	资深模拟设计技术经理
21	洪自立	3.8000	0.9040%	资深模拟设计工程师
22	TAEHAN YUN	3.8000	0.9040%	销售总监
23	许志尤	3.8000	0.9040%	数字设计组经理
24	沈纶铭	3.8000	0.9040%	已离职

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例	在发行人的任职
25	洪秋伯	3.8000	0.9040%	高级客户经理
26	康为	3.3440	0.7955%	软件技术经理
27	谭朝丽	3.3440	0.7955%	质量工程部经理
28	BAI SONGRONG	3.1352	0.7458%	研发总监
29	陈奎光	2.8501	0.6780%	高级技术支持工程师
30	陈明儒	2.5080	0.5966%	业务经理
31	罗永	2.0900	0.4972%	客户项目管理工程师
32	吴祖生	2.0900	0.4972%	技术支持工程师
33	赖朝琴	1.9001	0.4520%	资深软件开发经理
34	徐嘉骏	1.9001	0.4520%	模拟设计副理
35	杨智强	1.9001	0.4520%	资深数字设计经理
36	朱正伟	1.9001	0.4520%	数字 IC 设计技术副理
37	梁佑安	1.8810	0.4475%	高级模拟 IC 设计工程师
38	张哲维	1.5674	0.3729%	模拟设计技术副理
39	DOHEON KIM	0.9500	0.2260%	CQE
40	Pradeep Karn	0.9500	0.2260%	高级算法工程师
合计		420.3563	100.0000%	

(2) 汇恒创

汇恒创成立于 2013 年 11 月 13 日，目前持有注册号为 440301108319954 的《企业法人营业执照》，企业类型为“有限责任公司”，法定代表人为廖崇清，注册资本为 383.6288 万元，实收资本为 383.6288 万元，注册地址为深圳市福田区保税区桂花路帝港海湾豪园——城市 3 米 6 公寓 2219，经营范围为“电器技术开发；经济信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）”。

截至本招股说明书签署之日，汇恒创的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	在发行人的任职
1	皮涛	94.0500	24.5159%	芯片设计一部总监
2	龙华	64.4839	16.8089%	副总经理
3	李文昱	38.0000	9.9054%	高级客户经理
4	廖崇清	26.2188	6.8344%	副总经理、财务负责人、董事会秘书
5	何毅	19.0000	4.9527%	工艺开发组总监

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	在发行人的任职
6	詹昶	13.5850	3.5412%	芯片设计组经理
7	王光耀	12.5400	3.2688%	资深数字IC设计工程师
8	李明皓	8.3600	2.1792%	项目经理
9	詹春林	8.3600	2.1792%	算法技术经理
10	何汝标	8.3600	2.1792%	物理实现组总监
11	马任飞	7.6001	1.9811%	产品经理
12	张均军	6.2700	1.6344%	资深模拟 IC 设计工程师
13	曹晖	5.7000	1.4858%	品牌经理
14	赵所峰	4.7501	1.2382%	应用与云端开发部资深经理
15	王兵	4.7501	1.2382%	指纹应用开发部资深经理
16	李子荣	4.7501	1.2382%	算法技术经理
17	李卫锋	4.7501	1.2382%	后端技术经理
18	程城	4.1800	1.0896%	产品拓展
19	杨旺旺	4.1800	1.0896%	系统工程师
20	白丽影	3.8002	0.9906%	已离职
21	陈敏	3.3440	0.8717%	模拟版图设计工程师
22	方军	3.3440	0.8717%	软件技术经理
23	张明	2.2803	0.5944%	芯片验证工程师
24	龙云芳	2.0900	0.5448%	软件技术经理
25	黄强	2.0900	0.5448%	高级算法工程师
26	杜灿鸿	1.9001	0.4953%	系统工程师
27	赵毅	1.9001	0.4953%	高级软件工程师
28	易江涛	1.9001	0.4953%	高级软件工程师
29	代理军	1.9001	0.4953%	高级软件工程师
30	陈德坤	1.9001	0.4953%	技术经理
31	李丹	1.9001	0.4953%	高级算法工程师
32	武丹	1.9001	0.4953%	高级软件工程师
33	蔡小淳	1.9001	0.4953%	高级软件工程师
34	桂新涛	1.9001	0.4953%	高级算法工程师
35	杨北	1.5203	0.3963%	模拟版图设计工程师
36	汪智	1.5203	0.3963%	模拟版图设计工程师
37	苏晓斌	1.2540	0.3268%	客户经理

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	在发行人的任职
38	胡鹏	0.9502	0.2477%	高级工程师
39	龙卫	0.8360	0.2179%	封装结构组主管/项目主管
40	何迎春	0.8360	0.2179%	仓库主管
41	钟翔	0.5701	0.1486%	高级工程师
42	蒋宏	0.5701	0.1486%	系统工程师
43	刘相英	0.5701	0.1486%	资深结构工程师
合计		383.6288	100.0000%	

(3) 汇恒智

汇恒智成立于 2015 年 7 月 9 日，目前持有注册号为 440301113302675 的《企业法人营业执照》，企业类型为“有限责任公司”，法定代表人为廖崇清，注册资本为 240.3116 万元，实收资本为 240.3116 万元，注册地址为深圳市福田区沙头街道车公庙天祥大厦 9A1-75，经营范围为“电器技术开发；经济信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）”。

截至本招股说明书签署之日，汇恒智股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	在发行人的任职
1	罗记成	27.0499	11.2562%	资深产品经理
2	李强	18.9350	7.8794%	FP BM Head
3	雷利	16.2300	6.7537%	知识产权部经理
4	张学志	16.2300	6.7537%	质量体系经理
5	刘和兴	13.5249	5.6281%	研发总监
6	米海燕	11.1582	4.6432%	触控产品 BM Head
7	熊明	10.8200	4.5025%	高级项目经理
8	张雅杰	10.8200	4.5025%	高级项目经理
9	邓辉	10.8200	4.5025%	IT 部经理
10	吴梦霞	10.8200	4.5025%	采购经理
11	廖崇清	8.4933	3.5343%	副总经理、财务负责人、董事会秘书
12	尚振兴	8.1150	3.3769%	产品经理
13	李绍龙	8.1150	3.3769%	市场营销经理
14	向文芹	6.6949	2.7859%	财务经理
15	范硕	6.6949	2.7859%	资深模拟设计工程师

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	在发行人的任职
16	孙泽民	6.6949	2.7859%	流程管理
17	覃耀辉	5.4100	2.2512%	算法技术经理
18	钟志鑫	5.4100	2.2512%	软件技术经理
19	谭波	4.4632	1.8573%	资深数字 IC 设计工程师
20	谭胤	4.4632	1.8573%	高级产品经理
21	张孟文	4.4632	1.8573%	模拟 IC 设计工程师
22	李周群	2.7050	1.1256%	资深模拟 IC 设计工程师
23	朱松	2.7050	1.1256%	高级算法工程师
24	吴艳辉	2.7050	1.1256%	资深模拟 IC 设计工程师
25	王军波	2.7050	1.1256%	产品拓展
26	陈飞飞	2.7050	1.1256%	高级算法工程师
27	钱为	2.7050	1.1256%	系统和芯片架构工程师
28	冯籍澜	2.7050	1.1256%	算法工程师
29	高宇庆	2.7050	1.1256%	产品拓展
30	涂晶晶	1.62300	0.6754%	资深失效分析工程师
31	吴宝全	1.62300	0.6754%	晶圆制程组主管/项目主管
合计		240.3116	100.0000%	

（三）其他重要股东

1、惠邦投资

本次发行前，惠邦投资持有公司 1,998.40 万股，持股比例为 4.9960%。惠邦投资成立于 2008 年 5 月 22 日，目前持有注册号为 510000000055665 的《企业法人营业执照》，法定代表人为杜正琪，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，注册地址为成都市青羊区方池街 43 号 2-2 幢 4 楼 7 号，经营范围为“商务服务业；科技交流及推广服务业；农业服务业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）”。

惠邦投资股东为杜正琪、鲜继庚，两人为夫妻关系，为惠邦投资实际控制人。截至本招股说明书签署之日，惠邦投资的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	杜正琪	500.00	50.0000

序号	股东姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
2	鲜继庚	500.00	50.0000
合计		1,000.00	100.0000

截至 2015 年 12 月 31 日，惠邦投资总资产为 3,407.10 万元，净资产为 1,511.72 万元，2015 年度净利润为 383.21 万元（以上数据未经审计）。

截至本招股说明书签署之日，惠邦投资与公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在涉及公司经营业绩、发行上市、影响董事会及股东大会表决或股份变动的任何特殊协议安排。惠邦投资、其股东及其他关联方与公司本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、签字人员、经办人员之间均不存在任何直接或间接的股权关系、其他权益关系或关联关系，均不存在影响公司股权稳定的协议安排。

2、汇持科技

汇持科技是公司员工持股公司之一，本次发行前持有公司 760.04 万股，持股比例为 1.9001%。汇持科技成立于 2012 年 1 月 17 日，目前持有注册号为 440301105964920 的《企业法人营业执照》，法定代表人为龙华，注册资本为 166.656 万元，实收资本为 166.656 万元，注册地址为深圳市福田区保税区桂花路帝港海湾豪园——城市 3 米 6 公寓 2226 房，经营范围为“电器技术开发；经济信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）”。

截至本招股说明书签署之日，汇持科技的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人的任职
1	龙华	42.6463	25.5895%	副总经理
2	郝学哲	12.4992	7.5000%	硬件技术经理
3	谢创伟	12.4992	7.5000%	市场拓展经理
4	苏艳书	8.3328	5.0000%	已离职
5	林育波	8.3328	5.0000%	测试项目主管
6	刘光涛	8.3328	5.0000%	测试项目主管
7	郑明	8.3328	5.0000%	客户经理
8	李海	7.4473	4.4687%	触控产品开发部总监兼系统验证组经理
9	肖章茂	6.6664	4.0001%	销售助理
10	王立志	5.5389	3.3236%	高级客户经理

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人的任职
11	邓玲玲	4.8000	2.8802%	财务部经理
12	刘辉	4.1664	2.5000%	触控深圳技术支持经理
13	王静	4.1664	2.5000%	指纹技术支持经理
14	毛建平	2.3390	1.4035%	高级软件工程师
15	潘彬	2.2220	1.3333%	证券事务代表
16	阮滨	1.7543	1.0526%	软件技术经理
17	庞树	1.7543	1.0526%	技术经理
18	熊晓锋	1.6666	1.0000%	销售助理
19	谢倩	1.6666	1.0000%	销售助理
20	肖裕权	1.4033	0.8421%	工程平台开发主管
21	彭圣	1.1696	0.7019%	产品经理
22	戴磊	1.1695	0.7017%	高级软件工程师
23	陈楠	1.1695	0.7017%	高级软件工程师
24	申聪	1.1695	0.7017%	产品经理
25	乔胜强	1.1695	0.7017%	技术支持工程师
26	宋海宏	1.1695	0.7017%	IC 测试主管
27	易福建	1.1694	0.7017%	硬件平台开发组经理
28	郝奇毅	1.1694	0.7017%	产品经理
29	王美	1.1508	0.6905%	产品经理
30	谭玮	1.1508	0.6905%	客户经理
31	冯敬平	0.9999	0.6000%	硬件助理工程师
32	张城林	0.9999	0.6000%	客户经理
33	石雪波	0.9356	0.5614%	高级技术支持工程师
34	苏俊伟	0.9048	0.5429%	客户经理
35	付静涛	0.8000	0.4800%	生产计划工程师
36	楚尚建	0.7017	0.4210%	模组设计工程师
37	毛栋良	0.6400	0.3841%	软件工程师
38	石吉财	0.5846	0.3508%	技术支持工程师
39	杜健康	0.5846	0.3508%	高级软件工程师
40	于海洋	0.4800	0.2880%	技术支持工程师
41	朱铜钟	0.4800	0.2880%	失效分析工程师
42	赵汝东	0.3200	0.1920%	高级硬件工程师

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人的任职
	合计	166.6560	100.0000%	

截至 2015 年 12 月 31 日，汇持科技总资产为 220.45 万元，净资产为 220.19 万元，2015 年度净利润为 183.84 万元（以上数据未经审计）。

（四）控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署之日，发行人的控股股东及实际控制人张帆，除直接持公司 53.8390% 的股份，不存在控制其他企业的情况。

（五）控股股东、实际控制人持有发行人股份的质押或其他有争议情况

截至本招股说明书签署之日，发行人控股股东、实际控制人张帆持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。

八、发行人股本情况

（一）本次发行前后发行人股本情况

假设本次发行新股 10,000 万股，公司发行前后股本结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	本次发行前股本结构		本次发行后股本结构	
		持股数（万股）	持股比例（%）	持股数（万股）	持股比例（%）
1	张帆	21,535.60	53.8390	21,535.60	43.0712
2	汇发国际	9,496.60	23.7415	9,496.60	18.9932
3	汇信科技	4,560.20	11.4005	4,560.20	9.1204
4	惠邦投资	1,998.40	4.9960	1,998.40	3.9968
5	朱星火	1,198.76	2.9969	1,198.76	2.3975
6	汇持科技	760.04	1.9001	760.04	1.5201
7	杨奇志	450.40	1.1260	450.40	0.9008
8	社会公众股东	-	-	10,000.00	20.0000
	合计	40,000.00	100.0000	50,000.00	100.0000

（二）发行人前十名股东持股情况

截至本招股说明书签署之日，公司共有 7 名股东，其持股情况如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
----	---------	---------	---------

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	张帆	21,535.60	53.8390
2	汇发国际	9,496.60	23.7415
3	汇信科技	4,560.20	11.4005
4	惠邦投资	1,998.40	4.9960
5	朱星火	1,198.76	2.9969
6	汇持科技	760.04	1.9001
7	杨奇志	450.40	1.1260
合计		40,000.00	100.0000

（三）前十名自然人股东及其在发行人担任的职务

截至本招股说明书签署之日，公司共有 3 名自然人股东，其在公司任职情况如下表所示：

序号	股东姓名	股份数（万股）	持股比例（%）	在发行人的任职
1	张帆	21,535.60	53.8390	董事长、总经理
2	朱星火	1,198.76	2.9969	董事
3	杨奇志	450.40	1.1260	董事

（四）国有或外资股份情况

截至本招股说明书签署之日，公司不存在国有股份。公司股东汇发国际系在香港注册的境外公司。2011 年 9 月，汇顶有限增加股东汇发国际并变更为中外合资企业，就本次变更，深圳科信委于 2011 年 9 月 19 日出具《关于深圳市汇顶科技有限公司股权并购变更设立为中外合资企业的批复》（深科工贸信字[2011]1625 号），同意汇发国际以认购增资方式并购公司的股权，认购增资的对价为现汇 200 万美元，占本次变更完成后公司注册资本的 18.414%；深圳市人民政府于 2011 年 9 月 20 日核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深合资证字[2011]0054 号），批准本次变更。汇发国际的基本情况参见本节“（二）持有 5% 以上股份的其他股东情况”之“1、汇发国际”。

（五）股东中的战略投资者持股及其简况

截至本招股说明书签署之日，公司不存在战略投资者。

（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前公司各间接股东间的关联关系如下表所示：

姓名	关联关系	在发行人所任职务	间接持股企业	间接持有公司股份比例
熊晓亮	熊晓亮与熊晓锋为堂兄弟，张城林为熊晓亮配偶的弟弟	销售副总监	汇信科技	0.3132%
熊晓锋		销售助理	汇持科技	0.0190%
张城林		客户经理	汇持科技	0.0114%
陈伟	陈伟与朱阿兰为夫妻关系，朱阿兰与朱铜钟为姐弟关系	资深业务经理	汇信科技	0.2656%
朱阿兰		销售总监特助	汇信科技	0.1904%
朱铜钟		失效分析工程师	汇持科技	0.0055%
石钱松	石钱松与郝洁为夫妻关系，石雪波与石钱松为兄弟关系	项目经理	汇信科技	0.2850%
郝洁		高级客户经理	汇信科技	0.1904%
石雪波		高级技术支持工程师	汇持科技	0.0107%
谢创伟	夫妻关系	市场拓展经理	汇持科技	0.1425%
王美		产品经理	汇持科技	0.0131%

除上述关联关系外，本次发行前直接或间接持有公司股份的股东之间不存在其他关联关系。

（七）本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺

参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

九、内部职工股、工会持股、职工持股会持股或股东数量超过二百人的情况

截至本招股说明书签署之日，发行人未发行过内部职工股，亦不存在工会持股、职工持股会持股或股东数量超过 200 人的情况。

十、发行人委托、信托持股及其变化情况

截至本招股说明书签署之日，发行人不存在委托持股与信托持股的情况。

十一、发行人员工及其社会保障情况

（一）员工基本情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司及其下属公司员工总数为 659 人，具体构成情况如下表所示：

1、员工专业结构

岗位专业类型	人数	占员工总数比例
研发人员	544	82.55%
销售人员	43	6.53%
行政管理人员	72	10.93%
合计	659	100.00%

2、员工受教育程度

学历类型	人数	占员工总数比例
博士	15	2.28%
硕士	200	30.35%
本科	380	57.66%
专科及以下	64	9.71%
合计	659	100.00%

3、员工年龄分布

年龄区间	人数	占员工总数比例
40 岁以上	47	7.13%
31-40 岁	220	33.38%
30 岁以下	392	59.49%
合计	659	100.00%

（二）发行人执行社会保障制度、住房公积金缴纳、医疗制度等情况

公司已与员工依法签订劳动合同，双方按照劳动合同约定行使权利并履行义务。

1、社会保险的缴纳情况

报告期内，公司及其子公司缴纳社会保险的比例或金额如下表所示：

期末	养老保险 (深户)		养老保险 (非深户)		综合医疗保险		工伤保险		失业保险		生育保险	
	公司	个人	公司	个人	公司	个人	公司	个人	公司	个人	公司	个人
2013 年 末	14%	8%	10%	8%	6.5%	2%	0.4%	-	2%	1%	0.5%	-
2014 年 末	14%	8%	13%	8%	6.2%	2%	0.2%/ 0.4%	-	32.54 元 /36.16 元	18.08 元	0.5%	-
2015 年 末	14%	8%	13%	8%	6.2%	2%	0.1%	-	18.27 元 /16.24 元	10.15 元	0.5%	-

注 1：由于上述每一年度期间曾发生缴费比例变动，为便于统计，上述比例为各期末适用缴费比例。上表中失业保险发行人于 2014 年末、2015 年末的缴费金额分别为 32.54 元、18.27 元，汇芯科技于 2014 年末、2015 年末的缴费金额分别为 36.16 元、16.24 元。

注 2：依据金慧通的确认，截至 2015 年 12 月末，金慧通员工人数为 0，据此，上述社会保险缴纳比例中不含金慧通缴纳情况。

报告期内，发行人及其子公司社会保险的缴纳人数如下表所示：

期末	在册人数 (人)	境外公司的员工 (人)	应缴人数 (人)	实缴人数 (人)	差异 (人)
2013 年末	300	21	279	279	0
2014 年末	413	44	369	369	0
2015 年末	659	78	581	573	8

注：上表“境外公司的员工”无需在境内缴纳社会保险。上表的计算方式为：应缴人数=在册人数-境外公司的员工；差异=应缴人数-实缴人数。

上述缴纳人数差异的原因主要为：按照相关政策，发行人每月 15 日之后入职的员工要在下月才能办理社保缴存手续，导致在期末统计时点部分新入职员工未能办理社保。

2016 年 1 月 1 日，深圳市社会保险基金管理局出具《证明》，证明“公司自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间无因违反社会保险法律、法规或者规章而被我局行政处罚的记录”。

2016 年 1 月 1 日，深圳市社会保险基金管理局出具《证明》，证明“汇芯科技自 2013 年 4 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间无因违反社会保险法律、法规或者规章而被我局行政处罚的记录”。

2016 年 2 月 18 日，成都高新技术产业开发区社会保险事业管理处出具《证明》，证明金慧通的 2 名员工“在我处办理社会保险登记，参加城镇职工社会保险并申报缴纳社会保险费”。

2016年1月30日，香港刘大潜律师行出具《法律意见书》，确认汇顶香港劳动用工符合香港相关法规规定。

2016年1月30日，香港刘大潜律师行出具《法律意见书》，确认易易非凡劳动用工符合香港相关法规规定。

2016年2月11日，美国博钦律师事务所出具《法律意见和事实确认书》，确认美国汇顶劳动用工不违反加利福尼亚相关法规规定。

2、住房公积金的缴纳情况

报告期内，公司住房公积金缴纳比例及缴存人数情况如下表所示：

期末	公司缴纳比例	个人缴纳比例	应缴人数(人)	实缴人数(人)	缴纳差异(人)
2013年末	5%	5%	279	269	10
2014年末	5%	5%	364	364	0
2015年末	5%	5%	578	572	6

上述缴纳人数差异的原因主要为：按照相关政策，发行人每月15日之后入职的员工要在下月才能办理住房公积金缴存手续，导致在期末统计时当月新入职员工未能缴存住房公积金；此外发行人还有数名外籍员工按相关规定无需缴纳住房公积金。

2016年1月19日，深圳市住房公积金管理中心出具《单位住房公积金缴存证明》，证明公司缴存时段为2010年12月至2015年12月，公司没有因违法违规而被深圳市住房公积金管理中心处罚的情况。

2016年1月19日，深圳市住房公积金管理中心出具《单位住房公积金缴存证明》，证明汇芯科技缴存时段为2013年4月至2015年12月，汇芯科技没有因违法违规而被深圳市住房公积金管理中心处罚的情况。

3、控股股东关于补缴社会保险、住房公积金的承诺

发行人控股股东、实际控制人张帆已出具承诺：“若应有权部门要求或决定，公司及其子公司需要补缴社会保险、住房公积金，或为此前未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿无条件代公司及其子公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司及其子公司不因此受到损失。”

十二、持有 5%以上股份的主要股东，作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

（一）避免同业竞争的承诺

参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（二）发行人控股股东、实际控制人及其他重要股东作出的避免同业竞争的承诺”。

（二）限售安排和自愿锁定股份的承诺

参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

（三）补缴社会保险和住房公积金的承诺

参见本节“十一、发行人员工及其社会保障情况”之“（二）发行人执行社会保障制度、住房公积金缴纳、医疗制度等情况”之“3、控股股东关于补缴社会保险、住房公积金的承诺”。

（四）其他重要承诺

发行人持有 5%以上股份的主要股东，作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的其他重要承诺包括：切实履行公司填补回报措施的承诺、股价稳定措施的承诺、关于招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺以及未能履行承诺时的约束措施承诺，具体承诺事项参见本招股说明书“重大事项提示”。

第六节 业务和技术

一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况

（一）发行人主营业务

本公司从事智能人机交互技术的研究与开发，主要向市场提供面向手机、平板电脑等智能终端的电容屏触控芯片和指纹识别芯片。

（二）发行人主要产品及变化情况

目前，公司主要产品为电容触控芯片和指纹识别芯片，除此之外为固定电话芯片产品。

1、电容触控芯片

本公司的电容触控芯片主要为电容屏触控芯片，应用于智能手机、平板电脑、导航仪等智能终端触摸屏的控制，此外还有少量电容触摸按键芯片，应用于 MP3、MP4、家用电器等终端产品按键的控制。

本公司凭借在人机交互技术领域的技术积累，开发出拥有自主知识产权、具备高性价比的电容触控芯片，广泛应用于智能手机、平板电脑、导航仪、MP3、MP4、PMP、家用电器等产品领域，为用户带来流畅的触控及人机交互体验。

（1）电容屏触控芯片

电容屏触控芯片对互电容式传感器起检测和控制作用，其工作原理为：互电容式触摸屏在玻璃表面用透明 ITO 导电材料制作成横向（X）与纵向（Y）电极阵列（如下图 1），纵横电极相互之间构成电容。当手指触摸电容屏表面时，由于人体影响了纵横电极之间的电场，从而改变了这两个电极之间的电容（如下图 2）。芯片工作时，驱动电极依次输出特定的激励信号，感应电极同步检测所接收到的信号，由此可以得到所有电容的大小，即一组表征电容屏互电容大小的二维矩阵数据，根据该矩阵的数据变化计算出手指的坐标，即触摸点。同时，由于检测数据是二维的，因此可以真实反映多个触点的数据变化，从而实现多点触控。

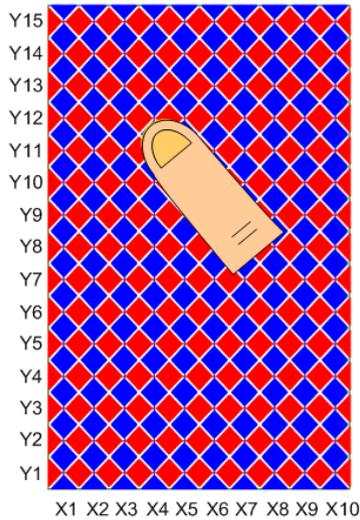


图 1 互电容式传感器布局示意图

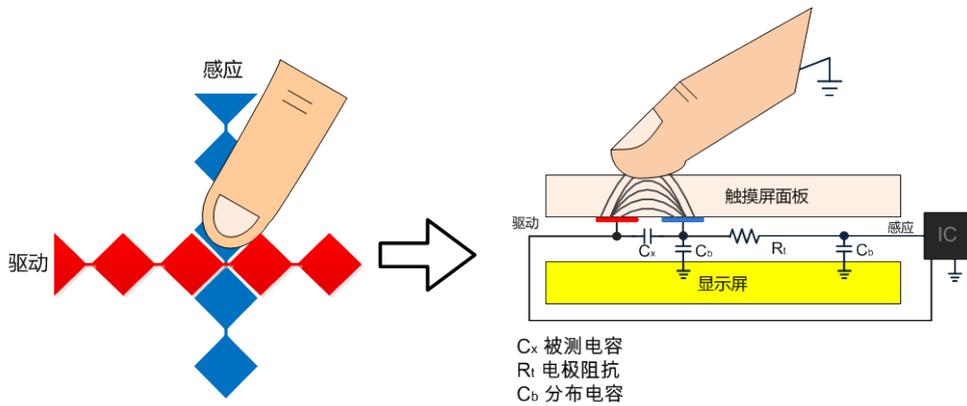


图 2 互容电容检测原理

(2) 电容触摸按键芯片

电容触摸按键芯片的工作原理为：对于电容触摸按键（其原理如下图 3 所示）来说，当人体（手指）触摸按键的表面时，由于人体相当于一个接大地的电容，因此会加大按键感应片的对地电容，电容触摸按键芯片即通过检测感应片对地电容的变化，判断出是否有触摸的动作。

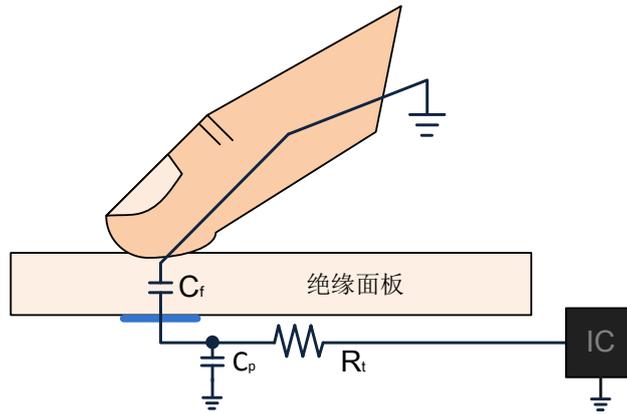


图3 电容式触摸按键原理

2、指纹识别芯片

电容式指纹识别芯片较普通电容触控芯片具有更高的分辨率和灵敏度，基本原理与电容触控芯片相似，通过检测每个极板与手指的耦合电容以得到检测数据。手指触摸传感器表面时（其原理如下图4所示），指纹脊和谷与检测电极表面的距离会有细微差异，当检测极板的尺寸小于指纹的脊或谷的宽度时，则每个极板与手指的耦合电容大小会随位置的不同而不同，脊下面的极板由于与手指距离更近，其耦合电容大于谷下面的极板，因此通过检测整个极板阵列的电容大小，即可得到指纹图像。

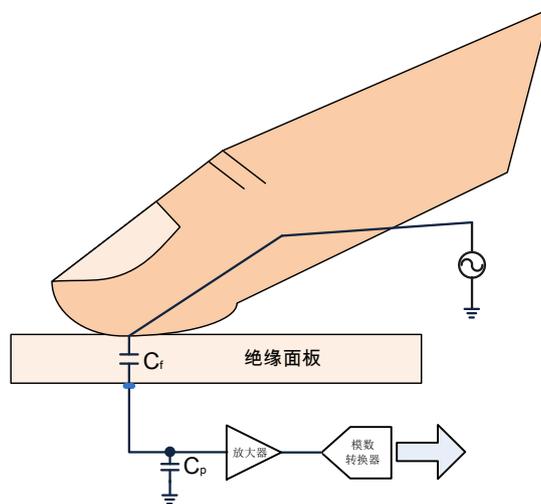
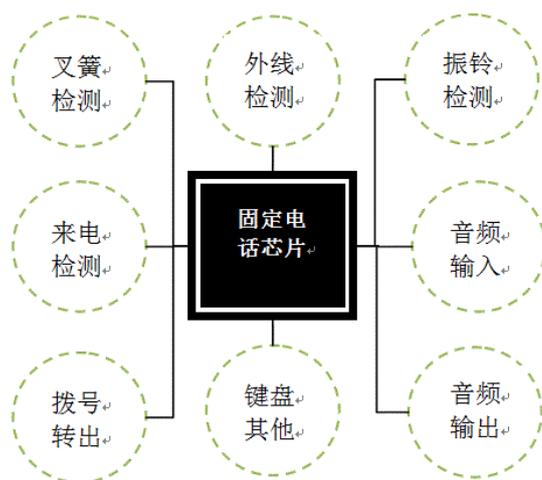


图4 指纹识别芯片原理

3、固定电话芯片

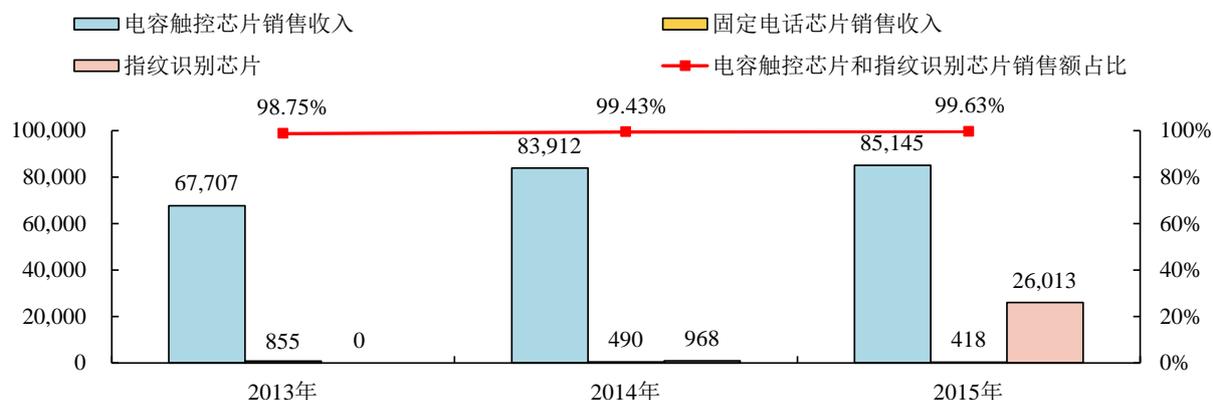
固定电话芯片是安装在固定电话中，通过接收、检测、反馈电流等微弱信号以实现来电显示、振铃检测、键盘扫描、拨号控制、铃声播放等人机交互的控制芯片，其主要功能如下图所示：



4、主要产品的变化情况

报告期内，公司一直从事智能人机交互技术的研究与开发。2006年，在前期固定电话芯片研发经验的基础上，公司研制出电容触摸按键芯片；2007年开始电容屏触控芯片的研发，并于2009年研发出工程样片，2010年实现了小批量生产和销售。随着2011年以来智能手机、平板电脑等智能终端市场的快速发展，公司电容屏触控芯片销售额迅速提升，固定电话芯片销售占比下降。2014年公司研制出指纹识别芯片产品并成功实现销售，进一步丰富了产品线。报告期内，公司主要产品的构成情况如下图所示：

单位：万元



数据来源：汇顶科技财务报告

公司电容屏触控芯片和指纹识别芯片各代产品系列、主要特点及量产时间如下表所示：

电容屏触控芯片	系列	主要特点	时间
第一代	GT80	该系列产品采用了0.35um工艺，具有超过80倍以上的信噪比；主要应用于手机和平板市场	2010年初

电容屏触控芯片	系列	主要特点	时间
第二代	GT8	该系列产品采用了 0.18um 工艺，具有超过 100 倍以上的信噪比，内置高压，增加了检测通道；主要应用于手机和平板市场	2012 年初
第三代	GT9	该系列产品采用了 0.11um 工艺，具有超过 120 倍以上的信噪比，具有全屏驱动的扫描模式，可支持主动式电容笔等，主要应用于手机、平板和超极本市场	2012 年末
第四代	GT9P	该系列产品采用了 0.11um 工艺，在 GT9 的基础上，增加了检测通道，支持自电容检测，进一步提升抗干扰性能，主要应用于手机市场	2014 年中
	GT9L	该系列产品采用 0.11um 工艺，在 GT9P 的基础上减少检测道，提升自容检测能力，进一步提升接近感应性能，主要应用于低端手机市场	2015 年中
指纹识别芯片	系列	主要特点	时间
第一代	GF9	该系列产品采用 0.35 工艺，支持 300 微米的蓝宝石盖板，主要应用于手机市场	2014 年中
第二代	GF11	该系列产品采用 0.35 工艺，最厚支持 300 微米玻璃盖板和额外两个按键检测，支持无 Ring 设计和 Finger flash 功能，适用于 Coating、玻璃、IFS 全系列，满足手机、平板市场要求	2015 年中
第三代	GF12	该系列产品采用 0.25 工艺，采用自互一体架构，在第二代产品基础上增加活体指纹识别和心率检测功能	2015 年末

二、发行人所处行业的基本情况

（一）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

1、行政主管部门及监管体制

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司所处行业为“C 制造业——C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，其主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，自律组织为中国半导体行业协会。

工信部主要负责拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；拟定行业法律、法规，发布行政规章；制定行业技术标准、政策等，并对行业发展进行整体宏观调控。

中国半导体行业协会的职能主要为贯彻落实政府有关政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；协助政府制（修）订

行业标准、国家标准及推荐标准，并推动标准的贯彻执行；经政府有关部门批准，在行业内开展评比、评选、表彰等活动等。

2、主要法律法规及产业政策、行业标准

2000 年至今，国家先后出台了一系列针对集成电路行业的法律法规和产业政策，规范了行业发展秩序，极大地推动了该行业的发展壮大。2000 年以来，有关集成电路行业的主要法律法规及政策如下表所示：

序号	时间	文件名称	有关本行业的主要内容
1	2015 年	《国家发展改革委关于实施新兴产业工程包的通知》（发改高技[2015]1303 号）	面向重大信息化应用、战略性新兴产业发展和国家信息安全保障等重大需求，着力提升先进工艺水平、设计业集中度和产业链配套能力，选择技术较为成熟、产业基础好，应用潜力广的领域，加快高性能集成电路产品产业化。通过工程实施，推动重点集成电路产品的产业化水平进一步提升，移动智能终端、网络通信、云计算、物联网、大数据等重点领域集成电路设计技术达到国际领先水平，设计业的产业集中度显著提升；32/28 纳米制造工艺实现规模量产，16/14 纳米工艺技术取得突破；产业链互动发展格局逐步形成，关键设备和材料在生产线上得到应用。培育出一批具有国际竞争力的集成电路龙头企业。
2	2014 年	《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》	通过研发资金，支持集成电路产业的技术创新和产品开发，鼓励培养、引进集成电路产业人才
3	2014 年	《国家集成电路产业发展推进纲要》	着力发展集成电路设计业。围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动制造业的发展。近期聚焦移动智能终端和网络通信领域，开发量大面广的移动智能终端芯片、数字电视芯片、网络通信芯片、智能穿戴设备芯片及操作系统，提升信息技术产业整体竞争力
4	2013 年	《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	依托国家科技计划（基金、专项）和重大工程，大力提升集成电路设计、制造工艺技术水平。支持地方探索发展集成电路的融资改革模式，利用现有财政资金渠道，鼓励和支持有条件的地方政府设立集成电路产业投资基金，引导社会资金投资集成电路产业，有效解决集成电路制造企业融资瓶颈
5	2012 年	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	将电子核心基础产业作为发展方向：围绕重点整机和战略领域需求，大力提升高性能集成电路产品自主开发能力，突破先进和特色芯片制造工艺技术，先进封装、测试技术以及关键设备、仪器、材料核心技术，加强新一代半导体材料和器件工艺技术研发，培育集成电路产业竞争新优势
6	2012 年	《集成电路产业“十二五”发展规划》	提出到“十二五”末，产业规模再翻一番以上等发展目标；要着力发展芯片设计业，开发高性能集

序号	时间	文件名称	有关本行业的主要内容
			成电路产品，培育 5-10 家销售收入超过 20 亿元的骨干设计企业，加大要素资源倾斜和政策扶持力度，打造一批“专、精、特、新”的中小企业等
7	2011 年	《国务院关于印发工业转型升级规划（2011-2015 年）的通知》（国发[2011]47 号）	提出到“十二五”末，集成电路产业规模占全球 15% 以上。着力发展集成电路设计业，持续提升先进和特色集成电路芯片生产技术和能力，突破高端通用芯片核心技术，开发面向网络通信、数字视听、计算机、信息安全、工业应用等领域的集成电路产品等
8	2011 年	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）	继续实施“国发 18 号文件”规定的财税、投融资等政策，进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业
9	2010 年	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32 号）	新一代信息技术被作为战略性新兴产业之一，提出要着力发展集成电路、新型显示、高端软件等核心基础产业
10	2009 年	《电子信息产业调整和振兴规划》	提出要完善集成电路产业体系。具体包括完善集成电路设计支撑服务体系，促进产业集聚；引导芯片设计企业与整机制造企业加强合作，依靠整机升级扩大国内有效需求；实现部分专用设备的产业化应用，形成较为先进完整的集成电路产业链
11	2008 年	《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（2008）》（财税[2008]1 号）	明确了鼓励软件产业和集成电路产业发展的优惠政策，集成电路设计企业视同软件企业，享受软件企业的有关企业所得税政策
12	2007 年	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》	将集成电路确定为当前应优先发展的高技术产业化重点领域
13	2006 年	《2006-2020 年国家信息化发展战略》	提出要加强政府引导，突破集成电路、软件、关键电子元器件等基础产业的发展瓶颈，提高在全球产业链中的地位
14	2005 年	《财政部、信息产业部、国家发展改革委关于印发〈集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法〉的通知》（财建[2005]132 号）	为鼓励集成电路企业加强研究与开发活动，国家设立集成电路产业研究与开发专项资金，研发资金由中央财政预算安排，专项用于支持集成电路产业研究与开发活动
15	2002 年	《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》（财税[2002]70 号）	出台了更多鼓励软件产业和集成电路产业的政策规定
16	2002 年	信息产业部、国家税务总局关于印发《集成电路设计企业及产品认定管理办法》的通知（信部联产[2002]86 号）	该办法规定了集成电路设计企业认定、集成电路产品认定的原则、条件、审批程序等，是为集成电路设计企业和集成电路产品享受国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》制定的审定办法和认定程序
17	2001 年	《集成电路布图设计保护条例》以及《集成电路布图设计保护条例实施细则》（国家知识产权局令 11 号）	国务院颁布的保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展的条例；实施细则是条例的配套规定

序号	时间	文件名称	有关本行业的主要内容
18	2000 年	《财政部国家、税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）	是（国发[2000]18号）的配套规定，具体规定了软件产业和集成电路产业的税收政策及税务管理

（二）行业发展情况

1、集成电路设计行业简介

集成电路作为信息产业的基础和核心，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。随着产业分工不断细化，集成电路行业可分为集成电路设计、制造、封装及测试等子行业。其中，集成电路设计处于产业链的上游，负责芯片的开发设计。

近年来，智能手机、平板电脑等消费类电子以及移动互联网、3G 通信、汽车电子、工业控制、仪器仪表、信息安全、医疗电子等市场快速发展，极大地带动了集成电路设计业的快速成长。据中国半导体行业协会统计，2014 年，国内集成电路设计业继续保持较快增长，行业销售额同比增长了 29.5%，规模达到 1,047.4 亿元。

2、电容屏触控芯片市场分析

（1）整体市场状况

近年来，随着电子设备操控性的提升和电子技术的发展，触摸屏技术在手机、平板电脑、PMP、导航仪等电子设备中的应用有了突飞猛进的发展，此外，触摸屏技术在教育、金融、工业控制等行业中的应用也发展迅速。在全球电容触摸屏市场需求不断释放的推动下，电容屏触控芯片市场火速升温。赛迪顾问的统计数据显示，2014 年全球电容屏触控芯片市场销量达 177,588 万颗，同比增长 13.20%，预计 2017 年的销售量将达到 226,801 万颗。

2008-2017年全球电容屏触控芯片市场规模及增长

单位：万颗



数据来源：CCID

中国是全球电子产品的制造基地，尤其是手机、平板电脑、MP3/MP4/PMP 等便携式电子产品产量较大。2008 年以来，随着 iPhone/iTouch 在手机和便携电子设备中的引领作用，电容屏触控芯片在下游应用市场的推动下实现了大幅增长。2010 年发布的 iPad 为电容触摸屏带来了新的应用市场，使电容屏触控芯片市场又迎来了新一轮的大幅增长。在下游应用市场的推动下，中国电容屏触控芯片市场表现出了巨大的增长潜力，预计 2017 年的销售量将达 99,838 万颗。

2008-2017 年中国电容屏触控芯片市场规模及增长

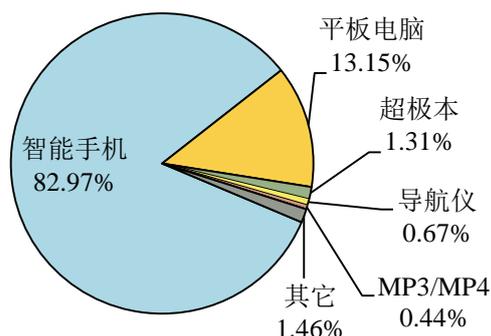
单位：万颗



数据来源：CCID

(2) 细分市场状况

电容屏触控芯片可应用于智能手机、平板电脑、MP3、MP4、PMP 和导航仪等领域，其中智能手机和平板电脑占据主要部分。以销售量为例，2014 年中国电容屏触控芯片市场应用结构中，智能手机和平板电脑二者合计占比 96.12%，如下图所示：



数据来源：CCID

智能手机和平板电脑两大细分领域的市场状况如下：

1) 智能手机用电容屏触控芯片的市场容量和发展前景

智能手机产量是影响手机电容屏触控芯片市场发展的关键因素。近年来，全球和中国范围内智能手机市场均迎来快速发展时期。

受智能手机整机市场的拉动，智能手机用电容屏触控芯片销量也实现了快速增长。赛迪顾问的统计数据显示，2014年，中国智能手机用电容屏触控芯片销量达到60,549万颗，同比增长27.17%，预计到2017年，销量将达到82,691万颗。

2008-2017年中国智能手机用电容屏触控芯片市场规模及增长

单位：万颗



数据来源：CCID

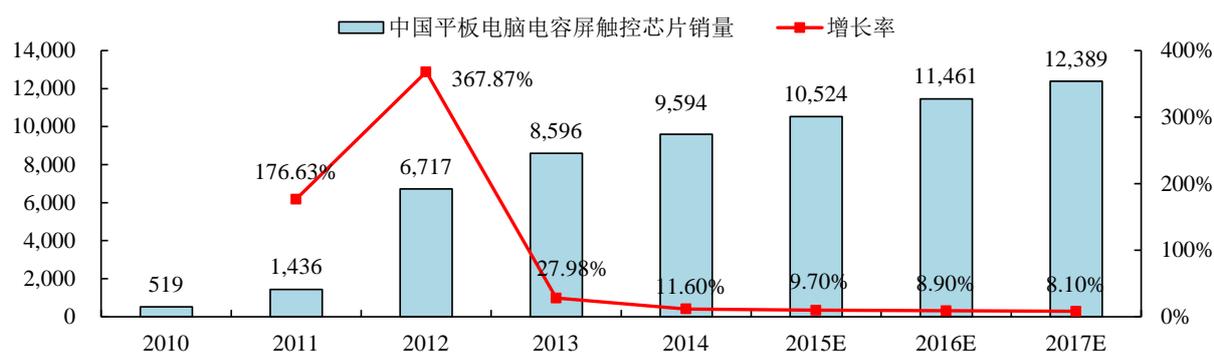
2) 平板电脑用电容屏触控芯片的市场容量和发展前景

苹果公司2010年成功发布平板电脑产品iPad，成为中国平板电脑发展的“助推剂”。赛迪顾问的统计数据显示，2014年中国平板电脑产量达8,165万台，同比增长25.81%。预计未来几年，中国平板电脑产量仍将保持较快增长。

平板电脑整机市场的爆发式增长也推动了平板电脑用电容屏触控芯片市场的飞速发展。2014年，中国平板电脑用电容屏触控芯片销量达到9,594万颗，同比增长11.60%。预计到2017年，销量将达到12,389万颗。

2010-2017年中国平板电脑用电容屏触控芯片市场规模及增长

单位：万颗



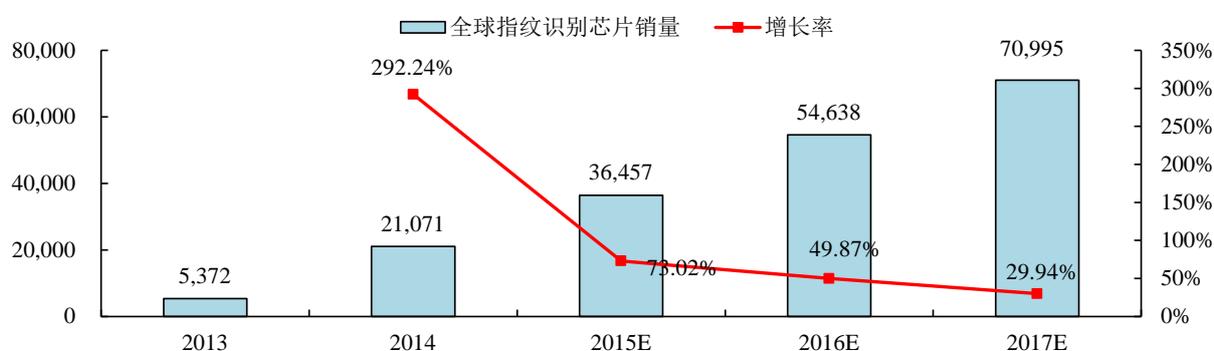
数据来源：CCID

3、指纹识别芯片市场分析

2013年9月，具备指纹识别功能的智能手机iPhone 5S的面市，迅速带动了指纹识别功能在智能手机领域的推广应用。随后三星、华为、HTC、魅族等主流智能手机厂商都逐步推出支持指纹识别功能的智能手机。2014年，全球智能终端指纹识别芯片的销售量达到21,071万颗，较2013年增长232.24%。预计到2017年，销量将达到70,995万颗。

2013-2017年全球指纹识别芯片市场规模及增长

单位：万颗



数据来源：CCID

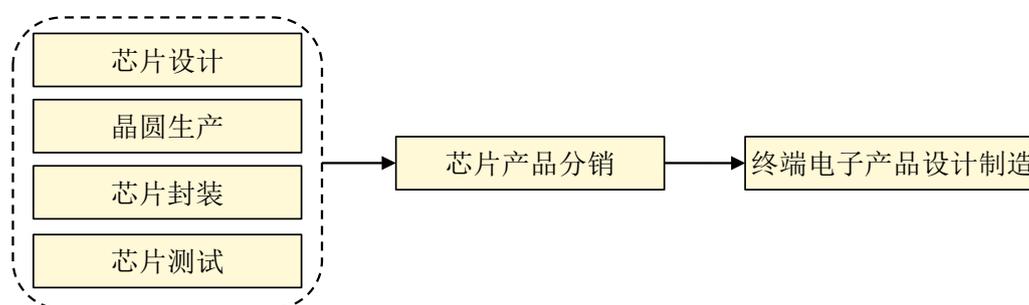
4、固定电话芯片市场分析

从 2003 年开始，全球移动电话用户总数开始超过固定电话用户总数，并以高于固定电话的增速增长。2007 年以后，市场由成长期转入成熟期。受下游市场影响，固定电话芯片市场亦步入成熟期。中国固定电话芯片市场发展状况与全球市场基本一致，已步入成熟期。

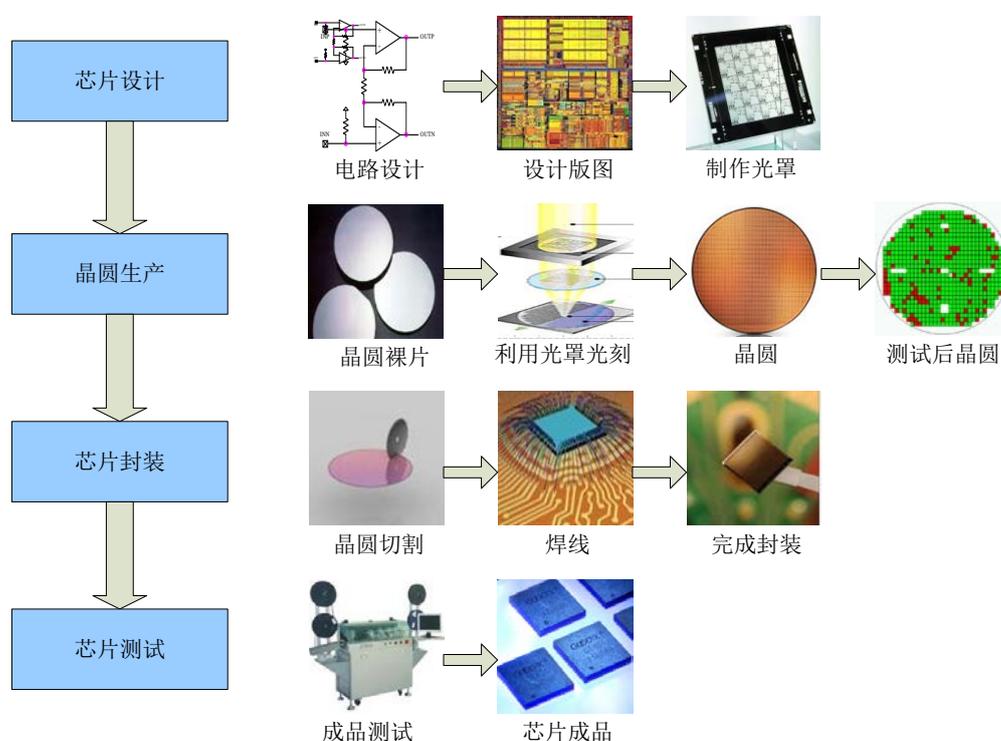
(三) 行业经营模式

1、集成电路行业产业链

集成电路产业链通常由芯片设计制造、芯片产品分销以及终端电子产品设计制造三个环节组成。



对芯片制造来说，需要经芯片设计、晶圆生产、芯片封装和芯片测试等环节，具体流程如下图所示：



对上述主要生产环节说明如下：

（1）芯片设计

芯片设计是芯片的研发过程，具体来说，是通过系统设计和电路设计，将设定的芯片规格形成设计版图的过程。设计版图是一款芯片产品的最初形态，决定了芯片的性能、功能和成本，因此在芯片的生产过程中处于至关重要的地位，是集成电路设计企业技术水平的体现。设计版图完成后进行光罩制作，形成模版，光罩成功则表明芯片设计成功，可以进入晶圆生产环节。

（2）晶圆生产

晶圆生产过程是利用晶圆裸片，将光罩上的电路图形信息大批量复制到晶圆裸片上，在晶圆裸片上形成电路的过程，即晶圆的量产。晶圆生产后通常要进行晶圆测试，检测晶圆的电路功能和性能，将不合格的晶粒标识出来。

（3）芯片封装

芯片封装是将生产出来的合格晶圆进行切割、焊线、塑封，使芯片电路与外部器件实现电气连接，并为芯片提供机械物理保护的工艺过程。针对指纹识别芯片的技术特点和要求，在此环节对指纹识别芯片需要进行晶圆级封装：晶圆级封装是对未切割的晶圆上每颗 IC 进行过孔、重布线、生成焊盘和植上可焊接锡球等动作，实现芯片 3D 堆叠或封装最小化。

（4）芯片测试

芯片测试是指利用集成电路设计企业提供的测试工具，对封装完毕的芯片进行功能和性能测试。测试合格后，即形成可供整机产品使用的芯片产品。

上述过程是芯片生产的一般流程，不同的集成电路设计企业，或者针对不同的芯片产品，在生产流程上可能存在一定差异。例如，在晶圆生产的良率有充分保障的情况下，集成电路设计企业出于成本的考虑，可以选择在晶圆生产环节后不进行晶圆测试；有的芯片需要在封装后写入软件程序，因此在程序烧录后再对整颗芯片进行测试。

2、集成电路行业的企业类型

集成电路行业经过多年发展，产业分工不断细化，目前已形成 Fabless、Foundry、封装和测试以及 IDM 等企业类型，各类型的特征及代表性企业如下：

(1) Fabless

Fabless 指的是无晶圆厂的集成电路设计企业，其主要从事集成电路的设计和銷售，而將晶圓制造、封装及测试环节通过委外方式进行。该模式下，集成电路设计企业可以专注于集成电路的研发，而不必投资大量资金建设晶圓生产线、封装测试工厂等。目前，全球绝大多数集成电路企业均为 Fabless 模式，包括美国高通、Synaptics（新突思）、和本公司等。

(2) Foundry

Foundry 指的是晶圓委外加工厂商，其自身不设计集成电路，而是受集成电路设计企业的委托，为其提供晶圓制造服务。由于晶圓生产线的投入很大，且工艺水平要求较高，这类企业一般具有较强的资金实力和工艺水平。采用此类模式的企业包括台积电、X-FAB、中芯国际等。

(3) 封装、测试企业

封装和测试企业负责晶圓生产出来后的封装和测试工作，本身不从事集成电路的设计，而是接受集成电路设计企业的委托，为其提供封装测试服务。该模式也要求较大的资金投入进行生产线的建设。采用此类模式的企业包括日月光、长电科技等。

(4) IDM

IDM 指的是垂直整合制造商，即涵盖了集成电路设计、晶圓制造、封装和测试所有环节的模式。该模式对技术和资金实力均具有很高的要求，为少数国际大型企业所采纳，如英特尔、三星、德州仪器等。

3、Fabless 的经营模式

目前，芯片设计在产业中已起到“龙头”作用，Fabless 经营模式主要一般为：组织研发人员进行芯片设计，形成设计版图；將版图交给晶圓委外加工厂商，委托其加工生产晶圓片；將加工好的晶圓片交给封装测试企业，委托其进行晶圓的切割、封装和测试，得到芯片成品；將芯片成品直接或通过经销商销售给方案商、模组厂或整机厂等下游客户。

与其他类型的企业相比，Fabless 的运营模式，有利于其提升新技术和新产品的开发速度，确保企业始终站在行业技术前沿，保持并扩大自身技术优势。该模式有效降低了大规模固定资产投资所带来的财务风险。同时，Fabless 能够根据市场行情及时调整产能，从而进一步提升生产运营的灵活性。

（四）行业竞争格局

1、行业的市场化程度

中国集成电路设计行业呈现高度市场化的特征。一方面，从事集成电路设计的国内企业数量众多，竞争较为激烈；另一方面，国外的众多 IC 设计企业纷纷涌入中国市场，其中不乏具有较强资金及技术实力的知名设计公司，进一步加剧了中国市场的竞争。

目前，在中国电容式触摸屏控制芯片市场上，欧美企业拥有技术优势，在系统噪声处理、灵敏度、稳定度、分辨率等方面有一定的技术积累，如 Atmel、Cypress、Synaptics 等，都具有较强的竞争实力。而随着近年来中国电容式触摸屏控制芯片市场的高速成长，各 IC 设计公司均加大了对电容式触摸屏控制芯片的研发投入，以期通过产品优势来占据更多的市场份额。中国电容式触摸屏控制芯片市场的前五大厂商在技术和市场上各具特点，如 Synaptics 在高端市场上具备一定的技术优势且在国际品牌的市场上具备较强的市场竞争优势，而本公司在单层多点等技术上具备较强的领先优势，同时在国内品牌市场上具备较强的竞争优势。

2、主要竞争企业

（1）电容屏触控芯片市场竞争格局

中国电容屏触控芯片市场集中度较高，除本公司外，主要由资金及研发实力雄厚的美国及台湾厂商主导，例如 Synaptics（新突思）、Atmel（爱特梅尔）、Cypress（赛普拉斯）、Focaltech（敦泰科技）、Mstar（晨星台湾）等。随着国内电容屏触控芯片企业的快速崛起，这一格局逐渐得到改观。

（2）指纹识别芯片市场竞争格局

目前，全球能提供指纹识别芯片产品的企业主要包括 AuthenTec、Validity、Fingerprint Cards、汇顶科技、思立微、敦泰科技、IDEX 等。其中，AuthenTec 于 2012 年被苹果收购，其指纹识别芯片产品全部用于苹果智能手机和平板电脑；Validity 于

2013年11月被 Synaptics 收购，其芯片目前主要应用在 HTC one max 和三星 Galaxy S5 等产品上。

(3) 固定电话芯片市场竞争格局

近几年，固定电话芯片市场渐趋饱和，技术标准亦日臻完善。全球固定电话芯片市场主要由几家中国企业主导，这些企业在固定电话芯片领域均具有较为丰富的经验，并在技术与成本控制方面具备各自的优势。公司为全球固定电话芯片主要厂商之一，产品销售量名列行业前列，其他主要竞争对手为深圳市天讯龙软件技术有限公司、金科龙软件科技（深圳）有限公司、深圳市大开实业发展有限公司、深圳市迅骏科技有限公司。

(五) 进入本行业的壁垒

1、技术实力壁垒

集成电路设计属于技术密集型行业，企业只有具备深厚的技术底蕴，才能在行业中立足。同时，由于集成电路技术及产品的更新速度很快，要求业内企业具备较强的持续创新能力，不断满足多变的市场需求。因此，行业内的后来者往往需要经历一段较长的技术摸索和积累时期，才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡。

2、人才壁垒

目前，国内集成电路设计行业，特别是在电容屏触控芯片领域的技术和管理人才仍较为稀缺。而富有技术创新力的技术人才和经验丰富的管理人才有利于行业内企业保持技术领先性，提升运营管理效率。同时，由于行业发展速度快，从业者需在专业公司内通过长期工作实践逐步学习成长，才能成长为具备丰富经验的高端人才。因此，该行业具有较高的人才壁垒。

3、资金实力壁垒

集成电路设计行业同时兼具资金密集型特征，主要表现在前期需要耗费大量资金用于技术研发和产品开发，以及行业研发人员工资水平较高，需要较多的人力成本投入。由于上述投入均是从事集成电路设计的经常性投入，新进入者不得不考虑自身资金实力是否能够维持高额的各项研发支出，因此也构成其进入该行业的壁垒之一。

4、产业化壁垒

虽然从产业链分工的角度看，集成电路设计企业仅负责芯片的设计开发，不从事芯片的生产制造，但是一款芯片产品要取得市场的认可，除了极为关键的设计开发外，还需要产业链其他环节的高度协同以及企业自身的良好运营，二者均要求集成电路设计企业具有强大的产业链整合能力，在产品市场定位、技术可行性、成功量产、外协加工、下游客户开拓、客户支持及自身运营等各方面均需具备良好的保障。然而，对于行业新进入者来说，积累上述各方面的经验，通常需要较长的时间。

（六）行业利润水平情况

集成电路设计行业的利润水平总体较为稳定，但单一产品的利润水平通常呈现先高后低的趋势。一般情况下，一款新的芯片产品推出时，价格较高，毛利率相应较高；随着量产规模扩大，产品成本逐渐降低，价格也相应下降，由于价格下降的速度通常快于成本下降的速度，因此毛利率逐渐下降；若市场出现有力的竞争产品，或者产品面临更新换代时，价格下降的速度将更为明显。

但是，对于具有较强技术创新能力的集成电路设计企业来说，其可以通过不断推出新产品以维持高于行业平均的利润水平。

（七）影响行业发展的有利与不利因素

1、有利因素

（1）集成电路行业的发展受到国家大力支持

作为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，集成电路行业历来受到国家的鼓励和支持。一方面，国家陆续出台了《集成电路设计企业及产品认定暂行管理办法》、《集成电路布图设计保护条例》、《集成电路布图设计保护条例实施细则》等法律法规，规范了行业的竞争秩序，加强了集成电路相关知识产权保护力度，为该行业的健康发展提供了法制保障。另一方面，自 2000 年 6 月《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》发布并实施以来，国家颁布了多项鼓励支持集成电路行业的产业政策及措施，例如《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（2008）》（财税[2008]1 号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）、《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》、《集成电路产业“十一五”专项规划》、《集成电路产业“十二五”发

展规划》及《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》等，为业内企业创造了有利的投融资、税收、出口环境。

（2）下游终端市场对芯片的需求巨大

集成电路设计行业的发展主要取决于下游终端市场的发展。近年来，智能手机、平板电脑等消费类电子以及移动互联网、4G 通信、汽车电子、工业控制、仪器仪表等市场的快速发展，尤其是智能手机和平板电脑市场的爆发式增长，催生出大量芯片需求，推动了芯片行业的巨大发展。据中国半导体行业协会统计，2014 年，国内集成电路设计业继续保持较快增长，行业销售额同比增长了 29.5%，规模达到 1,047.4 亿元。未来几年，下游智能手机、平板电脑两大终端市场仍将保持增长势头，超极本、车载电子等终端市场亦将迎来快速发展时期，对芯片的需求量将持续增长，从而为集成电路设计企业提供了难得的发展机遇。

2、不利因素

（1）集成电路设计行业基础仍较为薄弱

2000 年以来，我国集成电路设计行业虽然实现了快速发展，技术水平和产业规模都有所提升，但与美国、欧洲、韩国等发达国家市场相比，基础还较为薄弱。一方面，国内集成电路行业尚不如国外市场成熟，产业环境有待进一步完善，在基础性技术方面也容易受制于国外企业；另一方面，国内集成电路企业总体资金实力较弱，在新技术和新产品的研发上投入不足。

（2）集成电路产业人才较为缺乏

集成电路设计涉及硬件、软件、电路、工艺等多个方面，需要多个相关学科的专业人才，虽然国内集成电路设计行业已历经一段快速发展时期，但就目前及未来的发展需要而言，人才尤其是高端人才还是相对匮乏。随着越来越多的国内集成电路设计企业意识到产业人才的重要性，并开始在这一方面重点布局，这一现象有望逐步缓解。

（八）行业技术水平及特点

集成电路设计技术通常随着整机产品的技术升级而不断演进和提升，电容触控芯片的技术发展亦是如此。电容触控最早是自电容技术，如笔记本电脑触摸板。随后发展出

互电容技术，支持多点触控，从而满足了各类智能终端对多点触摸的需求，目前主流的电容触控技术即为互电容技术。

从芯片技术的角度，电容屏触控芯片的发展趋势是提升用户体验、提高产品的抗干扰能力以及降低系统成本。为此，需要通过提升 MCU 的运算能力，完善硬件加速技术，为提升用户体验奠定良好的基础；通过提升模拟电路的信噪比、加强 ESD 保护电路等措施，提高系统的抗干扰能力；通过提升芯片的高阻抗适应能力，使原有的电容式触控屏模组可以由双层 ITO 简化为单层 ITO，从而达到降低系统成本的目的。

此外，触控芯片 COB 方案也成为一种重要应用方式。通过将电容触控芯片置于主板之上，可大幅降低模组成本，从而实现整机成本的降低。但在该方案下，由于电容触控芯片处于主板上，芯片的运行环境更为复杂，要求芯片具有较强的抗干扰能力，对集成电路设计企业提出了更高的技术要求。

（九）行业的周期性、区域性和季节性

集成电路设计行业自身的周期性并不明显，主要受宏观经济形势及下游市场需求因素影响。同时，亦不存在明显的季节性，但对于消费类电子产品芯片而言，由于节假日产品销量较多，因此在节前的芯片出货量一般较高。

目前，国内集成电路产业较为发达的地区主要为长三角地区、珠三角地区和京津环渤海地区，上述地区拥有较多的集成电路设计企业以及产业链其他环节的各类企业。国内电容屏触控芯片厂商也主要分布在深圳、上海等沿海地区。

（十）本行业的上下游关系

集成电路产业链的上游为集成电路设计、晶圆制造、封装和测试，下游为方案商、模组厂、整机厂商等客户。晶圆委外加工厂商和封装测试厂的工艺水平、生产管理水平和产能对芯片的良率和交货周期影响较大，而下游客户的需求特征和数量则直接决定集成电路设计企业芯片产品的销售效果。

三、发行人的竞争地位

（一）公司行业地位

本公司致力于智能人机交互技术的研究与开发，并通过卓越的科研技术、优质的产品，逐渐发展成为中国电容屏触控芯片和指纹识别芯片两大市场的主要竞争者，在业内树立起较强的品牌影响力。公司是科技部火炬高技术产业开发中心认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局认定的“高新技术企业”，工业和信息化部软件与集成电路促进中心认定的“2013年度第八届‘中国芯’最具投资价值企业”，中国半导体协会认定的“2012年中国最具成长性集成电路设计企业”；公司的电容屏触控芯片产品 GT915 被工业和信息化部软件与集成电路促进中心评为“2013年度第八届‘中国芯’最佳市场表现产品”；公司的电容屏触控芯片产品 GT968 被工业和信息化部软件与集成电路促进中心评为“2014年度第九届‘中国芯’最佳市场表现产品”；公司的指纹识别芯片产品 GF5118M 被工业和信息化部软件与集成电路促进中心评为“2015年度第十届‘中国芯’最具潜质产品”；公司拥有自主知识产权的 IFS 和 Goodix Link 技术斩获 2016 国际消费电子展（CES）两项嵌入式技术大奖。

在电容屏触控芯片领域，按 2014 年电容屏触控芯片产品的出货量统计，本公司是中国电容屏触控芯片市场前五大厂商中唯一一家国内企业，赛迪顾问的统计数据显示，2014 年公司电容屏触控芯片产品的出货量约占中国市场销售量的 28.23%，市场排名第二，其他企业分别是 Focaltech（敦泰科技）、Mstar（晨星台湾）、Synaptics（新突思）和 Cypress（赛普拉斯），均为美国和台湾企业。

在指纹识别芯片领域，公司为全球第一家发布 IFS 技术（Invisible Fingerprint Sensor，隐藏于触控面板下面的指纹识别技术）和样片的厂商。2014 年 5 月，公司推出指纹识别芯片产品并迅速实现量产，该产品搭载于魅族推出的 MX4 Pro 手机。

在固定电话芯片领域，赛迪顾问的统计数据显示，本公司产品销售量名列行业前茅，为全球固定电话芯片主要供应商之一，其他主要竞争对手为深圳市天讯龙软件技术有限公司、金科龙软件科技（深圳）有限公司、深圳市大开实业发展有限公司、深圳市迅骏科技有限公司。

（二）主要产品竞争对手情况

1、Synaptics（新突思）

Synaptics（新突思）成立于1986年，纳斯达克上市公司（股票代码：SYNA），总部位于美国加利福尼亚州。该公司是一家全球知名的移动计算、通信和娱乐设备人机界面交互解决方案开发商。

2、Fingerprint Cards AB（FPC）

Fingerprint Cards AB（FPC）为纳斯达克上市公司（股票代码：FINGB），总部位于瑞典哥德堡。该公司致力于开发、生产和销售生物识别技术和传感器、芯片等产品，帮助用户通过分析和比对个人独特的指纹确认身份。

3、FocalTech（敦泰科技）

FocalTech（敦泰科技）于2006年在美国注册成立，专注于电容屏触控芯片和TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）显示驱动芯片的设计研发、制造及销售。

4、Atmel（爱特梅尔）

Atmel（爱特梅尔）成立于1984年，纳斯达克上市公司（股票代码：ATML），总部位于美国加利福尼亚州。该公司致力于设计和制造各类微控制器、电容式触摸解决方案、先进逻辑、混合信号、非易失性存储器和射频元件。

5、Cypress（赛普拉斯）

Cypress（赛普拉斯）成立于1982年，纳斯达克上市公司（股票代码：CY），总部位于美国加利福尼亚州。该公司提供各种高性能、混合信号、可编程芯片解决方案，可为消费、移动电话、计算、数据通信、汽车、工业和军事等多种市场提供服务。

（三）公司竞争优势

本公司在以下六个方面具有较强的竞争优势：

1、拥有卓越的研发能力和突出的技术优势，较早实现多项行业领先技术产品的量产

本公司的芯片产品具备较强的技术领先优势。公司为高新技术企业，依靠持续的研发和积累，现已取得专利 82 项（其中发明专利 30 项）、软件著作权 73 项，在电容屏触控芯片及指纹识别芯片领域形成了具备自主知识产权的核心技术：

（1）公司于 2011 年实现 10 点触控芯片的量产，并在坐标刷新率、点精度、线性度、触摸屏阻抗适应能力等关键技术指标上具有突出表现，提升了客户整机的技术水平。

（2）公司的芯片产品于 2011 年实现了在触摸屏上支持去除屏蔽层，协助减少了贴合、涂胶、绑定三道触摸屏生产工艺，极大降低触摸屏成本；而后分别于 2012 年和 2013 年实现智能手机及平板电脑用单层多点触控芯片的量产，使得触摸屏生产工艺进一步简化，帮助客户继续降低触摸屏成本。

（3）公司于 2010 年实现了将触控芯片放置在整机主板上的新型设计方式（COB），极大简化了整机设计流程，开发周期和触摸屏交付时间平均缩短各一周；此外，本公司的触控芯片产品在抗 TFT 显示器干扰、电磁干扰、水膜干扰、共模干扰和悬浮干扰等方面表现优异。

（4）公司在 2013 年推出通过电容屏实现近距离通信的触控芯片，帮助智能手机，平板电脑之间实现新的数据交换方式及产生更多新颖应用功能，提升了公司触控产品的市场竞争力。

（5）公司于 2014 年推出了指纹传感器技术、指纹匹配算法两项核心技术，并利用这两项技术研发出业内领先的指纹芯片产品，主要应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等产品。这两项技术将成为智能终端数据安全、保密的重要保障手段，拥有较为广阔的市场前景，从而进一步提升了公司产品的技术领先性。

在固定电话芯片领域，本公司的芯片产品具有较强的来电信号解码能力，同时实现了多制式兼容，并较早在业界实现了符合国家和国际标准的高效取电技术。

2、国内领先的行业地位和丰富的客户资源优势

公司致力于智能人机交互技术的研究与开发，现为国内电容屏触控芯片、指纹识别芯片和固定电话芯片两大市场的主要竞争者。根据 2014 年电容屏触控芯片产品的出货量统计，公司为中国电容屏触控芯片市场前五大厂商中唯一一家国内企业，2014 年公

司电容屏触控芯片产品的出货量约占中国市场销售量的 28.23%，市场排名第二；同时，公司也是全球指纹识别芯片和固定电话芯片主要供应商之一。

依靠卓越的科研能力和优质的产品，公司获得了良好的行业品牌认知度，具有明显的品牌效应，也树立起了国内领先的行业地位。公司产品现已覆盖国内外多家智能终端整机厂商，通过直销和经销等渠道，公司陆续成为三星、中兴、华为、酷派、联想、魅族、维沃等国内领先智能终端品牌的原厂供应商。另外，报告期内，集成电路行业内的知名经销商，例如品佳电子有限公司、上乘电子科技股份有限公司等企业，成为公司的经销商，该等经销商销售网络完善、下游客户众多、市场影响力较大；公司通过与其合作，共同开发了多家优质下游客户，积累了模组厂、方案商或整机厂等广泛的客户群体。具有市场影响力的终端客户及丰富的客户群体进一步提高了公司的品牌知名度，公司产品和服务的推出、升级、更新换代能被市场快速接受，具有突出的客户资源优势。

3、完善的技术支持和服务体系

IC 设计公司对下游客户的技术支持对芯片功能的最终实现、整机产品质量以及客户的生产成本和开发生产周期具有重大影响。

作为本土芯片企业，本公司除提供芯片产品外，还致力于向下游客户提供高效、完善的技术支持和周到快捷的客户服务。本公司不仅与同行业的其他设计公司一样，关注售前、售中、售后的技术支持，同时通过首创和领先的电容屏综合测试系统、触摸屏参数自动配置工具、传感器自动设计工具、调试工具、量产工具等自动化的设计、调试、生产、测试工具来缩短客户的设计、调试以及生产、测试时间，并通过这些自动化的工具降低了差错率；同时人性化、简单易学的各类自动化工具也使客户的设计、调试、生产、测试工程师对本公司的产品更加熟悉，使客户在选型时更加愿意选择非常熟悉的本公司产品。

4、全面的质量管理体系和快速交付能力

整机客户尤其是知名品牌厂商，对芯片的质量和可靠性具有极其严格的要求。公司按照 ISO9001 质量控制标准，与外协加工厂商密切合作，制定并实施了一整套从晶圆制造到封装测试及成品系统测试的专业质量控制流程，确保所销售芯片产品的高品质和优良率，保障客户量产的顺利进行。

针对消费电子产品生命周期较短，产品更新换代速度快的特点，公司在芯片研发阶段实行为生产而设计（DFM，Design for Manufacturing）和为测试而设计（DFT，Design for Testing），缩短了芯片产品的验证周期；同时，基于多代芯片产品的开发上市经验，公司的研发、生产运营、技术支持等部门已建立高效的协作机制，加快了新产品设计、验证、试生产、小批量生产、大批量生产的进程；公司还建立了全面的生产计划管理流程，实现了销售预测、委外生产、成品发货的高效运转，极大缩短了芯片产品的交付周期。综合上述因素，公司具备快速交付芯片产品的能力，从而帮助下游客户产品快速上市、抢占市场先机。

5、专业而稳定的研发团队

本公司高度重视研发团队的建设，投入大量人力物力，组建由各种专业人才组成的研发团队。公司大部分核心技术人员自公司设立以来就在公司任职，在智能人机交互技术和芯片设计领域积淀了丰富的研发经验。此外，公司还积极引进国内外高端技术人才，提升公司的研发实力。对新入职的员工，公司采用业务或专业领域轮岗、项目实践、继续教育、职业培训、参加国际展会等多种方式进行人才继续培养，不断提升研发团队的专业能力，将一大批员工培养成各自专业领域的技术骨干。同时，公司通过提供行业内具有竞争力的薪酬以及员工持股计划对研发团队进行激励，极大地提高了研发团队的归属感和积极性。截至 2015 年末，公司研发人员达到 544 人，占员工总人数的 82.55%。专业、稳定的研发团队构成本公司近年来业绩快速发展的基础。

6、优异的行业管理经验，使公司具备了较强的市场竞争力和盈利能力

公司具有优秀精干的管理团队，团队成员长期致力于智能人机交互技术的研究与开发，在业务技术方面具有较深造诣，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据市场情况推陈出新，不断将新产品、新技术推向市场。同时，公司管理层在市场开拓和经营管理方面也具有丰富的经验。公司针对集成电路行业特点，不断探索优化技术开发模式、经营组织方式，建立了完善研发、生产和采购、销售等业务体系，保障了公司对市场的快速有效反应能力，提高了经营效率。借助前述优异的行业管理经验，使公司具备较强的市场竞争力和盈利能力。2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司营业收入分别为 568,562.09 万元、85,369.36 万元和 111,575.99 万元，同期

综合毛利率分别为 65.79%、65.53% 和 57.86%，最近三年公司业务规模显著提升，盈利水平稳定。

（四）公司竞争劣势

1、资金实力不足

虽然本公司近两年取得了快速发展，业务规模进一步扩大，但由于身处集成电路设计行业，技术和产品不断升级换代，要求本公司持续投入大量资金，进行前沿技术、创新产品的研发，以维持公司的可持续发展，而仅通过公司自身经营积累难以满足未来快速扩张的资金需求。因此，公司需要拓宽融资渠道，为未来发展储备充足的资金。

2、高端人才不足

虽然本公司研发团队能够适应目前业务的需要，但从募集资金投资项目的实施以及未来长远发展的角度来看，本公司仍然面临人才不足的困境，尤其是高端人才较为匮乏。因此，对本公司而言，能否引进、培养和储备足够多的优秀人才，是影响未来发展的关键因素之一。

3、与欧美知名集成电路设计公司相比，公司品牌影响力仍存在差距

与欧美知名集成电路设计公司相比，公司品牌的影响力和知名度仍有一定差距。如何进一步提高品牌国际影响力，是本公司扩大市场占有率和进军国际市场的关键。

四、主营业务情况

（一）主要产品及用途

公司主要产品及其用途参见本节“一、公司主营业务和主要产品”之“（二）发行人主要产品及变化情况”。

（二）主要产品工艺流程

1、电容触控芯片的工艺流程

对于电容屏触控芯片，本公司设计好芯片版图后，向晶圆委外加工厂商采购定制加工生产的晶圆，委托封装厂对加工好的晶圆进行封装，最后委托测试烧录厂在封装好的

芯片上进行软件程序的烧录并完成芯片测试。具体流程参见本节“二、发行人所处行业的基本情况”之“（三）行业经营模式”。

对于电容触摸按键芯片，由本公司制定芯片的规格参数、完成系统设计和验证后，向芯片空片供应商采购空片，并将本公司自主设计的软件程序写入空片，生产出最终的芯片成品。

2、指纹识别芯片的工艺流程

对于指纹识别芯片，本公司设计好芯片版图后，向晶圆委外加工厂商采购定制加工生产的晶圆，委托封装厂对加工好的晶圆进行封装，最后委托测试烧录厂在封装好的芯片上进行软件程序的烧录并完成芯片测试，由于指纹识别芯片种类的不同，部分指纹识别芯片不需要烧录和测试环节。具体流程参见本节“二、发行人所处行业的基本情况”之“（三）行业经营模式”。

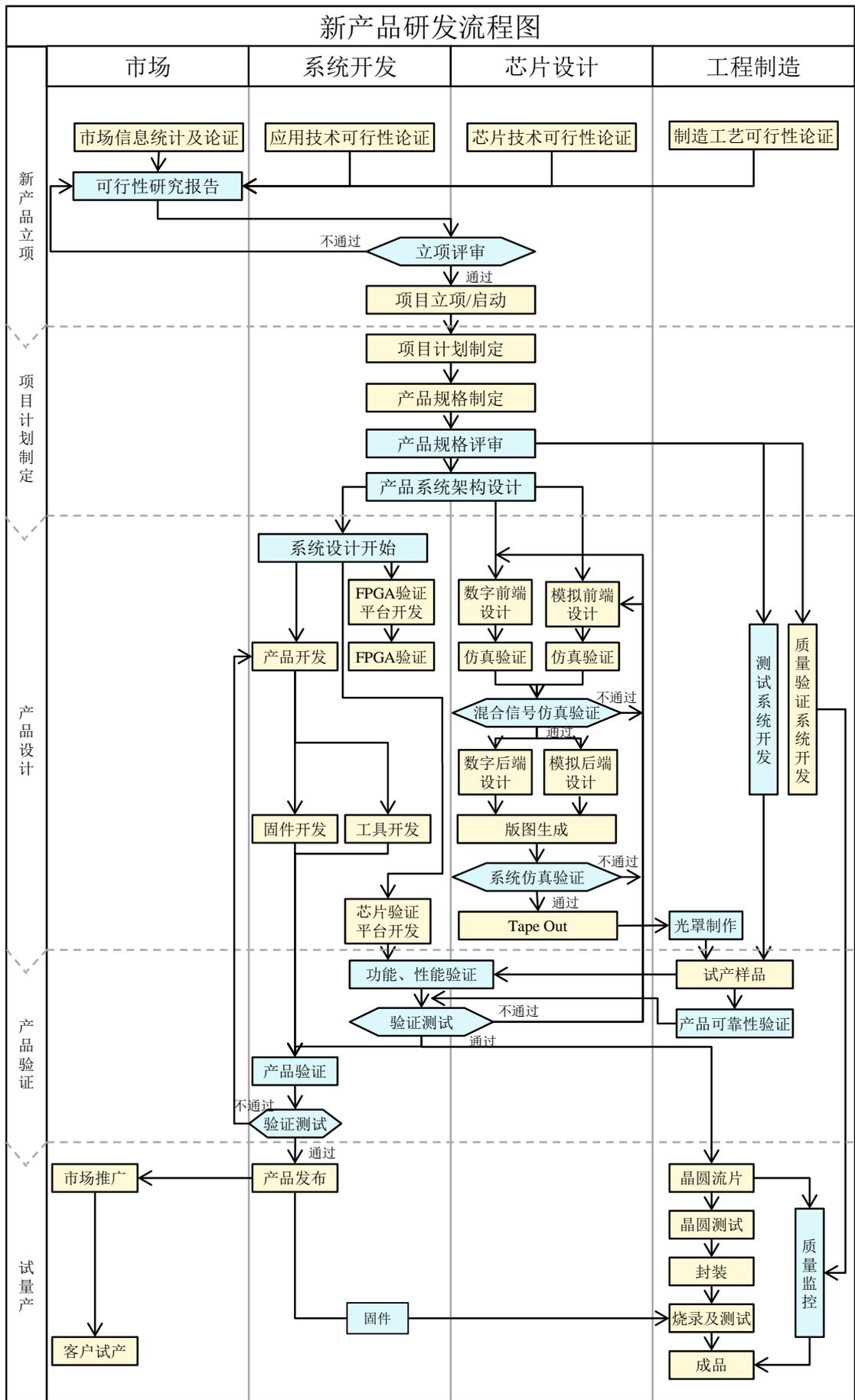
3、固定电话芯片的工艺流程

固定电话芯片由本公司制定芯片的规格参数，完成系统设计和性能指标验证后，向芯片空片供应商采购芯片，并委托供应商将本公司设计的软件程序写入空片，供应商将烧录完毕的芯片成品交付本公司。

（三）经营模式

1、研发模式

本公司新产品的研发历经项目立项、项目计划制定、开发设计、产品验证和试量产几个阶段，具体流程如下图所示：



对上述主要研发流程说明如下：

(1) 项目立项

产品经理根据新技术发展趋势、市场信息、客户需求等信息，形成新产品构思，如初步判断技术可行，则向项目审核委员会提交《项目需求书》。项目需求提交人在项目正式成立前，应从技术、资源需求、时间、市场风险、客户风险、收益风险、对生产的影响、财务等多方面进行分析，并形成《NPI 评估审核表》。项目需求提交人将《NPI 评估审核表》和《项目需求书》提交项目审核委员会审核，审核通过则项目正式立项。

(2) 项目计划制定

项目计划包括产品规格、总体方案的制定。项目经理根据《项目需求书》、资源条件、技术难度等因素在项目组内讨论并制定《项目计划书》，计划书通常包括软硬件开发进度、产品规格书、文档、资源需求、里程碑、检查点、设计验证等。项目计划制定后，项目经理对方案的可行性和不确定性做出评估，组织产品经理、芯片开发负责人、应用设计负责人及相关技术人员进行总体方案评审。项目组根据评审意见修改整体方案，再提交评审，通过后即进入研发设计阶段。

(3) 产品设计

产品设计是具体落实前期制定的项目计划及总体方案，实现所定规格的过程。项目组根据项目计划安排研发进度，当项目进程达到某个里程碑时，不同类型的项目会因目的不同而进入不同的流程。在开发设计的过程中，项目组根据计划安排进行阶段验证。产品型项目因完成后会投入生产，所以当到达里程碑时需要进行设计验证，以确保产品达到设计标准和预期要求。研究型项目完成后只用于演示或评估用途，一般不进行设计验证。

(4) 产品验证

产品验证是一系列产品测试的过程。项目经理在测试节点前提出测试申请。提交测试前，研发人员需进行自测，并提供自测报告。测试人员进行性能测试和功能测试完成后，将《测试报告》提交给项目组。如验证不通过，项目组需进行设计修改，进入下轮测试，直至通过。最后，项目经理召集项目需求提交人、项目组、研发副总经理、产品

支持副总经理、软件开发总监、生产运营部负责人及相关技术人员进行设计评审和确认。通过设计评审的项目进入产品发布流程，未通过的项目重回设计流程。

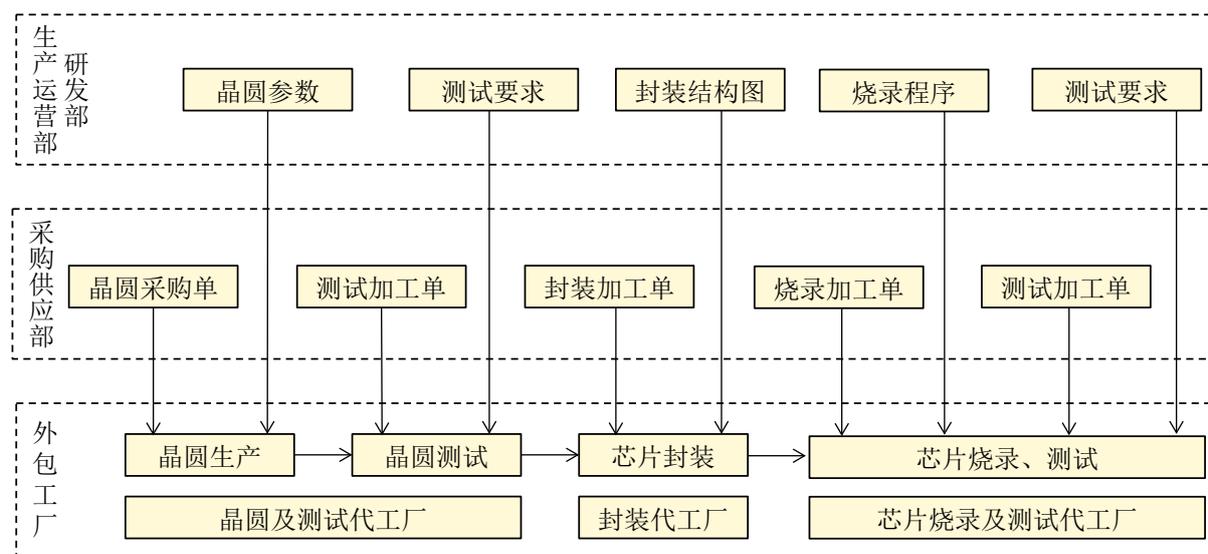
(5) 试量产

试量产是产品正式量产前的试生产阶段。试量产发现产品缺陷，根据问题的具体情况进行芯片设计改版，重回产品设计阶段。试量产无问题后即开始量产。

2、生产和采购模式

对于电容屏触控芯片和指纹识别芯片，本公司设计好芯片版图后，向晶圆委外加工厂商采购定制加工生产的晶圆，委托封装厂对加工好的晶圆进行切割、封装，委托测试烧录厂将本公司自主设计的软件写入已封装芯片并完成测试。报告期内，对于指纹识别芯片产品，根据少数整机厂对产品交付方式的临时需求，在完成指纹识别芯片的烧录和测试后，公司委托模组厂商组装生产包含指纹识别芯片的模组，由公司将模组交付客户。对于电容触摸按键芯片，由本公司制定芯片的规格参数、完成系统设计和验证后，向芯片空片供应商采购空片，并将本公司自主设计的软件程序写入空片，生产出最终的芯片成品。固定电话芯片由本公司制定芯片的规格参数，完成系统设计和性能指标验证后，向芯片空片供应商采购芯片，并委托供应商将本公司设计的软件程序写入空片，供应商将烧录完毕的芯片成品交付本公司。

公司日常经营的生产、采购活动主要由研发部、生产运营部和采购供应部共同负责，公司的生产采购流程如下图所示：



上述生产和采购模式涉及较多的委外加工过程，为控制委外加工风险，本公司制定了《采购控制及外包管理程序》、《外包方管理程序》、《物流服务提供商管理办法》等管理制度，并在与受托厂商的业务往来中通过各种措施降低风险，具体包括：

（1）委外供应商的选择及管理

针对委外供应商，本公司制定了《采购控制及外包管理程序》和《外包方管理程序》，前者适用于晶圆和芯片供应商的选择和管理，后者适用于封装厂和测试烧录厂的选择和管理。

根据上述内部规程，公司实行合格供方登录制度，经审批合格的供应商登录在《合格供方名录》中，作为选择采购方的依据。在选择封装厂和测试烧录厂时，公司根据芯片封装或烧录的技术要求以及对方的合作意向，收集厂家资料，发出《供方调查表》，对其制程控制和品质控制进行现场评鉴。初步达成合作意向后，公司组织进行小批量试产，试产合格后，将其列入《合格供方名录》。

公司对供应商进行年度考核制度，考核内容包括产品质量、交货时间、支持服务等。对考核不合格的供应商，公司解除其合格供应商资格，并将其从《合格供方名录》中去除。

（2）委外质量控制措施

公司与合格供应商签订有关协议，详细约定采购产品名称、加工方式、价格、交货期、加工工艺要求、物料要求、检验要求、合理损耗、包装要求、标识要求、交货/付款方式、运输方式、违约责任、不合格品处理、争议解决方式等事项，形成对供应商的约束，使其在各个环节均确保本公司产品的质量。

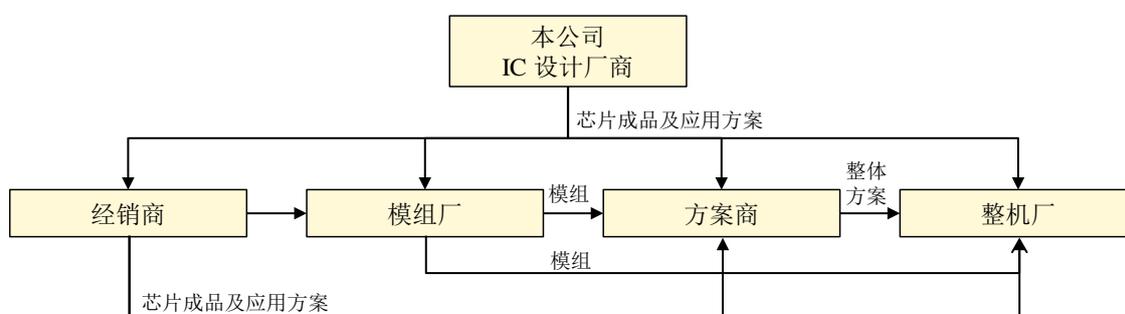
同时，根据《采购控制及外包管理程序》、《外包方管理程序》以及《生产控制流程》等制度文件的规定，本公司采购供应部负责晶圆或芯片采购，生产运营部和采购供应部共同负责芯片封装及测试等业务环节，依照操作流程，严格把控每一环节的完成质量。公司还根据具体情况，在部分供应商处派驻现场工程师，对委外加工过程进行指导和监督。

（3）委外技术保密措施

本公司历来重视自身核心技术的保密工作。公司委外生产过程中可能涉及技术泄密的环节主要为晶圆代工和软件烧录。为此，本公司在委外加工时实施了技术加密措施，并与相关厂商就委托加工过程中的技术保密事宜加以约定，防止可能存在的泄密风险。

3、销售模式

本公司电容屏触控芯片、指纹识别芯片采用直销和经销两种模式，为下游方案商、模组厂和整机厂等终端客户提供包括芯片产品及技术支持。在直销模式下，模组厂、方案商或整机厂直接向本公司下订单；在经销模式下，本公司与经销商之间属于买断式销售，经销商向本公司采购芯片，并向其下游客户销售芯片。报告期内，对于指纹识别芯片产品，根据整机厂对产品交付方式的临时需求，公司以模组形式交付产品。具体如下图所示：



本公司的电容触摸按键芯片和固定电话芯片主要采取直销模式，由整机厂或方案商向本公司下订单，本公司根据订单发出芯片。

报告期内，公司产品直销和经销的金额和比例如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直销	46,204.72	58.59%	28,575.05	33.47%	29,875.71	43.57%
经销	65,376.63	41.41%	56,794.31	66.53%	38,686.38	56.43%
合计	111,581.35	100%	85,369.36	100.00%	68,562.09	100.00%

2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司产品在经销模式下的销售额占比分别为 56.43%、66.53% 和 41.41%，经销模式为公司目前重要的销售渠道之一，其主要原因是：

(1) 2013 年度、2014 年度和 2015 年度公司的电容屏触控芯片和指纹识别芯片的销售额占比分别为 98.75%、99.42%和 99.62%，是公司报告期内收入贡献最大的产品，而经销商销售是电容屏触控芯片、指纹识别芯片重要的销售渠道；

(2) 公司下游经销商经过多年的积累，具备较为丰富的客户资源，如模组厂、方案商和整机厂等，经销商就公司的电容屏触控芯片产品向其下游客户进行了有效的市场推广；

(3) 品佳电子有限公司、上乘电子科技股份有限公司、恒智科技股份有限公司/亿莱科技（深圳）有限公司、深圳市海威思科技有限公司/德思达（香港）有限公司等行业知名经销商开始成为公司的主要客户，该等客户销售网络完善、下游客户众多，因此公司对其销售额也较大。

经销模式有效的分担了业务规模快速扩大给公司销售、技术支持和管理等方面带来的成本压力。公司利用经销商的客户资源，进一步开拓新客户及产品市场，降低了对新客户进行考察、对客户进行日常管理以及售后技术支持服务的成本，在扩大业务规模的同时提高了公司的运作效率和市场响应速度。公司对主要经销商的管控模式具体如下：

公司成立了独立的销售部门，针对经销商客户制定了相关管理制度，对销售环节及经销商进行集中管理：公司首先会根据经销商的下游客户资源、技术服务能力等因素对经销商进行综合评价，在确定合作意向后，签订框架合作协议，除大联大商贸（深圳）有限公司和上乘电子科技股份有限公司（含其关联方）外，公司与其他主要经销商均在框架合作协议中约定在同类产品中，经销商只能代理销售由公司设计生产的触控芯片产品；签订框架合作协议后，经销商根据市场需求向公司发送产品订单，在价格方面，公司对经销商实行统一的销售价格政策，对经销商向其下游客户的销售提供指导售价；在售后服务方面，一般情况下由经销商负责对终端厂商进行技术支持服务，针对特别重大的技术问题，由公司和经销商共同派出技术团队提供技术支持服务。

直销模式则主要针对业内市场排名较为靠前的客户，如魅族科技（中国）有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司、东莞金卓通信科技有限公司、东莞市金铭电子有限公司等，公司通过直接服务业内重大客户来确保产品推广的直接、有效，提高服务效率，并

且能够及时获得公司产品技术改进和创新的最新市场信息，有利于不断创造和推出更优质产品。

公司的销售模式有效保证了下游客户能够及时获得优质触控芯片产品和售后技术支持服务。

（四）主要产品产销情况

1、主要产品产量和产销率

报告期内，公司主要产品产量、销量情况如下表所示：

产品类别	2015 年度		
	产量（万颗）	销量（万颗）	产销率
电容触控芯片	23,826.05	23,679.69	99.39%
固定电话芯片	397.26	412.23	103.77%
指纹识别芯片	1,286.92	1,142.47	88.78%
合计	25,510.23	25,234.39	98.92%
产品类别	2014 年度		
	产量（万颗）	销量（万颗）	产销率
电容触控芯片	21,394.16	20,751.50	97.00%
固定电话芯片	478.41	543.93	113.70%
指纹识别芯片	36.45	15.84	43.46%
合计	21,909.02	21,311.27	97.27%
产品类别	2013 年度		
	产量（万颗）	销量（万颗）	产销率
电容触控芯片	14,370.70	13,677.99	95.18%
固定电话芯片	896.95	937.80	104.55%
合计	15,267.65	14,615.79	95.73%

2、主要产品的销售收入

报告期内，公司主要产品销售收入分产品分类情况和按地区分类情况参见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”之“（一）营业收入构成及变动分析”。

3、报告期内公司前五名客户销售情况

报告期内，公司前五名客户的销售情况如下表所示：

单位：万元

2015 年度			
序号	客户名称	金额	占营业收入比例
1	深圳市海威思科技有限公司、德思达（香港）有限公司	19,847.56	17.79%
2	南昌欧菲光科技有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司、南昌欧菲显示科技有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司	14,926.71	13.38%
3	香港弘泰电子技术有限公司、厦门弘汉智能科技有限公司	11,447.87	10.26%
4	恒智科技股份有限公司、亿莱科技（深圳）有限公司	10,936.92	9.80%
5	德沃尔半导体（香港）有限公司、深圳市德沃尔实业有限公司	9,462.64	8.48%
合计		66,621.70	59.71%
2014 年度			
序号	客户名称	金额	占营业收入比例
1	南昌欧菲光科技有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司	11,981.55	14.03%
2	德沃尔半导体（香港）有限公司、深圳市德沃尔实业有限公司	11,787.88	13.81%
3	深圳市海威思科技有限公司、德思达（香港）有限公司	9,541.52	11.18%
4	香港和式有限公司、深圳市华信科科技有限公司、科通无线科技（香港）有限公司	8,458.66	9.91%
5	恒智科技股份有限公司、亿莱科技（深圳）有限公司	7,813.31	9.15%
合计		49,582.92	58.08%
2013 年度			
序号	客户名称	金额	占营业收入比例
1	南昌欧菲光科技有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司	9,669.60	14.10%
2	堃昶股份有限公司、堃昶国际贸易（上海）有限公司	7,103.25	10.36%
3	德沃尔半导体（香港）有限公司、深圳市德沃尔实业有限公司	5,926.16	8.64%
4	聚兴科技股份有限公司、上乘电子科技股份有限公司	5,915.88	8.63%
5	品佳电子有限公司、大联大商贸（深圳）有限公司	5,871.45	8.56%
合计		34,486.34	50.29%

注：同一主体控制下的客户销售金额合并披露。

公司 2014 年度前五名客户构成与 2013 年度相比变化较大，原因分析如下：公司的经销商客户深圳市海威思科技有限公司/德思达（香港）有限公司、香港和式有限公司/深圳市华信科科技有限公司/科通无线科技（香港）有限公司、恒智科技股份有限公司/亿莱科技（深圳）有限公司拥有充足的售后服务团队，能够为其下游模组厂、方案商和整机厂等客户提供较为完善的技术支持服务，因此公司加大了对上述三家经销商的销售金额。

2015 年度公司前五大客户较 2014 年度新增香港弘泰电子技术有限公司/厦门弘汉智能科技有限公司，香港弘泰电子技术有限公司/厦门弘汉智能科技有限公司在 2014 年度即为公司第六大客户。除此之外，2015 年公司前五大客户与 2014 年相比整体结构保持稳定。

4、报告期内公司经销商变动情况

报告期内，公司经销商整体保持稳定，品佳电子有限公司/大联大商贸（深圳）有限公司、聚兴科技股份有限公司/上乘电子科技股份有限公司等经销商一直与公司保持良好的合作关系。报告期内，公司新增或减少经销商的销售金额及其占当期经销商销售金额的比重情况如下所示：

单位：万元

新增/减少 年份	经销商名称	销售额					
		2015 年度		2014 年度		2013 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
2013 年度新增	厦门弘汉光电科技有限公司、厦门弘汉智能科技有限公司、香港弘泰电子技术有限公司	11,447.87	17.51%	7,736.80	13.62%	670.96	1.73%
2014 年度减少	堃昶股份有限公司、堃昶国际贸易（上海）有限公司	-	-	160.47	0.27%	7,103.25	18.36%
2015 年度减少	深圳市国准科技有限公司	461.81	0.71%	2,241.77	3.95%	2,889.72	7.47%

公司新增经销商的原因为协助公司拓展市场和终端客户资源，并增加技术支持服务团队规模，以提升对终端厂商技术服务能力和效率。公司于 2014 年度和 2015 年度分别解除与堃昶股份有限公司/堃昶国际贸易（上海）有限公司和深圳市国准科技有限公司

的合作，原因为该等经销商的主要客户群体是对应白牌终端厂商的模组厂，2014年起市场竞争日趋激烈，其所负责的终端客户出货需求大幅滑落。

（五）报告期内主要产品原材料、能源及其供应情况

1、委托生产加工情况

公司专注于集成电路设计，采用 Fabless 经营模式，不直接从事芯片产品的生产制造，晶圆制造、检测、封装、芯片烧录测试等生产制造环节均以委外方式完成。报告期内，公司外协加工具体金额以及占各期成本的比例如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	占比	金额	占比
电容触控芯片	29,617.81	100.00%	28,297.85	100.00%	22,903.91	100.00%
其中：外协原材料成本	16,069.86	54.26%	16,404.12	57.97%	14,384.36	62.80%
非外协原材料成本	65.39	0.22%	87.38	0.31%	71.50	0.32%
封装成本	11,262.01	38.02%	9,841.73	34.78%	7,078.26	30.90%
烧录测试成本	1,948.78	6.58%	1,622.34	5.73%	1,105.97	4.83%
刻字等其他成本	271.77	0.92%	342.28	1.21%	263.81	1.15%
指纹识别芯片	17,087.35	100.00%	827.29	100.00%	-	-
其中：外协原材料	8,187.40	47.91%	185.66	22.44%	-	-
封装成本	3,780.83	22.13%	86.05	10.40%	-	-
组装成本	4,167.98	24.39%	523.55	63.28%	-	-
其他成本	951.14	5.57%	32.03	3.88%	-	-
固定电话芯片	249.32	100.00%	300.33	100.00%	548.41	100.00%
非外协芯片成本	249.32	100.00%	300.33	100.00%	548.41	100.00%
成本合计		46,954.48		29,425.47		23,452.32
其中：外协加工金额		46,639.77		29,037.76		22,832.40
外协加工金额占成本比例		99.33%		98.68%		97.36%

1、电容触控芯片

电容触控芯片方面，公司主要向 Dongbu Hitec co., Ltd、北京兆易创新科技股份有限公司、华邦电子股份有限公司等采购定制加工生产的晶圆，然后委托日月光封装测试

（上海）有限公司、华天科技（西安）有限公司、华天科技（昆山）电子有限公司等对合格晶圆进行封装，使芯片电路与外部器件实现电气连接，并为芯片提供机械物理保护，最后，再发往广东利扬芯片测试股份有限公司、京隆科技（苏州）有限公司等外协烧录厂写入软件程序，并程序烧录完毕后对整颗芯片进行测试。

公司向 X-FAB Sarawak Sdn.Bhd 采购的订制晶圆主要用于 GT8 系列产品，向 Dongbu Hitec co., Ltd、华邦电子股份有限公司、北京兆易创新科技股份有限公司等采购的订制晶圆主要用于 GT9 系列产品。2013 年上半年，公司电容触控芯片的主要产品系列为 GT8 系列芯片，因此向 X-FAB Sarawak Sdn.Bhd 外协采购的金额较高，2013 年度为 1,889.39 万元；随着 2013 年公司推出 GT9 系列芯片产品，向 X-FAB Sarawak Sdn.Bhd 的晶圆采购额大幅下降，2014 年度和 2015 年度分别为 3.12 万元和 0.00 万元。同时，公司向 Dongbu Hitec co., Ltd、华邦电子股份有限公司、北京兆易创新科技股份有限公司的晶圆采购额大幅上升。由于不同系列产品的封装与烧录测试工艺并无太大区别，因此报告期内公司封装与烧录测试所涉及的外协厂商没有明显变化。

报告期内，公司电容触控芯片前五大外协厂商及其外协内容和金额如下表所示：

单位：万元

2015 年度			
序号	外协厂商名称	采购金额	外协内容
1	Dongbu Hitec co., Ltd	13,850.96	晶圆
2	日月光封装测试（上海）有限公司	6,567.72	封装
3	北京兆易创新科技股份有限公司	3,719.59	晶圆
4	华天科技（西安）有限公司、华天科技（昆山）电子有限公司	3,057.75	封装
5	南通富士通微电子股份有限公司	1,476.85	封装
6	其他	2,255.96	
合计		30,928.83	
2014 年度			
序号	外协厂商名称	采购金额	外协内容
1	Dongbu Hitec co., Ltd	12,315.54	晶圆
2	日月光封装测试（上海）有限公司	6,263.85	封装
3	南通富士通微电子股份有限公司	1,896.58	封装
4	华邦电子股份有限公司	1,823.39	晶圆

5	华天科技（西安）有限公司、华天科技（昆山）电子有限公司	1,727.08	封装
6	其他	5,477.17	
合计		29,503.61	
2013 年度			
序号	外协厂商名称	采购金额	外协内容
1	Dongbu Hitec co., Ltd	8,741.71	晶圆
2	日月光半导体制造股份有限公司、日月光封装测试（上海）有限公司、日月光半导体（昆山）有限公司	4,780.53	烧录、封装
3	华邦电子股份有限公司	4,690.94	晶圆
4	X-FAB Sarawak Sdn.Bhd.	1,889.39	晶圆
5	江苏长电科技股份有限公司	1,695.10	封装
6	其他	3,102.85	
合计		24,900.52	

2、指纹识别芯片

指纹识别芯片是公司 2014 年推出的新产品。成本构成中，2015 年度较 2014 年度组装成本大幅下降，外协原材料成本及封装成本有所上升，主要是由于 2015 年下半年起，公司的指纹识别芯片系列产品由销售模组为主转为销售芯片为主。公司主要向 X-FAB Sarawak Sdn.Bhd.、X-FAB Dresden GmbH & Co. KG 采购订制晶圆，向精亿五金有限公司、舜远科技有限公司等采购蓝宝石相关制品，然后委托江苏长电科技股份有限公司、昆山凯尔光电科技有限公司、安靠封装测试（上海）有限公司等对检测合格的晶圆进行封装与组装，最后再发往华天科技（西安）有限公司、华天科技（昆山）电子有限公司对芯片进行 Trench 工艺并测试。报告期内，公司指纹识别芯片前五大外协厂商及其外协内容和金额如下表所示：

单位：万元

2015 年度			
序号	外协厂商名称	采购金额	外协内容
1	X-FAB Dresden GmbH & Co. KG、X-FAB Sarawak Sdn.Bhd.	10,860.79	晶圆
2	安靠封装测试（上海）有限公司	4,141.02	封装
3	昆山凯尔光电科技有限公司	1,275.51	组装
4	江苏长电科技股份有限公司	439.68	封装
5	东莞市精亿五金有限公司	437.08	RING 铁环

6	其他	2,608.61	
合计		19,762.69	
2014 年度			
序号	外协厂商名称	采购金额	外协内容
1	X-FAB Dresden GmbH & Co. KG、X-FAB Sarawak Sdn.Bhd.	985.20	晶圆
2	江苏长电科技股份有限公司	387.70	封装
3	东莞市精亿五金有限公司	357.86	RING 铁环
4	深圳市舜远科技有限公司	342.67	蓝宝石
5	东莞市联佳电子科技有限公司	339.81	蓝宝石
6	其他	1,461.77	
合计		3,875.01	

以上所有外协生产厂商均非公司关联方，定价完全参照市场价，遵循公正公开的原则，由双方协商确定。

2、主要能源供应情况

本公司从事集成电路芯片的研发和销售，生产经营所需能源主要为少量水电，由当地相关部门配套供应，报告期内供应稳定。

3、前五名供应商情况

报告期内，公司前五名供应商情况如下表所示：

单位：万元

2015 年度				
序号	供应商名称	金额	采购内容	占采购总额比例
1	Dongbu Hitec co., Ltd	13,940.69	晶圆	27.28%
2	X-FAB Dresden GmbH & Co. KG、X-FAB Sarawak Sdn.Bhd.	10,872.79	晶圆	21.28%
3	日月光封装测试（上海）有限公司	6,568.34	封装	12.86%
4	安靠封装测试（上海）有限公司	4,141.02	封装	8.10%
5	北京兆易创新科技股份有限公司	3,903.17	晶圆	7.64%
合计		39,426.01		77.16%
2014 年度				
序号	供应商名称	金额	采购内容	占采购总额比例
1	Dongbu Hitec co., Ltd	12,545.45	晶圆	36.92%

2	日月光封装测试（上海）有限公司	6,263.85	封装	18.44%
3	华天科技（西安）有限公司、华天科技（昆山）电子有限公司	1,978.11	封装代工和晶圆加工	5.82%
4	南通富士通微电子股份有限公司	1,896.58	封装	5.58%
5	华邦电子股份有限公司	1,851.06	晶圆	5.45%
合计		24,535.05		72.21%
2013 年度				
序号	供应商名称	金额	采购内容	占采购总额比例
1	Dongbu Hitec co., Ltd	8,741.71	晶圆	34.01%
2	日月光半导体制造股份有限公司、日月光封装测试（上海）有限公司、日月光半导体（昆山）有限公司	4,780.53	封装和烧录测试代工	18.60%
3	华邦电子股份有限公司	4,690.94	晶圆	18.25%
4	X-FAB Sarawak Sdn.Bhd.、X-FAB Dresden GmbH & Co. KG	1,889.39	晶圆	7.35%
5	江苏长电科技股份有限公司	1,695.10	封装代工	6.60%
合计		21,797.67		84.81%

注：同一主体控制下的供应商采购金额合并披露。

2014 年度，公司的电容触控芯片产品封装由单芯片封装技术转为多芯片封装技术，因此新增封装厂商南通富士通微电子股份有限公司，其封装份额超过江苏长电科技股份有限公司，成为公司 2014 年度的第四大供应商。由于封装的代工质量和服务较优，公司加强了与华天科技（西安）有限公司的合作，对其采购额提升较大；同时公司 2014 年开始销售指纹识别芯片产品，能够承接指纹识别芯片晶圆加工的中国厂商较少，出于对生产工艺、质量和服务水平的综合考虑，公司选择华天科技（昆山）电子有限公司为指纹识别芯片产品进行晶圆加工。随着公司 GT8 系列产品逐步退出市场，公司对该产品主要晶圆供应商 X-FAB Sarawak Sdn.Bhd./X-FAB Dresden GmbH & Co. KG 的采购份额下降较大。

与 2014 年度相比，2015 年度公司的前五名供应商新增 X-FAB、安靠封装测试（上海）有限公司和北京兆易创新科技股份有限公司，其中 X-FAB 和北京兆易创新科技股份有限公司是公司长期合作伙伴；公司设计研发的指纹识别芯片产品对封装测试工艺要求较高，出于技术水平的考虑，2015 年公司在指纹识别芯片的封装测试环节向安靠封装测试（上海）有限公司的采购金额增幅较大。

（六）董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在前五名供应商及前五名客户中所占权益的情况

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在前五名供应商及前五名客户中未占有权益。

（七）安全生产和环境保护

公司所属行业不存在高危险、重污染作业的情况，亦不存在对自然环境造成污染或其他影响的情况。

五、产品质量控制情况

（一）公司执行的相关质量控制标准及体系

本公司将“创新技术、优质产品、高效服务、快捷交付、持续改进”作为质量方针，坚持高标准要求，通过各种措施，力争为客户带来性能优异、质量稳定的芯片产品。

公司内部建立了完整的质量控制体系，并已通过 ISO9001 质量管理体系认证。公司专设质量体系部负责公司质量管理体系的维护与改进，其主要职责包括 ISO9001 质量管理体系建立、维护及改善；完善公司内部各部门的工作流程；公司质量目标的监视和测量；策划及举行公司内部审核与管理评审；供应商和外包方的评估与管理；重大质量问题的跟踪；以及客户满意度调查与分析等。

（二）质量控制具体措施

在涉及委外生产时，公司执行严格的合格供应商制度，优选合作厂商，充分保证原材料的高品质以及受托厂商的生产质量和工艺水平。在具体业务开展中，公司多环节把控产品质量，在性能测试、安规测试、EMC 测试、热测试、环境测试与运输、跌落测试等多个环节，做到随时掌握生产状况，确保产品质量。必要时在封装厂和测试烧录厂安排技术人员驻场，以便及时了解生产状况，解决生产过程中的问题，保证生产质量。目前，公司已与 Dongbu Hitec co., Ltd、X-FAB、日月光、长电科技、华天科技（西安）有限公司等供应商建立起长期稳定的合作关系。

（三）质量控制效果

截至本招股说明书签署之日，本公司未发生因质量问题而导致的重大纠纷。深圳市监局已出具证明，证明本公司没有违反市场监督管理有关法律法规的记录。

（四）经销商退换货情况

报告期内，因产品质量和版本问题，公司下游经销商存在换货情况，具体金额如下表所示：

年份	退货金额（万元）	退货原因	换货金额（万元）	换货原因
2015 年度	-		73.88	版本错误或质量问题
2014 年度	5.51	与堃昶终止合作时，公司认为可以代为消耗库存，因此同意退换	64.09	芯片问题及版本错误
2013 年度	-		8.60	芯片质量问题

公司收到换回的货品后，一般处理的程序是退回外协厂检测，若检测为良品，则可继续销售。若检测为不良品，则申请报废，属外协厂责任导致的，要求其相应赔偿。

六、发行人的主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司主要固定资产情况如下表所示：

单位：万元

资产名称	原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	14,554.56	993.21	13,561.35	93.18%
办公及电子设备	1,312.88	646.39	666.49	50.77%
仪器仪表	584.07	275.26	308.81	52.87%
运输设备	98.86	64.24	34.62	35.02%
合计	16,550.37	1,979.10	14,571.27	88.04%

（二）房屋及土地使用权

1、房产

截至本招股说明书签署之日，公司拥有的房产情况如下表所示：

序号	房产坐落	产权证号	建筑面积 (m ²)	建设土地使用年限	用途	取得方式	
1	深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B 座 13 层	深房地字第 3000700954 号	1,460.97	50 年, 从 1992-11-21 至 2042-11-20	工业厂房	股东投入	
2	深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地	4 栋 B 座 9 层 901 房	深房地字第 4000630078 号	1,083.91	50 年, 从 2011-8-18 至 2061-8-17	研发办公	购买取得
3		4 栋 B 座 9 层 902 房	深房地字第 4000630170 号	985.61			
4		4 栋 D 单元 8 层 801 号房	深房地字第 4000630124 号	343.50			
5		4 栋 D 单元 8 层 802 号房	深房地字第 4000630186 号	308.68			
6		4 栋 D 单元 8 层 803 号房	深房地字第 4000630180 号	352.72			
7		4 栋 D 单元 8 层 804 号房	深房地字第 4000630182 号	347.91			
8		4 栋 D 单元 8 层 805 号房	深房地字第 4000630150 号	313.40			
9		4 栋 D 单元 8 层 806 号房	深房地字第 4000630173 号	310.46			
10		4 栋 D 单元 9 层 901 号房	深房地字第 4000630073 号	343.43			
11		4 栋 D 单元 9 层 902 号房	深房地字第 4000630133 号	308.61			
12		4 栋 D 单元 9 层 903 号房	深房地字第 4000630068 号	352.64			
13		4 栋 D 单元 9 层 904 号房	深房地字第 4000630066 号	350.51			
14		4 栋 D 单元 9 层 905 号房	深房地字第 4000630128 号	313.72			
15		4 栋 D 单元 9 层 906 号房	深房地字第 4000630126 号	309.99			
16	深圳市南山区安托山一治广场	2 栋 B 单元 2002 室	59.68	70 年, 从 2012-5-15 至 2082-5-14	人才住房	购买取得	
17	2 栋 B 单元 1805 室	60.42					
18	2 栋 B 单元 505 室	60.47					

注：依据公司向相关主管部门的确认，上述 16-18 项企业人才住房不予办理房产证。根据《福田区企业人才住房配售管理办法》，发行人对其购买的上述 16-18 项企业人才住房享有有限产权，发行人不得向政府以外的任何单位或个人进行任何形式的产权交易。

截至本招股说明书签署之日，发行人及其子公司租赁的房产情况如下表所示：

序号	承租方	出租方	租赁房屋地址	面积	用途	租赁期限
1	发行人	天主教上海教区	上海市徐汇区斜土路 2899 甲号 1 幢 902 室	354.29 m ²	办公	2014.1.1-2016.8.15

序号	承租方	出租方	租赁房屋地址	面积	用途	租赁期限
2	发行人	深圳市深福保(集团)有限公司	深圳市福田区保税区桃花路6号腾飞工业大厦B栋十二层	1,460.97 m ²	厂房	2013.9.9-2016.9.8
3	发行人	全银花	朝阳区广顺南大街16号院2号楼14层1607	110.16 m ²	办公	2015.12.21-2017.12.27
4	发行人	深圳市经济贸易和信息化委员会	梅山苑二期1栋302、303、304号房	123.81 m ²	住宅	2015.2.1-2016.1.31 ^注
5	发行人成都分公司	联发芯软件设计(成都)有限公司	成都市高新区天府五街168号联发芯软件设计(成都)有限公司新大楼第九层	1,978.67 m ²	办公、研发	2016.1.15-2018.1.14
6	发行人	卢静	深圳市保税区桂花路9号帝涛豪园2-6F	91.54 m ²	住宅	2015.12.17-2016.12.16
7	发行人	HUPIS 有限责任公司	京畿道, 城南市, 盆堂区, 三坪洞, 672号5-pili, 7楼	542.79 m ²	办公	2015.8.31-2018.8.30
8	汇顶香港	德晟租赁股份有限公司	台北市忠孝西路一段50号11F之13、14、15房屋	197.10 坪	办公	2014.12.1-2017.12.31
9	汇芯科技	深圳市深福保(集团)有限公司	深圳市福田区保税区桃花路6号腾飞工业大厦B栋二层	1,491.93 m ²	厂房	2016.3.1-2019.2.28
10	易易非凡	西信工业有限公司	新北市莺歌区南靖里三莺路119巷1号	68 m ²	办公	2015.08.01-2020.07.31
11	汇顶香港	谢沛廷	新竹县竹北市嘉丰十一路一段100号十楼之六	86 坪	办公	2015.04.20-2016.04.19
12	汇顶美国	Harvest Holdings, LLC	6472 Camden Avenue, in the City of San Jose, County of Santa Clara, State of California, with zip code 95120	637 平方英尺	办公	2015.01.01-2016.03.31
13	汇顶美国	PS Business Parks, Inc.	F204, 6370 Lusk Blvd., San Diego, California	1,822 平方英尺	办公	2015.01.01-2016.12.31

注：上述第4项租赁合同已到期，该房屋的续租手续正在办理中，预计2016年3月完成。续租合同签署前，仍由发行人按照原租赁合同约定承租该房屋。

就上述租赁房产，如到期后不能续租对发行人生产经营影响如下：

(1) 发行人拥有的位于深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层的建筑面积为1,460.97 m²的房产，以及发行人拥有的位于深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地4栋的14处房产，建筑面积共计为6,025.09 m²；(2) 发行人主要从事智能人机交互技术的研究与开发，主要向市场提供面向手机、平板电脑等智能终端的电容屏触控芯片。发行人采用Fabless经营模式，业务经营所涉及的固定资产投资主要为研发设备和办公设备等，该等固定资产对土地房产的依附度较低且相关房产的可替代性较强；(3)

发行人业务开展对租赁场地要求不高，也无特殊要求，在目前商业地产供给持续攀升的商业环境下，寻找租赁场地较为便利；同时，办公设施的搬迁、安装、调试较为简单。

综上所述，保荐机构和发行人律师认为，租赁场所的租赁期届满后无法续租不会给发行人业务经营带来重大不利影响。

2、土地使用权

依据2015年2月12日成都市公共资源交易服务中心发布的“成公资土挂告[2015]11号”《成都市挂牌出让国有建设用地使用权公告》，成都市国土资源局高新分局作为出让方以挂牌方式出让位于高新区大源组团（桂溪街道勤俭村2、3、4组）宗地编号为GX2015-13（214/211）的国有土地使用权，土地净面积53,729.34 m²（合80.5940亩），楼面地价为1,140元/平方米。

依据金慧通与成都金证博泽科技有限公司、成都融智大数据服务有限公司、成都金证同康信息技术有限公司、成都金证同洲科技有限公司共同签署的《联合竞买协议》，约定上述五家公司联合竞买位于成都市高新区大源组团（桂溪街道勤俭村2、3、4组）宗地编号为GX2015-13（214/211）宗地，其中，分配至金慧通的项目区域为3区，建筑面积（地上）为42,094.60m²，对应需由金慧通支付的土地合同款（含税费）为3,598.18万元（对应区域面积为10.39亩）。

依据成都市国土资源局高新分局、成都市公共资源交易服务中心与上述五家公司于2015年3月23日共同签署的《成都市挂牌出让国有建设用地使用权成交确认书》，成都市国土资源局高新分局向上述五家公司出让位于高新区大源组团（桂溪街道勤俭村2、3、4组）编号为GX2015-13（214/211）的地块，地块面积53,729.34 m²（合80.594亩），使用年限为40年，规划用地适用性质为“其他商务用地（科研办公）兼容商业用地（兼容小于等于49%商业）”，成交价为楼面地价1,140元/m²，挂牌成交总额为245,005,790.40元。

2015年9月15日，成都市国土资源局高新分局作为出让人与受让人金慧通、成都金证博泽科技有限公司、成都融智大数据服务有限公司、成都金证同康信息技术有限公司、成都金证同洲科技有限公司共同签署《国有建设用地使用权出让合同》（510100-2015-C-002）及其补充协议，就上述国有土地使用权出让事宜进行详细约定。

截至本招股说明书签署之日，金慧通支付全部应由其承担的土地出让金及税费，相关土地使用权证书正在办理中。

除上述外，截至本招股说明书签署之日，发行人及其控股子公司未拥有土地使用权。

（三）主要知识产权

1、专利

截至本招股说明书签署之日，发行人在中国已取得专利证书的专利共 76 项，具体情况如下表所示：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日
1	电容式触摸检测装置及其检测方法	发明	200810217924.1	2008.11.28
2	一种抗工频及其谐波干扰的信号采样方法及系统	发明	200910190073.0	2009.9.15
3	一种触摸屏终端的唤醒方法及系统	发明	200910110486.3	2009.11.4
4	一种抗干扰的方法、系统及电容型触摸传感器	发明	200910110063.1	2009.11.10
5	触摸屏边缘区域被触摸点的坐标的线性处理方法及系统	发明	200910109731.9	2009.11.17
6	一种触摸感应扫描检测方法、系统及电容型触摸传感器	发明	200910109696.0	2009.11.23
7	一种触摸检测灵敏度的自动校准方法、系统及触控终端	发明	200910189017.5	2009.12.16
8	一种双耦合型检测电路、雨量传感器及雨量识别方法	发明	201010147175.7	2010.4.9
9	一种触控设备配置参数的自动生成方法、系统	发明	201010189490.6	2010.6.1
10	一种触摸屏终端的触摸检测方法、检测系统	发明	201010242981.2	2010.8.2
11	触摸控制器自适应电容式触摸传感器的方法及系统	发明	201110278456.0	2011.9.19
12	一种触摸检测系统及其检测方法	发明	201010239424.5	2010.7.28
13	光线感应传感器及触摸屏终端	发明	201210579116.6	2012.12.27
14	一种触摸屏终端的近场通信方法、系统及触摸屏终端	发明	201210337236.5	2012.9.4
15	触摸检测装置的降噪处理方法及系统	发明	ZL201110075916.X	2011.3.28
16	电容式多点触摸屏基准数据更新的方法及系统	发明	ZL201110139017.1	2011.5.25
17	触摸检测装置检测数据中的形变噪声的消除方法及系统	发明	ZL201210201172.6	2012.6.8
18	触摸终端及其近场通讯方法和系统	发明	ZL201310177369.5	2013.5.4
19	可排除大面积干扰的触摸检测终端的	发明	201210201178.3	2012.6.8

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日
	基准更新方法及系统			
20	一种电容式触摸屏的测试方法、系统及电子设备	发明	ZL201210501337.1	2012.11.30
21	一种外部电源和电池供电的电源切换电路	发明	ZL201310286721.9	2013.7.9
22	近场通信系统、方法和终端	发明	ZL201410035742.8	2014.1.24
23	一种用于触摸检测的噪声抑制方法、系统及触摸终端	发明	ZL201210266422.4	2012.7.19
24	电容屏触摸检测系统	发明	ZL201210590513.3	2012.12.31
25	低功耗存储器接口电路	实用新型	201520042960.4	2015.1.21
26	触摸式遥控器	实用新型	200820212792.9	2008.10.21
27	一种单面布线的电容型触摸面板及触摸屏终端	实用新型	200920131325.8	2009.4.20
28	一种触摸按键感应装置、电子设备、雨量传感器及汽车	实用新型	200920131644.9	2009.5.8
29	一种滑动触摸感应装置与机械按键的组合结构及电子设备	实用新型	200920132385.1	2009.6.5
30	一种抗干扰的电容式触摸屏及电子设备	实用新型	200920133522.3	2009.7.3
31	一种组合式输入装置及包括该装置的电子产品	实用新型	200920133580.6	2009.7.8
32	分体式多媒体电话机系统及电话座机	实用新型	200920206030.2	2009.10.16
33	一种电容式感应设备和具有触摸功能的电子装置	实用新型	200920205869.4	2009.10.23
34	一种触摸屏模组及触摸屏终端	实用新型	200920260013.7	2009.11.2
35	一种溢水监控装置及防沸溢厨具	实用新型	200920260493.7	2009.11.23
36	一种电容式触控结构、触控模块及触控终端	实用新型	200920261968.4	2009.12.24
37	一种电容式触摸传感器、触摸检测装置及触控终端	实用新型	201020110486.1	2010.2.4
38	一种压电式触摸检测系统	实用新型	201020274328.X	2010.7.28
39	单层式二维触摸传感器及触控终端	实用新型	201220103621.9	2012.3.7
40	电容式触摸传感器、触摸检测装置及触控终端	实用新型	201220281078.1	2012.6.8
41	一种单层电容式二维触摸传感器	实用新型	201220358178.X	2012.7.16
42	单层触摸传感器	实用新型	201220396829.4	2012.8.3
43	单层电容式二维触摸传感器	实用新型	201220429129.0	2012.8.22
44	一种单层电容式二维触摸传感器	实用新型	201220429147.9	2012.8.22
45	一种电容式单层二维触摸传感器	实用新型	201220449768.3	2012.8.28
46	一种电平转换电路	实用新型	201220451367.1	2012.8.29

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日
47	电容式单层二维触摸传感器	实用新型	201220455439.X	2012.8.31
48	电容屏触控笔	实用新型	201220438933.5	2012.8.31
49	电容屏触摸笔	实用新型	201220438952.8	2012.8.31
50	触摸笔	实用新型	201220486662.0	2012.9.21
51	一种单层多点二维触摸传感器	实用新型	201220538159.5	2012.10.19
52	单层多点二维触摸传感器	实用新型	201220551367.9	2012.10.25
53	单层电容触摸传感器及触控终端	实用新型	201320042577.X	2013.1.25
54	单层电容触摸传感器及触控终端	实用新型	201320042555.3	2013.1.25
55	电容式二维触摸传感器	实用新型	201320044302.X	2013.1.25
56	单层布线的电容式二维触摸传感器	实用新型	201320211127.9	2013.4.24
57	一种单层多点的电容式二维触摸传感器	实用新型	201320365190.8	2013.6.24
58	单层布线的电容式二维触摸传感器	实用新型	201320376437.6	2013.6.27
59	一种充电开关及其集成电路	实用新型	201320406800.4	2013.7.9
60	一种电平转移电路	实用新型	201320406742.5	2013.7.9
61	一种变压器结构及充电器	实用新型	201320352699.9	2013.6.19
62	双条搭桥结构的单层电容式二维触摸传感器	实用新型	201320717847.2	2013.11.13
63	相邻电极互叉的单层电容式二维触摸传感器	实用新型	201320718807.X	2013.11.13
64	双层布线多条图案的电容式触摸传感器	实用新型	201320719436.7	2013.11.13
65	采用金属网格式电极的单层二维触摸传感器	实用新型	201320723336.1	2013.11.13
66	电容触摸屏及其触摸终端	实用新型	201320744298.8	2013.11.21
67	单层多点式电容触摸传感器	实用新型	201320833732.X	2013.12.17
68	晶圆级封装结构和指纹识别装置	实用新型	201420009042.7	2014.1.7
69	金属网格触摸传感器和电容触摸屏	实用新型	201420156338.1	2014.4.1
70	电容式触摸传感器及其电极结构、电容式触摸屏	实用新型	201420211369.2	2014.4.28
71	电容触摸屏传感器的图案结构和电容触摸屏	实用新型	201420184400.8	2014.4.16
72	一种单层布线的电容式二维触摸传感器及其触摸屏	实用新型	201420396685.1	2014.7.17
73	触摸屏终端	实用新型	ZL201420842385.1	2014.12.25
74	具有压力检测功能的触摸屏终端	实用新型	ZL201520526236.9	2015.7.20
75	一种可实现指纹检测的电子设备及其边框	实用新型	ZL201520599244.6	2015.8.11

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日
76	传感芯片封装组件和具有该传感芯片封装组件的电子设备	实用新型	ZL201520701432.5	2015.9.11

截至本招股说明书签署之日，发行人在美国已取得发明专利 6 项，具体情况如下表所示：

序号	专利名称	专利号	申请日	授权日	期限
1	NOISE REDUCTION METHOD AND SYSTEM FOR TOUCH DETECTION DEVICE	US8,570,293 B2	2011.5.20	2013.10.29	20 年
2	CAPACITIVE TOUCH SENSOR, TOUCH DETECTION DEVICE AND TOUCH TERMINAL	US8,803,823 B2	2011.3.23	2014.8.12	20 年
3	DEVICE-TO-DEVICE COMMUNICATIONS BASED ON CAPACITIVE SENSING AND COUPLING VIA HUMAN BODY OR DIRECT DEVICE-TO-DEVICE COUPLING	US8,982,094 B2	2013.3.11	2015.3.17	20 年
4	METHOD AND SYSTEM FOR UPDATING REFERENCE DATA OF CAPACITIVE MULTI-TOUCH SCREEN	US9,134,850,B2	2013/4/10	2015/9/15	20 年
5	METHOD AND SYSTEM FOR ENABLING TOUCH CONTROLLER TO BE ADAPTIVE TO CAPACITIVE TOUCH SENSOR	US9,152,282,B2	2013/5/3	2015/10/6	20 年
6	TOUCH-SCREEN TERMINAL AND METHOD AND SYSTEM FOR NEAR-FIELD COMMUNICATION	US9,191,077,B2	2014/3/17	2015/11/17	20 年

2、集成电路布图设计

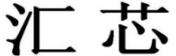
截至本招股说明书签署之日，发行人拥有 7 项集成电路布图设计登记证书，具体情况如下表所示：

序号	布图设计名称	登记号	申请日	颁证日
1	Guitar 多点触控集成电路	BS.09500714.8	2009.10.10	2010.3.4
2	多点触控集成电路（GT818）	BS.11501345.8	2011.12.31	2012.4.24
3	GT828 多点触控集成电路	BS.12500096.0	2012. 01.16	2012.3.1
4	GT915	BS.13501418.2	2013.11.18	2013.12.20
5	GT1151	BS.145007413	2014.7.31	2014.9.10
6	GF16 指纹识别集成电路	BS.15501184.7	2015.12.24	2016.2.4

序号	布图设计名称	登记号	申请日	颁证日
7	GF18 指纹识别集成电路	BS.15501060.3	2015.11.22	2016.2.4

3、商标

截至本招股说明书签署之日，发行人已取得 4 项中国注册商标，具体情况如下表所示：

序号	商标	类别	注册号	注册有效期
1		第 9 类	3465704	2014.7.21-2024.7.20
2		第 9 类	3481582	2014.7.28-2024.7.27
3		第 9 类	13298424	2015.1.28-2025.1.27
4	HUIDING	第 9 类	14056135	2015.7.14-2025.7.13

截至本招股说明书签署之日，发行人已取得 1 项美国商标专用权，具体情况如下表所示：

序号	商标	注册登记日	登记编号	权利期限
1		2012-08-28	4197527	10 年

截至本招股说明书签署之日，发行人已取得 2 项日本商标专用权，具体情况如下表所示：

序号	商标	类别	登记编号	登记日
1		9	5759375	2015.4.17
2		9	5759376	2015.4.17

注：依据 1959 年 1 月 1 日生效的日本商标法相关规定，商标权的有效期为 10 年（自建立注册之日起算）；此外，经查询日本“特许电子图书馆（IPDL）”日本商标查询数据库

（https://www3.j-platpat.inpit.go.jp/cgi-bin/ET/TM_SEARCH），上述商标的有效期限均截至 2025 年 4 月 17 日。

截至本招股说明书签署之日，易易非凡已取得 1 项台湾商标专用权，具体情况如下表所示：

序号	商标	类别	注册号数	权利期间
1		9	01735376	2015.11.1-2025.10.31

4、计算机软件著作权

截至本招股说明书签署之日，发行人及其控股子公司通过原始取得方式获得 73 项计算机软件著作权，具体情况如下表所示：

序号	软件著作权名称	登记号	首次发表日	著作权人
1	HA2612S—汇顶感应式转轮或滑条触控检测应用软件[简称：HA2612S 软件] V1.0	2008SR29949	2008.9.12	汇顶科技
2	HC8217—汇顶 Callwaiting 电话信号处理应用软件[简称：HC8217 软件]V1.0	2008SR29950	2005.7.9	汇顶科技
3	HC2101—汇顶精简来电显示电话处理应用软件 V2.0[简称：HC2101 软件]	2008SR34069	2006.1.3	汇顶科技
4	HA2608—汇顶感应式触控按键检测应用软件 V1.0[简称：HA2608 软件]	2009SR00646	2008.5.10	汇顶科技
5	HC2009—汇顶内置电源管理的多制式 Caller ID 处理应用软件[简称：HC2009 软件]V1.0	2009SR042537	2009.5.14	汇顶科技
6	HC8107—汇顶来电显示微控制器软件 V6.0[简称：HC8107 软件]	2009SR05121	2007.10.27	汇顶科技
7	CD828A—汇顶来电显示微控制器软件 V3.0[简称：CD828A 软件]	2009SR05122	2007.8.3	汇顶科技
8	汇顶 5 点电容式触控检测软件 V1.00	2010SR052362	2010.4.12	汇顶科技
9	HA2734 汇顶高精度转轮控制软件[简称：HA2734 软件]V1.00	2010SR052363	2009.10.10	汇顶科技
10	汇顶 10 点电容式触控检测软件 V1.00	2010SR052364	2010.7.10	汇顶科技
11	HA2620 汇顶多通道电容触控按键控制软件[简称：HA2620 软件] V1.01	2010SR058046	2009.9.1	汇顶科技
12	HC2007N 汇顶通用多功能电话终端管理软件[简称：HC2007N 软件] V1.00	2010SR065214	2009.8.21	汇顶科技
13	HA3516 汇顶电磁炉感应控制系统软件[简称：HA3516 软件]V1.00	2010SR065217	2009.6.2	汇顶科技
14	HC2101N 汇顶来电显示微控制器软件[简称：HC2101N 软件]V2.00	2010SR065223	2009.6.15	汇顶科技
15	HC822 汇顶多国点阵电话处理软件[简称：HC822 软件]V1.00	2010SR065224	2010.7.16	汇顶科技
16	HT800 汇顶精简型 PSTN 网络终端管理软件[简称：HT800 软件] V1.00	2010SR065288	2010.1.18	汇顶科技
17	T12A 汇顶大屏幕多功能电话终端控制软件[简称：T12A 软件] V6.00	2010SR065703	2010.1.12	汇顶科技
18	T18P 汇顶大屏幕中东电话终端控制软件[简称：T18P 软件] V7.00	2010SR065761	2010.2.5	汇顶科技
19	HA3528S 汇顶电容触控滑条控制软件[简称：HA3528S 软件] V1.00	2010SR074377	2010.1.28	汇顶科技
20	HA2708 汇顶带背光电容触摸按键控制软件[简称：HA2708 软件] V1.01	2011SR000010	2009.8.21	汇顶科技
21	HA2608S 高精度滑条控制软件[简称：HA2608S 软件]V1.00	2011SR000012	2009.10.20	汇顶科技
22	HA3612 汇顶内置 LED 驱动的触摸控制系统软件[简称：HA3612 软件]V1.00	2011SR000023	2010.8.28	汇顶科技

序号	软件著作权名称	登记号	首次发表日	著作权人
23	HA2605 汇顶 5 通道触摸控制应用软件[简称: HA2605 软件]V1.00	2011SR002755	2010.6.2	汇顶科技
24	GT818 汇顶多点触控应用软件[简称: GT818 软件]V1.00	2011SR002756	2010.12.8	汇顶科技
25	GT819 汇顶适用于 MID 的电容触控应用软件[简称: GT819 软件]V1.00	2011SR029057	2011.2.25	汇顶科技
26	GT8110 汇顶适用于 Tablet 的 10 点电容触控应用软件[简称: GT8110 软件]V 1.00	2011SR029058	2011.1.20	汇顶科技
27	GT8105 汇顶适用于 Tablet 的 5 点电容触控应用软件[简称: GT8105 软件]V1.00	2011SR029060	2011.2.26	汇顶科技
28	HA2620 汇顶多通道电容触控按键控制软件[简称: HA2620 软件]V2.00	2011SR066701	2010.12.15	汇顶科技
29	HT800 汇顶精简型 PSTN 网络终端管理软件[简称: HT800 软件]V2.00	2011SR066705	2010.11.10	汇顶科技
30	HC2007N 汇顶通用多功能电话终端管理软件[简称: HC2007N 软件]V2.00	2011SR066712	2010.10.10	汇顶科技
31	T18P 汇顶大屏幕中东电话终端控制软件[简称: T18P 软件]V8.00	2011SR066714	2011.1.18	汇顶科技
32	T12A 汇顶大屏幕多功能电话终端控制软件[简称: T12A 软件]V7.00	2011SR066716	2010.11.7	汇顶科技
33	HA2734 汇顶高精度转轮控制软件[简称: HA2734 软件]V2.00	2011SR066717	2010.10.21	汇顶科技
34	HA2608S 汇顶高精度滑条控制软件[简称: HA2608S 软件]V2.00	2011SR066720	2010.11.30	汇顶科技
35	HA3528S 汇顶电容触控滑条控制软件[简称: HA3528S 软件]V2.00	2011SR066723	2011.2.16	汇顶科技
36	HA2708 汇顶带背光电容触摸按键控制软件[简称: HA2708 软件]V2.00	2011SR066767	2010.11.1	汇顶科技
37	GT816 汇顶小尺寸两点触控应用软件[简称: GT816 软件]V1.00	2011SR077308	2011.10.8	汇顶科技
38	DBG01 汇顶触控面板性能分析软件[简称: DBG01 软件]V1.00	2011SR078404	2011.10.9	汇顶科技
39	GT813 汇顶具有 34 个通道的微型电容屏控制软件[简称: GT813 软件]V1.00	2011SR095503	2011.10.22	汇顶科技
40	GT827 汇顶具有 45 个通道的电容屏控制软件[简称: GT827 软件]V1.00	2011SR095506	2011.10.22	汇顶科技
41	GT828 汇顶具有 50 个通道的大尺寸电容屏控制软件[简称: GT828 软件]V1.00	2012SR019723	2011.11.30	汇顶科技
42	GT811 汇顶具有 26 个通道的 5 点电容屏控制软件[简称: GT811 软件]V1.00	2012SR019725	2012.1.30	汇顶科技
43	GT818X 汇顶带有接近感测功能的多点触控软件[简称: GT818X 软件] V1.00	2012SR050605	2012.2.15	汇顶科技
44	GTZ02 汇顶大屏手机 5 点电容触控软件[简称: GTZ02 软件] V1.00	2012SR052780	2012.4.2	汇顶科技
45	GT868 汇顶针对手机应用的单层多点触控软件[简称: [GT868 软件] V1.00	2012SR052898	2012.4.5	汇顶科技
46	HC2006 汇顶 CallerID 处理软件[简称: HC2006 软件]V2.00	2012SR064936	2006.9.29	汇顶科技

序号	软件著作权名称	登记号	首次发表日	著作权人
47	T80 汇顶 PSTN 网络终端管理软件[简称: T80 软件]V1.00	2012SR066613	2007.6.9	汇顶科技
48	汇顶带笔写功能的多点电容屏触控软件 V1.00	2012SR075147	2012.7.20	汇顶科技
49	汇顶平板电脑多通道电容屏触控软件 V1.00	2012SR075176	2012.7.23	汇顶科技
50	汇顶移动多媒体 5 点电容屏触控软件 V1.00	2012SR075180	2012.7.22	汇顶科技
51	汇顶主动式电容笔信号控制软件[简称: GT930 软件]V1.00	2012SR088076	2012.8.26	汇顶科技
52	HC2007 汇顶通用多功能电话终端管理软件[简称: HC2007 软件]V1.00	2012SR105575	2007.8.20	汇顶科技
53	T10 汇顶多功能电话终端控制软件[简称: T10 软件]V1.00	2012SR105602	2007.7.12	汇顶科技
54	汇顶移动多媒体 10 点电容屏触控软件 V1.00	2012SR109846	2012.9.25	汇顶科技
55	T9 汇顶综合多功能电话终端管理软件[简称: T9 软件]V1.00	2012SR115162	2006.5.11	汇顶科技
56	HC8030 汇顶印度电信 BSNL 定制软件[简称: HC8030 软件]V1.00	2012SR115179	2007.5.16	汇顶科技
57	HC78801 汇顶来电显示微控制器软件[简称: HC78801 软件]V2.00	2012SR123348	2004.11.30	汇顶科技
58	HC9823 汇顶 PSTN-SMS 通讯终端管理软件[简称: HC9823 软件]V1.00	2012SR123429	2007.12.27	汇顶科技
59	汇顶主动式笔写配套电容屏触控软件 V1.00	2012SR123480	2012.11.25	汇顶科技
60	汇顶单层 2 点电容触控软件 V1.00	2013SR004960	2012.12.25	汇顶科技
61	汇顶家用电器触控按键软件 V1.00	2013SR016442	2013.1.20	汇顶科技
62	汇顶电容触控技术短距离信息传输软件 V1.00	2013SR056455	2013.4.1	汇顶科技
63	汇顶平板电脑精简型电容屏触控软件 V1.00	2013SR123096	2013.10.1	汇顶科技
64	汇顶支持蓝宝石面板的触摸式指纹芯片识别软件 V1.00	2014SR090706	2014.5.1	汇顶科技
65	汇顶支持涂层的触摸式指纹识别软件 V1.00	2015SR111257	2015.5.10	汇顶科技
66	汇顶支持免金属环的触摸式指纹识别软件 V1.00	2015SR173360	2015.5.10	汇顶科技
67	汇顶支持透明盖板的触摸式指纹识别软件 V1.1	2015SR127563	2015.5.20	汇顶科技
68	汇芯平板电脑低成本电容屏触控软件 V1.00	2013SR038467	2013.4.10	汇芯科技
69	汇芯移动多媒体多通道电容屏触控软件 V1.00	2013SR056459	2013.5.1	汇芯科技
70	汇芯平板电脑多点电容屏触控软件 V1.00	2013SR056462	2013.5.1	汇芯科技
71	汇芯平板电脑 10 点电容屏触控软件 V1.00	2013SR056466	2013.5.1	汇芯科技

序号	软件著作权名称	登记号	首次发表日	著作权人
72	汇芯单层多点电容触控软件 V1.00	2014SR036554	2014.3.1	汇芯科技
73	汇芯移动多媒体触控技术近场通信软件 V1.00	2015SR272096	2015.9.30	汇芯科技

5、软件产品

截至本招股说明书签署之日，发行人及其控股子公司已登记的软件产品共 46 项，具体情况如下表所示：

序号	软件产品名称	证书编号	有效期至	所有权人
1	汇顶 CallerID 处理软件 (HC2006) V2.00	深 DGY-2007-0562	2017 年 7 月 27 日	汇顶科技
2	汇顶 PSTN 网络终端管理软件 (T80) V1.00	深 DGY-2007-0563	2017 年 7 月 27 日	汇顶科技
3	汇顶 Callwaiting 电话信号处理软件 (HC8217) V1.00	深 DGY-2007-1210	2017 年 12 月 28 日	汇顶科技
4	汇顶 PSTN-SMS 通讯终端管理软件 (HC9823) V1.00	深 DGY-2008-0628	2018 年 7 月 31 日	汇顶科技
5	汇顶触控感应按键应用软件 (HA2608) V1.00	深 DGY-2008-0856	2018 年 8 月 29 日	汇顶科技
6	汇顶转轮/滑条触控感应应用软件 (HA2612S) V1.00	深 DGY-2008-1027	2018 年 9 月 28 日	汇顶科技
7	汇顶内置电源管理多制式 Caller ID 处理应用软件 (HC2009) V1.00	深 DGY-2009-0921	2019 年 6 月 30 日	汇顶科技
8	汇顶适用于 Tablet 的 10 点电容触控应用软件 (GT8110) V1.00	深 DGY-2011-0593	自 2011 年 5 月 31 日起五年	汇顶科技
9	汇顶适用于 Tablet 的 5 点电容触控应用软件 (GT8105) V1.00	深 DGY-2011-0594	自 2011 年 5 月 31 日起五年	汇顶科技
10	汇顶适用于 MID 的电容触控应用软件 (GT819) V1.00	深 DGY-2011-0595	自 2011 年 5 月 31 日起五年	汇顶科技
11	汇顶通用多功能电话终端管理软件 (HC2007N) V2.00	深 DGY-2011-1479	自 2011 年 11 月 1 日起五年	汇顶科技
12	汇顶大屏幕中东电话终端控制软件 (T18P) V8.00	深 DGY-2011-1480	自 2011 年 11 月 1 日起五年	汇顶科技
13	汇顶带背光电容触摸按键控制软件 (HA2708) V2.00	深 DGY-2011-1481	自 2011 年 11 月 1 日起五年	汇顶科技
14	汇顶高精度滑条控制软件 (HA2608S) V2.00	深 DGY-2011-1482	自 2011 年 11 月 1 日起五年	汇顶科技
15	汇顶大屏幕多功能电话终端控制软件 (T12A) V7.00	深 DGY-2011-1483	自 2011 年 11 月 1 日起五年	汇顶科技
16	汇顶高精度转轮控制软件 (HA2734) V2.00	深 DGY-2011-1484	自 2011 年 11 月 1 日起五年	汇顶科技
17	汇顶多通道电容触控按键控制软件 (HA2620) V2.00	深 DGY-2011-1485	自 2011 年 11 月 1 日起五年	汇顶科技
18	汇顶电容触控滑条控制软件 (HA3528S) V2.00	深 DGY-2011-1486	自 2011 年 11 月 1 日起五年	汇顶科技
19	汇顶精简型 PSTN 网络终端管理软	深 DGY-2011-1487	自 2011 年 11 月 1 日	汇顶科技

序号	软件产品名称	证书编号	有效期至	所有权人
	件 (HT800) V2.00		起五年	
20	汇顶触控面板性能分析软件 (DBG01) V1.00	深 DGY-2011-1690	自 2011 年 11 月 30 日起五年	汇顶科技
21	汇顶小尺寸两点触控应用软件 (GT816) V1.00	深 DGY-2011-1691	自 2011 年 11 月 30 日起五年	汇顶科技
22	汇顶具有 34 个通道的微型电容屏控制软件 (GT813) V1.00	深 DGY-2011-2110	自 2011 年 12 月 31 日起五年	汇顶科技
23	汇顶具有 45 个通道的电容屏控制软件 (GT827) V1.00	深 DGY-2011-2111	自 2011 年 12 月 31 日起五年	汇顶科技
24	汇顶具有 26 个通道的 5 点电容屏控制软件 (GT811) V1.00	深 DGY-2012-0428	自 2012 年 3 月 30 日起五年	汇顶科技
25	汇顶具有 50 个通道的大尺寸电容屏控制软件 (GT828) V1.00	深 DGY-2012-0429	自 2012 年 3 月 30 日起五年	汇顶科技
26	汇顶大屏手机 5 点电容触控软件 (GTZ02) V1.00	深 DGY-2012-1240	自 2012 年 6 月 29 日起五年	汇顶科技
27	汇顶针对手机应用的单层多点触控软件 (GT868) V1.00	深 DGY-2012-1241	自 2012 年 6 月 29 日起五年	汇顶科技
28	汇顶带有接近感测功能的多点触控软件 (GT818X) V1.00	深 DGY-2012-1242	自 2012 年 6 月 29 日起五年	汇顶科技
29	汇顶移动多媒体 5 点电容屏触控软件 V1.00	深 DGY-2012-1823	自 2012 年 8 月 31 日起五年	汇顶科技
30	汇顶带笔写功能的多点电容屏触控软件 V1.00	深 DGY-2012-1824	自 2012 年 8 月 31 日起五年	汇顶科技
31	汇顶平板电脑多通道电容屏触控软件 V1.00	深 DGY-2012-1825	自 2012 年 8 月 31 日起五年	汇顶科技
32	汇顶主动式电容笔信号控制软件 (GT930) V1.00	深 DGY-2012-2160	自 2012 年 9 月 28 日起五年	汇顶科技
33	汇顶移动多媒体 10 点电容屏触控软件 V1.00	深 DGY-2012-2954	自 2012 年 11 月 28 日起五年	汇顶科技
34	汇顶主动式笔写配套电容屏触控软件 V1.00	深 DGY-2012-3358	自 2012 年 12 月 28 日起五年	汇顶科技
35	汇顶单层 2 点电容触控软件 V1.00	深 DGY-2013-0287	自 2013 年 3 月 29 日起五年	汇顶科技
36	汇顶家用电器触控按键软件 V1.00	深 DGY-2013-0466	自 2013 年 3 月 29 日起五年	汇顶科技
37	汇顶电容触控技术短距离信息传输软件 V1.00	深 DGY-2013-1329	自 2013 年 6 月 28 日起五年	汇顶科技
38	汇顶通用多功能电话终端管理软件 (HC2007) V1.00	深 DGY-2007-1209	2017 年 12 月 28 日	汇顶科技
39	汇顶综合多功能电话终端管理软件 (T9) V1.00	深 DGY-2007-1211	2017 年 12 月 28 日	汇顶科技
40	汇顶平板电脑精简型电容屏触控软件 V1.00	深 DGY-2013-3021	自 2013 年 11 月 29 日起五年	汇顶科技
41	汇顶支持蓝宝石面板的触摸式指纹芯片识别软件 V1.00	深 DGY-2014-1835	自 2014 年 7 月 31 日起五年	汇顶科技
42	汇芯平板电脑低成本电容屏触控软件 V1.00	深 DGY-2013-1132	自 2013 年 6 月 28 日起五年	汇芯科技

序号	软件产品名称	证书编号	有效期至	所有权人
43	汇芯平板电脑多点电容屏触控软件 V1.00	深 DGY-2013-1326	自 2013 年 6 月 28 日起五年	汇芯科技
44	汇芯平板电脑 10 点电容屏触控软件 V1.00	深 DGY-2013-1327	自 2013 年 6 月 28 日起五年	汇芯科技
45	汇芯移动多媒体多通道电容屏触控软件 V1.00	深 DGY-2013-1328	自 2013 年 6 月 28 日起五年	汇芯科技
46	汇芯单层多点电容触控软件 V1.00	深 DGY-2014-0956	2019 年 4 月 28 日	汇芯科技

注：依据深圳市软件业协会于 2015 年 5 月 18 日发布的《关于“双软认定”取消及开展“行业自律评估服务”的通知》，“双软认定”事项已取消其行政管理的性质，产业主管部门不再对软件产品、软件企业发证盖章。据此，软件登记产品有效期届满的无法再办理续延登记。

依据深圳市软件行业协会于 2015 年 10 月 21 日分别出具的编号为“深软函 2015-C-2064”、“2015-C-2127”的《软件产品证明函》，分别证明公司“汇顶支持免金属环的触摸式指纹识别软件 V1.00”、“汇顶支持透明盖板的触摸式指纹识别软件 V1.1”均已完成软件产品检测（检测机构为中国赛宝实验室）及计算机软件著作权登记，该等软件产品均属于纯软件。

七、发行人技术情况

（一）核心技术及其来源

本公司一贯重视关键核心技术的研发和积累，视其为公司构建竞争优势以及保持可持续发展的基础。截至本招股说明书签署之日，本公司已在电容触控芯片、指纹识别芯片和固定电话芯片领域形成的主要核心技术如下表所示：

序号	核心技术名称	技术内容简介	技术来源	创新类型
1	基于互电容检测的 10 点触控技术	检测触摸屏上由于手指或触摸笔触摸而引起的微弱电容变化，且可以同时检测多个触点	自主研发	原始创新
2	互电容单层多点触控技术	该技术采用单层导电介质（ITO）作为传感器，搭配专用的触控检测芯片以及软件算法，实现多点触控检测。该技术大大降低了触摸屏的生产制造成本，同时保证了多点触控的性能	自主研发	原始创新
3	电容屏触控芯片的抗干扰技术	利用软硬件结合的方法滤除来自 LCD 的干扰，从而支持无屏蔽层的触摸屏；利用窄带检测与软件跳频相结合的方法避开共模干扰；利用软件算法滤除因触摸屏形变引起的干扰，降低对触摸屏和整机的设计要求	自主研发	原始创新
4	高精度带压力检测的主动式电容笔技术	该技术在不改变原有 Sensor 的情况下，通过修改检测电路和检测软件同时支持手和笔的输入	自主研发	原始创新

序号	核心技术名称	技术内容简介	技术来源	创新类型
5	基于互电容检测的接近感应	该技术利用已有的触摸屏,通过软硬件结合的方法使其支持接近感应功能	自主研发	原始创新
6	基于电容检测的近场通信技术	该技术基于电容检测原理,通过两部终端的电容式触摸屏或触摸板实现近距离通信	自主研发	原始创新
7	电容触摸屏综合测试系统	该系统用于测试触摸屏的线性度、准确度、灵敏度等指标,能模拟单指和多指操作,可针对模块或整机进行测试,适应性广,实用性强	自主研发	原始创新
8	电容触摸屏自动参数配置	该工具根据用户输入的触摸屏 Sensor 外观等基本参数,以及简单的触摸手势,自动生成检测电路和软件的相关参数。降低应用的难度,保证参数的科学性	自主研发	原始创新
9	电容触摸屏传感器自动设计技术	该工具根据用户输入的图案类型、所使用的检测芯片、Sensor 的工艺要求等信息自动绘制图案。大大提高效率,同时避免出错	自主研发	原始创新
10	高效外线取电技术	利用开关电源技术从电话机外线进行高效取电,供电话机工作。能自动适应不同的外线电压	自主研发	原始创新
11	指纹传感器技术	采用高灵敏度的微弱电容检测技术,支持厚度达 300 μ m 的蓝宝石或玻璃面板,以及触控面板与指纹传感器一体化的 IFS 技术,采用小型化的特殊封装设计,适用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等产品	自主研发	原始创新
12	指纹匹配算法	在极小的传感器面积下,实现高效准确的指纹识别,满足智能手机、平板电脑、可穿戴设备等产品小型化的需求	自主研发	原始创新
13	活体指纹识别技术	在指纹传感器上增加电路模块和活体检测技术,可有效防止假手指对电容式指纹传感器的破解,提高安全级别	自主研发	原始创新
14	心率检测技术	在指纹传感器上增加电路模块和心率检测技术,可实现精确检测用户心率,提高传感器智能程度	自主研发	原始创新
15	指纹导航技术	利用指纹传感器的检测电路,在不增加硬件成本的基础上实现低功耗导航	自主研发	原始创新

(二) 核心技术产品收入占营业收入的比例

报告期内,公司核心技术产品收入及其占公司营业收入的比例情况如下表所示:

报告期	核心技术产品	涉及的主要核心技术	收入金额	占营业收入的比例
2015 年度	电容触控芯片	1-9	85,144.94	76.31%
	固定电话芯片	10	418.33	0.37%
	指纹识别芯片	11-12	26,012.72	23.31%
	合计		11,575.99	100.00%
2014 年度	电容触控芯片	1-9	83,912.06	98.29%
	固定电话芯片	10	489.55	0.57%
	指纹识别芯片	11-12	967.76	1.13%
	合计		85,369.36	100.00%
2013 年度	电容触控芯片	1-9	67,707.20	98.75%

报告期	核心技术产品	涉及的主要核心技术	收入金额	占营业收入的比例
	固定电话芯片	10	854.90	1.25%
	合计		68,562.09	100.00%

注：公司已经产生收入的主要核心技术包括：1、基于互电容检测的10点触控技术；2、互电容单层多点触控技术；3、电容屏触控芯片的抗干扰技术；4、高精度带压力检测的主动式电容笔技术；5、基于互电容检测的接近感应；6、基于电容检测的近场通信技术；7、电容触摸屏综合测试系统；8、电容触摸屏自动参数配置；9、电容触摸屏传感器自动设计技术；10、高效外线取电技术；11、指纹传感器技术；12、指纹匹配算法。

（三）研发情况

1、研发投入

截至2015年12月31日，本公司共有研发人员544人，占员工总数的82.55%；其中核心技术人员6人。

报告期内，公司研发投入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年	2014年度	2013年度
研发支出	16,040.99	8,220.88	4,397.33
营业收入	111,960.13	85,369.36	68,562.09
研发支出占收入比	14.33%	9.63%	6.41%

2、主要技术储备和研发项目

序号	在研产品名称	拟达到的目标	目前进度	研发方式
1	GF31x	按压式指纹识别芯片，采用互电容技术实现指纹检测功能，支持 finger flash 功能，支持 Coating 材质模组	已量产	自主研发
2	GF51x	按压式指纹识别芯片，采用互电容技术实现指纹检测功能，支持 finger flash 功能，支持玻璃盖板模组	已量产	自主研发
3	GF31xM	按压式指纹识别芯片，无 ring 方案，支持 finger flash 功能，支持额外两个按键功能，支持 Coating 材质模组	已量产	自主研发
4	GF51xM	按压式指纹识别芯片，无 ring 方案，支持 finger flash 功能，支持额外两个按键功能，支持玻璃盖板模组	已量产	自主研发
5	GF816M	实现 IFS 功能，支持玻璃盖板，支持 Home, Back, Menu 三个按键	试量产	自主研发
6	GF526S	全新架构指纹识别芯片，支持自互容一体技术，360度任意方向指纹识别，支持蓝宝石、玻璃、Coating 材质模组	产品设计	自主研发
7	GT1152	IncCell 10点触控芯片，支持被动笔、手套，支持固定手势和自定义手势	试量产	自主研发
8	GT9176	IncCell 10点触控芯片，支持被动笔、手套，支持固定手势和自定义手势	已量产	自主研发
9	GT1151	10点触控芯片，支持被动笔、手套，支持固定手势和自定义手势，支持 Hotknot 功能	已量产	自主研发

序号	在研产品名称	拟达到的目标	目前进度	研发方式
10	GT9286	10点触控芯片，支持被动笔、手套，支持固定手势和自定义手势，支持 Hotknot 功能，支持超薄 GFF/OGS/Amoled	已量产	自主研发
11	GT5688	10点触控芯片，支持被动笔、手套，支持固定手势和自定义手势，支持 GFF、OGS，支持全贴合	试量产	自主研发
12	GT5668	5点触控芯片，支持手套，支持固定手势和自定义手势，支持单层多点与双层 GFF、OGS，支持全贴合，支持接近感应	试量产	自主研发
13	GT5663	5点触控芯片，手套，支持固定手势和自定义手势，支持单层多点与双层 GFF、OGS，支持全贴合，支持接近感应，支持≤5寸中端手机	试量产	自主研发
14	GT6286	10点触控芯片，应用于8~10.1寸平板，适应双层导电介质的触摸屏，支持固定手势唤醒	产品设计	自主研发
15	GT967	10点触控芯片，应用于7-8吋平板电脑，适应单层导电介质的触摸屏，支持与 LCD 直接贴合	已量产	自主研发
16	GT9110P	10点触控芯片，应用于9-11吋平板电脑，适应双层导电介质的触摸屏，支持与 LCD 直接贴合。可基于普通电容触摸屏实现主动式电容笔与手指的自动识别，取代电磁屏	已量产	自主研发
17	GT915S	10点触控芯片，应用于6吋以下智能手机，在触控芯片上增加待机手势唤醒功能，支持被动笔和手套操作，提升用户体验，增加产品附加值	已量产	自主研发
18	GT950	2点触控芯片，应用于5吋以下智能手机，适应单层触摸屏，简化触摸屏的制造工艺	已量产	自主研发
19	GT9157	10点触控芯片，支持单双层结构、手势唤醒并具有电容式近场通信功能的多点电容触控芯片	已量产	自主研发
20	GT615	5点触控芯片，支持 On-cell 技术，支持 LCD 与机壳盖板之间采用口字胶贴合，简化触摸屏的制造工艺	已量产	自主研发
21	GF900	针对智能手机、平板电脑等智能终端的指纹识别模组，可输出 96×96 像素、500DPI、256 级灰度的指纹图像	已量产	自主研发
22	GF11	新一代指纹传感器，具有更高的信噪比，更低的功耗，支持与触摸屏模组集成	已量产	自主研发
23	GT9226	压力+触控 2 合 1 芯片，支持 1 指压力检测，AMOLED 结构支持 5.5-5.7 寸以上高端、旗舰手机，Out-cell 结构支持 6.4 寸及以下高端、旗舰手机，触控性能兼容 GT9286	产品设计	自主研发
24	GT9228	压力+触控 2 合 1 芯片，支持 1 指与分区 2 指压力检测，AMOLED 结构支持 5.5-5.7 寸以上高端、旗舰手机，Out-cell 结构支持 6.4 寸及以下手机、平板，触控性能兼容 GT9286	产品设计	自主研发
25	GT6263	多道通压力检测芯片，支持 2 指压力检测，兼容目前主流所有触控叠构，触控性能兼容 GT9286	产品设计	自主研发
26	GF3208	基于自容的新一代 coating 指纹识别传感器，具有更低的功耗，更高的 Sensor 占比，有效提高 FRR 性能	产品验证	自主研发
27	GF5206	基于自互一体技术的指纹识别传感器，支持 300um 玻璃盖板，可支持活体指纹识别技术和心率检测	产品验证	自主研发

注：本公司新产品的研发进度可分为新产品立项、产品规格制定、产品设计、产品验证、试量产等阶段。

3、与科研机构的合作

报告期内，本公司不存在与其他单位合作研发的情况。

（四）创新机制

本公司通过以下制度安排和具体措施，促进技术创新，不断巩固公司核心技术的领先地位，保持公司产品在市场上的竞争优势。

1、全面贯彻以市场需求为导向的技术研发理念

本公司以“创新技术、丰富生活”为使命，旨在通过自主研发，不断提高公司技术水平，提升公司产品的竞争力和知名度。为达到这一目标，公司紧密跟踪行业技术发展水平及市场需求，并将此作为公司确定研发方向、配置研发资源的核心指导原则。在操作层面上，公司研发部和销售管理部均会对市场上发生的新情况进行了解，由研发部组织人员对新情况进行初步研究，需要进一步研究的，则由公司层面组织人员加以详细论证。目前，公司经过仔细研究，已经将超极本触控用芯片、In-cell 触控技术、车载电子触控芯片、电容式近场通信芯片、指纹识别芯片等新产品或新技术作为公司下一步重点拓展的方向，相应地，在募集资金投资项目的确定、公司内部研发资源的配置上，均对这些方向予以了重点考虑。公司将凭借这种市场导向的研发理念，为未来的快速成长做好技术及产品准备。

2、构建规范、高效的研发体系

完善的研发体系对于处在快速发展时期的集成电路设计企业来说至关重要，其可以规范公司的研发秩序，使公司高效配置研发资源、避免不必要的资源浪费，促进技术成果转化，有利于公司构建持续的竞争优势。本公司一直重视建立一个规范、高效的研发体系，以做到巩固核心技术、快速响应市场需求。一方面，公司建立了架构完整的研发组织。公司研发部作为一级部门，下设软件开发部、硬件开发部、芯片设计部、系统开发部等二级部门，各个二级部门之间既合理分工、各司其职，又高效协作、共同促进公司整体目标的实现。另一方面，公司制定了完善的研发管理制度，包括《新产品研发控制程序》、《产品发布流程》、《项目提交测试子流程》、《项目（模块）设计评审子流程》、《测试规格书》等多项制度规定和操作规程，并在公司内部严格执行，使公司的各项研发活动保持在可预期、可控的状态下，有效地促进了研发资源的配置和产出。

3、保持研发投入力度，力促技术及产品创新

芯片技术和产品的升级往往涉及较大的投入，主要包括员工薪酬及培训费用、研发设备及软件采购费用等，这是集成电路设计企业保持创新及领先地位的必备举措。为此，本公司近年来加大了研发投入力度，2013年度、2014年度和2015年度，公司的研发费用分别为4,397.33万元、8,220.88万元和16,040.99万元，过去三年呈逐步上升趋势。公司研发人员数量也逐步增加，截至2015年12月31日，公司研发人员达到544人，占员工总人数的82.55%。上述投入取得了明显成效，公司已自主研发并积累核心技术15项，拥有专利82项，其中发明专利30项，公司营业收入在报告期内也实现了快速增长。未来，公司仍将继续在新技术、新产品上加大投入，继续引进优秀人才，力促技术和产品的持续创新，进一步巩固公司的竞争地位。

4、始终重视技术人才培养和研发团队建设

集成电路设计企业是典型的智力密集型企业，人才是企业发展并保持活力的根本性因素。因此，本公司一直将人才培养和团队建设作为公司的战略性任务，并形成了自己的人才培养理念和方法，具体如下：

(1) 人才培养理念及模式

公司坚持“专业培养和综合培养同步进行”的人才培养政策，即培养专家型的技术人才和综合型的管理人才，前者指在某一工作领域内掌握较高技术水平的人才，后者指在本单位或本部门工作领域具备全面知识、有较高管理水平的人才。对于业务/管理型专才，需在业务线和管理线上深度培养，采用“业务或专业领域内轮岗+项目工作+继续教育+内部指导人培养”多种培养方式进行培养。

(2) 人才培养组织体系

公司建立“统分结合”的人才培养体系。职能部门和各项目组是人才培养的基地，负责培养对象的初步甄选和培养计划的具体实施；人力资源部是发行人人才培养的组织协调部门，负责培养规划、甄选标准及程序的制定、培养对象的确定以及培养计划的统筹安排。

(3) 战略人才动态管理

为了保证公司人才培养规划的有效实施，促进公司战略人才积极进取的精神，公司战略人才将实行动态管理，每半年结合公司其他管理制度进行调整，淘汰不符合条件的人员，并吸收新的优秀人才加入。

上述举措收到了良好的效果，公司未来仍将坚持上述措施，通过持续加大研发投入，培养内部人才、吸引更多外部高层次技术和管理人才，为公司技术和产品的持续创新奠定坚实基础。

八、发行人名称冠名“科技”的依据

公司专业从事智能人机交互技术的研究与开发，主要向市场提供面向手机、平板电脑等智能终端的电容屏触控芯片。依靠技术领先优势，公司已经成为国内领先的电容屏触控芯片厂商。截至本招股书书签署之日，公司为高新技术企业，已取得专利 82 项。在持续创新过程中，公司的基于互电容检测的 10 点触控技术、互电容单层多点触控技术、电容屏触控芯片的抗干扰技术、电容式指纹识别芯片技术等多项核心技术达到行业领先水平。公司的技术优势及技术情况分别参见本节“三、发行人的竞争地位”之“（三）公司竞争优势”之“1、拥有卓越的研发能力和突出的技术优势，较早实现多项行业领先技术产品的量产”，以及“七、发行人技术情况”。因此，公司名称中冠有“科技”字样。

第七节 同业竞争与关联交易

一、发行人的独立性

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具备独立完整的研发、采购和销售系统。

（一）资产完整情况

公司系由汇顶有限整体变更设立，依法承继了汇顶有限的所有资产、负债与权益。公司具备完整的与经营相关的业务体系和相关资产。公司的资产产权清晰，截至本招股说明书签署之日，公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立情况

公司建立了独立的人事档案，健全了人事聘用、考核及薪酬制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，不存在公司股东、其他任何部门、单位或人员违反《公司章程》规定干预公司人事任免的情形。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬的情形；本公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

（三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的财务和核算体系以及规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司开设了独立的银行账号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的情况。发行人不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

（四）机构独立情况

公司建立健全了与公司业务相适应的内部经营管理机构，独立行使经营管理权，依照《公司法》和《公司章程》规定建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等组织机构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况。公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形，未发生控股股东、实际控制人干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

（五）业务独立情况

公司主要从事智能人机交互技术的研究与开发，拥有独立完整的研发、采购及销售体系，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况，具有独立完整的业务和直接面向市场自主经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

此外，公司与第二大股东汇发国际的实际控制人联发科之间不存在技术和销售渠道等方面的依赖，具体分析如下：

（1）公司对联发科不存在技术依赖

首先，公司与联发科的主要产品不同，相应核心技术不同。公司主要向市场提供面向手机、平板电脑等智能终端的电容触控芯片和指纹识别芯片，此外还有部分固定电话芯片。联发科（含晨星台湾）则侧重于液晶电视芯片、手机主控芯片及无线通讯芯片组等产品及业务，除晨星台湾外，联发科及其纳入合并报表范围内的子公司与公司经营业务不存在竞争情形，而与公司存在竞争的电容触控芯片产品亦非晨星台湾的主要产品。

其次，公司在联发科投资之前已完成主要产品研发及技术积累。2011年11月，联发科下属子公司汇发国际对公司增资。对于触控芯片，在此次增资前，公司已完成触控芯片等主要产品研发及技术积累，具体过程如下：2006年，公司在固定电话芯片研发经验的基础上，研制出电容触摸按键芯片；2007年开始电容屏触控芯片的研发，并于2009年研发出工程样片，2010年实现批量生产和销售；随着2011年智能手机、平板电脑等智能终端市场的快速发展，公司电容屏触控芯片销售额迅速提升，在前述电容触控芯片研发过程中，公司实现了相关产品的技术积累。同时，公司具备触控芯片的核心技

术也是联发科投资公司的主要原因之一。对于指纹识别芯片，为保持长期竞争力，公司在前期积累的电容触控技术基础上，于 2013 年开始自主研发指纹传感器技术、指纹匹配算法等核心技术，推出“蓝宝石按压式方案”，公司于 2014 年实现指纹芯片投产，并成功应用于魅族旗舰手机 MX4 Pro，2015 年公司指纹识别芯片产品得到乐视、中兴、维沃、金立等智能手机品牌厂商的应用。经保荐机构、发行人律师核查，在投资公司及收购晨星台湾之前，联发科未从事电容触控芯片的研发；收购晨星台湾之后，晨星台湾保留了之前的电容触控芯片产品线，并开始研发指纹识别芯片产品，但上述产品的研发与发行人没有任何关联，且目前指纹识别芯片尚未实现量产。因此，公司主要产品及核心技术的研发与联发科不存在依赖关系。

第三，公司拥有独立的产品研发团队。截至 2015 年 12 月末，公司研发人员达到 544 人，占员工总人数的 82.55%，其中包括多名自国外引进的高层次技术人才。公司通过提供行业内有竞争力的薪酬以及员工持股计划对研发团队进行激励，极大地提高了研发团队的归属感和稳定性。稳定的技术团队为公司的自主研发提供可靠的人才保证。公司现有的 6 名核心技术人员（分别为张帆、朱星火、龙华、邓耿淳、颜彦、冉锐）中的部分人员除在发行人下属子公司及员工持股企业股东中担任董事、监事、高级管理人员外，未在其他企业或单位任职，亦无受联发科委派的情形。此外，上述核心技术人员均已与公司签署劳动合同及竞业禁止协议等，该等人员大部分自公司设立以来就在公司任职，并专注于为公司服务，有利于公司业务的发展及研发能力的升级。

第四，公司拥有完整的知识产权体系。通过不断创新及自主研发，公司已在电容触控芯片、指纹识别芯片和固定电话芯片领域积累多项核心技术，在业内具有一定的领先性；前述核心技术目前均由公司或其控股子公司占有并使用；此外，为防止核心技术泄露，公司针对前述核心技术申请或取得相关专利、集成电路布图设计登记证书、软件著作权等，截至本招股说明书签署之日，公司已取得专利 82 项（其中发明专利 30 项）、软件著作权 73 项，在相关技术领域形成具备自主知识产权的核心技术。发行人技术实力雄厚，拥有完整独立的自主核心技术并且该等技术均已取得专利保护或是受到著作权保护，除与联发科的软件授权合作（该等软件授权合作不影响发行人核心技术研发的独立性）外，公司与联发科之间不存在任何技术转让或其他授权许可等情况。

(2) 公司对联发科不存在销售渠道依赖

首先，公司销售产品与联发科不同，同时两公司无产品购销往来。如前所述，公司销售的产品主要是电容触控芯片、指纹识别芯片和固定电话芯片，与联发科（含晨星台湾）的主要产品不同。同时，发行人与联发科在产业链上非上下游关系，两公司无产品购销往来，不存在产品销售渠道依赖。

其次，公司销售渠道独立。公司的产品销售分为直销和经销两种，在直销模式下，公司的产品直接销售给下游模组厂或整机厂商；在经销模式下，公司的产品通过买断式销售的方式销售给经销商。因此公司的销售渠道主要包括整机厂商、模组厂和经销商。如前所述，联发科和公司的核心产品存在差异，但联发科的手机主控芯片产品和公司的电容触控芯片、指纹识别芯片都可以应用于手机和平板电脑，也都会通过品佳、上乘电子等经销商进行销售（业内知名的经销商同时经销不同类别、非竞争性的芯片属于行业惯例），在销售渠道和终端方面存在一定的重合。经保荐机构、发行人律师核查，该等客户确认，即使其同时成为公司和联发科的客户，其采购公司和联发科的产品行为也是独立的，并不存在联发科和公司产品绑定销售的情形。

第三，公司销售人员独立。公司已经在公司内部设立销售管理部并建立完整独立的销售团队，负责代表公司与客户建立合作伙伴关系，并深化长期战略合作的商务价值，推广公司产品，树立公司的产品形象。依据前述并经公司、联发科分别确认，公司销售团队成员完全专职于公司，服务于公司经营业务的拓展，不存在公司销售人员与联发科销售人员混同的情形。据此，公司销售人员独立。

保荐机构经核查，认为发行人上述独立性分析的内容真实、准确、完整。

二、同业竞争

（一）同业竞争情况

1、发行人与控股股东、实际控制人及其他主要股东的同业竞争情况

发行人主营业务为智能人机交互技术的研究与开发，主要向市场提供面向手机、平板电脑等智能终端的电容屏触控芯片。

发行人控股股东、实际控制人张帆以及其他主要股东汇发国际、汇信科技、惠邦投资除对发行人投资外，无其他对外投资，亦未从事与发行人主营业务相同或相似的生产经营活动。发行人与控股股东、实际控制人及其他主要股东不存在同业竞争的情形。

2、发行人与联发科的同业竞争情况

发行人主要股东汇发国际的实际控制人联发科主要从事手机主控芯片及无线通讯芯片组的研发、设计。联发科 2016 年 2 月 1 日出具的《承诺函》及中银律师事务所（台北）2016 年 2 月 1 日出具的《联发科技股份有限公司间接在大陆地区投资深圳市汇顶科技股份有限公司之法律意见书》均确认，截至 2016 年 2 月 1 日，除晨星台湾外，联发科及其纳入合并报表范围内的子公司与发行人从事的基于固定电话芯片技术、电容触控芯片技术和指纹识别芯片技术产生的相同或相类似产品的经营业务不存在同业竞争情况。

联发科于 2012 年 6 月 25 日至 2012 年 8 月 13 日以公开收购方式，取得晨星半导体已发行普通股股数的 48%，并与晨星半导体签署合并契约及其补充协议，约定在获得相关审批部门核准同意后，合并案生效，即由联发科作为存续公司，通过增资发行新股吸收合并晨星半导体并将其下市。

根据台湾圆方法律事务所于 2014 年 2 月 12 日出具的《法律补充意见书》，联发科已于 2014 年 2 月 5 日完成合并案，晨星半导体下市，联发科取得晨星半导体控股子公司晨星台湾 99.99% 的股权。但根据商务部《关于附加限制性条件批准联发科技股份有限公司吸收合并开曼晨星半导体公司经营者集中反垄断审查决定的公告》（商务部公告 2013 年第 61 号，以下简称“《决定》”），合并完成后，晨星半导体的手机芯片及其他无线通信业务并入联发科，液晶电视主控芯片及其他业务由其子公司晨星台湾拥有并运营，联发科需在《决定》生效之日（2013 年 8 月 6 日）起的至少 3 年内保持晨星台湾作为独立竞争者的法人地位（3 年期满需获得商务部同意方可解除“保持晨星台湾作为独立竞争者的法人地位”的相关义务），仅能行使晨星台湾的有限股东权利，即除取得晨星台湾的分红、上市公司合并财报信息以及有条件委任董事外，暂不行使其他股东权利，如确有必要行使其他股东权利时，应事先向商务部提出申请并证明不会损害与晨星台湾的相互独立和有效竞争，基于此，目前联发科决定晨星台湾财务和经营政策的权利受限。

晨星半导体主要通过控股子公司晨星台湾从事显示器、通讯网络相关芯片的研发设计及销售。根据中银律师事务所（台北）2016年2月1日出具的《联发科技股份有限公司间接在大陆地区投资深圳市汇顶科技股份有限公司之法律意见书》，晨星台湾产品中，智能手机电容式单层单指触控屏幕控制芯片、电容式触控屏幕控制芯片、智能手机电容式单层多指触控屏幕控制芯片、平板电脑电容式单层多指触控屏幕控制芯片和智能手机 On-cell 触控屏幕控制芯片与汇顶科技存在竞争关系；在晨星台湾正在开发的产品中，指纹识别芯片与汇顶科技存在潜在竞争关系。经保荐机构和发行人律师核查，报告期内，晨星台湾与汇顶科技上述存在竞争关系的产品不存在重合的直接客户（包括经销商、模组厂、整机厂商等），重合的供应商为4家，晨星台湾和汇顶科技向该等重合供应商采购金额占各自采购总额的比重均很低。

根据联发科2015年2月出具的承诺，前述产品不属于《决定》中需并入联发科的手机芯片及其他无线通信业务范畴，目前仍由晨星台湾拥有并运营。就此，联发科需取得商务部同意后，与晨星台湾协商，将晨星台湾与汇顶科技构成竞争或潜在竞争的产品业务出售给联发科或第三方，联发科就此事宜出具承诺：如经相关主管机关同意晨星台湾可出售与汇顶科技存在竞争或潜在竞争的产品业务给联发科，联发科同意于取得相关竞争性资产决策权后三至六个月内，在并购相关主管机关同意且无其他任何法规、命令限制时，处分上述产品业务，否则其将承担相应的法律责任。

2015年8月，联发科已正式向商务部提出书面申请，请商务部确认其可向晨星台湾购买与汇顶科技存在竞争或潜在竞争关系的产品业务，截至2016年2月1日，尚未获得商务部的回复。未来如果商务部同意联发科的申请，其将切实履行上述2015年2月作出的承诺。

为进一步明确承诺的可实施性，联发科于2016年2月重新出具承诺：除非商务部延长独立竞争期限，联发科预计将于2016年9月独立竞争期限到期后向商务部申请解除合并限制，如取得同意则将取得晨星台湾完全控制权。因此未来在取得并购相关主管机关必要同意后，处分晨星台湾相关竞争性资产具有可行性，预计可于2017年3月起启动处分程序，处分程序最晚在2个月内完成，否则其将承担相应的法律责任。

此外，2015年8月26日，台湾上市驱动IC厂商奕力科技股份有限公司(3598.TW, 以下简称“奕力”)发布公告，晨星台湾旗下子公司晨发科技股份有限公司将以每股51

元价格，取得奕力全部股权，奕力及晨发科技股份有限公司董事会、股东会已依相关法令决议通过该合并案，预计 2016 年第二季完成合并，届时，奕力将成为联发科合并范围内的子公司。经核查公开资料并经联发科书面确认，（1）晨星台湾目前处于独立运营期，该收购决策是由晨星台湾自主决策，并非联发科决策；（2）奕力的主营业务是 TFT LCD 面板驱动芯片，但其现有产品线及未来研发产品线包括电容触控芯片，与汇顶科技存在竞争关系。为妥善解决收购完成后可能产生的同业竞争问题，联发科于 2016 年 2 月出具承诺，在晨星台湾收购奕力完成，且晨星台湾独立运营期限到期后，其将参照晨星台湾触控芯片和指纹芯片等与汇顶科技存在竞争或潜在竞争关系的竞争性资产的处理方式（包括解决方案、解决时间和责任承担方式），妥善处置奕力的竞争性资产，消除其与汇顶科技的竞争，否则其将承担相应的法律责任。

（二）发行人控股股东、实际控制人及其他重要股东作出的避免同业竞争的承诺

发行人控股股东、实际控制人张帆出具承诺函，承诺：“本人未通过任何形式（包括但不限于投资、任职、为自己或为他人经营等方式）直接或间接从事与发行人所经营业务相同或类似的业务，与发行人不存在现实或潜在的同业竞争。未来，在本人作为发行人持股 5% 以上的主要股东或在发行人（包括子公司）任职期间，本人亦不会以任何方式直接或间接经营与发行人所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人亦承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争。本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺的约束；如因违背上述承诺而给发行人造成任何损失，本人愿承担相应的法律责任。”

发行人主要股东汇发国际出具承诺函，承诺：“截至本《承诺函》出具日，本公司及本公司直接、间接控制的公司未从事与汇顶科技构成竞争或可能构成竞争的业务。在本公司直接和间接持有汇顶科技 5% 及以上股权时，本公司将不以任何方式直接、间接从事公司从事的基于固定电话芯片技术和电容触控芯片技术产生的相同或相类似芯片产品的经营业务，以避免对汇顶科技构成竞争或可能构成竞争，并将促使本公司直接、间接控制的公司比照前述规定履行不竞争的义务。如本公司或本公司直接、间接控制的公司违反前述不竞争义务，应于合理期限内予以改正，否则将承担相应的法律责任。”

汇发国际的实际控制人联发科已于 2015 年 2 月出具承诺函，承诺：“截至本《承诺函》出具日，除晨星台湾外，本公司及本公司纳入合并报表范围内的子公司未从事与汇顶科技构成竞争或可能构成竞争的业务。在本公司直接和间接持有汇顶科技 5% 及以上股权时，本公司将不以任何方式直接、间接从事公司从事的基于固定电话芯片技术、电容触控芯片技术和指纹识别芯片技术产生的相同或相类似芯片产品的经营业务，以避免对汇顶科技构成竞争或可能构成竞争，并将促使本公司纳入合并报表范围内的子公司比照前述规定履行不竞争的义务。如本公司或本公司纳入合并报表范围内的子公司违反前述不竞争义务，应于合理期限内予以改正，否则将承担相应的法律责任。”

本公司于 2014 年 2 月 5 日因完成并购晨星半导体合并案，取得晨星台湾 99.99% 的股权。根据商务部《关于附加限制性条件批准联发科技股份有限公司吸收合并开曼晨星半导体公司经营者集中反垄断审查决定的公告》（商务部公告 2013 年第 61 号），合并完成后，晨星半导体的手机芯片及其他无线通信业务并入本公司，液晶电视主控芯片及其他业务由晨星半导体的子公司晨星台湾拥有并运营，并需在 3 年内与本公司联发科保持独立竞争。本公司确认晨星台湾与汇顶科技存在竞争关系的电容式单层单指触控屏幕控制芯片、电容式触控屏幕控制芯片业务、智能手机电容式单层多指触控屏幕控制芯片、平板电脑电容式单层多指触控屏幕控制芯片和智能手机 On-cell 触控屏幕控制芯片和晨星台湾正在开发的、与汇顶科技存在潜在竞争关系的指纹识别芯片业务均不属于手机芯片及其他无线通信业务的范畴，目前仍由晨星台湾拥有并独立运营；由于本公司仅能根据商务部的上述决定行使晨星台湾的有限股东权利，即除取得晨星台湾的分红、上市公司合并财报信息以及有条件委任董事外，暂不行使其他股东权利，如确有必要行使其他股东权利时，应事先向商务部提出申请并证明不会损害与晨星台湾的相互独立和有效竞争，因此本公司决定晨星台湾的财务和经营政策的权利受限。

如晨星台湾经相关主管机关同意可出售与汇顶科技存在竞争关系或潜在竞争关系的产品业务给本公司，本公司同意于取得相关竞争性资产决策权后三至六个月内，在并购相关主管机关同意且无其他任何法规、命令限制时，处分上述两类产品业务，否则本公司将承担相应的法律责任。”

汇发国际的实际控制人联发科已于 2016 年 2 月出具承诺函，承诺：“除非中国商务部延长独立竞争期限，本公司预计将于 2016 年 9 月独立竞争期限到期后向中国商务部申请解除合并限制，如取得同意则得以取得晨星台湾完全控制权。因此未来在取得并购

相关主管机关必要同意后，处分晨星台湾相关竞争性资产具有可行性，预计可于 2017 年 3 月起启动处分程序，处分程序最晚在 2 个月内完成，否则本公司将承担相应之法律责任。

在晨星台湾收购奕力完成，且晨星台湾独立运营期限到期后，本公司将参照晨星台湾触控芯片和指纹芯片等与汇顶科技存在竞争或潜在竞争关系的竞争性资产的处理方式（包括解决方案、解决时间和责任承担方式），妥善处置奕力的竞争性资产，消除本公司与汇顶科技的竞争，否则本公司将承担相应之法律责任。”

发行人主要股东汇信科技出具承诺函，承诺：“本公司未通过任何形式直接或间接从事与汇顶科技所经营业务相同或类似的业务，与汇顶科技不存在现实或潜在的同业竞争。未来，在本公司持有汇顶科技 5% 以上股份期间，本公司亦不会以任何方式直接或间接经营与汇顶科技所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。如汇顶科技进一步拓展其业务范围，本公司亦承诺不会以任何方式直接或间接经营与汇顶科技拓展后业务相竞争的业务。如上述承诺与事实不符，本公司愿承担相应的法律责任。”

发行人主要股东惠邦投资出具承诺函，承诺：“本公司未通过任何形式直接或间接从事与汇顶科技所经营业务相同或类似的业务，与汇顶科技不存在现实或潜在的同业竞争。未来，在本公司持有汇顶科技股份不变及增持的情况下，本公司亦不会以任何方式直接或间接经营与汇顶科技所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。如汇顶科技进一步拓展其业务范围，本公司亦承诺不会以任何方式直接或间接经营与汇顶科技拓展后业务相竞争的业务。如上述承诺与事实不符，本公司愿承担相应的法律责任。”

三、关联方、关联关系及关联交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的规定，截至本招股说明书签署之日，发行人的关联方及关联关系如下：

1、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

本次发行前，张帆持有公司 21,535.60 万股，持股比例为 53.8390%，是公司的控股股东及实际控制人。张帆的基本情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管

理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“（一）董事”。

截至本招股说明书签署之日，张帆除持有公司 53.8390%的股份外，未直接或者间接控制其他企业。

2、公司的控股企业、合营企业和联营企业

截至本招股说明书签署之日，公司拥有四家全资子公司汇芯科技、汇顶香港、汇顶美国、金慧通，一家控股子公司易易非凡，无合营和联营企业。

3、其他持有 5%以上股份的股东

股东名称	持股比例（%）	与发行人关系
汇发国际	23.7415	持有 5%以上股份的股东
汇信科技	11.4005	持有 5%以上股份的股东

4、其他关联方

（1）其他关联自然人

序号	关联自然人姓名	与发行人关系
1	朱星火	发行人的董事
2	杨奇志	发行人的董事
3	游人杰	发行人的董事
4	郭磊明	发行人的独立董事
5	王建新	发行人的独立董事
6	张波	发行人的独立董事
7	颜彦	发行人的监事
8	陈恒真	发行人的监事
9	王营	发行人的监事
10	龙华	发行人的副总经理
11	邓耿淳	发行人的副总经理
12	廖崇清	发行人的副总经理、财务负责人兼董事会秘书
13	柳玉平	发行人的副总经理
14	刘锡麟	过去十二个月曾任发行人监事
15		张帆及前述人员关系密切的家庭成员

（2）其他关联企业

序号	关联法人名称	关联关系
1	汇持科技	虽未直接持有发行人 5% 以上的股份，但由关联自然人龙华担任其执行董事兼总经理的法人股东
2	惠邦投资	持有发行人 4.996% 的股份，根据实质重于形式的原则，确定其为关联方
3	汇恒源	关联自然人邓耿淳担任董事长、总经理的公司
4	汇恒创	关联自然人廖崇清担任执行董事及总经理的公司
5	汇恒智	关联自然人廖崇清担任执行董事及总经理的公司
6	深圳市成电新电子技术有限公司	关联自然人张林（张帆的弟弟）持股 60% 并担任执行董事兼总经理的公司
7	联发科	汇发国际的实际控制人
8	MediaTek Investment Singapore Pte.Ltd	联发科所控制的企业，间接持有汇发国际 100% 的股份
9	讯发有限公司	联发科所控制的企业，间接持有汇发国际 100% 的股份
10	Gold Rich International (Samoa) Limited	联发科所控制的企业，直接持有汇发国际 100% 的股份
11	联发芯软件设计（成都）有限公司	联发科所控制的企业，与公司存在关联交易
12	联发通讯科技（苏州）有限公司	董事游人杰担任董事长的公司
13	MediaTek Korea Inc.	董事游人杰担任董事的公司
14	翔发投资股份有限公司	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司
15	旭达投资股份有限公司	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司
16	晓明国际股份有限公司	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司
17	SMARTHEAD LIMITED	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司
18	T-Rich Technology (Cayman) Corp.	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司
19	MediaTek Wireless FZ-LLC (Dubai)	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司
20	MediaTek Wireless Finland Oy	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司
21	Cloud Ranger Limited	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司
22	Gold Rich Internatioal (Samoa) Limited	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司
23	Lepower Limited	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司
24	联发利宝（香港）有限公司	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司
25	奕微科半导体科技（股）公司	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司
26	E-Vehicle Holdings Corp.	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司
27	E-Vehicle Investment Limited	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司
28	MediaTek India Technology Pvt.Ltd	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司
29	常忆科技股份有限公司	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司

序号	关联法人名称	关联关系
30	Digital Lord Limited	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司
31	中华精测科技股份有限公司	发行人监事陈恒真担任法人董事代表人的公司
32	深圳市中育培智资讯有限公司	董事杨奇志及其妻子合计持股 100%的公司
33	万商天勤（深圳）律师事务所	独立董事郭磊明担任合伙人律师的事务所
34	湖北金环股份有限公司	独立董事郭磊明担任独立董事的公司
35	常州光洋轴承股份有限公司	独立董事郭磊明担任独立董事的公司
36	恒康医疗集团股份有限公司	独立董事郭磊明担任独立董事的公司
37	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	独立董事王建新担任合伙人的会计师事务所
38	中航地产股份有限公司	独立董事王建新担任独立董事的公司
39	广东海印集团股份有限公司	独立董事王建新在过去十二个月内曾担任独立董事的公司
40	重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司	独立董事王建新担任独立董事的公司
41	成都芯成微电子有限责任公司	独立董事张波的妻子马文莹持股 51%且担任执行董事、总经理的公司
42	四川和芯微电子股份有限公司	独立董事张波担任独立董事的公司
43	深圳深爱半导体股份有限公司	独立董事张波担任独立董事的公司
44	江苏中科君芯科技有限公司	独立董事张波担任董事长的公司

注 1：惠邦投资对发行人持股比例接近 5%，出于谨慎考虑，将其视同为关联方；

注 2：本公司主要股东汇发国际只是持股平台，出于谨慎考虑，将直接、间接控制汇发国际的 Gold Rich International (Samoa) Limited、MediaTek Investment Singapore Pte.Ltd、讯发有限公司、联发科列为关联方；

注 3：联发芯软件设计（成都）有限公司系联发科所控制并纳入合并报表范围内的企业，因报告期内与公司存在关联交易，出于谨慎考虑，将其列为关联方；

注 4：广东海印集团股份有限公司系过去十二个月独立董事王建新曾担任独立董事的公司，出于谨慎考虑，将其列为关联方。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

2011 年 8 月 1 日，公司与联发科签订《Software License and Cooperation Agreement》，约定联发科非独占地许可汇顶科技使用部分联发科拥有知识产权的程序及文档，主要目的是使包括汇顶科技在内的相关硬件厂商的产品能够与联发科的芯片产品兼容，该等许可安排属于行业惯例，不涉及许可费用。该协议规定除非协议双方终止协议，该协议始终有效。2011 年 11 月，联发科实际控制的汇发国际成为持有公司股份超过 5%的主要股东，上述协议的履行构成关联交易。

根据公司与联发科于 2014 年 1 月 7 日签订的《软件授权合作协议书》以及双方于 2014 年 5 月 20 日签订并追溯至 2014 年 1 月 8 日生效的《软件授权合作协议书补充协议》的约定，由汇顶科技将其独立开发并拥有自主知识产权的许可软件，以独家、不可转让、可再授权的方式在特定的许可范围内无偿许可给联发科，双方合作将许可软件集成至联发科的软件解决方案中向许可厂商进行推广和发布。发行人和联发科对来自于该等许可厂商的许可软件权利净收入依此规定平均分配（即联发科将许可软件权利净收入的 50%，按规定在台湾当地代扣代缴 20% 所得税后支付给汇顶科技）：（1）当授权的许可厂商为供应商时，联发科授权供应商使用许可软件的许可使用费，每软件解决方案不得低于 40 万美金；（2）当授权的许可厂商为客户时，联发科授权该客户使用许可软件的许可使用费，每软件解决方案不得低于 5,000 美金，但公司同意联发科因合作需要授权某些特定客户使用许可软件不收取许可使用费。上述协议有效期为 5 年，如协议届满前 60 日任何一方未书面通知对方终止，则协议自动续展 1 年。截至本招股说明书签署之日，公司就该协议的履行而取得净收入 16 万美元。

2016 年 1 月 15 日，联发芯软件设计（成都）有限公司（以下简称“联发芯”）作为出租方与承租方深圳市汇顶科技股份有限公司成都分公司（以下简称“成都分公司”）签署《房屋租赁合同》，约定联发芯将其位于成都市高新区天府五街 168 号联发芯软件设计（成都）有限公司新大楼第九层 1,978.67m² 房屋租赁给成都分公司用于办公、研发，租赁保证金为人民币 742,001.25 元，租金为每月 247,333.75 元（即每月每平方米 125 元，其中含每平方米 15 元的物业服务费），租金支付方式为按季提前 5 日支付，租赁期限自 2016 年 1 月 15 日至 2018 年 1 月 14 日。

报告期内，公司除履行上述合同及向董事、监事、高级管理人员及关联自然人张林支付薪酬外，与各关联方不存在其他经常性关联交易；且除前述交易外，发行人与联发科之间亦不存在其他业务合作。

2、偶发性关联交易

报告期内，公司与各关联方不存在偶发性关联交易。

（三）关联交易决策权限与程序的规定

为规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的相关规

定，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等公司制度中对关联方及关联交易的类型、关联方的回避措施、关联交易的披露及独立董事的作用等方面进行了严格规定。

1、《公司章程》对于关联交易的有关规定

《公司章程》第三十五条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

《公司章程》第三十六条规定：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(1) 审议公司与关联人发生的交易（获赠现金资产、提供担保以及单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；

(2) 审议因董事会审议关联交易事项时，出席董事会的非关联董事人数不足三人的事项；

(3) 审议公司与关联人进行与日常经营相关的关联交易事项（包括：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；在关联人财务公司存款；与关联人共同投资）时，金额达到本条第（1）项的规定或签订没有具体交易金额的日常关联交易协议的事项；

(4) 审议公司拟购买关联人资产价格超过账面值 100% 的重大关联交易；

《公司章程》第三十七条规定：公司对关联方以及持股 5% 以下的股东提供的担保须经股东大会审议通过。

《公司章程》第七十四条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

董事会应对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。

审议关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如下：

(1) 与股东大会审议的事项有关联关系的股东，应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系并主动申请回避；

(2) 股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并对关联股东与关联交易事项的关联关系进行解释和说明；

(3) 大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决；

(4) 关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过；如该交易事项属本章程第七十二条规定的特别决议事项，应由出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

关联股东未主动申请回避的，其他参加股东大会的股东或股东代表有权要求关联股东回避；如其他股东或股东代表提出回避请求时，被请求回避的股东认为自己不属于应回避范围的，应由股东大会会议主持人根据情况与现场董事、监事及相关股东等会商讨论并作出是否回避的决定。

应予回避的关联股东可以参加审议与其有关联关系的关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但该股东无权就该事项参与表决。

《公司章程》第一百条规定：董事会在公司股东大会的授权范围内，审议：（1）除需经公司股东大会审议批准以外的关联交易事项，即公司与关联自然人发生的金额在30万元以上以及与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项；（2）除需提交股东大会审议外的公司与关联人发生的日常关联交易事项（包括：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；在关联人财务公司存款；与关联人共同投资）。

《公司章程》第一百一十二条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

《公司章程》第一百三十四条规定：监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、《股东大会议事规则》对于关联交易的有关规定

《股东大会议事规则》第四条规定：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(1) 审议公司与关联人发生的交易（获赠现金资产、提供担保以及单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；

(2) 审议因董事会审议关联交易事项时，出席董事会的非关联董事人数不足三人的事项；

(3) 审议公司与关联人进行与日常经营相关的关联交易事项（包括：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；在关联人财务公司存款；与关联人共同投资）时，金额达到本条第（1）项的规定或签订没有具体交易金额的日常关联交易协议的事项；

(4) 审议公司拟购买关联人资产价格超过账面值 100% 的重大关联交易。

《股东大会议事规则》第四十一条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

3、《董事会议事规则》对于关联交易的有关规定

《董事会议事规则》第六条规定：

(1) 董事会在公司股东大会的授权范围内，审议除需经公司股东大会审议批准以外的关联交易事项，即公司与关联自然人发生的金额在 30 万元以上以及与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项；

(2) 审议除需提交股东大会审议外的公司与关联人发生的日常关联交易事项（包括：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；在关联人财务公司存款；与关联人共同投资）。

4、《独立董事工作制度》对于关联交易的有关规定

《独立董事工作制度》第二十条规定：重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于本公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

《独立董事工作制度》第二十一条规定：独立董事应当对涉及关联交易的以下重大事项发表独立意见：

(1) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来；公司是否采取有效措施回收欠款；以及公司向股东、实际控制人及其关联企业提供资金；

(2) 公司拟与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的重大关联交易，以及公司购买关联人资产的价格超过账面值 100%的重大关联交易；

(3) 公司关联方以资抵债方案。

5、《关联交易管理制度》对于关联交易的有关规定

《关联交易管理制度》第二条规定：公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。

《关联交易管理制度》第四条规定：公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

《关联交易管理制度》第十七条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如下：股东大会审议有关关联交易事项时，有关关联关系的股东应当回避；关联股东未主动回避，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避，不参与投票表决。会议需要关联股东到会进行说明的，关联股东有责任和义务到会如实作出说明；有关关联关系的股东回避和不参与投票表决的事项，由会议主持人在会议开始时宣布并在表决票上作出明确标识。

《关联交易管理制度》第二十九条规定：公司拟购买关联人资产的价格超过账面值100%的重大关联交易，公司除公告溢价原因外，应当为股东参加股东大会提供网络投票或者其他投票的便利方式。

《关联交易管理制度》第三十三条规定：公司在审议关联交易事项时，应由独立董事事前认可（需取得全体独立董事的二分之一以上同意，对外担保的关联交易需取得全体独立董事三分之二以上同意）后，方可按权限提交董事会或股东大会审议。独立董事在审查关联交易时，应当就该交易是否有利于公司和全体股东的利益发表独立意见。独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据，所需费用由公司承担。

《关联交易管理制度》第三十四条规定：公司审计委员会应当同时对关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。公司监事会应当对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并在年度报告中发表意见。

6、《对外担保管理制度》对于关联交易的有关规定

《对外担保管理制度》第十七条规定：公司对外担保涉及关联交易的，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，该董事会会议由过半数无关联关系的董事出席即可举行，董事会所作决议须经无关联关系董事过半数通过，并经出席董事会的三分之二以上无关联关系董事以及全体独立董事的三分之二以上书面同意。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该项提交股东大会审议。

《对外担保管理制度》第十九条规定：股东大会审议担保，应经出席股东大会所持表决权的过半数通过；对按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为关联方以及持股5%以下的股东提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东审议通过。

（四）关联交易履行程序情况及独立董事意见

1、关联交易履行程序情况

报告期内，发行人就关联交易履行具体会议审议程序如下：

（1）与联发科签订相关协议

2013年12月10日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司与联发科技股份有限公司签署软件授权合作协议的议案》。

2013年12月25日，公司召开2013年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司与联发科技股份有限公司签署软件授权合作协议的议案》。

2014年4月18日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司与联发科技股份有限公司签署软件授权合作补充协议的议案》。

2014年5月5日，公司召开2014年度第二次临时股东大会，审议通过《关于公司与联发科技股份有限公司签署软件授权合作补充协议的议案》。

（2）与联发芯签署租赁合同

2015年12月23日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

（3）向公司董事、监事、高级管理人员支付薪酬

1) 2013年2月28日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会召开第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员绩效考核的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。

2013年2月28日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。

2) 2014年1月28日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会召开第二次会议，审议通过《关于公司高级管理人员绩效考核的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。

2014年1月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。

3) 2015年2月28日,公司第一届董事会薪酬与考核委员会召开第三次会议,审议通过《关于公司高级管理人员绩效考核的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。

2015年2月28日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。

4) 2015年8月15日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于提请股东大会确定第二届董事会董事和监事会股东代表监事薪酬的议案》。

2015年8月31日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过《关于确定第二届董事会董事和监事会股东代表监事薪酬的议案》。

5) 2016年2月5日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会召开第一次会议,审议通过《关于公司高级管理人员绩效考核的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。

2016年2月5日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。

(4) 向关联自然人张林支付薪酬

2013年10月8日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过《关于聘用关联人张林及拟定其薪酬的议案》。

2015年2月28日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过《关于确认关联人张林2014年度薪酬的议案》。

2016年2月5日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于确认关联人张林2015年度薪酬的议案》。

综上所述,发行人报告期内与关联方之间发生的关联交易均履行了相应的法律程序,关联董事或股东在审议相关关联交易议案时回避表决,关联交易的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

2、独立董事意见

(1) 2014年8月8日,发行人独立董事出具独立意见,具体如下:

1) 关联交易的事项

2012年至2014年，公司与关联方之间不存在偶发性关联交易，经常性关联交易包括：1) 履行与联发科签订的《Software License and Cooperation Agreement》，由联发科无偿、非独占地许可公司使用部分联发科拥有知识产权的程序及文档；2) 履行与联发科签订的《软件授权合作协议书》及《软件授权合作协议书补充协议》，由公司将独立开发并拥有自主知识产权的许可软件，以独家、不可转让、可再授权的方式在特定的许可范围内无偿许可给联发科，双方合作将许可软件集成至联发科的软件解决方案中向许可厂商进行推广和发布。公司和联发科对来自于该等许可厂商的许可软件权利金收入按照一定原则进行平均分配；3) 2012年至2014年，公司向公司的董事、监事、高级管理人员支付薪酬。除履行上述合同及向董事、监事、高级管理人员支付薪酬外，公司与各关联方不存在其他经常性关联交易或偶发性关联交易。

2) 关联交易的公允性

公司与联发科于2011年8月签订《Software License and Cooperation Agreement》，主要目的是使包括公司在内的相关硬件厂商的产品能够与联发科的芯片产品兼容；许可的对象是包括公司在内的相关硬件厂商；该等许可安排属于行业惯例，不涉及许可费用，不存在损害公司及其股东利益的情形。

公司与联发科于2014年1月签订《软件授权合作协议书》，主要目的是双方利用各自在智能终端芯片领域的技术优势以及联发科的品牌影响力，合作推广基于电容检测的电容屏通信技术。公司未向联发科收取软件许可费用，但双方对许可客户的权利金收入进行平均分配，条件公允，不存在损害公司及其股东利益的情况。

公司与联发科于2014年5月签订并追溯至2014年1月生效的《软件合作协议书补充协议》，系为就上述《软件授权合作协议书》之关联交易中合作费用条款的修改，修改后双方对许可客户的权利金收入依照一定的原则进行分配，该等分配原则、分配条件公允，不存在损害公司及其股东利益的情况。

公司于2012年至2014年向董事、监事、高级管理人员发放薪酬之薪酬水平系依据公司所处行业及地区的薪酬水平并结合公司经营的实际情况拟定，不存在损害公司及其股东利益的情形，有利于调动董事、监事、高级管理人员的积极性，符合公司的长远发展。

3) 关联交易的审议程序

上述关联交易的审议程序符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部治理文件的规定。

(2) 2015年2月28日，发行人独立董事出具独立意见，具体如下：

1) 新增关联交易事项

公司依据有关薪酬制度的规定及有关绩效考核的结果，于2014年度共计向关联自然人张林支付薪酬人民币48.68万元（含税）。

除上述及向公司董事、监事、高级管理人员支付薪酬外，2014年度期间，公司与各关联方不存在其他经常性关联交易或偶发性关联交易。

2) 关联交易的公允性

公司向关联自然人支付薪酬符合公司相关薪酬制度的规定，亦符合公司绩效考核要求，经考察关联自然人张林2014年度薪酬与公司相同岗位，具有类似履历其他员工薪酬水平相当，且该事项已经第一届董事会第十八次会议确认并审议通过。

(3) 2015年8月15日，发行人独立董事出具独立董事意见，具体如下：

1) 关联交易事项

2015年1-6月份，公司与关联方之间不存在新增偶发关联性交易，新增经常性关联交易情况如下：1) 公司依据有关薪酬制度的规定，于2015年1-6月向关联自然人张林支付薪酬；2) 2015年1-6月份公司向公司的董事、监事、高级管理人员支付薪酬构成关联交易。除向董事、监事、高级管理人员、关联自然人张林支付薪酬外，2015年1-6月，公司与各关联方不存在其他新增经常性关联交易或偶发性关联交易。

2) 关联交易的公允性

公司向公司的董事、监事、高级管理人员发放薪酬之薪酬水平系依据公司所处行业及地区的薪酬水平并结合公司经营的实际情况拟定，不存在损害公司及其股东利益的情形，有利于调动董事、监事、高级管理人员的积极性，符合公司的长远发展。公司关联自然人张林的薪酬与公司相同岗位、具有类似履历的其他员工薪酬水平相当。

3) 关联交易的审议程序

该等关联交易的审议程序符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部治理文件的规定。

(4) 2015年12月23日，发行人独立董事就公司第二届董事会第三次会议相关事项出具独立董事意见，具体如下：

公司与联发芯发生的关联租赁事宜符合公司实际生产经营需要，且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条款公允、合理，交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司非关联股东利益的情形。同意公司与联发芯进行的关联交易。董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事游人杰依法回避表决，会议审议程序符合《公司法》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定。

(5) 2016年2月5日，发行人独立董事出具独立意见，具体如下：

1) 关联交易事项

2015年度，公司向公司的董事、监事、高级管理人员支付薪酬以及根据相关薪酬制度的规定及有关绩效考核结果向关联自然人张林共计支付薪酬人民币55.62万元（含税），构成关联交易。

2) 关联交易公允性

公司于2015年度向董事、监事、高级管理人员发放薪酬之薪酬水平系依据公司所处行业及地区的薪酬水平并结合公司经营的实际情况拟定，不存在损害公司及其股东利益的情形，有利于调动董事、监事、高级管理人员的积极性，符合公司的长远发展。

公司于2015年度向关联自然人张林支付的薪酬符合公司相关薪酬制度的规定，亦符合公司绩效考核要求，同时关联自然人张林2015年度薪酬与公司相同岗位、类似履历的其他员工薪酬水平相当。

3) 关联交易审议程序

认可公司于2015年度新发生的上述关联交易，相关关联交易的审议程序亦符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部治理文件的规定。

（五）规范和减少关联交易的措施

对于公司未来可能发生的关联交易，公司将严格执行相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司上市地上市规则的要求以及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，并通过独立董事对关联交易的监督，保障关联交易的合理、公平和透明。

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介

公司现有董事 7 名（其中独立董事 3 名），监事 3 名（其中职工监事 1 名），高级管理人员 5 名（其中总经理 1 名、副总经理 4 名、财务负责人兼董事会秘书由 1 名副总经理兼任），核心技术人员 6 名。

公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的具体情况如下：

（一）董事

公司董事会由张帆、朱星火、杨奇志、游人杰、郭磊明、王建新、张波 7 人组成，其中郭磊明、王建新、张波为独立董事，全部董事均由股东大会选举产生，不存在由关联人直接或间接委派的情况。

1、张帆

张帆，男，1965 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于电子工业部第十研究所、日本北陆电器株式会社深圳办事处、深圳市成电新电子有限公司。2002 年 5 月至今，参与创办汇顶有限，历任执行董事、总经理等职务；现任公司董事长兼总经理，汇顶美国董事。其在发行人的董事、总经理任期自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日。

2、朱星火

朱星火，男，1962 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于中南大学、珠海东发电子公司、深圳成电新电子有限公司。2002 年 5 月至今，参与创办汇顶有限，历任监事、董事、知识产权顾问等职务；现任公司董事，任期自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日。

3、杨奇志

杨奇志，男，1965 年生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾就职于成都电焊条厂、深圳大学、成都华美电子科技有限公司、深圳市成电新电子有限公司。2011 年 4 月至今任深圳市中育培智资讯有限公司监事。2002 年 5 月至今，参与创办汇

顶有限，历任董事、销售顾问等职务；现任公司董事，任期自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日。

4、游人杰

游人杰，男，1971 年生，中国台湾籍，硕士研究生学历。曾就职于建碁科技股份有限公司、联积科技股份有限公司。2001 年 7 月至今历任联发科事业部总经理、副总经理；现任公司董事，任期自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日。

5、郭磊明

郭磊明，男，1974 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于深圳经济特区发展（集团）公司。2000 年 11 月至今任万商天勤（深圳）律师事务所律师、合伙人。2012 年 9 月至今任公司独立董事，任期自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日。

6、王建新

王建新，男，1970 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师、注册会计师。曾就职于深圳蛇口信德会计师事务所、安永会计师事务所、平安证券有限责任公司、北京立信会计师事务所。2006 年 12 月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2012 年 9 月至今任公司独立董事，任期自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日。

7、张波

张波，男，1964 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任电子科技大学教师、美国 Virginia 理工大学访问教授，1999 年 11 月至今任电子科技大学教授，1999 年 11 月至 2015 年 12 月任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长，2015 年 6 月至今任江苏中科君芯科技有限公司董事长；2012 年 9 月至今任公司独立董事，任期自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日。

（二）监事

公司监事会由颜彦、陈恒真、王营 3 名监事组成，其中，颜彦由职工代表大会选举产生，陈恒真、王营由股东大会选举产生，不存在由关联人直接或间接委派的情况。

1、颜彦

颜彦，男，1983年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月大学毕业至今历任公司软件工程师、固网开发项目经理、技术支持经理、软件开发部总监、监事等职务；现任公司项目管理部总监、监事会主席。颜彦为公司职工监事，其任期自2015年8月31日至2018年8月30日。

2、陈恒真

陈恒真，女，1967年生，中国台湾籍，本科学历。曾就职于致远联合会计师事务所、香港商思捷股份有限公司、摩根大通银行台北分行、国巨股份有限公司，2008年至今任职于联发科技股份有限公司；现任公司监事，任期自2015年8月31日至2018年8月30日。

3、王营

王营，女，1986年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月大学毕业至今历任公司硬件工程师、TP模组设计工程师、客户项目管理部经理、汇芯科技监事及客户项目管理部经理；现任公司监事、汇芯科技技术支持部总监兼客户项目管理部经理。其监事任期自2015年8月31日至2018年8月30日。

（三）高级管理人员

1、张帆

张帆为公司总经理，其简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“（一）董事”。

2、龙华

龙华为公司副总经理，男，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于江西省赣新电视有限公司、江西省吉安市农村信用合作社、深圳市成电新电子技术有限公司。2002年至今历任公司硬件部经理、研发部经理、产品部经理、副总经理等职务；现任公司副总经理、汇持科技执行董事、总经理、汇信科技董事、汇恒创监事。其副总经理任期自2015年8月31日至2018年8月30日。

3、邓耿淳

邓耿淳为公司副总经理，男，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月大学毕业至今历任公司软件工程师、项目经理、技术与产品开发部经理、副总经理及汇信科技执行董事等职务；现任公司副总经理、汇信科技董事长、总经理、汇恒源董事长、总经理。其副总经理任期自2015年8月31日至2018年8月30日。

4、廖崇清

廖崇清为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书，男，1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于中国农业银行福建宁化支行、深圳市豪风实业发展有限公司、深圳市豪威科技有限公司、深圳市同洲电子股份有限公司、深圳市融创天下科技股份有限公司。2012年3月至今历任公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书等职务；现任公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书、汇信科技董事、汇恒创执行董事兼总经理、汇恒智执行董事兼总经理。其副总经理、财务负责人、董事会秘书任期自2015年8月31日至2018年8月30日。

5、柳玉平

柳玉平为公司副总经理，男，1974年出生，中国籍，本科学历。2005年3月至2015年1月历任公司软件工程师、项目经理、品质控制部经理、工程部总监等职务；现任公司副总经理、汇持科技监事，其副总经理任期自2015年8月31日至2018年8月30日。

（四）核心技术人员

发行人核心技术人员包括6名核心技术人员，分别为张帆、朱星火、龙华、邓耿淳、颜彦、冉锐。发行人核心技术人员的有关情况如下：

1、张帆

个人简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“（一）董事”。在公司工作期间，张帆主导和参与公司芯片底层硬件设计及制程选择等基础技术架构的工作，包括固定电话芯片、GT8及GT9系列电容屏触控芯片等产品。张帆系“分体式多媒体电话系统及电话座机”等专利的发明人之一。

2、朱星火

个人简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“(一)董事”。在公司工作期间，朱星火主要参与核心技术方案研究，制定产品功能需求、技术规格与检验标准，参与完成多个创新产品项目，主导完成 GT818 触控芯片产品的研发。朱星火曾获得湖南省科技进步三等奖、中南大学技术成果二等奖、中南大学实验技术成果特等奖等科研奖项；朱星火作为发明人申请的已公告的中国专利目前已达十几项。

3、龙华

个人简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“(三)高级管理人员”。在公司工作期间，龙华主导完成公司核心技术基于互电容检测的 10 点触控技术、电容屏触控芯片的抗干扰技术、电容触摸屏自动参数配置、电容触摸屏传感器自动设计技术、来电显示信号的软件解码技术、高效外线取电技术等研发。龙华系“一种触控设备配置参数的自动生成方法、系统”、“一种触摸屏模组及触摸屏终端”、“一种抗工频及其谐波干扰的信号采样方法及系统”等专利的发明人之一。

4、邓耿淳

个人简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“(三)高级管理人员”。在公司工作期间，邓耿淳主要负责研发管理工作，曾主导完成 HC2006 汇顶 Caller ID 处理软件、HC2007 汇顶通用多功能电话终端管理软件，以及 GT8 系列多点触控芯片的系统设计、软件开发、传感器涉及；主导完成 GF9 系列指纹芯片产品的系统设计、结构设计等工作。邓耿淳系“一种触摸屏终端的唤醒方法及系统”发明专利以及“一种触摸屏模组及触摸屏终端”、“一种电容式触摸传感器、触摸检测装置及触控终端”等多项专利的发明人之一。

5、颜彦

个人简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“(二)监事”。在公司工作期间，颜彦曾主导完成 HC2007、HC78813、HC8030、T12 等固定电话芯片系列产品的开发；主导完成 GT9 系列多点触控芯片的系统设计、软件开发等工作。

6、冉锐

冉锐，男，1979年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于上海普爱尔传感器有限公司。2006年至今历任公司硬件工程师、芯片开发项目组经理、硬件部经理、系统工程部经理、系统工程部总监；现任公司技术总监。在公司工作期间，冉锐主要从事系统硬件架构设计，微弱信号检测与处理等研发工作，曾主导完成“逃生”功能 VoIP 电话机、GT8 系列芯片、主动式触摸笔等项目的研发。

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况

1、直接持股

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下表所示：

姓名	职务	持股数（万股）	持股比例	所持股份是否质押或冻结
张帆	董事长兼总经理	21,535.60	53.8390%	无
朱星火	董事	1,198.76	2.9969%	无
杨奇志	董事	450.40	1.1260%	无

2、间接持股

公司董事、监事、高级管理员及核心技术人员及其近亲属通过汇信科技（包括在汇信科技的直接出资额以及通过汇恒源、汇恒创、汇恒智在汇信科技的间接出资额）、汇持科技间接持有公司股份的情况如下表所示：

姓名	职务	间接持股企业	在间接持股企业出资额（万元）	间接持有汇顶科技股份数（万股）	所持股份是否质押或冻结
颜彦	监事会主席	汇信科技	33.3000	151.8547	无
王营	监事	汇信科技	16.7000	76.1553	无
龙华	副总经理	汇信科技	41.0952	187.4022	无
		汇持科技	42.6463	194.4904	无
邓耿淳	副总经理	汇信科技	69.4994	316.9311	无
廖崇清	副总经理、财务负责人、董事会秘书	汇信科技	75.5224	344.3974	无
柳玉平	副总经理	汇信科技	50.0000	228.0100	无

姓名	职务	间接持股企业	在间接持股企业出资额（万元）	间接持有汇顶科技股份数（万股）	所持股份是否质押或冻结
冉锐	技术总监	汇信科技	33.3000	151.8547	无

（二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属最近三年所持股份变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股比例及变化情况如下表所示：

姓名	2015年12月31日			2014年12月31日			2013年12月31日		
	直接持股（万股）	间接持股（万股）	持股比例（%）	直接持股（万股）	间接持股（万股）	持股比例（%）	直接持股（万股）	间接持股（万股）	持股比例（%）
张帆	21,535.60	-	53.8390	8,883.4350	-	53.8390	8,883.4350	-	53.8390
朱星火	1,198.76	-	2.9969	494.4885	-	2.9969	494.4885	-	2.9969
杨奇志	450.40	-	1.1260	185.7900	-	1.1260	185.7900	-	1.1260
颜彦	-	151.8547	0.3796	-	62.6400	0.3796	-	62.6400	0.3796
王营	-	76.1553	0.1904	-	31.4141	0.1904	-	31.4141	0.1904
龙华	-	381.8926	0.9547	-	158.9810	0.9635	-	174.3168	1.0565
邓耿淳	-	316.9311	0.7923	-	130.7341	0.7923	-	303.2144	1.8377
廖崇清	-	344.3974	0.8610	-	137.9940	0.8363	-	156.6946	0.9497
柳玉平	-	228.0100	0.5700	-	94.0541	0.5700	-	94.0541	0.5700
冉锐	-	151.8547	0.3796	-	62.6400	0.3796	-	62.6400	0.3796

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况

截至本招股说明书签署之日，除本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方、关联关系及关联交易”之“（一）关联方及关联关系”之“4、其他关联方”中披露对外投资情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在对外投资情况。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年的薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员最近一年在公司的薪酬情况如下表所示：

姓名	职务	2015年在本公司领取薪酬（税前/元）	在关联企业领薪情况（元）
张帆	董事长兼总经理	316,164.00	-
朱星火	董事	169,824.00	-
杨奇志	董事	148,800.00	-
游人杰	董事	-	新台币 15,000,000.00
郭磊明	独立董事	99,999.96	-
王建新	独立董事	99,999.96	-
张波	独立董事	99,999.96	-
颜彦	监事会主席	396,900.00	-
刘锡麟	原监事	-	新台币 3,500,000.00
陈恒真	监事	-	新台币 3,500,000.00
王营	监事	295,030.65	-
龙华	副总经理	661,500.00	-
邓耿淳	副总经理	711,416.70	-
廖崇清	副总经理、董事会秘书、财务负责人	516,000.00	-
柳玉平	副总经理	528,796.00	-
冉锐	技术总监	387,386.24	-

截至本招股说明书签署之日，公司不存在其他特殊的待遇和退休金计划。公司董事、监事、高级管理人员报告期内也未在实际控制人及其控制的其他企业领薪。

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况如下表所示：

姓名	公司职务	其他任职单位	现任职务	其他任职单位与公司关系
张帆	董事	汇顶香港	董事	公司全资子公司
		汇芯科技	执行董事、总经理	公司全资子公司
		汇顶美国	董事	公司全资子公司
		金慧通	执行董事、总经理	公司全资子公司
		易易非凡	董事	公司控股子公司
杨奇志	董事	深圳市中育培智资讯有限公司	监事	无业务往来，无持股关系
游人杰	董事	联发科	副总经理	发行人法人股东的实际控

姓名	公司职务	其他任职单位	现任职务	其他任职单位与公司关系
				制人
		联发通讯科技（苏州）有限公司	董事长	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
		MediaTek Korea Inc.	董事	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
郭磊明	独立董事	万商天勤（深圳）律师事务所	合伙人	无业务往来，无持股关系
		常州光洋轴承股份有限公司	独立董事	无业务往来，无持股关系
		湖北金环股份有限公司	独立董事	无业务往来，无持股关系
		恒康医疗集团股份有限公司	独立董事	无业务往来，无持股关系
		深圳市前海精准健康管理有限公司	监事	无业务往来，无持股关系
		广州丰和酒店有限公司	监事	无业务往来，无持股关系
王建新	独立董事	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	无业务往来，无持股关系
		中航地产股份有限公司	独立董事	无业务往来，无持股关系
		重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司	独立董事	无业务往来，无持股关系
张波	独立董事	电子科技大学	教授	无业务往来，无持股关系
		深圳深爱半导体股份有限公司	独立董事	无业务往来，无持股关系
		四川和芯微电子股份有限公司	独立董事	无业务往来，无持股关系
		江苏中科君芯科技有限公司	董事长	无业务往来，无持股关系
陈恒真	监事	联发科	处长	发行人法人股东的实际控制人
		晓明国际股份有限公司	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
		翔发投资股份有限公司	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
		旭达投资股份有限公司	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
		SMARTHEAD LIMITED	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
		T-Rich Technology (Cayman) Corp.	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
		MediaTek Wireless FZ-LLC (Dubai)	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
		MediaTek Wireless Finland Oy	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
		Cloud Ranger Limited	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
		Gold Rich Internatioal (Samoa) Limited	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
		Lepower Limited	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控

姓名	公司职务	其他任职单位	现任职务	其他任职单位与公司关系
				制人控制的企业
		联发利宝（香港）有限公司	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
		奕微科半导体科技（股）公司	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
		E-Vehicle Holdings Corp.	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
		E-Vehicle Investment Limited	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
		汇发国际	法人董事代表人	发行人法人股东
		MediaTek India Technology Pvt.Ltd	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
		常忆科技股份有限公司	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
		Digital Lord Limited	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控制人控制的企业
		中华精测科技股份有限公司	法人董事代表人	发行人法人股东的实际控制人参股的企业
王营	监事	汇芯科技	监事、技术支持部总监兼客户项目管理部经理	公司全资子公司
龙华	副总经理	汇持科技	执行董事、总经理	发行人法人股东
		汇信科技	董事	发行人法人股东
		汇恒创	监事	发行人法人股东的股东
邓耿淳	副总经理	汇信科技	董事长、总经理	发行人法人股东
		汇恒源	董事长、总经理	发行人法人股东的股东
廖崇清	副总经理、董事会秘书、财务负责人	汇信科技	董事	发行人法人股东
		汇恒创	执行董事、总经理	发行人法人股东的股东
		汇恒智	执行董事、总经理	发行人法人股东的股东
柳玉平	副总经理	汇持科技	监事	发行人法人股东

除上述兼职以外，本公司董事、监事、高级管理人员没有在其他单位兼职的情况。

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及做出的重要承诺

（一）协议

公司与同时作为公司员工的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订了《劳动合同》、《竞业限制协议书》、《保密协议》和《知识产权协议》，对职责、权利与义务等作了明确的规定。

（二）重要承诺

公司主要股东和实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函，具体情况请参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（二）发行人控股股东、实际控制人及其他重要股东作出的避免同业竞争的承诺”。

关于公司董事、监事、高级管理人员及核心人员自愿锁定股份的承诺，详细情况请参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

公司主要股东，董事、监事、高级管理人员出具了股价稳定措施的承诺、关于招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺、公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向承诺以及未能履行承诺时的约束措施承诺，具体承诺事项参见本招股说明书“重大事项提示”。

截至本招股说明书签署之日，上述人员均严格遵守并履行了上述承诺。

八、公司董事、监事、高级管理人员任职资格

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的任职资格均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，不存在中国证监会规定的其他不允许担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情况。

九、董事、监事、高级管理人员最近三年变动情况

公司自整体变更设立至今董事、监事和高级管理人员保持稳定，未发生重大变化。公司近三年来董事、监事和高级管理人员变动情况如下表所示：

变动时间	董事	监事	高级管理人员
2012年9月 整体变更	董事长：张帆 董事：朱星火、杨奇志、 游人杰 独立董事：郭磊明、王 建新、张波	颜彦、刘锡麟、 王营	总经理：张帆 副总经理：龙华、邓耿淳、 廖崇清、赵书来 财务负责人：廖崇清 董事会秘书：廖崇清
2015年1月	董事长：张帆 董事：朱星火、杨奇志、 游人杰 独立董事：郭磊明、王 建新、张波	颜彦、刘锡麟、 王营	总经理：张帆 副总经理：龙华、邓耿淳、 廖崇清、柳玉平 财务负责人：廖崇清 董事会秘书：廖崇清
2015年8月	董事长：张帆 董事：朱星火、杨奇志、 游人杰 独立董事：郭磊明、王 建新、张波	颜彦、陈恒真、 王营	总经理：张帆 副总经理：龙华、邓耿淳、 廖崇清、柳玉平 财务负责人：廖崇清 董事会秘书：廖崇清

1、2012年9月，汇顶有限整体变更设立为股份有限公司，公司根据上市公司规范治理要求建立了董事会、监事会和高级管理人员架构。

2、2015年1月，公司副总经理赵书来因个人原因从公司离职，为完善公司高级管理人员架构、加强公司技术管理，公司聘任柳玉平为公司副总经理。

3、2015年8月，公司董事会、监事会换届选举，并由新一届董事会聘任公司高级管理人员。

上述发行人董事、监事、高级管理人员的变化符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，并已履行了必要的法律程序，发行人董事、监事、高级管理人员最近三年未发生重大变化。

第九节 公司治理

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化和高效化。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经理层之间已建立相互协调和相互制衡的运作机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性，公司治理架构能按照相关法律法规和公司章程的规定有效运作。

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

发行人依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

1、股东大会的职权

根据现行有效的《公司章程》的规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （3）审议批准董事会的报告；
- （4）审议批准监事会报告；
- （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(8) 对发行公司债券作出决议；

(9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(10) 修改《公司章程》；

(11) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(12) 审议批准章程规定的担保事项；

(13) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；

(14) 审议公司购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产（获赠现金资产除外）、债权或债务重组（单纯减免公司义务的债务除外）、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等交易涉及的交易金额达到如下标准之一的事项：

1) 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上；

2) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

3) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元；

4) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

5) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；

(15) 审议公司与关联人发生的交易（获赠现金资产、提供担保以及单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；

(16) 审议因董事会审议关联交易事项时，出席董事会的非关联董事人数不足三人的事项；

(17) 审议公司与关联人进行与日常经营相关的关联交易事项（包括：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；在关联人财务公司存款；与关联人共同投资）时，金额达到本条第（十五）项的规定或签订没有具体交易金额的日常关联交易协议的事项；

(18) 审议公司拟购买关联人资产价格超过账面值 100% 的重大关联交易；

(19) 审议公司的股份回购方案；

(20) 审议股权激励计划；

(21) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

公司下列对外担保（含对子公司的担保）行为，须经股东大会审议通过：

(1) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；

(2) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；

(3) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；

(4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；

(5) 对关联方以及持股 5% 以下的股东提供的担保；

(6) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30% 的担保；

(7) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；

(8) 法律、法规及规范性文件规定的其他应由股东大会审议的对外担保行为。

公司对外担保除应当经全体董事的过半数通过外，还应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

股东大会审议本条第（六）款担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为关联方以及持股 5% 以下的股东提供的担保议案时，该股东或者受该股东支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东审议通过。

2、股东大会的议事规则

本公司根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定，结合本公司的实际情况，制定了《股东大会议事规则》。《公司章程》、《股东大会议事规则》对股东大会的召开、召集、提案、通知、审议与表决作出了详细规定，主要内容如下：

(1) 召开：股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。出现《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所，说明原因并公告。

(2) 召集：董事会负责按时召集股东大会。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3；公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时；董事会认为必要时；监事会提议召开时；法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。

(3) 提案：公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容。除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合股东大会议事规则相关条款规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

(4) 通知：召集人应当在年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事、保荐机构发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事、保荐机构的意见及理由。

(5) 审议和表决：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

(6) 决议：股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。下列事项由股东大会以特别决议通过：

- 1) 公司增加或者减少注册资本；
- 2) 公司的分立、合并、解散和清算或者变更公司形式；
- 3) 《公司章程》的修改；
- 4) 公司在一年内购买、出售资产达到或超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；

5) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保;

6) 股权激励计划;

7) 法律、行政法规或公司章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

3、股东大会的运行情况

本公司自创立大会以来共召开了 14 次股东大会, 具体情况如下:

(1) 2012 年 9 月 18 日, 公司召开创立大会暨第一次股东大会, 审议通过《关于深圳市汇顶科技有限公司整体变更为深圳市汇顶科技股份有限公司的议案》、《关于选举深圳市汇顶科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举深圳市汇顶科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《关于设立深圳市汇顶科技股份有限公司董事会专门委员会的议案》、《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》, 以及股东大会、董事会、监事会议事规则草案等议案。

(2) 2012 年 12 月 3 日, 公司召开 2012 年度第一次临时股东大会, 审议通过《关于公司 2012 年第三季度利润分配的议案》以及修订股东大会、董事会、监事会议事规则等议案。

(3) 2013 年 3 月 22 日, 公司召开 2012 年度股东大会, 审议通过《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2013 年度财务预算报告》、《2012 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司购置房产的议案》等议案。

(4) 2013 年 8 月 19 日, 公司召开 2013 年度第一次临时股东大会, 审议通过《关于根据中小企业板相关规定修订公司现行适用〈公司章程〉的议案》、《关于根据中小企业板相关规定修订公司现行适用的需由股东大会通过的公司治理制度的议案》等议案。

(5) 2013 年 9 月 16 日, 公司召开 2013 年度第二次临时股东大会, 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》、《关于公司募集资金投资项目的议案》、《关

于公司募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于公司发行上市前滚存未分配利润分配方案的议案》、《关于授权公司董事会全权办理与发行上市有关事项的议案》、《关于同意发行上市相关议案有效期的议案》、《关于根据中小企业板相关规定制订公司首次公开发行股票并在上市后适用的需由股东大会通过的公司治理制度的议案》等议案。

(6) 2013年12月25日,公司召开2013年度第三次临时股东大会,审议通过《关于公司与联发科技股份有限公司签署软件授权合作协议的议案》等议案。

(7) 2014年2月21日,公司召开2013年度股东大会,审议通过《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》、《2013年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改公司首次公开发行股票并上市的议案》、《关于增加公司募集资金投资项目的议案》、《关于公司募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于本次发行上市相关议案有效期的议案》、《关于修改公司现行以及上市后适用的需由股东大会通过的公司治理制度的议案》、《关于公司上市后稳定公司股价的议案》、《关于公司签署有关承诺函的议案》等议案。

(8) 2014年4月12日,公司召开2014年度第一次临时股东大会,审议通过《关于公司首次公开发行股票并在中小企业板上市涉及相关决议终止或变更的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》、《关于公司募集资金投资项目的议案》、《关于公司募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于公司发行上市前滚存未分配利润分配方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与发行上市有关事项的议案》、《关于本次发行上市相关议案有效期的议案》、《关于根据上交所相关规定修订公司现行适用<公司章程>的议案》、《关于根据上交所相关规定修订公司现行适用的需由股东大会通过的公司治理制度的议案》、《关于根据上交所相关规定制订公司首次公开发行股票并在上市后适用的需由股东大会通过的公司治理制度的议案》等议案。

(9) 2014年5月5日,公司召开2014年度第二次临时股东大会,审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并上市方案的议案》、《关于修改公司募集资金投资项目的议案》等议案。

(10) 2014年8月25日,公司召开2014年度第三次临时股东大会,审议通过《关于修改<公司章程(草案)>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》等议案。

(11) 2015年4月18日,公司召开2014年度股东大会,审议通过《2014年度董事会报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年年度报告》、《2014年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

(12) 2015年8月31日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并上市方案的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会董事的议案》、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于确定第二届董事会董事和监事会股东代表监事薪酬的议案》等议案。

(13) 2016年1月22日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的分析的议案》、《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

(14) 2016年2月26日,公司召开2015年度股东大会,审议通过《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年年度报告》、《2015年度利润分配方案》、《关于延长本次发行上市相关议案有效期的议案》等议案。

自创立大会至本招股说明书签署之日,公司共计召开了14次股东大会。公司股东大会召集、召开程序合法,股东认真履行职责,充分行使股东权利,运作规范;股东大会机构和制度的建立和执行对完善本公司治理机构和规范本公司运作发挥了积极作用,为公司经营业务的长远发展奠定了坚实基础。

(二) 董事会制度的建立健全及运行情况

1、董事会的构成

根据现行有效的《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,公司设董事会,对股东大会负责。董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人。董事由股东大会选举或更换,任期三年,可连选连任。

2、董事会的职权

根据现行有效的《公司章程》的规定，董事会行使下列主要职权：

- (1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (2) 执行股东大会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (8) 在公司股东大会的授权范围内，审议除需经公司股东大会审议批准以外、并达到下述标准的购买、出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；租入或租出资产；委托或受托管理资产和业务；赠与或受赠资产；债权或债务重组；签订许可使用协议；转让或受让研究与开发项目等重大交易事项：
 - 1) 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上；
 - 2) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
 - 3) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；
 - 4) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
 - 5) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；

(9) 在公司股东大会的授权范围内，审议除需经公司股东大会审议批准以外的关联交易事项，即公司与关联自然人发生的金额在 30 万元以上以及与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项；

(10) 审议除需提交股东大会审议外的公司与关联人发生的日常关联交易事项（包括：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；在关联人财务公司存款；与关联人共同投资）；

(11) 审议购买原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的交易（不含与关联方的交易以及资产置换中涉及购买、出售资产的交易）额度占最近一期经审计的净资产 30% 以上的交易事项；

(12) 在公司股东大会的授权范围内，审议除需经公司股东大会审议批准以外的公司对外担保事项；

(13) 决定公司年度借款额度，决定公司用于融资的资产抵押、质押额度；

(14) 决定公司内部管理机构的设置；

(15) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(16) 拟定董事会各专门委员会的设立方案并报股东大会批准，决定董事会专门委员会人员的选聘；

(17) 制订公司的基本管理制度；

(18) 制订《公司章程》的修改方案；

(19) 管理公司信息披露事项；

(20) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(21) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(22) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

3、董事会议事规则

本公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，公司创立大会暨第一次股东大会会议审议通过了《董事会议事规则》。《公司章程》、《董事会议事规则》对董事会的议事程序及规则作出了详细规定，主要内容如下：

(1) 召集

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议，分别于每年上、下半年度召开，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事监事、以及董事会秘书和总经理。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、监事会、1/2 以上独立董事认为必要时，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

(2) 通知

召开董事会定期会议的，董事会办公室应当于会议召开 10 日以前将会议通知，通过直接送达、传真等书面方式，提交全体董事、监事以及总经理和董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

召开董事会临时会议的，董事会办公室应当于会议召开 5 日以前将会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、监事以及总经理和董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，并立即召开，但召集人应当在会议上做出说明。

(3) 召开

董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

以非现场方式召开的，根据以下方式计算出席会议的董事人数：视频显示在场、在电话会议中发表意见、在规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票。

(4) 表决

董事会会议的表决方式为：举手表决或投票表决，每一董事享有一票表决权。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

(5) 决议

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会在审议董事会决策权限内担保事项的议案时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，超过董事会决策权限内的须报股东大会审议批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得提供担保。

董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者《公司章程》、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

4、董事会运行情况

本公司自股份公司设立以来共召开了 26 次董事会，具体情况如下：

(1) 2012 年 9 月 18 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举深圳市汇顶科技股份有限公司第一届董事会董事长的议案》、《关于选聘深圳市汇顶科技股份有限公司总经理的议案》、《关于选聘深圳市汇顶科技股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于选聘深圳市汇顶科技股份有限公司审计委员会委员的议案》、《关于选聘深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选聘深圳市汇顶科技股份有限公司提名委员会委员的议案》、《关于选聘深圳市汇顶科技股份有限公司战略委员会委员的议案》、《关于深圳市汇顶科技股份有限公司内部管理部门设置的议案》、《董事会秘书工作制度（草案）》、《审计委员会工作条例（草案）》，以及选聘公司副总经理、财务负责人等议案。

(2) 2012年11月15日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过《关于批准报出公司2009年至2011年及2012年1-9月审计报告的议案》、《关于公司2012年第三季度利润分配的预案》、《关于设立香港全资子公司的议案》以及《关于签订购房意向协议书的议案》等议案。

(3) 2012年11月18日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过《关于<公司章程(草案)>的议案》等议案。

(4) 2012年12月28日,公司召开第一届董事会第四次会议,审议通过《关于改聘公司审计部负责人的议案》以及《关于计提2012年全体员工年终奖金的议案》等议案。

(5) 2013年2月28日,公司召开第一届董事会第五次会议,审议通过《2012年度总经理工作报告》、《2012年度董事会工作报告》、《关于批准报出公司2012年度审计报告的议案》、《2012年度财务决算报告》、《2013年度财务预算报告》、《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于设立深圳全资子公司的议案》、《关于公司购置房产的议案》、《关于召开2012年度股东大会的议案》等议案。

(6) 2013年8月2日,公司召开第一届董事会第六次会议,审议通过《关于根据中小企业板相关规定修订公司现行适用<公司章程>的议案》、《关于根据中小企业板相关规定修订公司现行适用的需由股东大会通过的公司治理制度的议案》、《关于根据中小企业板相关规定修订公司现行适用的需由董事会通过的公司治理制度的议案》、《关于<股东回报规划事宜的论证报告>的议案》、《关于授权董事会确定公司首次公开发行股票并上市的保荐机构和承销机构的议案》等议案。

(7) 2013年8月25日,公司召开第一届董事会第七次会议,审议通过《关于会计师事务所对公司2010年至2012年及2013年1-6月财务报表的审计报告(初稿)的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市的预案》、《关于公司募集资金使用的可行性分析的预案》、《关于公司发行上市前滚存未分配利润分配方案的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与发行上市有关事项的议案》、《关于提请股东大会同意发行上市相关议案有效期的议案》、《关于根据中小企业板相关规定制订公司

首次公开发行股票并在上市后适用的需由股东大会通过的公司治理制度的议案》、《关于根据中小企业板相关规定制订公司首次公开发行股票并在上市后适用的需由董事会通过的公司治理制度的议案》等议案。

(8) 2013年9月15日,公司召开第一届董事会第八次会议,审议通过《关于聘请保荐机构及主承销商的议案》。

(9) 2013年10月8日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过《关于向全资子公司汇顶科技(香港)有限公司增资的议案》等议案。

(10) 2013年12月10日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过《关于公司在台湾地区设立办事处的议案》、《关于计提2013年全体员工年终奖金的议案》、《关于公司与联发科技股份有限公司签署软件授权合作协议的议案》、《关于召开2013年度第三次临时股东大会的议案》等议案。

(11) 2014年1月29日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过《2013年度总经理工作报告》、《2013年度董事会工作报告》、《关于批准报出公司2011年至2013年审计报告(初稿)的议案》、《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》、《2013年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于修改公司首次公开发行股票并上市的预案》、《关于增加公司募集资金投资项目的预案》、《关于公司募集资金使用的可行性分析的预案》、《关于提请股东大会同意本次发行上市相关议案有效期的议案》、《关于修改公司现行以及上市后适用的需由股东大会通过的公司治理制度的议案》、《关于公司上市后稳定公司股价的议案》、《关于公司签署有关承诺函的议案》、《关于召开2013年度股东大会的议案》等议案。

(12) 2014年3月27日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司首次公开发行股票并在中小企业板上市涉及相关决议终止或变更的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市的预案》、《关于公司募集资金投资项目的预案》、《关于公司募集资金使用的可行性分析的预案》、《关于公司发行上市前滚存未分配利润分配方案的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与发行上市有关事项的议案》等议案。

(13) 2014年4月18日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并上市方案的议案》、《关于修改公司募集资金投资项目的议案》等议案。

(14) 2014年6月18日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司投资设立境外全资子公司的议案》。

(15) 2014年8月8日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《关于2014年上半年度内部控制自我评价的报告》、《2014年中期报告》、《关于批准报出公司2011年至2013年及2014年1-6月审计报告(初稿)的议案》、《关于修改<公司章程(草案)>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》等议案。

(16) 2014年12月25日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过《关于计提2014年全体员工年终奖金的议案》等议案。

(17) 2015年1月4日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过《关于聘任深圳市汇顶科技股份有限公司副总经理的议案》、《关于修改深圳市汇顶科技股份有限公司内部组织架构设置的议案》等议案。

(18) 2015年2月28日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过《关于批准报出公司2012年至2014年审计报告(初稿)的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于确认关联人张林2014年度薪酬的议案》等议案。

(19) 2015年3月29日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过《2014年总经理工作报告》、《关于公司2014年度内部控制自我评价的报告》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年年度报告》、《2014年度利润分配的预案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《审计委员会2015年度工作计划》、《关于召开2014年年度股东大会的议案》等议案。

(20) 2015年7月31日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过《关于在韩国设立代表处的议案》等议案。

(21) 2015年8月15日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于2015年上半年度内部控制自我评价的报告》、《2015年中期报告》、《关于批准报

出公司 2012 年至 2014 年及 2015 年 1-6 月审计报告（初稿）的议案》、《关于修改公司首次公开发行股票并上市方案的议案》、《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于提请股东大会确定第二届董事会董事和监事会股东代表监事薪酬的议案》等议案。

（22）2015 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举深圳市汇顶科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选聘深圳市汇顶科技股份有限公司总经理的议案》、《关于选聘深圳市汇顶科技股份有限公司副总经理的议案》、《关于选聘深圳市汇顶科技股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于选聘深圳市汇顶科技股份有限公司财务负责人的议案》、《关于选举深圳市汇顶科技股份有限公司审计委员会委员的议案》、《关于选举深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举深圳市汇顶科技股份有限公司战略委员会委员的议案》、《关于选举深圳市汇顶科技股份有限公司提名委员会委员的议案》等议案。

（23）2015 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于收购成都金慧通数据服务有限公司 100% 股权的议案》。

（24）2015 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》、《关于计提 2015 年全体员工年终奖金的议案》。

（25）2016 年 1 月 6 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的分析的议案》、《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》等议案。

（26）2016 年 2 月 5 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《2015 年度总经理工作报告》、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价的报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《2015 年年度报告》、《2015 年度利润分配方案》、《关于批准报出公司 2013 年至 2015 年审计报告（初稿）的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于延长本次发行上市相关议案有效期的议案》等议案。

公司董事（包括独立董事）均出席董事会，监事、部分高级管理人员列席董事会；历次董事会会议的召集、召开、议事程序、表决、会议记录和决议签署规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

1、监事会的构成

根据现行有效的《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司设监事会，监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会报告工作。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人。监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生。监事任期三年，连选可以连任。

2、监事会的职权

监事会行使下列职权：

- （1）检查公司财务；
- （2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- （3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- （4）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- （5）向股东大会提出提案；
- （6）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- （7）监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所，律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
- （8）关注公司信息披露情况，对董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督，发现信息披露重大缺陷或存在违法违规问题的，进行调查并提出处理建议；根据监管部门的要求形成对公司信息披露事务管理制度实施情况的年度评价报告，并在年度报告的监事会公告部分进行披露；
- （9）对董事会定期报告的编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整的反应公司的实际情况发表书面审核意见，并对董事会的内部控制自我评价报告发表意见；

(10) 对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并在年度报告中发表意见；

(11) 如会计师事务所对公司内部控制有效性出具非无保留结论鉴证报告的，监事会应当针对鉴证结论涉及事项做出专项说明；

(12) 如公司财务会计报告被会计师事务所出具非标准无保留审计意见的，监事会应当就董事会针对前述事项的专项说明出具意见和相关决议；

(13) 对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序情况进行监督；

(14) 董事应至少每一年度接受一次公司监事会对其履职情况的考评，董事的述职报告和考评结果由监事会应妥善归档；

(15) 董事会秘书离任前，应当接受监事会的离任审查并在监事会监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办事项；

(16) 股东大会决议或《公司章程》规定的其他职权。

3、监事会议事规则

本公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，公司创立大会暨第一次股东大会会议审议通过了《监事会议事规则》。《公司章程》、《监事会议事规则》对监事会的议事程序及规则作出了详细规定，主要内容如下：

(1) 召集

监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次，出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

1) 任何监事提议召开时；

2) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定时；

3) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

4) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

5) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上交所公开谴责时；

6) 证券监管部门要求召开时；

7) 《公司章程》规定的其他情形。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

(2) 通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过专人送出、传真、邮件（包括电子邮件）方式，提交全体监事和董事会秘书。非直接送达的，还应通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，并立即召开，但召集人应当在会议上作出说明。

(3) 召开

监事会定期会议应当以现场方式召开。

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件等方式召开，也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。在非现场会议的情形下，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在规定的时限内根据会议通知投票至指定的地点，在规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

(4) 表决

监事会会议的表决实行一人一票，采用记名投票方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

(5) 决议

监事会形成决议应当经全体监事半数以上同意。与会监事和记录人员应当对会议记录进行签字确认。监事应当保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。

4、监事会运行情况

公司监事会按照《公司章程》的规定，对公司董事、高级管理人员的履职行为、财务决算报告、内部控制制度的执行情况等进行了监督、评价。

本公司自股份公司设立以来共召开了 11 次监事会，具体情况如下：

(1) 2012 年 9 月 18 日，公司召开第一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举深圳市汇顶科技股份有限公司第一届监事会主席的议案》等议案。

(2) 2012 年 11 月 18 日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》等议案。

(3) 2013 年 2 月 28 日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2013 年度财务预算报告》、《2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

(4) 2013 年 8 月 2 日，公司召开第一届监事会第四次会议，审议通过《关于根据中小企业板相关规定修订公司现行适用〈监事会议事规则〉的议案》等议案。

(5) 2014 年 1 月 29 日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议通过《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2014 年度财务预算报告》、《2013 年利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司上市后稳定公司股价的预案》、《关于公司签署有关承诺函的议案》等议案。

(6) 2014 年 3 月 27 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过《关于根据上交所相关规定修订公司现行适用〈监事会议事规则〉的议案》等议案。

(7) 2014 年 8 月 8 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过《关于 2014 年上半年度内部控制自我评价的报告》、《2014 年中期报告》等议案。

(8) 2015年3月29日,公司召开第一届监事会第八次会议,审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价的报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年年度报告》、《2014年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

(9) 2015年8月15日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过《关于2015年上半年度内部控制自我评价的报告》、《2015年中期报告》、《关于监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》等议案。

(10) 2015年8月31日,公司召开第二届监事第一次会议,审议通过《关于选举深圳市汇顶科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》等议案。

(11) 2016年2月5日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价的报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年年度报告》、《2015年度利润分配的预案》等议案。

公司监事均出席了历次监事会,部分高级管理人员列席监事会;历次监事会会议的召集、召开、议事程序、表决、会议记录和决议签署规范,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度要求。

(四) 独立董事制度的建立健全及运行情况

1、独立董事的构成

为进一步优化公司治理结构,建立科学完善的现代企业制度,本公司2012年9月18日召开的创立大会选举张波、王建新、郭磊明为独立董事,且于2015年8月31日召开的2015年第一次临时股东大会进行董事会换届选举时,选举张波、王建新、郭磊明为公司第二届董事会独立董事。公司独立董事3名,占董事会全体成员的比例超过三分之一,符合有关规定。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。

2、独立董事的制度安排

依据现行有效的《公司章程》与《独立董事工作制度》的规定,公司董事会设三名独立董事,其中至少包括一名会计专业人士。独立董事应当按国家相关法律、法规和《公

公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事每届任期与本公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

独立董事应当亲自出席董事会会议，确实不能亲自出席的，独立董事应当委托其他独立董事代为出席；涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一事项所持同意、反对或弃权的意见。为保持独立董事的独立性，独立董事不接受除独立董事之外其他董事的委托。独立董事若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。未按要求辞职的，公司董事会应在 2 日内启动决策程序免去其独立董事职务。独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予的董事的职权外，独立董事还享有以下特别职权：

(1) 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于本公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

(2) 聘任或解聘会计师事务所的提议与事前认可权；

(3) 向董事会提请召开临时股东大会；

(4) 提议召开董事会会议；

(5) 独立聘请外部审计机构（包括聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告）和咨询机构；

(6) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

独立董事行使上述职权，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

(1) 提名、任免董事；

(2) 聘任或解聘高级管理人员；

(3) 公司董事、高级管理人员的薪酬；

(4) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来；公司是否采取有效措施回收欠款；以及公司向股东、实际控制人及其关联企业提供资金；

(5) 应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，并在公司年度报告中，对公司累计和当期对外担保的情况、公司关于对外担保方面的法律、法规的执行情况发表意见；

(6) 公司拟与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的重大关联交易，以及公司购买关联人资产的价格超过账面值 100% 的重大关联交易；

(7) 公司利润分配预案以及对董事会执行现金分红政策和股东回报规划涉及的相关事宜发表意见；

(8) 公司关联方以资抵债方案；

(9) 公司股权激励计划；

(10) 根据相关募集资金使用的法规和内控管理制度，对公司募集资金使用的相关情况发表意见；

(11) 对内部控制自我评价报告发表意见；

(12) 在公司财务会计报告被会计师事务所出具非标准无保留审计意见时，独立董事需对审计意见涉及的事项发表意见；

(13) 独立董事认为可能损害中、小股东权益的事项；

(14) 交易所对独立董事发出年报工作风险警示函的；

(15) 公司章程以及相关法律、法规、规范性文件规定的其他事项。

3、独立董事制度运行情况

本公司独立董事分别担任战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的委员。自聘任以来，公司独立董事通过出席董事会、列席股东大会、参加董事会专门委员会等方式，及时了解公司经营管理、公司治理、内部控制等各项情况，谨慎、勤勉、尽责、独立地履行职责，在关联交易管理、内部控制有效运行的督促检查、法人治理结构的规范化运作等方面发挥了积极有效的作用。随着公司独立董事制度不断地建立健全和完善，公司的独立董事将在公司治理中起到更加重要的作用。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司设董事会秘书 1 名。公司第一届董事会第一次会议制定了《董事会秘书工作制度》，董事会秘书根据《公司法》、《公司章程》及《董事会秘书工作制度》等相关规定开展工作。

1、董事会秘书制度

董事会秘书的主要职责是在公司准备上市和上市后的期间内：

（1）公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：负责公司信息对外发布；制定并完善公司信息披露事务管理制度；督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；负责公司未公开重大信息的保密工作；负责公司内幕知情人登记报备工作；关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。

（2）董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；建立健全公司内部控制制度；积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；积极推动公司建立健全激励约束机制；积极推动公司承担社会责任。

（3）董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。

（4）董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：保管公司股东持股资料；办理公司限售股相关事项；督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；其他公司股权管理事项。

(5) 董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。

(6) 董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。

(7) 董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上交所报告。

(8) 董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和上交所要求履行的其他职责。

2、董事会秘书履行职责情况

2012年9月18日，本公司召开的第一届董事会第一次会议聘任廖崇清为董事会秘书，并于2015年8月31日公司换届选举出的第二届董事会召开的第一次会议中，仍聘任廖崇清为董事会秘书，至今未发生变动。公司现任董事会秘书自聘任以来，严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的规定开展工作，列席历次董事会、股东大会，并负责会议记录；历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均及时为董事提供会议材料、会议通知等相关文件，较好地履行相关职责。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调、公司重大生产经营决策以及主要管理制度的制定等方面发挥重要作用。

(六) 董事会专门委员会的建立健全及运行情况

为进一步完善公司治理结构，更好的发挥独立董事的作用，根据《公司法》、《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，公司在董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。

根据公司创立大会暨第一次股东大会决议，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。2012年9月18日，第一届董事会第一次会议通过《审计委员会工作条例》、《薪酬与考核委员会工作条例》、《提名委员会工作条例》、《战略委员会工作条例》。各专门委员会成员全部由董事组成，且各委员会成员均不少于三名董事；其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上

并担任召集人，且审计委员会的召集人为会计专业人士，公司各专门委员会按照专门委员会工作条例的相关规定履行职责，为董事会有效作出相关决议提供决策依据，各专门委员会组成情况及主要职责如下：

1、战略委员会

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，公司特设立董事会战略委员会。董事会战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。目前，公司的战略委员会成员为张帆、游人杰、张波（独立董事），其中张帆为战略委员会的召集人。战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，战略委员会的主要职责权限：

- （1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
- （2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；
- （3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
- （4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （5）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见；
- （6）董事会授权的其他事宜。

截至本招股说明书签署之日，战略委员会已召开 3 次会议，具体为：

2013 年 2 月 28 日，公司第一届董事会战略委员会召开第一次会议，审议通过了《关于公司未来发展战略的议案》、《2013 年度战略委员会工作重点》。

2014 年 1 月 28 日，公司第一届董事会战略委员会召开第二次会议，审议通过了《2014 年度战略委员会工作重点》。

2016 年 2 月 5 日，公司第一届董事会战略委员会召开第二次会议，审议通过了《2016 年度战略委员会工作重点》。

2、审计委员会

为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设立董事会审计委员会。审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上，且在独立董事中至少有一名为会计专业人士。目前，公司的审计委员会成员为张帆、郭磊明（独立董事）及王建新（独立董事），其中王建新系会计专业人士，并担任审计委员会召集人。董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，审计委员会的主要职责权限：

- （1）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构；
- （2）指导内部审计工作，监督公司的内部审计制度的建立及其实施；
- （3）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
- （4）评估内部控制的有效性；
- （5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
- （6）审查公司内控制度，在年度和半年度结束后审查内部审计部门提交的内部控制评价报告初稿，并在年度结束后编制内部控制自我评估报告草案并报董事会审议，并形成决议后披露；
- （7）有权召集公司内控制度有关部门会议；
- （8）在董事会通过后，实施审计委员会工作计划；
- （9）至少每半年召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等；
- （10）至少每半年向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量、发现的重大问题以及审议审计委员会提交的计划、报告等；
- （11）确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告；
- （12）对该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会，审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据；
- （13）公司以现金流量折现法或假设开发法等估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价依据的，公司审计委员会应当对该等关联交易发表意见，审计委员会作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据；
- （14）公司董事会授予的其他事宜。

审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议上市前至少每半年召开一次，上市后每年须至少召开四次定期会议；当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会主任认为有必要时，可以召开临时会议。定期会议应于会议召开前 10 日发出会议通知；临时会议应于会议召开前 3 日发出会议通知。审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

截至本招股说明书签署之日，审计委员会已召开 10 次会议，具体为：

2012 年 11 月 15 日，公司第一届董事会审计委员会召开第一次会议，审议通过《关于批准报出公司 2009 至 2011 年及 2012 年 1-9 月审计报告的议案》。

2012 年 12 月 27 日，公司第一届董事会审计委员会召开第二次会议，审议通过《关于改聘公司审计部负责人的议案》。

2013 年 2 月 28 日，公司第一届董事会审计委员会召开第三次会议，审议通过《关于批准报出公司 2012 年度审计报告的议案》、《2012 年度财务决算报告》、《2013 年度财务预算报告》、《关于审查审计机构独立性的议案》、《审计委员会年度工作计划》、《内部审计部门工作情况报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2013 年 8 月 25 日，公司第一届董事会审计委员会召开第四次会议，审议通过《关于会计师事务所对公司 2010 年至 2012 年及 2013 年 1-6 月财务报表的审计报告（初稿）的议案》。

2014 年 1 月 28 日，公司第一届董事会审计委员会召开第五次会议，审议通过《关于批准报出公司 2011 年至 2013 年审计报告（初稿）的议案》、《2013 年度财务决算报告》、《2014 年度财务预算报告》、《审计委员会年度工作计划》、《内部审计部门工作情况报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2014 年 8 月 8 日，公司第一届董事会审计委员会召开第六次会议，审议通过《关于 2014 年上半年度内部控制自我评价的报告》、《2014 年中期报告》、《关于会计师事务所对公司 2011 年至 2013 年及 2014 年 1-6 月财务报表的审计报告（初稿）的议案》、《2014 年下半年度公司内部审计部门工作计划》、《2014 年上半年度公司内部审计部门工作情况报告》。

2015年2月28日，公司第一届董事会审计委员会召开第七次会议，审议通过《关于批准报出公司2012年至2014年审计报告（初稿）的议案》。

2015年3月19日，公司召开第一届董事会审计委员会召开第八次会议，审议通过《2014年度内部控制自我评价的报告（草案）》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2014年年度报告》、《2014年下半年度公司内部审计部门工作情况报告》、《2015年上半年度公司内部审计部门工作计划》、《审计委员会2015年度工作计划》。

2015年8月15日，公司召开第一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于2015年上半年度内部控制自我评价的报告》、《2015年中期报告》、《关于批准报出公司2012年至2014年及2015年1-6月审计报告（初稿）的议案》、《2015年下半年度公司内部审计部门工作计划》、《2015年上半年度公司内部审计部门工作情况报告》。

2016年2月5日，公司召开第二届董事会审计委员会召开第一次会议，审议通过《2015年度内部控制自我评价的报告（草案）》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《关于批准报出公司2013年至2015年审计报告（初稿）的议案》、《2015年年度报告》、《2015年下半年度公司内部审计部门工作情况报告》、《2016年上半年度公司内部审计部门工作计划》、《审计委员会2016年度工作计划》等议案。

3、提名委员会

为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司特设立董事会提名委员会。董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。目前，董事会提名委员会成员为张帆、郭磊明（独立董事）、王建新（独立董事）、其中王建新为提名委员会的召集人。董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构提名委员会的主要职责权限：

- （1）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
- （2）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
- （3）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

- (4) 对董事候选人和高级管理人员的人选先进行审查并提出建议；
- (5) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员的人选进行审查并提出建议；
- (6) 在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
- (7) 董事会授权的其他事宜。

截至本招股说明书签署之日，提名委员会已召开 2 次会议，具体为：

2015 年 1 月 4 日，公司第一届董事会提名委员会召开第一次会议，审议通过《关于提名柳玉平为深圳市汇顶科技股份有限公司副总经理的议案》。

2015 年 8 月 15 日，公司第一届董事会提名委员会召开第二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》。

4、薪酬与考核委员会

为建立、完善公司董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。目前，董事会薪酬与考核委员会成员为张帆、张波（独立董事）、郭磊明（独立董事），其中郭磊明为薪酬与考核委员会的召集人。董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，薪酬与考核委员会的主要职责权限：

- (1) 制定公司高级管理人员的工作岗位职责；
- (2) 制定公司高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；
- (3) 制订公司董事和高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准，并每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益、年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行一次检查，出具检查报告并提交董事会；
- (4) 制订公司董事和高级管理人员的长期激励计划；
- (5) 负责对公司长期激励计划进行管理；
- (6) 对授予公司长期激励计划的人员资格、授予条件、行权条件等进行审查；

(7) 董事会授权的其他事宜。

截至本招股说明书签署之日，薪酬与考核委员会已召开 4 次会议，具体为：

2013 年 2 月 28 日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会召开第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员绩效考核的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。

2014 年 1 月 28 日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会召开第二次会议，审议通过《关于公司高级管理人员绩效考核的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。

2015 年 2 月 28 日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会召开第三次会议，审议通过《关于公司高级管理人员绩效考核的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。

2016 年 2 月 5 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会召开第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员绩效考核的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司在董事会下设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，强化公司的内部管理，切实发挥董事会在公司战略方向、重大决策、选择管理人员、加强内部监督等方面的作用。

二、发行人近三年违法违规的情况

发行人严格遵守国家的有关法律和法规开展经营活动，根据相关主管部门出具的证明文件，发行人在报告期内不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管部门重大处罚的情形。

三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况

发行人建立了严格的资金管理制度，报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

发行人的《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，报告期内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

四、发行人内部控制制度的自我评估和鉴证报告

（一）发行人管理层对内部控制制度的自我评价

公司管理层认为：“公司在 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，公司目前的治理结构和现有内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防并及时发现、纠正公司运营中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性和有效性方面不存在重大缺陷。”

（二）注册会计师对发行人内部控制制度的鉴证意见

大华就本公司内部控制出具《深圳市汇顶科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字[2016]000698 号），认为“汇顶科技按照《内部会计控制规范——基本规范（试行）》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

第十节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司最近三年经审计的财务状况和经营业绩。引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告。

一、会计报表

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	606,077,836.74	497,729,794.38	318,249,098.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	138,984,880.37	79,855,012.58	59,025,856.36
应收账款	201,628,241.07	104,167,709.77	55,595,202.24
预付款项	6,034,012.19	3,834,324.43	3,216,471.44
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	19,574,674.22	1,313,453.51	490,917.02
存货	142,191,013.60	104,293,638.02	64,134,779.21
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	1,114,490,658.19	791,193,932.69	500,712,324.84
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	64,395,930.33	64,531,566.14	-

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
固定资产	145,712,655.05	141,052,417.60	12,449,085.10
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	49,999,978.68	3,895,485.97	3,836,497.87
开发支出	-	-	-
商誉	2,749,710.14	-	-
长期待摊费用	2,032,581.88	486,444.37	539,991.50
递延所得税资产	2,947,492.39	1,392,992.40	1,926,199.74
其他非流动资产	10,593,257.16	2,635,567.24	130,429,802.00
非流动资产合计	278,431,605.63	213,994,473.72	149,181,576.21
资产总计	1,392,922,263.82	1,005,188,406.41	649,893,901.05
流动负债：			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	112,872,452.14	72,131,356.79	29,995,130.85
预收款项	164,966.15	1,299,770.10	220,261.83
应付职工薪酬	37,558,841.02	19,033,791.29	13,196,111.30
应交税费	17,554,957.31	12,437,936.77	5,735,812.65
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	45,302,386.22	6,745,882.79	2,327,978.46
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	213,453,602.83	111,648,737.74	51,475,295.09
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
长期应付职工薪酬	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	3,811,423.20	1,136,284.92	7,090,684.11
递延所得税负债	1,755,675.84	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	5,567,099.04	1,136,284.92	7,090,684.11
负债合计	219,020,701.87	112,785,022.66	58,565,979.20
股东权益：			
股本	400,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	34,229,048.13	54,729,048.13	54,729,048.13
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	260,642.82	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	119,712,657.63	80,582,128.53	42,270,037.26
未分配利润	617,814,782.13	592,092,207.09	329,328,836.46
归属于母公司股东的所有者权益合计	1,172,017,130.71	892,403,383.75	591,327,921.85
少数股东权益	1,884,431.24	-	-
股东权益合计	1,173,901,561.95	892,403,383.75	591,327,921.85
负债和股东权益总计	1,392,922,263.82	1,005,188,406.41	649,893,901.05

2、合并利润表

单位：元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业总收入	1,119,601,256.54	853,693,634.18	685,620,949.63
减：营业成本	471,853,838.63	294,254,746.91	234,523,173.79
营业税金及附加	11,037,376.28	10,419,913.89	8,739,116.52
销售费用	35,631,159.06	25,169,938.14	26,161,271.69
管理费用	215,490,121.61	114,431,736.55	92,003,154.42
财务费用	-13,642,417.16	-5,500,472.77	-431,976.91
资产减值损失	8,065,195.50	5,707,812.19	5,219,097.45

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	391,165,982.62	409,209,959.27	319,407,112.67
加：营业外收入	44,735,012.49	35,315,576.50	4,842,564.51
减：营业外支出	200,000.00	-	19,540,835.07
其中：非流动资产处置损失	-	-	21,382.57
三、利润总额	435,700,995.11	444,525,535.77	304,708,842.11
减：所得税费用	57,623,301.56	60,950,073.87	48,071,970.21
四、净利润	378,077,693.55	383,575,461.90	256,636,871.90
归属于母公司所有者的净利润	378,353,104.14	383,575,461.90	256,636,871.90
少数股东损益	-275,410.59	-	-
五、每股收益			
基本每股收益	0.95	0.96	0.64
稀释每股收益	0.94	0.96	0.64
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额	378,455,028.37	383,575,461.90	256,636,871.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	378,613,746.96	383,575,461.90	256,636,871.90
归属于少数股东的综合收益总额	-158,718.59	-	-

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,083,981,223.75	868,560,532.19	708,540,270.43
收到的税费返还	44,699,816.68	34,981,448.22	18,669,102.84
收到其他与经营活动有关的现金	9,841,973.67	8,867,960.93	15,433,718.30
经营活动现金流入小计	1,138,523,014.10	912,409,941.34	742,643,091.57
购买商品、接受劳务支付的现金	571,423,347.74	338,776,929.75	289,256,780.03
支付给职工以及为职工支	128,258,125.51	79,863,677.27	43,071,955.77

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
付的现金			
支付的各项税费	116,288,880.43	108,326,516.51	98,017,357.74
支付其他与经营活动有关的现金	94,079,948.64	50,784,342.11	60,643,807.22
经营活动现金流出小计	910,050,302.32	577,751,465.64	490,989,900.76
经营活动产生的现金流量净额	228,472,711.78	334,658,475.70	251,653,190.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	19,180,736.26	-	1,250,000.00
投资活动现金流入小计	19,180,736.26	-	1,250,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,278,601.41	72,964,443.46	139,237,914.01
投资支付的现金	13,880,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	50,000.00
投资活动现金流出小计	48,158,601.41	72,964,443.46	139,287,914.01
投资活动产生的现金流量净额	-28,977,865.15	-72,964,443.46	-138,037,214.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,000,000.00	82,500,000.00	15,900,246.00
其中：子公司支付给少数		-	-

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	2,615,337.65	577,358.50	1,150,943.37
筹资活动现金流出小计	101,615,337.65	83,077,358.50	17,051,189.37
筹资活动产生的现金流量净额	-101,615,337.65	-83,077,358.50	-17,051,189.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,468,533.38	864,022.07	-3,213,081.87
五、现金及现金等价物净增加额	108,348,042.36	179,480,695.81	93,351,705.56
加：期初现金及现金等价物余额	497,729,794.38	318,249,098.57	224,897,393.01
六、期末现金及现金等价物余额	606,077,836.74	497,729,794.38	318,249,098.57

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	543,264,059.67	472,708,087.65	294,710,316.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	138,984,880.37	79,855,012.58	59,025,856.36
应收账款	195,887,122.47	103,570,593.26	55,595,202.24
预付款项	5,909,003.80	3,834,324.43	3,216,471.44
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	68,109,960.55	1,877,145.59	1,198,210.34
存货	142,189,860.07	104,247,553.62	62,869,848.68
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	1,094,344,886.93	766,092,717.13	476,615,905.69
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	58,489,509.49	34,854,817.50	28,650,417.50
投资性房地产	64,395,930.33	64,531,566.14	-
固定资产	145,487,123.15	141,049,808.75	12,449,085.10
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	7,220,348.20	3,895,485.97	3,836,497.87
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1,220,808.07	486,444.37	539,991.50
递延所得税资产	2,947,492.39	1,392,992.40	1,926,199.74
其他非流动资产	3,778,325.00	2,223,920.00	130,429,802.00
非流动资产合计	283,539,536.63	248,435,035.13	177,831,993.71
资产总计	1,377,884,423.56	1,014,527,752.26	654,447,899.40
流动负债：			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	110,778,920.11	79,471,553.10	29,995,130.85
预收款项	164,966.15	1,299,770.10	220,261.83
应付职工薪酬	29,713,198.99	15,524,329.08	11,616,453.05
应交税费	17,481,433.31	12,415,970.13	5,790,674.40
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	25,578,857.31	6,629,511.49	2,305,274.45
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	183,717,375.87	115,341,133.90	49,927,794.58

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	3,811,423.20	1,136,284.92	7,090,684.11
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	3,811,423.20	1,136,284.92	7,090,684.11
负债合计	187,528,799.07	116,477,418.82	57,018,478.69
所有者权益：			
股本	400,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	34,229,048.13	54,729,048.13	54,729,048.13
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	119,712,657.63	80,582,128.53	42,270,037.26
未分配利润	636,413,918.73	597,739,156.78	335,430,335.32
所有者权益合计	1,190,355,624.49	898,050,333.44	597,429,420.71
负债和所有者权益总计	1,377,884,423.56	1,014,527,752.26	654,447,899.40

2、母公司利润表

单位：元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	1,113,983,599.62	850,663,825.54	685,620,949.63
减：营业成本	469,676,383.21	292,443,551.55	234,523,173.79
营业税金及附加	11,007,544.40	10,378,170.09	8,739,116.52
销售费用	32,135,338.03	23,282,089.52	24,748,574.95
管理费用	202,489,372.49	115,753,393.23	87,264,960.85
财务费用	-13,470,486.56	-5,611,163.61	-380,211.28

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
资产减值损失	7,744,506.60	5,661,774.66	5,214,323.27
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	404,400,941.45	408,756,010.10	325,511,011.53
加：营业外收入	44,735,012.49	35,314,976.50	4,840,164.51
减：营业外支出	200,000.00	-	19,540,835.07
其中：非流动资产处置损失	-	-	21,382.57
三、利润总额	448,935,953.94	444,070,986.60	310,810,340.97
减：所得税费用	57,630,662.89	60,950,073.87	48,071,970.21
四、净利润	391,305,291.05	383,120,912.73	262,738,370.76
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	391,305,291.05	383,120,912.73	262,738,370.76

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,083,356,557.57	865,863,159.85	708,540,270.43
收到的税费返还	44,699,816.68	34,981,448.22	18,669,102.84
收到其他与经营活动有关的现金	9,741,908.78	8,806,535.83	12,905,505.02
经营活动现金流入小计	1,137,798,283.03	909,651,143.90	740,114,878.29
购买商品、接受劳务支付的现金	570,261,526.24	337,470,303.08	287,946,906.75
支付给职工以及为职工支付的现金	104,092,507.87	68,026,744.34	38,973,030.64
支付的各项税费	116,232,974.63	108,188,041.29	98,017,357.74
支付其他与经营活动有关的现金	109,765,420.94	57,088,543.00	58,424,349.63
经营活动现金流出小计	900,352,429.68	570,773,631.71	483,361,644.76
经营活动产生的现金流量净额	237,445,853.35	338,877,512.19	256,753,233.53
二、投资活动产生的现金流量：			

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,350,000.00	-	1,250,000.00
投资活动现金流入小计	2,350,000.00	-	1,250,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,976,836.72	72,549,596.22	139,237,914.01
投资支付的现金	23,634,691.99	6,204,400.00	28,650,417.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	33,792,800.00	-	50,000.00
投资活动现金流出小计	79,404,328.71	78,753,996.22	167,938,331.51
投资活动产生的现金流量净额	-77,054,328.71	-78,753,996.22	-166,687,631.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,000,000.00	82,500,000.00	15,900,246.00
支付其他与筹资活动有关的现金	615,337.65	577,358.50	1,150,943.37
筹资活动现金流出小计	99,615,337.65	83,077,358.50	17,051,189.37
筹资活动产生的现金流量净额	-99,615,337.65	-83,077,358.50	-17,051,189.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,779,785.03	951,613.55	-3,201,489.03
五、现金及现金等价物净增加额	70,555,972.02	177,997,771.02	69,812,923.62
加：期初现金及现金等价物余额	472,708,087.65	294,710,316.63	224,897,393.01

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
六、期末现金及现金等价物余额	543,264,059.67	472,708,087.65	294,710,316.63

二、会计师事务所的审计意见

公司委托大华审计了公司截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日以及 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年、2014 年以及 2015 年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。大华出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2016]001315 号）。

三、财务报表编制基础、合并财务报表的范围及变化情况

（一）财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

（二）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（三）合并财务报表范围

报告期内公司通过投资设立方式取得的子公司包括汇芯科技、汇顶香港、汇顶美国，具体情况如下表所示：

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	法定代表人	主要经营范围	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
汇芯科技	全资子公司	中国深圳	2,000 万元	张帆	电子产品软硬件的技术开发及转让自行开发的技术成果；电子产品、集成电路模块、电子设备、机器设备的批发、进出口及相关配套业务	100	100
汇顶香港	全资子公司	中国香港	1,100 万港币	不适用	电子信息产品的研发、贸易、服务	100	100
汇顶美国	全资子公司	美国	5 万美元	不适用	电子产品经营与开发	100	100

报告期内公司通过收购方式取得的子公司包括易易非凡、金慧通。易易非凡成立于2014年4月，公司于2015年5月出资331.48万元取得其52.80%的股权。金慧通成立于2011年6月9日，公司于2015年11月出资1,388万元取得其100%的股权。

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	法定代表人	主要经营范围	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
易易非凡	控股子公司	中国香港	625万港币	不适用	各类产品的研发生产、推广销售、进出口及国际贸易	52.80	52.80
金慧通	全资子公司	中国成都	800万人民币	张帆	数据处理；研发、销售计算机软硬件及外围设备并提供技术咨询	100.00	100.00

四、主要会计政策和会计估计

（一）收入确认和计量的具体方法

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司报告期内收入均来自销售商品，在遵守上述一般原则的情况下，公司收入确认的具体时点：公司境内销售，根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，在客户对产品验收时确认收入；公司境外销售采用FOB形式，在外销产品完成报关时确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（二）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（三）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：占应收款项余额 10% 以上或金额在前 5 名的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项

以账龄为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例。按照账龄分析法计提坏账准备具体计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（四）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在途物资、原材料、委托加工物资、发出商品、半成品和库存商品。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日

起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（六）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3、固定资产后续计量及处置

（1）固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下表所示：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20.00 -30.00	5.00	3.17-4.75
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
仪器仪表	年限平均法	5.00	5.00	19.00
办公及电子设备	年限平均法	3.00	5.00	31.67

（2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（七）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1、无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

2、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下表所示：

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5 年	合理预计

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年	协议规定年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

（八）长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

（九）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

(十一) 经营租赁

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(十二) 股份支付

1、股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：(1) 期权的行权价格；(2) 期权的有效期；(3) 标的股份的现行价格；(4) 股价预计波动率；(5) 股份的预计股利；(6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3、确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

5、对于存在修改条款和条件的情况的，应说明修改的情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(十四) 前期差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

五、主要税项

(一) 公司及子公司适用的主要税种及税率

税种	具体税率情况
营业税	按应税收入的 5% 计缴
增值税	按销售货物、应税劳务收入和应税服务收入的 3% 或 17% 计缴；公司全资子公司汇芯科技在 2013 年 9 月前为增值税小规模纳税人，采用简易征收办法，征收率为 3%；根据深国税福认正[2013]2658 号规定，从 2013 年 9 月 1 日起按增值税一般纳税人规定征管；公司全资子公司金慧通为增值税小规模纳税人，采用简易征收办法，征收率为 3%
城市维护建设税	按应缴流转税税额的 7% 计缴
教育费附加	按应缴流转税税额的 3% 计缴
地方教育附加	按应缴流转税税额的 2% 计缴
企业所得税	本公司 2013-2015 年度按应纳税所得额的 15% 计缴；汇芯科技按应纳税所得额的 25% 计缴；汇顶香港按应纳税所得额的 16.5% 计缴；汇顶美国按应纳税所得额的 15%-35% 计缴；易易非凡按应纳税所得额的 16.5% 计缴；金慧通按应纳税所得额的 25% 计缴；汇顶香港和易易非凡执行香港利得税税率；汇顶美国执行美国超额累进税率

(二) 公司享受的税收优惠及批文

1、享受企业所得税税收优惠

根据深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局 2012 年 9 月 12 日联合颁发的高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据 2013 年 4 月 10 日深国税福减免备案[2013]130 号、131 号和 132 号《税收减免登记备案告知书》，本公司自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日执行高新技术企业所得税税收优惠，2012 年至 2014 年企业所得税税率为 15%。

根据深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局 2015 年 11 月 2 日联合颁发的高新技术企业证书，认定有效期为三年。本公司 2015 年至 2017 年企业所得税税率为 15%。

2、享受增值税税收优惠政策

2007 年本公司取得深圳市福田区国家税务局核发的《广东省出口企业退税登记证》，自营出口自产货物，增值税实行免、抵、退税管理办法。

2011 年 10 月 13 日由财政部和国家税务总局发布《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）：从 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

报告期内本公司自行开发的软件产品销售增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退税收政策。

六、最近一年及一期收购兼并情况

2015 年 5 月，本公司以老股转让和认购新股的方式，合计出资 331.48 万元现金取得易易非凡 52.80% 的股份。本次收购易易非凡的合并成本为 331.48 万元，取得的可辨认净资产公允价值份额 228.56 万元，确认的商誉为 102.92 万元。

2015 年 11 月，本公司以受让老股的方式，合计出资 1,388.00 万元现金取得金慧通 100% 的股份。本次收购金慧通的合并成本为 1,388.00 万元，取得的可辨认净资产公允价值份额 1,215.95 万元，确认的商誉为 172.05 万元。

七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（证监会公告[2008]43号）的规定，根据大华出具的非经常性损益鉴证报告（大华核字[2016]000700号），公司报告期内非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益	-	-	-2.14
计入当期损益的政府补助	313.75	814.02	273.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 ¹	-20.00	32.90	-1,948.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目 ²	-	-	-2,342.36
所得税影响额	-44.06	-127.03	251.47
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
非经常性损益合计	249.68	719.89	-3,767.84
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	37,585.63	37,637.65	29,431.53

注1：2013年度其他营业外收入和支出主要系公益性捐赠支出1,950.00万元。

注2：2013年度其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为2,342.36万元，系2013年度原始股东低价转让股权给公司员工，按照股份支付进行会计处理计入管理费用的损益。

八、最近一期末主要非流动资产情况

（一）固定资产

截至2015年12月31日，公司的固定资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年12月31日				
	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	折旧年限（年）
房屋建筑物	14,554.56	993.21	-	13,561.35	20-30
办公及电子设备	1,312.88	646.39	-	666.49	3
仪器仪表	584.07	275.26	-	308.81	5
运输设备	98.86	64.24	-	34.62	5
合计	16,550.37	1,979.11	-	14,571.27	-

注：经对报告期各期末固定资产进行的全面检查，各期末固定资产无需计提减值准备。

(二) 无形资产

截至 2015 年 12 月 31 日，公司的无形资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日
1、账面原值合计	5,398.03
外购软件	1,102.13
土地使用权	4,295.90
2、累计摊销合计	398.03
外购软件	380.09
土地使用权	17.94
3、无形资产账面净值合计	5,000.00
外购软件	722.03
土地使用权	4,277.96
4、减值准备合计	-
外购软件	-
土地使用权	-
5、无形资产账面价值合计	5,000.00
外购软件	722.03
土地使用权	4,277.96

(三) 其他非流动资产

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日
预付企业人才住房款	345.20
预付办公设备款	32.63
成都研发基地前期费用	681.49
合计	1,059.33

截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他非流动资产主要是预付企业人才住房款、预付办公设备款和成都研发基地前期费用。根据《福田区企业人才住房配售管理办法》和《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》，本公司配售企业人才住房 10 套，于 2013 年 10 月向深圳市福田区住房和建设局支付配售款。根据《福田区企业人才住房配售管理办法》规定，企业人才住房指由区政府筹集的，按照政府统一确定的价格向符合条件的

企业出售，再由企业按限定价格向本企业人才出租住房，企业对所购买的人才住房享有有限产权，即企业不得向政府以外的任何单位或个人进行任何形式的产权交易，2014年交付其中3套。成都研发基地前期费用为建设成都研发基地支付的报建费及设计费。

九、最近一期末主要债项

（一）短期借款

截至2015年12月31日，公司不存在短期借款。

（二）应付账款

截至2015年12月31日，公司应付账款余额为11,287.25万元。公司应付账款余额中无欠持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项，应付账款余额中无欠关联方款项或账龄超过一年的大额应付账款。

（三）预收款项

截至2015年12月31日，公司预收款项余额为16.50万元，均为预收货款。公司预收账款余额中无预收持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

（四）应付职工薪酬

截至2015年12月31日，公司的应付职工薪酬为3,755.88万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	3,745.12
职工福利费	-
社会保险费	3.11
其中：基本医疗保险费	2.75
工伤保险费	0.13
生育保险费	0.23
住房公积金	1.80
基本养老保险	5.51

项目	2015年12月31日
失业保险费	0.34
辞退福利	-
合计	3,755.88

(五) 应交税费

截至2015年12月31日，公司的应交税费余额为1,755.50万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年12月31日
营业税	0.02
增值税	218.40
城市维护建设税	206.11
教育费附加	88.33
地方教育附加	58.89
企业所得税	1,118.70
个人所得税	58.31
土地使用税	4.75
房产税	1.99
合计	1,755.50

(六) 应付股利

截至2015年12月31日，公司不存在应付股利。

(七) 其他应付款

截至2015年12月31日，公司其他应付款余额为4,530.24万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

款项性质	2015年12月31日
押金及保证金	40.49
差旅报销款	59.51
技术服务费	554.92
非金融机构借款	1,870.00

款项性质	2015年12月31日
诉讼律师费	1,639.01
其他	366.31
合计	4,530.24

截至2015年12月31日，其他应付款中无应付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项，无账龄超过一年的重要其他应付款。

（八）递延收益

截至2015年12月31日，公司的递延收益金额为381.14万元，均为政府补助所产生的递延收益。具体情况如下表所示：

单位：万元

政府补助项目	2015年12月31日	与资产相关/与收益相关
平板显示多点电容式触摸屏控制芯片产业化项目 ¹	70.58	与资产相关
内嵌式触控技术与触控芯片研发项目 ²	7.15	与资产相关
内嵌式触控技术与触控芯片研发项目 ²	13.10	与收益相关
基于电容感应的近场通讯技术与芯片设计项目 ³	200.34	与资产相关
基于电容感应的近场通讯技术与芯片设计项目 ³	89.98	与收益相关
合计	381.14	

注1：根据《深圳市发展改革委关于深圳市汇顶科技股份有限公司平板显示多点电容式触摸屏控制芯片产业化项目资金申请报告的批复》（深发改[2013]231号）：市新一代信息技术产业发展专项资金安排补助资金110万元，主要用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件、购置必要的技术和软件等。本公司将其计入与资产相关的政府补助，自相关资产可供使用时起，按相关资产摊销期限分期计入各期营业外收入，该递延收益于2013年度摊销金额为9,315.89元，2014年度摊销金额为175,899.19元，2015年度摊销金额为209,000.00元。

注2：本公司承担《深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书》（深发改[2013]993号）文件下达的深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目内嵌式触控技术与触控芯片研发，深圳市科技创新委员会无偿资助给本公司专项资金100万元，仅限用于本项目的设备费10万元，差旅费25万元，会议费14万元，劳务费30万元，专家咨询费21万元。本公司将用于设备费10万元计入与资产相关的政府补助，其他计入与收益相关的政府补助，因2013年度本项目尚无相关资产及费用支出，该政府补助2013年度未摊销，2014年度摊销金额为76.9万元，2015年度摊销金额为19,000.00元。

注3：根据本公司与深圳市科技创新委员会签订深圳市科技计划项目合同书，由本公司承担基于电容感应的近场通讯技术与芯片设计项目的执行，深圳市科技创新委员会无偿资助给公司资金人民币500万元，项目资助资金仅限用于本项目的设备费235万元（包括EDA软件180万元、手提电脑15万元和其他设备40万元），材料费30万元，测试化验加工费50万元，差旅费20万元，知识产权事务费8万元，劳务费52万元，绩效支出43万元，其他相关费用62万元。本公司将用于设备费235万元计入与资产相关的政府补助，其他计入与收益相关的政府补助，2015年摊销金额为2,096,861.72元。

（九）对内部人员和关联方的负债

公司对内部人员的负债主要为应付职工薪酬，具体情况参见本节“九、最近一期末主要债项”之“（四）应付职工薪酬”。除前述外，报告期内公司无对关联方的负债情况。

（十）或有负债及逾期未偿还债项

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无或有负债及逾期未偿还债项。

十、股东权益

（一）股东权益情况

公司报告期内的股东权益具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
股本	40,000.00	16,500.00	16,500.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	3,422.90	5,472.90	5,472.90
其他综合收益	26.06	-	-
盈余公积	11,971.27	8,058.21	4,227.00
未分配利润	61,781.48	59,209.22	32,932.88
归属于母公司股东权益合计	117,201.71	89,240.34	59,132.79
少数股东权益	188.44	-	-
股东权益合计	117,390.16	89,240.34	59,132.79

（二）股本

报告期内，公司的股本情况如下表所示：

单位：万元

投资者名称	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
张帆	21,535.60	8,883.44	8,883.44
朱星火	1,198.76	494.49	494.49
杨奇志	450.40	185.79	185.79
汇发国际	9,496.60	3,917.35	3,917.35
汇信科技	4,560.20	1,881.08	1,881.08

投资者名称	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
汇持科技	760.04	313.52	313.52
惠邦投资	1,998.40	824.34	824.34
合计	40,000.00	16,500.00	16,500.00

(三) 资本公积

报告期内，公司的资本公积情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本溢价	117.43	2,167.43	2,167.43
其他资本公积	3,305.47	3,305.47	3,305.47
合计	3,422.90	5,472.90	5,472.90

2013年度资本公积——股本溢价减少9,000.00万元，系根据公司2013年3月22日召开的2012年度股东大会决议，以总股本7,500万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增12股，共计转增9,000万股。2013年度资本公积——其他资本公积增加2,342.36万元系2013年度原始股东低价将其在员工持股公司中的股份转让给员工，按照股份支付进行会计处理增加资本公积——其他资本公积。

2015年度资本公积减少2,050.00万元，系根据公司2015年4月18日召开的2014年度股东大会决议，以资本公积转增股本2,050万股。

(四) 盈余公积

报告期内，公司的盈余公积均为法定盈余公积，盈余公积具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
法定盈余公积	11,971.27	8,058.21	4,227.00
任意盈余公积	-	-	-
合计	11,971.27	8,058.21	4,227.00

近三年增加的法定盈余公积本公司按照母公司报表净利润的10%计提。

(五) 未分配利润

报告期内，公司的未分配利润情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
调整前上期末未分配利润	59,209.22	32,932.88	9,896.58
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-	-	-
调整后期初未分配利润	59,209.22	32,932.88	9,896.58
加: 本期归属于公司所有者的 净利润	37,835.31	38,357.55	25,663.69
减: 提取法定盈余公积	3,913.05	3,831.21	2,627.38
应付普通股股利	9,900.00	8,250.00	-
转作股本的普通股股利	21,450.00	-	-
年末未分配利润	61,781.48	59,209.22	32,932.88

十一、现金流量情况

报告期内，公司的现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	22,847.27	33,465.85	25,165.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,897.79	-7,296.44	-13,803.72
筹资活动产生的现金流量净额	-10,161.53	-8,307.74	-1,705.12
现金及现金等价物净增加额	10,834.80	17,948.07	9,335.17

报告期内，公司不存在不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 资产负债表日后事项

截至 2016 年 2 月 5 日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(二) 或有事项及其他重要事项

2015 年 4 月 17 日本公司被他人在美国加州北地区法院 (NDCA) 和美国国际贸易委员会 (ITC) 起诉并指控本公司触控芯片侵犯其四件美国专利，请求 NDCA 判决本公司侵权，颁发禁令，并要求本公司支付侵权损害赔偿金，请求 ITC 做出本公司侵犯其

专利权的裁定，并颁发禁令；本公司收到诉状后采取积极应诉的策略，将向美国专利商标局专利审判与上诉委员会发起多方复审请求（IPR），请求无效涉案的四件专利。截至目前，NDCA 案程序被暂停，ITC 案正在进展中，IPR 案正积极准备中。本公司预计 2016 年将发生律师费及其他费用约 470 万美元，2017 年及之后将发生律师费及其他费用约 333 万美元。

除存在上述或有事项外，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

十三、财务指标

（一）主要财务指标

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动比率	5.22	7.09	9.73
速动比率	4.56	6.15	8.48
资产负债率（母公司）	13.61%	11.48%	8.71%
资产负债率（合并报表）	15.72%	11.22%	9.01%
每股净资产（元）	2.93	2.23	1.48
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例	0.62%	0.44%	0.65%
项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）	7.32	10.69	13.34
存货周转率（次）	3.83	3.49	4.19
息税折旧摊销前利润（万元）	44,856.51	45,214.39	30,766.84
利息保障倍数（倍）	不适用	不适用	不适用
每股经营活动的现金流量（元）	0.57	0.84	0.63
每股净现金流量（元）	0.27	0.45	0.23
归属母公司股东净利润（万元）	37,835.31	38,357.55	25,663.69
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	37,585.63	37,637.65	29,431.53

注 1：上述各指标计算公式如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债

- (2) 速动比率= (流动资产-存货) /流动负债
- (3) 资产负债率=负债总计/资产总计
- (4) 每股净资产=期末净资产/本次发行前总股本
- (5) 无形资产占净资产的比例=无形资产 (扣除土地使用权) /期末净资产
- (6) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均值
- (7) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均值
- (8) 息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+折旧+摊销
- (9) 利息保障倍数= (净利润+所得税+利息支出) /利息支出, 因公司报告期没有利息支出, 故利息保障倍数不适用
- (10) 每股经营活动的现金流量=当期经营活动产生的现金流量净额/本次发行前总股本
- (11) 每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/本次发行前总股本

(二) 净资产收益率和每股收益

按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订), 公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度的净资产收益率和每股收益情况如下表所示:

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益 (元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2015 年度	35.52%	0.95	0.95
	2014 年度	51.23%	0.96	0.96
	2013 年度	58.38%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2015 年度	35.28%	0.94	0.94
	2014 年度	50.27%	0.94	0.94
	2013 年度	66.95%	0.74	0.74

注 1: 基本每股收益按照归属于公司普通股股东的当期净利润, 除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数, 根据发行合同的具体条款, 从应收对价之日 (一般为股票发行日) 起计算确定。

注 2: 稀释每股收益的分子以归属于公司普通股股东的当期净利润, 调整下述因素后确定:

- (1) 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息;
- (2) 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用;
- (3) 上述调整相关的所得税影响。

注 3: 稀释每股收益的分母等于下列两项之和:

- (1) 基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数;
- (2) 假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

注 4：在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

十四、资产评估情况

（一）汇发国际对汇顶有限增资时的资产评估

2011 年 3 月，汇发国际决定对汇顶有限进行增资。深圳市鹏盛星辉资产评估事务所以 2011 年 4 月 30 日为基准日，采用资产基础法对汇顶有限全部权益进行了评估，并于 2011 年 6 月 21 日出具《关于深圳市汇顶科技有限公司的整体资产评估报告书》（深鹏盛评估报字 2011-C-028 号）。根据该评估报告，汇顶有限资产、负债和净资产在基准日的账面值分别为 7,263.76 万元、1,480.44 万元和 5,783.32 万元，评估值分别为 7,921.69 万元、1,675.51 万元和 6,246.18 万元，评估增值分别为 657.93 万元、195.07 万元和 462.86 万元。公司未对本次评估增值进行调账。

2013 年 9 月 9 日，广东中广信资产评估有限公司对该评估报告进行了复核，出具了《关于〈深圳市汇顶科技有限公司的整体资产评估报告书〉（深鹏盛评估报字 2011-C-028 号）复核报告》（中广信评复报字[2013]第 005 号），认为该评估报告的评估方法基本符合相关规范要求，评估结论基本公允。

（二）汇顶有限整体变更时的资产评估

2012 年 9 月，汇顶有限整体变更为股份有限公司。深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司（现已更名为“国众联资产评估土地房地产估价有限公司”）以 2012 年 6 月 30 日为基准日，采用资产基础法对汇顶有限全部权益进行了评估，并于 2012 年 7 月 31 日出具《深圳市汇顶科技有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的净资产评估报告》（深国众联评报字（2012）第 3-036 号）。根据该评估报告，汇顶有限资产、负债和净资产在基准日的账面值分别为 25,942.94 万元、7,275.50 万元和 18,667.43 万元，评估值分别为 27,732.76 万元、7,275.50 万元和 20,457.25 万元，评估增值分别为 1,789.82 万元、0 元和 1,789.82 万元。公司未对本次评估增值进行调账。

十五、历次验资情况

公司历次验资情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性”。

第十一节 管理层讨论与分析

公司管理层讨论主要依据最近三年经审计的合并财务报表，并结合公司实际经营情况对财务状况、盈利能力和现金流量进行分析。除特别说明外，本节分析所使用的财务数据均为合并报表数据或根据合并报表数据计算。

一、财务状况分析

(一) 资产、负债总体构成情况

报告期各期末，公司的主要资产、负债构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	111,449.07	80.01%	79,119.39	78.71%	50,071.23	77.05%
非流动资产	27,843.16	19.99%	21,399.45	21.29%	14,918.16	22.95%
资产总计	139,292.23	100.00%	100,518.84	100.00%	64,989.39	100.00%
流动负债	21,345.36	97.46%	11,164.87	98.99%	5,147.53	87.89%
非流动负债	556.71	2.54%	113.63	1.01%	709.07	12.11%
负债总计	21,902.07	100.00%	11,278.50	100.00%	5,856.60	100.00%

报告期内，公司资产规模呈快速增长态势，从2013年末的64,989.39万元增至2015年末的139,292.23万元。资产规模的扩大主要源于公司主营业务快速增长。

报告期内，公司资产结构呈现出以流动资产为主的“轻资产”特点，流动性较强，截至2013年末、2014年末和2015年末，公司流动资产占总资产的比例分别为77.05%、78.71%和80.01%。作为IC设计企业，公司与同行业多数公司一样，采取Fabless运营模式，专注于芯片的设计及研发，而芯片产品的封装、烧录及测试均委托专业外部加工厂商进行。因此，公司对生产设备的投入相对较少，非流动资产占比不高。

公司负债主要为流动负债，无银行借款，自成立以来主要依靠股东投入和自身盈利积累发展所需的营运资金。

（二）资产的构成及变动分析

1、流动资产的构成及变动分析

报告期内，公司流动资产的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	60,607.78	54.38%	49,772.98	62.91%	31,824.91	63.56%
应收票据	13,898.49	12.47%	7,985.50	10.09%	5,902.59	11.79%
应收账款	20,162.82	18.09%	10,416.77	13.17%	5,559.52	11.10%
预付款项	603.40	0.54%	383.43	0.48%	321.65	0.64%
其他应收款	1,957.47	1.76%	131.35	0.17%	49.09	0.10%
存货	14,219.10	12.76%	10,429.36	13.18%	6,413.48	12.81%
流动资产合计	111,449.07	100.00%	79,119.39	100.00%	50,071.23	100.00%

报告期内，在流动资产的构成中，货币资金、应收账款、应收票据、存货的占比较大，截至2013年末、2014年末和2015年末，上述四项合计占流动资产的比例分别为99.26%、99.35%和97.70%。

报告期内，公司的流动资产总体呈增长趋势，主要是由于公司经营规模和营业收入持续增长，货币资金、应收账款、应收票据、存货等流动资产快速增长。

（1）货币资金

报告期内，公司货币资金的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	2.05	1.91	1.81
银行存款	60,605.73	49,771.06	31,823.10
合计	60,607.78	49,772.98	31,824.91

截至2013年末、2014年末和2015年末，公司货币资金期末余额分别为31,824.91万元、49,772.98万元和60,607.78万元。货币资金期末余额呈增长态势，主要是由于公司业务规模迅速发展，经营活动现金流净流入增加。公司采取“轻资产”的Fabless运营模式，业务开展过程中的运营支出主要为研究开发过程中的人力资本投入，以及芯片

原材料和委外加工成本支出。随着业务规模的不断扩大，公司营运资本相应增加，需要较大的资金支持。因此，保有一定的资金储备是公司长期、稳定发展的需要。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(2) 应收票据

截至 2013 年末、2014 年末和 2015 年末，公司应收票据余额分别为 5,902.59 万元、7,985.50 万元和 13,898.49 万元，均为银行承兑汇票，随着公司业务规模的扩大，以票据结算的业务有所增加。截至 2015 年末，公司无已质押或已背书未到期的票据，亦无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

(3) 应收账款

1) 应收账款整体情况

报告期内，公司的应收账款情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收账款原值	21,224.03	10,965.33	5,852.13
坏账准备	1,061.20	548.56	292.61
应收账款净额	20,162.82	10,416.77	5,559.52
应收账款净额增幅	93.56%	87.37%	17.81%
应收账款净额占流动资产的比例	18.09%	13.17%	11.10%
应收账款净额占营业收入的比例	18.01%	12.20%	8.11%

截至 2013 年末、2014 年末和 2015 年末，公司的应收账款净额分别为 5,559.52 万元、10,416.77 万元和 20,162.82 万元，占流动资产的比例分别为 11.10%、13.17% 和 18.09%；应收账款净额占当期营业收入的比例分别为 8.11%、12.20% 和 18.01%。报告期应收账款增长主要是由于公司业务规模快速增长，应收账款伴随营业收入相应增长。受指纹识别芯片推出以及年末销售旺盛的影响，2014 年末应收账款净额占营业收入比例较 2013 年末有较大幅度的提高。2015 年下半年，公司指纹识别芯片开始与包括维沃、乐视等多家国内知名手机厂商合作，出货量大幅增长，并且由于指纹识别芯片的单价较高，使得指纹识别芯片相关的销售额增长迅速；同时触控芯片系列产品销售势头依旧保持强劲，因此 2015 年 11 月与 12 月公司销售额较 2014 年 11 月与 12 月增长了 1.15 亿

元,且公司客户账期多为月结 30 天或 60 天,因此导致 2015 年末的应收账款余额较 2014 年末有增长较大。

公司建立了客户信用评级及分类管理制度,销售部门根据不同客户的公司性质、财务状况、历史交易及付款记录等,对其进行信用评级,并制定相应的信用额度及信用期限。目前,公司对客户通常给予月结 30 天的信用期限;对于部分信誉良好、业务规模较大的客户给予月结 60 天信用期;对于部分新客户和采购量较少的客户,公司通常采取预收货款方式,在收款后发出货品。因此,报告期内公司应收账款账龄大部分在 3 个月以内。

2) 应收账款账龄分析

报告期内,公司应收账款的账龄情况如下表所示:

单位:万元

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面原值	比例	账面原值	比例	账面原值	比例
3 个月以内	21,181.91	99.80%	10,447.78	95.28%	5,786.86	98.88%
3 个月至半年	42.11	0.20%	508.84	4.64%	65.27	1.12%
半年至一年	-	-	-	-	-	-
一年至两年	-	-	8.71	0.08%	-	-
合计	21,224.03	100.00%	10,965.33	100.00%	5,852.13	100.00%

从账龄来看,公司应收账款以 3 个月以内的应收账款为主,主要是由于公司给予客户的信用期通常为月结 30 天至月结 60 天。

3) 应收账款前五大客户情况分析

报告期内,公司前五大应收账款客户情况如下表所示:

单位:万元

客户名称	账面余额	占应收账款原值的比例	账龄	与公司关系
2015 年 12 月 31 日				
南昌欧菲生物识别技术有限公司	5,856.95	27.59%	1 年以内	非关联方
深圳市海威思科技有限公司	3,462.16	16.31%	1 年以内	非关联方
维沃通信科技有限公司	1,829.08	8.62%	1 年以内	非关联方
深圳市华信科科技有限公司	1,299.86	6.12%	1 年以内	非关联方

客户名称	账面余额	占应收账款原值的比例	账龄	与公司关系
SAMSUNG DISPLAY Co., Ltd.	1,035.99	4.88%	1 年以内	非关联方
合计	13,484.03	63.52%		
2014 年 12 月 31 日				
魅族科技（中国）有限公司	1,108.46	10.11%	1 年以内	非关联方
东莞金卓通信科技有限公司	1,008.64	9.20%	1 年以内	非关联方
深圳欧菲光科技股份有限公司	971.83	8.86%	1 年以内	非关联方
深圳市海威思科技有限公司	778.04	7.10%	1 年以内	非关联方
南昌欧菲光科技有限公司	566.89	5.17%	1 年以内	非关联方
合计	4,433.86	40.44%		
2013 年 12 月 31 日				
堃昶股份有限公司	723.24	12.36%	1 年以内	非关联方
浙江金徕镀膜有限公司	615.93	10.52%	1 年以内	非关联方
东莞市金铭电子有限公司	566.07	9.67%	1 年以内	非关联方
苏州欧菲光科技有限公司	506.29	8.65%	1 年以内	非关联方
上乘电子科技股份有限公司	480.48	8.21%	1 年以内	非关联方
合计	2,892.02	49.41%		

截至 2013 年末、2014 年末和 2015 年末，公司前五大应收账款客户的应收账款原值合计分别为 2,892.02 万元、4,433.86 万元和 13,484.03 万元，占公司应收账款原值的比例分别为 49.41%、40.44%和 63.52%。截至 2015 年末，应收账款中无应收关联方款项。2014 年末新增的主要应收账款客户为魅族科技（中国）有限公司，其为公司指纹识别芯片和模组产品的终端用户；2015 年末主要应收账款客户南昌欧菲生物识别技术有限公司为公司指纹识别芯片的用户，新增应收账款前五大客户维沃通信科技有限公司为公司电容触控芯片以及指纹识别芯片终端用户，SAMSUNG DISPLAY Co., Ltd.为公司电容触控芯片客户，深圳市华信科科技有限公司为电容触控芯片以及指纹识别芯片的经销商，销售账期均按照月结 60 天执行。

4) 应收账款周转率与同行业比较

截至 2013 年末、2014 年末和 2015 年末，公司应收账款周转率分别为 13.34、10.69 和 7.32，同行业可比上市公司截至 2013 年末、2014 年末的应收账款周转率中位数分别

为 6.32、6.75。2013 年和 2014 年公司应收账款周转情况显著优于可比公司。具体分析参见本节“一、财务状况分析”之“（五）资产周转效率分析”。

5) 坏账计提比例

公司在充分考虑客户信用状况以及历史回款情况下制定了具体可行的坏账计提政策，并按照会计准则的规定以及应收账款的实际情况，足额地计提了坏账准备，具体计提比例如下表所示：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	50%
3 年以上	100%

截至 2013 年末、2014 年末和 2015 年末，公司应收账款坏账准备期末余额分别为 292.61 万元、548.56 万元和 1,061.20 万元。公司大部分客户信誉较高、合作良好，具有较强的资信水平和偿债能力，发生坏账损失的可能性较小。

公司应收账款坏账准备的计提政策与同行业可比上市公司应收账款坏账准备计提政策对比情况如下表所示：

账龄	应收账款坏账计提比例					
	北京君正	国民技术	欧比特	全志科技	中颖电子	公司
1 年以内	0-5%	1%	5%	5%	2%-20%	5%
1-2 年	10%	20%	10%	10%	100%	10%
2-3 年	30%	40%	20%	50%	100%	50%
3 年以上	80%-100%	90%-100%	50%-100%	100%	100%	100%

注：数据来源于可比公司 2014 年度报告、招股说明书。

从上表可见，与同行业可比上市公司相比，公司应收账款坏账准备计提较为合理。

6) 应收账款管理

随着公司业务规模快速增长，应收账款余额呈增长趋势。为有效降低应收账款增长对流动资金的占用以及坏账风险，公司管理层加强了应收账款的管理：第一，公司制定了应收账款管理与回款考核体系，应收账款的回收情况直接与销售人员业绩挂钩；第二，公司建立健全了客户信用档案，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，对存在经

营风险及欠款逾期的客户及时采取措施,加大应收账款的清收力度,以减少坏账的风险;第三,公司财务部门对账款逾期的客户进行严格的发货控制,有力保障了应收账款风险控制。报告期内,公司未发生坏账核销情况。

(4) 存货

报告期内,公司的存货明细如下表所示:

单位:万元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
在途物资	705.10	4.81%	1,005.94	9.42%	904.88	13.52%
原材料	278.01	1.90%	103.18	0.97%	47.64	0.71%
委托加工物资	9,071.66	61.93%	5,269.13	49.32%	2,094.20	31.29%
半成品	202.87	1.39%	456.80	4.28%	403.43	6.03%
库存商品	4,057.50	27.70%	3,241.82	30.30%	2,641.41	39.47%
发出商品	332.10	2.27%	611.38	5.72%	601.37	8.99%
合计	14,647.24	100.00%	10,688.25	100.00%	6,692.94	100.00%
存货跌价准备	428.14	2.92%	258.89	2.42%	279.46	4.18%
存货净额	14,219.10		10,429.36		6,413.48	
存货净额占流动资产比例	12.76%		13.18%		12.81%	

1) 存货结构分析

公司专注于集成电路设计,采用 Fabless 经营模式,不直接从事芯片的生产,生产制造环节均以委外方式完成。公司存货中,在途物资主要为 FOB 模式下向境外供应商采购的尚处于运输途中或报关过程中的原材料;原材料主要为电容屏触控芯片的定制晶圆;期末在委外加工厂商处的存货形成委托加工物资;期末完成上道工序、尚未发至委外加工厂商且在本公司仓库的存货形成半成品;委外加工生产全部完成后的产成品在公司验收入库后形成库存商品;期末已发出但客户尚未确认收货并验收合格的存货为发出商品。

报告期内,委托加工物资占存货的比例较大,2013年末、2014年末和2015年末分别为31.29%、49.30%和61.93%。委托加工物资涉及的生产环节及各环节的具体内容如下:

晶圆采购环节：公司设计好芯片版图后，向晶圆委外加工厂商采购订制加工生产的晶圆，此环节直接向晶圆加工厂商 Dongbu Hitec co.,Ltd、X-FAB、华邦电子股份有限公司、北京兆易创新科技股份有限公司等采购订制加工生产的晶圆，不涉及委托加工物资的核算。

晶圆检测环节：向晶圆委外加工厂商采购订制加工生产的晶圆入库后，公司将晶圆发外协检测商检测，以确定每片晶圆上良品的颗数及分布，避免不良品后续进一步封装、烧录发生的成本支出（一般封装及烧录加工费单价是按每颗定价）及对产品交付可能造成的影响，该环节委托加工物资核算的系发外协检测商检测的晶圆。

芯片封装环节：芯片封装是将生产出来的合格晶圆进行切割、焊线、塑封，使芯片电路与外部器件实现电气连接，并为芯片提供机械物理保护的工艺过程。该环节委托加工物资核算的系发外协封装商封装的晶圆及处在封装环节尚未交付汇顶科技验收入库的芯片。

芯片烧录测试：芯片烧录测试是指芯片封装后发外协烧录厂写入软件程序，在程序烧录完毕后再对整颗芯片进行测试。该环节委托加工物资核算的系发外协烧录测试的芯片及处在烧录测试环节尚未交付公司验收入库的成品芯片。

芯片及其他材料组装：芯片及其他材料组装是指芯片封装后将与其他材料发外协厂商组装成芯片模组。该环节委托加工物资核算的系发外协组装的芯片、其他材料及处在组装环节尚未交付汇顶科技验收入库的成品芯片模组。

2) 存货金额分析

截至 2013 年末、2014 年末和 2015 年末，公司存货净额分别为 6,413.48 万元、10,429.36 万元和 14,219.10 万元，分别占当期流动资产的 12.81%、13.18%和 12.76%。从公司销售部门与客户沟通预测销售需求至公司芯片产成品验收入库，一般需要 3-4 个月，随着业务规模的增长，公司还需要根据销售需求储备 1 个月左右的安全库存。

2013 年以来，随着智能手机和平板电脑市场的走强，公司电容屏触控芯片和指纹识别芯片订单大幅度增长，公司业务规模有了较大提高；同时，为满足及时向客户供货和备货需求，公司加大了原材料采购和委外加工规模，故 2014 年末以及 2015 年末存货余额较 2013 年末有较大的增长。

3) 存货跌价准备计提情况

公司期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。

2012年以来,GT9系列芯片成功推出,其在GT8系列芯片的基础上进行了技术改进及功能完善,从而逐步替代了GT8系列芯片。2013年末、2014年末和2015年末,公司根据谨慎性原则对GT8系列部分型号的产品计提了存货跌价准备,同期还存在部分存货跌价准备的转回和转销,截至2015年12月31日,公司GT8系列存货跌价准备余额为130.87万元。

2013年以来,由于部分GT9系列型号的市场反应不如预期,2013年末、2014年末和2015年末,公司对GT9系列部分型号产品计提了存货跌价准备,同期还存在部分存货跌价准备的转回和转销,截至2015年12月31日,公司GT9系列存货跌价准备余额为155.08万元。

2014年度及2015年上半年,公司指纹识别芯片产品以销售模组为主,2015年下半年开始转为以销售芯片为主,因此截至2015年12月31日,对于指纹识别芯片模组相关存货计提跌价准备83.99万元。

此外,截至2015年12月31日,公司包括按键式触控芯片在内的其他触控芯片与固定电话芯片的存货跌价准备余额为58.20万元。

4) 公司对存货中委托加工物资的盘点、减值测算的具体方法

公司各期末存货一部分存放于总部深圳仓存储;另一部分委托加工的存货存放于各委托加工商仓库。汇顶科技主要生产环节全部系委托外协加工,因此公司对外协厂商的库存、品质及流程实施的是动态管理,对主要外协厂商公司均有委派工程人员进驻,采购供应部专人负责与外协厂商实时核对库存数据并将核对的库存数据实时反馈给财务部门;另根据汇顶科技仓库管理盘点制度及实际业务流程,财务部会同采购部每个季度抽取一定比例的委托加工物资到外协厂商实地盘点委托加工物资。

公司结合产品及行业特性,各季末及年末对库龄超过180天存货(包括原材料、库存商品、委托加工物资、半成品)进行减值测试,对没有使用价值或被替代的存货全额计提跌价准备、对成本高于资产负债表日前后最近市场销售价格的,按照成本高于其可

变现净值的差额计提存货跌价准备。按照上述方法对委托加工物资进行减值测试，报告期内汇顶科技委托加工物资无需计提存货跌价准备。经保荐机构和申报会计师核查，汇顶科技委托加工物资不存在库存超过 180 天且没有使用价值或被替代的产品，因此委托加工物资不存在需要全额计提跌价准备的情形；汇顶科技产品毛利率保持在较高水平，经对各期末产品成本与资产负债表日前后市场销售价格进行比较，汇顶科技不存在成本低于售价，需大额计提存货跌价准备的情形。汇顶科技减值测试的方法保持了一贯，符合汇顶科技实际情况。

2、非流动资产的构成及变动分析

报告期内，公司的非流动资产主要包括投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉、递延所得税资产和其他非流动资产，具体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
投资性房地产	6,439.59	23.13%	6,453.16	30.16%	-	-
固定资产	14,571.27	52.33%	12,105.24	65.91%	1,244.91	8.34%
无形资产	5,000.00	17.96%	389.55	1.82%	383.65	2.57%
商誉	274.97	0.99%	-	-	-	-
长期待摊费用	203.26	0.73%	48.64	0.23%	54.00	0.36%
递延所得税资产	294.75	1.06%	139.30	0.65%	192.62	1.29%
其他非流动资产	1,059.33	3.80%	263.56	1.23%	13,042.98	87.43%
非流动资产合计	27,843.16	100.00%	21,399.45	100.00%	14,918.16	100.00%

报告期内，公司非流动资产规模呈快速增长趋势。2014 年末公司的非流动资产为 21,399.45 万元，较 2013 年末增加 6,481.29 万元，主要是 2014 年 4 月认购深圳市软件产业基地办公楼所致。2015 年末公司的非流动资产为 27,843.16 万元，较 2014 年末增加 6,443.71 万元，主要用于外购研发用软件及购买土地使用权。

(1) 投资性房地产

2014 年公司将购买的、暂时闲置的软件产业基地房产 4 栋 B901、B902 对外出租，按成本法计入投资性房地产。截至 2014 年末和 2015 年末，公司的投资性房地产金额分

别为 6,453.16 万元和 6,439.59 万元，占非流动资产的比例分别为 30.16%和 23.13%，占总资产的比例分别为 6.42%和 4.62%。

(2) 固定资产

截至 2013 年末、2014 年末和 2015 年末，公司的固定资产金额分别为 1,244.91 万元、14,105.24 万元和 14,571.27 万元，占非流动资产的比例分别为 8.34%、65.91%和 52.33%，占总资产的比例分别为 1.92%、14.03%和 10.46%。2014 年末，公司固定资产较 2013 年末增加 12,860.33 万元，主要是由于 2013 年预付购买的办公楼已经交付，由其他非流动资产转入固定资产。

报告期内各期末，公司的固定资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	折旧年限(年)
2015 年 12 月 31 日					
房屋及建筑物	14,554.56	993.21	-	13,561.35	20-30
办公及电子设备	1,312.88	646.39	-	666.49	5
仪器仪表	584.07	275.26	-	308.81	5
运输设备	98.86	64.24	-	34.62	3
合计	16,550.37	1,979.11	-	14,571.27	-
2014 年 12 月 31 日					
房屋及建筑物	13,809.37	515.32	-	13,294.04	20-30
办公及电子设备	847.58	381.17	-	466.41	3
仪器仪表	502.36	200.29	-	302.07	5
运输设备	98.86	56.15	-	42.72	5
合计	15,258.16	1,152.92	-	14,105.24	-
2013 年 12 月 31 日					
房屋及建筑物	949.00	268.49	-	680.51	20
办公及电子设备	516.35	189.92	-	326.42	3
仪器仪表	368.75	133.58	-	235.17	5
运输设备	56.26	53.45	-	2.81	5
合计	1,890.36	645.45	-	1,244.91	-

公司固定资产主要为房屋建筑物、办公及电子设备，使用状况良好，未发现减值迹象。固定资产比重相对较低，与集成电路设计公司“轻资产”特点相符。

(3) 无形资产

报告期内各期末，公司的无形资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1、账面原值合计	5,398.03	597.38	474.65
外购软件	1,102.13	597.38	474.65
土地使用权	4,295.90	-	-
2、累计摊销合计	398.03	207.83	91.00
外购软件	380.09	207.83	91.00
土地使用权	17.94	-	-
3、无形资产账面净值合计	5,000.00	389.55	383.65
外购软件	722.03	389.55	383.65
土地使用权	4,277.96	-	-
4、减值准备合计	-	-	-
外购软件	-	-	-
土地使用权	-	-	-
5、无形资产账面价值合计	5,000.00	389.55	383.65
外购软件	722.03	389.55	383.65
土地使用权	4,277.96	-	-

截至2013年末、2014年末和2015年末，公司无形资产分别为383.65万元、389.55万元和5,000.00万元。2015年末公司无形资产较2014年末增加4,610.45万元，系购买芯片设计软件、文件加密软件以及土地使用权。公司预计软件使用权的预计使用寿命为5年，并将其在该期限内按直线法摊销；根据《成都市挂牌出让国有建设用地使用权成交确认书》约定，公司购买的地块使用年限为40年，在该期限内按直线法摊销。报告期内各期末，没有出现使无形资产可收回净额低于账面价值的情形。

(3) 商誉

2015年末公司商誉较2014年末增加274.97万元，主要系公司2015年度非同一控制并购易易非凡、金慧通两个子公司形成。其中，并购易易非凡确认的商誉为102.92万元，并购金慧通确认的商誉为172.05万元。上述被收购主体均在按预期开展经营活动，经测试评估，年末商誉未发生减值。

(4) 长期待摊费用

截至 2013 年末、2014 年末和 2015 年末，公司的长期待摊费用分别为 54.00 万元、48.64 万元和 203.26 万元，为办公场所装修费用。

(5) 递延所得税资产

截至 2013 年末、2014 年末和 2015 年末，公司递延所得税资产期末余额分别为 192.62 万元、139.30 万元和 294.75 万元，主要来源于计提坏账准备和存货跌价准备引起的所得税暂时性差异，除上述因素外，还有部分来源于递延收益。

(6) 其他非流动资产

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预付购办公室款	-	-	12,739.38
预付企业人才住房款	345.20	222.39	303.60
预付办公室装修款	-	41.16	-
预付办公室家具款	32.63	-	-
成都研发基地前期费用	681.49	-	-
合计	1,059.33	263.56	13,042.98

公司 2013 年末其他非流动资产主要是公司与深圳市投资控股有限公司签订房地产认购书，认购房产总面积为 3,955.53 平方米，选择一次性付款，款项已在 2013 年 4 月份支付完毕，共支付房款 12,739.38 万元，由于 2013 年 12 月 31 日，该房产尚未交付公司，计入其他非流动资产。截至 2014 年 12 月 31 日，该房产已交付使用，因此转入固定资产。公司 2015 年末其他非流动资产主要是子公司金慧通为建设成都研发基地支付的报建费及设计费。

(三) 负债的构成及变动分析

1、流动负债的构成及变动分析

报告期内，公司流动负债主要包括应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、应付股利、其他应付款，具体构成如下表所示：

单位：万元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	-	-	-	-	-	-
应付账款	11,287.25	52.88%	7,213.14	64.61%	2,999.51	58.27%
预收款项	16.50	0.08%	129.98	1.16%	22.03	0.43%
应付职工薪酬	3,755.88	17.60%	1,903.38	17.05%	1,319.61	25.64%
应交税费	1,755.50	8.22%	1,243.79	11.14%	573.58	11.14%
其他应付款	4,530.24	21.22%	674.59	6.04%	232.80	4.52%
流动负债合计	21,345.36	100.00%	11,164.87	100.00%	5,147.53	100.00%

(1) 短期借款

截至2013年末、2014年末和2015年末，公司不存在短期借款。

(2) 应付账款

单位：万元

账龄	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	11,287.25	7,213.14	2,999.51
合计	11,287.25	7,213.14	2,999.51

截至2013年末、2014年末和2015年末，公司的应付账款余额分别为2,999.51万元、7,213.14万元和11,287.25万元，占流动负债的比例分别为58.27%、64.61%和52.88%。应付账款主要为应付晶圆、芯片货款和委外加工款。报告期内各期末应付账款余额总体呈增长趋势，主要是因为公司销售规模增长，存货备货和委外生产规模相应增加所致；此外，随着与供应商合作关系的深入以及采购规模的扩大，公司获得了较长的结算周期，信用额度亦有所增加，因此期末应付账款增长较快。2014年末，公司应付账款余额较2013年末有较大增长，除前述原因外，还因为2014年11月与12月公司开始批量生产指纹识别芯片，产生模组费用2,616.78万元，账期为月结30天，但公司以供应商开具发票为实际支付时点，并于2015年陆续支付大部分货款；截至2015年12月31日，该笔货款已全部支付。截至2015年末，公司应付账款前五名单位的情况如下表所示：

单位：万元

序号	应付账款单位名称	应付账款余额	占应付账款的比例	款项性质
1	X-FAB Sarawak Sdn.Bhd.	4,414.99	39.11%	晶圆采购

序号	应付账款单位名称	应付账款余额	占应付账款的比例	款项性质
2	Dongbu Hitec co., Ltd	3,288.38	29.13%	晶圆采购
3	安靠封装测试（上海）有限公司	1,818.02	16.11%	封装测试
4	日月光封装测试（上海）有限公司	418.09	3.70%	封装测试
5	华天科技西安有限公司	333.88	2.96%	封装
合计		10,273.35	91.02%	

（3）预收款项

截至 2013 年末、2014 年末和 2015 年末，公司预收款项分别为 22.03 万元、129.98 万元和 16.50 万元，账龄均在 1 年以内。公司对于部分新客户、采购量较小的客户采用款到发货方式销售，形成预收款项。

（4）应付职工薪酬

截至 2013 年末、2014 年末和 2015 年末，公司的应付职工薪酬分别为 1,319.61 万元、1,903.38 万元和 3,755.88 万元。报告期内，随着公司业务规模不断扩大和业绩稳定增长，员工人数及人均薪酬（包括工资和奖金）水平有所上升，导致公司应付职工薪酬增加。

（5）应交税费

截至 2013 年末、2014 年末和 2015 年末，公司的应交税费分别为 573.58 万元、1,243.79 万元和 1,755.50 万元，主要为应交企业所得税与增值税，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
营业税	0.02	-	-
增值税	218.40	333.89	78.22
城市维护建设税	206.11	38.77	42.48
教育费附加	88.33	16.62	18.20
地方教育附加	58.89	11.08	12.14
企业所得税	1,118.70	723.58	405.88
个人所得税	58.31	32.71	16.67
土地使用税	4.75	4.12	-
房产税	1.99	83.02	-

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
合计	1,755.50	1,243.79	573.58

截至2013年末、2014年末和2015年末，公司应交企业所得税为405.88万元、723.58万元和1,118.70万元。

2、非流动负债分析

公司2013年末、2014年末和2015年末存在非流动负债，主要是来自政府补助递延收益，具体内容参见本招股说明书“第十节 财务会计信息”之“九、最近一期末主要债项”之“（八）递延收益”。

（四）偿债能力分析

1、偿债能力主要财务指标

报告期内，公司偿债能力的主要财务指标如下表所示：

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动比率	5.22	7.09	9.73
速动比率	4.56	6.15	8.48
资产负债率（母公司）	13.61%	11.48%	8.71%
资产负债率（合并）	15.72%	11.22%	9.01%
项目	2015年度	2014年度	2013年度
息税折旧摊销前利润（万元）	44,856.51	45,214.39	30,766.84
利息保障倍数	不适用	不适用	不适用

注：利息保障倍数=（净利润+所得税+利息支出）/利息支出，因公司报告期没有利息支出，故利息保障倍数不适用。

2、公司偿债能力分析

（1）流动比率和速动比率分析

报告期内，公司流动比率和速动比率整体水平较高，公司的短期偿债能力较好，主要因公司没有短期借款，流动负债较小；同时公司采用 Fabless 的“轻资产”运营模式，主要资产为流动资产。截至2013年末、2014年末和2015年末，公司流动比率分别为9.73、7.09和5.22，速动比率分别为8.48、6.15和4.56，公司的短期偿债能力较强。

报告期内，公司与可比公司的流动比率、速动比率情况如下表所示：

项目	流动比率		
	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
北京君正		76.46	144.00
国民技术		19.30	23.51
欧比特		5.33	11.95
全志科技		5.58	5.84
中颖电子		10.07	9.74
平均值		23.35	39.01
中位值		10.07	11.95
公司	5.22	7.09	9.73
项目	速动比率		
	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
北京君正		72.08	135.60
国民技术		18.15	22.34
欧比特		4.15	9.59
全志科技		4.40	4.15
中颖电子		9.17	8.52
平均值		21.59	36.04
中位值		9.17	9.59
公司	4.56	6.15	8.48

注：数据来源于可比公司定期报告、招股说明书，截至本招股说明书签署之日，北京君正、国民技术、欧比特、全志科技、中颖电子 2015 年年报尚未披露。

2013 年末和 2014 年末，公司流动比率和速动比率低于同行业平均水平，主要是因为可比公司成功上市融资，流动比率和速动比率有较大增长。

(2) 资产负债率分析

截至 2013 年末、2014 年末和 2015 年末，公司的资产负债率（合并口径）分别为 9.01%、11.22% 和 15.72%，随着公司业务规模的迅速扩张，自身盈利积累使得资产整体增长较快，资产负债率水平保持在较低水平。

报告期内，公司与可比公司合并口径的资产负债率情况如下表所示：

项目	资产负债率（合并口径）		
	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日

项目	资产负债率（合并口径）		
	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
北京君正		1.40%	1.11%
国民技术		5.30%	4.65%
欧比特		11.45%	6.28%
全志科技		16.55%	15.48%
中颖电子		9.16%	9.33%
平均值		8.77%	7.37%
中位值		9.16%	6.28%
公司	15.72%	11.22%	9.01%

注：数据来源于可比公司定期报告、招股说明书，截至本招股说明书签署之日，北京君正、国民技术、欧比特、全志科技、中颖电子 2015 年年报尚未披露。

2013 年末和 2014 年末，公司资产负债率高于可比公司，主要是由于可比公司成功上市融资导致资产负债率水平较低。

（3）息税折旧摊销前利润与利息保障倍数分析

2013 年度、2014 年度和 2015 年末，公司的息税折旧摊销前利润分别为 30,766.84 万元、45,214.39 万元和 44,856.51 万元。报告期内，公司无利息支出，不适用于计算利息保障倍数。

（4）公司债务偿还能力综合分析

报告期内，公司的经营和资产状况良好，主营业务收入和盈利水平快速增长，负债水平合理，偿债能力较强，不存在重大偿债风险，主要体现在以下几个方面：1）公司的各项偿债指标处于合理水平，财务风险较低；2）公司的经营活动现金流情况良好，2013 年度、2014 年度和 2015 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 25,165.32 万元、33,465.85 万元和 22,847.27 万元，为公司的生产经营提供了足够的资金保障；3）公司目前不存在或有负债、大额诉讼或者对外担保等影响偿债能力的情况；4）公司建立了良好的内部财务管理政策和风险管理制度，与银行保持了良好的合作关系，信誉水平良好。

（五）资产周转效率分析

1、资产周转效率主要财务指标

报告期内，公司资产周转效率指标如下表所示：

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
存货周转率	3.83	3.49	4.19
存货周转天数（天）	94.03	103.15	85.91
应收账款周转率	7.32	10.69	13.34
应收账款周转天数（天）	49.16	33.69	26.98

注 1：存货周转天数=360/存货周转率；

注 2：应收账款周转天数=360/应收账款周转率。

2、公司资产周转效率分析

（1）存货周转率分析

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度的存货周转率分别为 4.19、3.49 和 3.83，存货周转天数分别为 85.91 天、103.15 天和 94.03 天。公司的存货主要为库存商品和委托加工物资。2013 年以来，随着公司新产品的陆续投放市场，一方面公司为满足下游市场的旺盛需求，避免供货缺口，用于备货的库存商品规模增长较大；另一方面，电容屏触控芯片委外加工周期相对较长，公司生产备货规模亦快速增长，导致期末存货余额增长较快，存货周转率有所下降。与同行业上市公司相比，2013 年和 2014 年，公司存货周转率优于可比公司，具体情况如下表所示：

项目	存货周转率		
	2015 年度	2014 年度	2013 年度
北京君正		0.49	0.93
国民技术		1.84	2.01
欧比特		1.18	1.23
全志科技		3.39	4.79
中颖电子		3.82	3.16
平均值		2.15	2.43
中位值		1.84	2.01
公司	3.83	3.49	4.19

注：数据来源于可比公司定期报告、招股说明书，截至本招股说明书签署之日，北京君正、国民技术、欧比特、全志科技、中颖电子 2015 年年报尚未披露。

（2）应收账款周转率分析

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度的应收账款周转率分别为 13.34、10.69 和 7.32，应收账款周转天数分别为 26.98 天、33.69 天和 49.16 天，总体而言保持在周转较快的水平，反映出公司在营业收入大幅度增长的同时，对应收账款的控制较好。

报告期内，公司与可比公司的应收账款周转率情况如下表所示：

项目	应收账款周转率		
	2015 年度	2014 年度	2013 年度
北京君正		6.75	6.32
国民技术		2.16	2.51
欧比特		1.47	1.40
全志科技		306.32	361.10
中颖电子		7.02	7.04
平均值		64.75	75.67
中位值		6.75	6.32
公司	7.32	10.69	13.34

注：数据来源于可比公司定期报告、招股说明书，截至本招股说明书签署之日，北京君正、国民技术、欧比特、全志科技、中颖电子 2015 年年报尚未披露。

从上表可以看出，2013 年和 2014 年，除全志科技基本采用款到发货方式应收账款金额较小外，公司应收账款周转情况好于可比公司。公司应收账款周转良好，不存在重大回收风险。

二、盈利能力分析

（一）营业收入构成及变动分析

1、主营业务收入的构成分析

公司主营业务收入的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
电容触控芯片	85,144.94	76.31%	83,912.06	98.29%	67,707.20	98.75%
指纹识别芯片	26,012.72	23.31%	967.76	1.13%	-	-
固定电话芯片	418.33	0.37%	489.55	0.57%	854.90	1.25%

项目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合计	111,575.99	100.00%	85,369.36	100.00%	68,562.09	100.00%

注：指纹识别芯片含芯片及模组。

报告期内，公司主营业务收入来源于电容触控芯片、指纹识别芯片和固定电话芯片的研发和销售，其中电容触控芯片目前是营业收入的最重要来源，指纹识别芯片是公司2014年以来推出的新产品，2015年下半年起收入大幅增长，未来有望成为营业收入新的增长点。

2、主营业务收入的变动分析

公司2013年度、2014年度和2015年度分别实现营业收入68,562.09万元、85,369.36万元和111,575.99万元，2013至2015年公司主营业务收入年复合增长率为27.57%，主要得益于电容触控芯片市场规模的持续增长、指纹识别芯片的推出和公司市场地位的进一步提升。未来公司仍将通过分析终端用户的需求，把握行业发展机会，不断推出新产品，为主营业务的持续发展提供保障。

(1) 近三年营业收入增长的原因分析

近三年公司营业收入增长的主要原因为：

1) 下游智能终端电子产品市场迅速发展，为公司营业收入增长提供了良好的市场环境

近年来，智能终端市场步入爆发式增长时期，以智能手机、平板电脑为代表的各类智能终端产品销售量急剧上升，电容式触摸屏技术获得消费者的广泛认可，智能手机、平板电脑等消费类电子产品的电容屏触控芯片的市场需求迅速扩大。公司主要从事电容屏触控芯片的开发和销售，契合了智能手机、平板电脑等消费类电子的市场需求。受智能手机整机市场的拉动，智能手机用电容屏触控芯片销量也实现了快速增长。赛迪顾问的统计数据显示，2014年，中国智能手机用电容屏触控芯片销量达到56,517万颗，同比增长18.70%；2014年，中国平板电脑用电容屏触控芯片销量达到9,593万颗，同比增长11.60%。中国电容屏触控芯片市场需求的快速增长，为公司业务规模的快速扩张提供了良好的外在基础。

2) 凭借产品的良好性能、质量和技术支持服务, 公司赢得国内电容屏触控芯片较大的市场份额

公司从 2007 年开始进行电容屏触控技术的研究, 2009 年研发出工程样片, 2010 年实现多点触摸电容屏触控芯片小批量出货, 成为国内首家成功量产的本土芯片设计公司。除提供芯片产品外, 公司还自主研发出电容屏传感器自动设计工具、自动调试工具和电容屏自动测试仪器等调试工具, 向客户提供综合的技术支持服务, 极大缩短了客户的开发时间, 降低了客户的开发成本。在公司的电容屏触控芯片进入市场之前, 中国电容屏触控芯片均被外资集成电路设计企业把持, 技术服务及客户响应相对滞后。对于国内平板和手机厂商而言, 芯片产品的性能、成本和技术支持是主要考虑因素。所以, 当公司的电容屏触控芯片 2011 年大批量出货后, 凭借良好性能、质量和技术支持服务迅速抢占了国产平板电脑市场以及智能手机市场, 逐步进入中兴、华为、酷派、联想等国内一线品牌及三星、华硕、宏基、东芝等国际品牌。

3) 联发科入股公司快速提升了汇顶科技的品牌知名度和市场影响力

2010 年公司的电容屏触控芯片开始小批量出货, 品牌知名度和市场认可程度尚待提高。2011 年联发科在众多触控芯片厂家中选择入股汇顶科技成为当年业界的重要新闻, 快速提升了公司在经销商、方案商、模组厂、整机厂等下游客户中的品牌影响力和产品认可度。公司充分把握这一市场契机, 凭借产品的优异性能、完善快速的技术服务支持, 在下游需求爆发式增长的背景下, 在 2012 年度快速实现销售收入的增长, 并将收入增长的趋势保持至今。

4) Fabless 业务模式能够迅速扩充产量满足市场需求, 是公司收入大幅度增长的有效保障

公司采用 Fabless 业务模式, 与委外加工厂商建立了良好的长期合作关系, 将芯片生产环节外包, 集中资源于芯片研发、设计以及市场营销环节。公司通过对研发的持续投入, 储备了大量核心技术, 并在市场调研的基础上, 准确预测未来技术的发展方向, 不断推出新型技术与产品, 努力做到贴近市场的需求, 灵活应对电子消费品市场热点的转换。借助 Fabless 业务模式下芯片生产环节的外包, 公司无需投入大量资金购置固定资产、扩建生产线, 可在较短周期内利用外部资源, 实现芯片产品的大量上市, 充分满足市场及客户日益增长的需求, 保证公司营业规模的大幅度增长。

5) 成功研发指纹识别芯片，为公司未来业务持续增长奠定坚实基础

近年来，电容触控芯片市场竞争日益激烈，单片售价不断下行，市场规模增速有所放缓。为保持长期竞争力，公司在前期积累的电容触控技术基础上，自主研发了指纹传感器技术、指纹匹配算法等核心技术，推出了市场领先的全系列指纹芯片产品，并成功应用于中兴、乐视、魅族、维沃、金立等知名品牌手机客户。根据赛迪顾问的报告，2014年，全球智能终端指纹识别芯片的出货量达到 21,071 万颗，市场销售额达到 20.90 亿美元。预计到 2017 年，全球智能终端指纹识别芯片市场规模将达到 70,995.10 万颗，销售额将达到 49.30 亿美元。由于指纹识别芯片技术含量高、产品单价高、准入门槛高等特点，有较好的发展前景，有望成为公司新一轮业绩增长点。

(2) 营业收入按产品类别分析

2013 年度、2014 年度和 2015 年度，电容触控芯片收入占公司营业收入的比重分别为 98.75%、98.29% 和 76.31%，为公司营业收入的主要来源。公司触控芯片主要应用于智能手机、平板电脑等终端的触屏信号以及 MP3、MP4 和家用电器的按键信号的检测和控制。报告期内，随着智能手机、平板电脑市场的快速升温，公司电容触控芯片收入快速增长。

2014 年度，公司推出新产品指纹识别芯片，2015 年度指纹识别芯片和模组收入占公司营业收入的比重已经上升至 23.31%，日益成为公司营业收入的重要组成部分。

报告期内，固定电话芯片收入占公司营业收入的比例呈下降的趋势。主要是由于电容触控芯片收入快速增长，导致固定电话芯片收入占比大幅降低；同时，随着移动通讯市场的发展，固定电话市场步入成熟期，固定电话芯片的销售收入亦随之逐步下降。

3、主营业务收入的区域性分析

2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司主营业务收入的区域分布如下表所示：

单位：万元

地区	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	占比
境内	75,121.74	67.33%	50,426.84	59.07%	40,645.30	59.28%
境外	36,454.25	32.67%	34,942.52	40.93%	27,916.80	40.72%
合计	111,575.99	100.00%	85,369.36	100.00%	68,562.09	100.00%

报告期内，公司存在一定比例的境外收入，主要是由于汇顶科技在香港实现了部分销售收入。香港是传统的电子产品集散地，由于一部电子设备（如手机或平板电脑）需要使用为数众多的芯片，而这其中大部分芯片需要从海外进口，客户往往在香港设立采购中心，方便其整体的交付及物流效率提升，因此众多客户选择在香港交货亦属行业惯例，该等货物销售以美元为结算货币。根据刘大潜律师行出具的法律意见书，芯片产品作为非战略产品出口至香港，无需向香港政府申请许可证，只需要一般进口货物的报关及缴交入口税。

4、其他业务收入

2015 年度，公司除主营业务收入外，还产生其他业务收入 384.13 万元，主要是公司将暂时闲置的自购房产出租给第三方取得租金收入，有利于提高公司的资产使用效率。

（二）经营成果的变动情况分析

报告期内，公司的经营成果变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅
一、营业收入	111,960.13	31.15%	85,369.36	24.51%	68,562.09	23.17%
减：营业成本	47,185.38	60.36%	29,425.47	25.47%	23,452.32	25.51%
二、毛利	64,774.74	15.79%	55,943.89	24.02%	45,109.78	21.98%
减：营业税金及附加	1,103.74	5.93%	1,041.99	19.23%	873.91	35.29%
销售费用	3,563.12	41.56%	2,516.99	-3.79%	2,616.13	174.63%
管理费用	21,549.01	88.31%	11,443.17	24.38%	9,200.32	15.71%
财务费用	-1,364.24	148.02%	-550.05	1173.26%	-43.20	-350.86%
资产减值损失	806.52	41.30%	570.78	9.36%	521.91	-9.97%
加：公允价值变动收益	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
三、营业利润	39,116.60	-4.41%	40,921.00	28.12%	31,940.71	19.03%
加：营业外收入	4,473.50	26.67%	3,531.56	629.27%	484.26	214.49%
减：营业外支	20.00	-	-	-	1,954.08	55058.11%

项目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅
出						
四、利润总额	43,570.10	-1.99%	44,452.55	45.89%	30,470.88	12.92%
减：所得税费用	5,762.33	-5.46%	6,095.01	26.79%	4,807.20	6.29%
五、净利润	37,807.77	-1.43%	38,357.55	49.46%	25,663.69	14.26%
六、扣除非经常性损益后的净利润	37,585.63	-0.14%	37,637.65	27.88%	29,431.53	11.70%

1、营业收入

营业收入的具体情况请参见本节“二、盈利能力分析”之“（一）营业收入构成及变动分析”。

2、营业成本

2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司的营业成本情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业成本	47,185.38	29,425.47	23,452.32
其中：主营业务成本	46,954.48	29,425.47	23,452.32
其他业务成本	230.90	-	-
营业成本增长率	60.36%	25.47%	25.51%
占营业收入比例	42.14%	34.47%	34.21%

注：其他业务成本主要是出租房产对应的折旧金额。

2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司的主营业务成本分别为 23,452.32 万元、29,425.47 万元和 46,954.48 万元，占主营业务收入的比例分别为 34.21%、34.47% 和 42.08%。报告期内，公司主营业务成本占主营业务收入的比例略有上升，主要是由于芯片产品售价不断下降。虽然得益于晶圆单价下降以及工艺改善等影响，公司电容触控芯片单位芯片成本同样下降，但整体上成本占收入比仍有升高。

（1）电容触控芯片成本分析

电容触控芯片报告期内营业成本、单位成本构成如下表所示：

项目	2015 年度	2014 年度
----	---------	---------

	营业成本 (万元)	成本构成 (%)	单位成本 构成 (元/ 颗)	营业成本 (万元)	成本构成 (%)	单位成本 构成 (元/ 颗)
总成本	29,617.81	100.00	1.25	28,297.85	100.00	1.36
其中：外协原材料成本	16,069.86	54.26	0.68	16,404.12	57.97	0.79
非外协原材料成本	65.39	0.22	-	87.38	0.31	-
封装成本	11,262.01	38.02	0.48	9,841.73	34.78	0.47
烧录测试成本	1,948.78	6.58	0.08	1,622.34	5.73	0.08
刻字等其他成本	271.77	0.92	0.01	342.28	1.21	0.02

续：

项目	2013 年度		
	营业成本 (万元)	成本构成 (%)	单位成本构成 (元/颗)
总成本	22,903.91	100.00	1.67
其中：外协原材料成本	14,384.36	62.80	1.05
非外协原材料成本	71.50	0.32	0.01
封装成本	7,078.26	30.90	0.52
烧录测试成本	1,105.97	4.83	0.08
刻字等其他成本	263.81	1.15	0.01

报告期内，公司电容触控芯片单位成本持续下降。

2015 年度、2014 年度和 2013 年度，公司外协原材料成本和封装成本占各期总成本比例分别为 92.28%、92.75% 和 93.70%，各期比较稳定。公司外协原材料是指外购晶圆，报告期内单位成本呈现下降趋势，由 2013 年度的 1.05 元/颗下降至 2015 年度的 0.68 元/颗；公司封装单位成本较为稳定，2013 年度为 0.52 元/颗，2015 年度为 0.48 元/颗。因此，电容触控芯片单位成本下降主要是因为成本构成中外协原材料单位成本下降所致。

报告期内，公司采用 0.11 微米工艺加工芯片，由于同一尺寸晶圆在 0.11 微米工艺下产出的芯片数量较多，因而单位成本保持较低；同时，随着业务规模扩大，公司议价能力增强，晶圆采购价格进一步下降。

(2) 指纹识别芯片成本分析

指纹识别芯片报告期内营业成本、单位成本构成如下表所示：

项目	2015 年度	2014 年度
----	---------	---------

	营业成本 (万元)	成本构成 (%)	单位成本 构成 (元)	营业成本 (万元)	成本构成 (%)	单位成本 构成 (元)
总成本	17,087.35	100.00	14.96	827.29	100.00	52.21
其中：外协原材料	8,187.40	47.91	7.17	185.66	22.44	11.72
封装	3,780.83	22.13	3.31	86.05	10.40	5.43
组装	4,167.98	24.39	3.65	523.55	63.28	33.04
其他	951.14	5.57	0.83	32.03	3.88	2.02

2014 年度和 2015 年度，指纹识别芯片单位成本绝对金额较高。2015 年度单位成本较 2014 年度大幅下降，特别是组装成本单价由 2014 年度的 33.04 元下降至 3.65 元，占比由 2014 年度 63.28% 下降至 24.39%，主要是因为 2014 年度汇顶科技指纹识别产品以销售模组为主，与电容触控芯片以销售芯片为主有所区别，在 2015 年度，特别是 2015 年下半年，汇顶科技指纹识别产品转为以销售芯片为主。

(3) 固定电话芯片成本分析

公司制定固定电话芯片的规格参数、完成系统设计和验证后，通过向供应商定制芯片空片并委托其在空片中写入公司设计的软件程序的方式，生产出最终的芯片成品。报告期内固定电话芯片营业成本均为芯片采购成本。

(4) 外协成本的核算方式及依据

公司主要产品为电容触控芯片和指纹识别芯片。公司主要从事芯片的设计和制造，而将晶圆制造、检测、封装、芯片烧录测试等环节均通过委外方式进行。目前，全球绝大多数集成电路企业均为此种模式。公司各环节外协的会计核算方式及依据如下：

1) 采购订制晶圆环节会计核算方式及依据

公司向各主要供应商采购晶圆均签订有采购订单，采购订单对订购晶圆的品类、价格、结算方式、交货方式、质量标准等均有约定。各月末供应商已发货在途的晶圆，财务部门凭采购订单及供应商对账单计入在途物资科目核算；对于验收入库的晶圆，仓库凭验收单制作原材料入库单并登记晶圆原材料明细台账，财务部门凭进口货物报关单、验收单、入库单计入原材料科目核算；外购晶圆以采购订单、进口货物报关单确定的外币金额折算人民币按实际成本计价入账。

2) 晶圆发外协厂商检测及已检测的晶圆收回入库环节的会计核算方式及依据

仓库凭采购供应部门测试加工单制作原材料出库单并登记晶圆原材料明细台账及晶圆外协加工明细台账，财务部门凭出库单按月末一次加权平均计价将发外协厂商检测的晶圆从原材料科目转入委托加工物资科目核算。经外协厂商检测完毕入库的晶圆，公司仓库凭外协厂商送货单，制作晶圆原材料入库单并登记晶圆原材料明细台账，财务部门凭入库单、送货单将原委托加工物资——晶圆材料成本及相应的应付检测加工费作为检测入库的晶圆成本计入原材料科目核算。

3) 晶圆发外协厂商封装及已封装的芯片收回入库环节会计核算方式及依据：

晶圆发外协厂商封装，仓库凭采购供应部封装加工单制作原材料出库单并登记晶圆原材料明细台账及晶圆外协加工明细台账，财务部门凭出库单按月末一次加权平均计价将发外协厂商封装的晶圆从原材料科目转入委托加工物资科目核算。

经外协厂商封装切割完毕入库的芯片（晶圆经封装切割完毕已转化成以颗为计量单位的芯片），公司仓库凭外协厂商送货单，制作芯片半成品入库单并登记芯片半成品明细台账，财务部门凭入库单、送货单将原委托加工物资——晶圆材料成本及相应的应付封装加工费作为封装入库的芯片成本计入半成品科目核算。

同时该环节委托加工物资按外协厂商，分外协原材料品种、规格型号、数量、成本金额明细核算。

4) 半成品芯片发外协厂商烧录测试及已烧录测试的芯片收回入库环节的会计核算方式及依据

公司与主要外协烧录测试商签订外协合同，外协合同对芯片烧录的技术标准、外协烧录价格、结算方式、交货方式等均有约定。封装后的半成品芯片发外协厂商烧录测试，仓库凭采购供应部烧录测试加工单制作芯片半成品出库单并登记半成品明细台账及半成品外协加工明细台账，财务部门凭出库单按月末一次加权平均计价将发外协厂商烧录测试的芯片从半成品科目转入委托加工物资科目核算。

经外协厂商烧录测试完毕入库的芯片，公司仓库凭外协厂商送货单，制作芯片产成品入库单并登记芯片产成品明细台账，财务部门凭入库单、送货单将原委托加工物资——芯片半成品成本及相应的应付烧录检测加工费作为入库的产成品芯片成本计入产成品科目核算。

同时该环节委托加工物资按外协厂商，分外协半成品品种、规格型号、数量、成本金额明细核算。

5) 半成品芯片及其他材料发外协厂商组装及已组装的芯片模组收回入库环节的会计核算方式及依据

报告期内芯片外协组装主要是 2014 年度以及 2015 年上半年针对向魅族销售的指纹识别芯片。汇顶科技与外协组装厂商签订外协合同，外协合同对芯片模组的技术标准、外协组装价格、结算方式、交货方式等均有约定。封装后的半成品芯片及其他材料发外协厂商组装，仓库凭采购供应部组装加工单制作芯片半成品及其他材料出库单并登记半成品及其他材料明细台账及半成品外协加工明细台账，财务部门凭出库单按月末一次加权平均计价将发外协厂商组装的芯片及其他材料从半成品及其他材料科目转入委托加工物资科目核算。

经外协厂商组装完毕入库的芯片模组，公司仓库凭外协厂商送货单，制作芯片模组产成品入库单并登记芯片模组产成品明细台账，财务部门凭入库单、送货单将原委托加工物资——芯片半成品成本及其他材料成本、应付组装加工费作为入库的产成品芯片模组成本计入产成品科目核算。

同时该环节委托加工物资按外协厂商，分外协半成品品种、规格型号、数量、成本金额明细核算。

经保荐机构和申报会计师核查，公司外协加工业务流程、各外协环节与主要外协加工商签订的外协加工合同以及各外协环节的内外部流转单据、会计核算记录、相应的明细台账，公司各环节外协会计核算方式符合其实际业务流程，与外协厂商签订的外协加工合同约定一致。

3、期间费用

报告期内，公司各项期间费用占营业收入的比例情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例
销售费用	3,563.12	3.18%	2,516.99	2.95%	2,616.13	3.82%

项目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例
管理费用	21,549.01	19.25%	11,443.17	13.40%	9,200.32	13.42%
财务费用	-1,364.24	-1.22%	-550.05	-0.64%	-43.20	-0.06%
合计	23,747.89	21.21%	13,410.12	15.71%	11,773.24	17.17%

与公司业务规模快速扩张相适应，报告期内公司期间费用总额逐年增长。

(1) 销售费用

报告期内，公司各期销售费用主要项目及所占比例如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例
技术服务费	1,284.02	1.15%	881.69	1.03%	1,193.95	1.74%
职工薪酬	1,217.25	1.09%	1,033.62	1.21%	844.35	1.23%
差旅费	299.62	0.27%	288.60	0.34%	195.35	0.28%
业务费	181.14	0.16%	142.52	0.17%	155.21	0.23%
报关费	3.47	0.00%	1.42	0.00%	8.06	0.01%
宣传费	451.17	0.40%	72.61	0.09%	101.63	0.15%
办公费	116.95	0.10%	87.32	0.10%	110.81	0.16%
折旧摊销费	9.50	0.01%	9.22	0.01%	6.77	0.01%
合计	3,563.12	3.18%	2,516.99	2.95%	2,616.13	3.82%

公司的销售费用主要包括技术服务费、职工薪酬、差旅费和业务费。2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司销售费用分别为 2,616.13 万元、2,516.99 万元和 3,563.12 万元，占同期营业收入的比例分别为 3.82%、2.95%和 3.18%。报告期内公司销售费用总体呈现增长趋势，主要是由于公司业务规模快速扩张，销售人员数量快速增长、薪酬水平有所提升，同时还产生了一定金额的技术服务费、差旅费、业务费和宣传费。

公司技术服务费的分析具体如下：

1) 技术服务费的内容和收费标准

根据公司与联想移动通信科技有限公司等公司签订的《服务外包框架协议》及其补充协议，技术服务内容主要包括该等厂商所有应用到汇顶科技产品的触摸屏模组的结构

设计、标准要求定义、程序设计（驱动调试）、产品性能优化及改善、与触摸屏模组厂等配合方之间的沟通服务等内容，服务的方式包括但不限于通过不定期、不定量的产品设计、测试分析、技术改造专业技术人员的培训等。

根据合同约定，收费标准主要有两种方式：一是每期服务费用的结算金额依据当期技术服务商提供服务的汇顶科技产品的数量（即：直接或间接采购量）乘以服务单价，服务单价由双方协商确定；二是每期服务费用的结算金额依据当期技术服务商提供服务的汇顶科技产品的销售金额（不含税）总额乘以一定百分比确定。

2) 技术服务费变化原因

公司报告期内技术服务费金额及提供商数量如下表所示：

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
技术服务费（万元）	1,284.02	881.69	1,193.95
技术服务提供商数量	11	8	2

由于知名品牌手机厂商对触控芯片产品的要求高于一般终端厂商，为帮助汇顶科技产品更好的应用于其手机产品，并符合其对性能和产品上市时间的要求，需要其为汇顶科技提供技术服务咨询。报告期内，随着汇顶科技触控芯片的销售规模扩大和应用于知名品牌手机厂商的销售占比提升，外包技术服务提供商数量从 2 家增加至 11 家。公司技术服务费 2014 年度较 2013 年度减少的原因系随着汇顶科技芯片相关技术的不断成熟，需要接受单家厂商的技术服务相应减少，技术服务收费单价或收费比例下降所致。技术服务费 2015 年度较 2014 年度增加，主要系随着汇顶科技芯片产品更新换代加快，及指纹识别芯片销售规模大幅增加，需要的技术服务量增加所致。

(2) 管理费用

报告期内，公司各期管理费用主要项目及所占比例如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例
研发费用	16,040.99	14.33%	8,220.88	9.63%	4,397.33	6.41%
职工薪酬	1,818.12	1.62%	1,470.26	1.72%	1,199.73	1.75%
办公经费	191.17	0.17%	204.66	0.24%	259.92	0.38%

项目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例
房租水电费	515.57	0.46%	446.87	0.52%	195.92	0.29%
咨询服务费	2,008.58	1.79%	142.76	0.17%	168.12	0.25%
业务差旅费	50.74	0.05%	104.57	0.12%	101.82	0.15%
招聘培训费	126.78	0.11%	120.30	0.14%	232.51	0.34%
存货盘亏	-	-	-	-	-	-
折旧摊销费	554.60	0.50%	490.80	0.57%	121.31	0.18%
税费	-2.05	0.00%	138.62	0.16%	49.69	0.07%
其他	244.50	0.22%	103.45	0.12%	131.59	0.19%
股份支付	-	-	-	-	2,342.36	3.42%
合计	21,549.01	19.25%	11,443.17	13.40%	9,200.32	13.42%

公司的管理费用主要为研发费用、职工薪酬及房租水电费等。2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司管理费用分别为 9,200.32 万元、11,443.17 万元和 21,549.01 万元，占营业收入的比例分别为 13.42%、13.40%和 19.25%。报告期内，公司管理费用总体呈现增长趋势，主要是由于公司加大了新产品和新技术的研发投入，陆续推出了应用于平板电脑和智能手机的系列电容屏触控芯片和指纹识别芯片，研发费用大幅度增加。此外，2013 年度股份支付金额为 2,342.36 万元，主要系原始股东低价转让股权给员工，按照股份支付进行会计处理计入管理费用的损益。2015 年度咨询服务费为 2,008.58 万元，主要包含专利诉讼中支付的律师费 1,874.53 万元。

公司研发费用的分析具体如下：

1) 研发费用的计提依据

报告期内公司研发费用包括研发新产品新技术发生的职工薪酬、研发耗材、差旅费、折旧摊销费等，其中职工薪酬核算研发部门人员发生的工资奖金、福利费、社会保险费及住房公积金等支出；研发耗材核算为实施研发项目而购买的原材料等相关支出；差旅费核算研发人员为研发项目发生的相关差旅支出；折旧摊销费核算研发用固定资产的折旧费用及研发用无形资产的摊销费用。公司研发费用在实际发生直接计入当期管理费用——研发费用。

2) 报告期内研发费用大幅增长的原因

公司的主营业务是芯片设计，产品升级较快、行业技术更新较快，为了更好地满足日益增长的客户需求，保持企业技术竞争优势，储备行业前瞻技术，公司持续加大新产品与新技术的研发投入。报告期内各期研发费用结构如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	11,689.15	6,037.72	3,079.74
研发耗材	840.21	763.62	305.55
项目评估测试费	294.25	92.50	34.71
外发加工费	455.43	241.40	-
差旅费	761.07	380.74	195.79
折旧摊销费	501.67	261.82	167.88
专利、咨询及设计费	1,182.40	334.12	557.46
其他	316.80	108.96	56.20
合计	16,040.99	8,220.88	4,397.33
占主营业务收入比重	14.38%	9.63%	6.41%
其中职工薪酬占比	72.87%	73.44%	70.04%

如上表所示，公司研发费用报告期内大幅增长，2014 年度较 2013 年度增长 86.95%，2015 年度较 2014 年度增长 95.12%。研发费用占主营业务收入的比重也持续上升，由 2013 年度 6.41% 上升至 2015 年度的 14.38%。研发费用大幅度增加的一个重要原因是公司大力投入指纹识别芯片的技术研究和产品开发，力求在短时间内通过大规模投入迅速建立在这一新兴市场的技术和产品领先优势。研发费用支出中主要是职工薪酬、研发耗材、差旅费，占各期研发费用的 85% 以上，其中职工薪酬占研发费用的 72% 左右，报告期内研发费用中职工薪酬的分析如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	11,689.15	6,037.72	3,079.74
职工薪酬增长率	93.60%	96.05%	76.67%
期末研发人员人数	544	311	200
研发人员人数增长率	74.92%	55.50%	61.29%
人均职工薪酬	21.49	19.41	15.40
人均职工薪酬增长率	10.72%	26.04%	9.52%

如上表分析，研发费用中职工薪酬的增加主要是研发人员增加及人均薪酬增加所致。经核查，保荐机构和申报会计师认为，汇顶科技研发费用的会计处理符合企业会计准则的规定以及公司的实际情况。

(3) 财务费用

报告期内，公司财务费用主要是汇兑损益等，财务费用主要项目如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
利息支出	-	-	-
减：利息收入	606.08	539.94	308.63
汇兑损益	-777.38	-18.16	257.85
加：其他	19.22	8.05	7.58
合计	-1,364.24	-550.05	-43.20

2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司财务费用分别为-43.20 万元、-550.05 万元和-1,364.24 万元。报告期内，公司不存在银行借款及利息支出。

(4) 销售费用率、管理费用率与可比公司的比较

报告期内，公司与可比同行业上市公司销售费用率、管理费用率比较情况如下表所示：

项目	销售费用率			管理费用率		
	2015 年度	2014 年度	2013 年度	2015 年度	2014 年度	2013 年度
北京君正		3.73%	2.00%		111.24%	63.39%
国民技术		13.37%	11.13%		45.15%	48.70%
欧比特		5.50%	5.25%		17.92%	19.83%
全志科技		2.17%	1.33%		20.04%	12.99%
中颖电子		3.18%	3.79%		27.60%	28.52%
平均值		5.59%	4.70%		44.39%	34.69%
中位值		3.73%	3.79%		27.60%	28.52%
公司	3.18%	2.95%	3.82%	19.25%	13.40%	13.42%

注：数据来源于可比公司定期报告、招股说明书，截至本招股说明书签署之日，北京君正、国民技术、欧比特、全志科技、中颖电子 2015 年年报尚未披露。

从上表可见，2013 年和 2014 年，公司销售费用率和管理费用率显著优于行业可比公司平均水平，主要原因是在收入大幅增长的情况下，公司有效控制了销售费用和管理费用的规模。

4、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
坏账损失	631.64	265.15	46.48
存货跌价损失	174.88	305.64	475.43
合计	806.52	570.78	521.91

2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司的资产减值损失分别为 521.91 万元、570.78 万元和 806.52 万元。报告期内，公司的资产减值损失主要为坏账损失和存货跌价损失。

5、营业外收入

报告期内，公司营业外收入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
软件增值税即征即退	4,159.76	2,684.64	207.13
政府补助	313.75	814.02	273.65
其他	-	32.90	3.48
合计	4,473.50	3,531.56	484.26

2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司的营业外收入分别为 484.26 万元、3,531.56 万元和 4,473.50 万元。报告期内，公司的营业外收入主要为软件增值税即征即退和政府补助。

6、营业外支出

报告期内，公司营业外支出情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损失合计	-	-	2.14
其中：固定资产处置损失	-	-	2.14

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
无形资产处置损失	-	-	-
公益性捐赠支出	-	-	1,950.00
其他支出	20.00	-	1.95
合计	20.00	-	1,954.08

公司 2013 年度营业外支出增长较大主要是因为：公司在 2013 年度向电子科技大学教育发展基金会、西安电子科技大学教育基金会、华中科技大学教育发展基金会、广东省华南理工大学教育发展基金会、中南大学教育基金会等机构进行公益性捐赠，总计 1,950.00 万元，上述捐赠有助于提升公司的品牌影响力和对国内优秀大学毕业生的吸引力。

（三）毛利率分析

1、毛利率情况

2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司综合毛利率分别为 65.79%、65.53% 和 57.86%，受芯片平均单价持续下降以及指纹识别芯片毛利率较低影响，公司综合毛利率持续下降，但总体上保持在较高水平，主要是由于公司根据市场需求，适时推出新产品，丰富和完善产品线，并不断改进现有产品工艺水平。

2、主营业务产品的毛利率情况

报告期内，公司的主营业务产品的毛利率情况如下表所示：

单位：万元

产品名称	2015 年度			2014 年度			2013 年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
电容触控芯片	85,144.94	29,617.80	65.21%	83,912.05	28,297.85	66.28%	67,707.20	22,903.91	66.17%
指纹识别芯片	26,012.72	17,087.35	34.31%	967.76	827.29	14.51%	-	-	-
固定电话芯片	418.33	249.32	40.40%	489.55	300.33	38.65%	854.90	548.41	35.85%

从上表可见，2013 年度、2014 年度和 2015 年度，电容触控芯片毛利率分别为 66.17%、66.28% 和 65.21%，总体保持较高水平；同期固定电话芯片毛利率分别为 35.85%、38.65% 和 40.40%，基本保持稳定。而 2014 年起新推出的指纹识别芯片毛利率较低，2014 年度与 2015 年度毛利率分别为 14.51% 和 34.31%。具体分析如下：

(1) 电容触控芯片

2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司电容触控芯片的平均单价分别为 4.95 元、4.04 元和 3.60 元，单位成本分别为 1.67 元、1.36 元和 1.25 元，毛利率分别为 66.17%、66.28%和 65.21%。2014 年度毛利率较 2013 年度有所上升，主要是由于公司在 GT9 系列的基础上推出了 GT1151 等新一代高端系列产品，该等产品作为 GT9 系列的高端型号，推出后在市场上获得良好反响；公司通过高端产品的研发和销售，在触控芯片售价整体下降的情况下，维持了较好的毛利率水平。

(2) 指纹识别芯片

2014 年度和 2015 年度，指纹识别芯片的平均单价分别为 61.09 元和 22.77 元，单位成本分别为 52.21 元和 14.96 元，毛利率分别为 14.51%和 34.31%，显著低于电容触控芯片和固定电话芯片。公司于 2014 年四季度推出指纹识别芯片，由于指纹识别技术是非常新的技术，在当时尚无成熟模组配套供应链体系。为满足客户的交付要求并对客户的量产交付时间及质量直接负责，公司采取了委外加工模组并交付指纹模组给客户。由于芯片在模组的成本结构中占比较低而且首批模组量产良率尚有待提高，因此毛利率较低。鉴于指纹模组生产技术日趋完善，模组供应商日益增多，2015 年下半年开始，公司回归向客户提供芯片的业务模式，与模组相比，芯片单价下降幅度较大，但全年指纹识别芯片产品毛利率较 2014 年度显著提升；同时公司持续开发的新产品技术更先进、集成度更高，预计未来指纹识别芯片毛利率有望大幅提高。

(3) 固定电话芯片

2013 年度、2014 年度和 2015 年度，固定电话芯片毛利率分别为 35.85%、38.65%和 40.40%，固定电话属于传统成熟的市场领域，固定电话芯片毛利率基本维持稳定。

3、可比公司的毛利率情况

2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司与可比公司的综合毛利率指标如下表所示：

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
北京君正		55.46%	48.66%
国民技术		39.18%	38.09%
欧比特		45.76%	46.99%
全志科技		30.44%	41.32%

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
中颖电子		36.41%	37.23%
平均值		41.45%	42.46 %
中位值		39.18%	41.32 %
公司	57.86%	65.53%	65.79%

注：数据来源于可比公司定期报告、招股说明书，截至本招股说明书签署之日，北京君正、国民技术、欧比特、全志科技、中颖电子 2015 年年报尚未披露。

目前 A 股上市公司中，除本公司外，尚无其他从事电容触控芯片和指纹识别芯片设计与研发的企业。本招股说明书中选取的可比公司均从事集成电路设计业务，但具体业务和产品应用差异较大，如下表所示：

公司名称	主营业务	产品应用
北京君正	CPU 芯片和配套平台的设计和 sales	教育电子产品和消费电子产品，如学生平板等
国民技术	信息安全芯片和通讯芯片研发与销售	USBKEY 安全芯片、移动支付芯片，广泛应用于银联卡等
欧比特	片上系统芯片、智能控制平台和总线控制模块的研发、设计与销售	应用于航空航天以及卫星相关技术
全志科技	终端应用处理器芯片和电源管理芯片的设计与销售	平板电脑、电源管理芯片等
中颖电子	MCU 芯片的设计与销售	小家电以及电脑数码产品等
公司	电容触控芯片和指纹识别芯片的设计与销售	智能手机、平板电脑等

由于可比公司下游终端客户所处行业不同，毛利率相差较大。2013 年以来，公司电容屏触控芯片销售快速增长，电容屏触控芯片应用于平板电脑和智能手机领域，属于消费类电子产品新兴热点领域，技术水平高。因此，与同行业上市公司相比，公司毛利率高于可比公司。

（四）利润的主要来源及盈利能力的连续性和稳定性分析

1、利润的主要来源

报告期内，公司利润的来源情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
主营业务毛利	64,621.51	55,943.89	45,109.78
其他业务毛利	153.23	-	-
投资收益	-	-	-

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业利润	39,116.60	40,921.00	31,940.71
营业外收支净额	4,453.50	3,531.56	-1,469.83
利润总额	43,570.10	44,452.55	30,470.88
净利润	37,807.77	38,357.55	25,663.69
净利率	33.77%	44.93%	37.43%

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度的净利润分别为 25,663.69 万元、38,357.55 万元和 37,807.77 万元。公司 2015 年度净利润率较 2014 年度有所下滑，主要原因包括指纹识别芯片毛利率较低以及研发费用大幅增长等。从上表看出，公司报告期内的利润主要来源于主营业务。

2、影响盈利能力连续性和稳定性的因素

公司管理层认为，公司在智能人机互动技术领域具备较强的技术实力、持续的研发创新能力以及市场需求分析能力，公司未来能够保持盈利的持续与稳定，但以下几个因素可能会对公司发展的稳定性产生一定的影响：

(1) 宏观经济的波动及市场需求的变化

公司芯片产品主要应用于电容屏触控以及带有指纹识别功能的电子产品，随着智能手机、平板电脑等移动智能终端的普及，用户对电子产品触控体验以及指纹识别的需求日益增强，极大地刺激了市场上对此类产品的偏好。

消费类电子产品具有更新换代较快的特点，公司产品具有广阔的市场空间。但宏观经济波动，可能影响市场整体消费能力，消费类电子产品的新购和重置可能会放缓，新产品的消费需求可能受到影响。除更新换代较快外，消费类电子产品的功能也日益向多元化、综合化发展。随着市场上新型产品的不断推出，以及用户需求偏好的变化，可能会对公司产品的市场需求产生影响。

对此，公司坚持以市场需求为导向，注重产品的客户体验，紧密跟踪智能手机、平板电脑等智能终端市场的需求，根据市场需求及技术发展趋势进行产品研发，以应对宏观经济的波动以及市场需求的变化。

(2) 持续的技术创新能力及产品的更新换代

消费类电子产品市场日新月异，产品的形态、功能以及客户需求转换较快，芯片等电子元器件需要不断的革新，在性能、适用范围等方面持续调整和提升，对集成电路设计企业的研发能力提出了较高要求。如果公司未来不能保持持续创新能力，则将落后于行业的发展节奏，从而失去竞争优势。另一方面，公司技术研发方向可能与市场发展趋势相偏离，导致公司研发资源浪费并错失市场发展机会。

对此，公司秉承“引领先进技术、紧跟市场需求”的新产品研发理念，持续加大研发投入，加强项目跟踪和控制能力，针对消费类电子产品市场需求转换，适时推出芯片产品和技术方案，以持续推动产品技术的更新换代，保持公司盈利的持续性和稳定性。

（3）同行业市场竞争的加剧

集成电路设计行业的市场竞争日趋激烈。以公司主要产品电容屏触控芯片为例，由于电容式触摸屏应用最近几年的爆发性增长，吸引了国内外多家集成电路设计公司相继进入这一市场，其中不乏国际知名的设计公司，使得设计厂商队伍迅速扩大，竞争日渐升温。一方面，欧美企业拥有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，如 Atmel、Cypress、Synaptics 等均具有较强的综合竞争实力。与之相比，公司虽然具有较好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力和品牌知名度方面还有一定差距。另一方面，随着更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，芯片产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。

（4）原材料价格及委外加工成本的波动

公司为集成电路设计企业，采取 Fabless 运营模式，专注于研发设计芯片，芯片的生产委托专业加工厂商进行。若原材料和委外加工价格大幅上涨，或由于原材料供货短缺、委外厂商产能不足、生产管理水平欠佳等原因影响公司的产品生产，将会对公司的存货备货和盈利能力造成影响。

（5）募集资金投资项目的开展

本次公开发行股票，募集资金将用于大、中、小尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目、On-cell 触摸屏控制芯片开发项目、主动式电容触控笔芯片技术升级项目、电容式近场通信微控制器开发及产业化项目、指纹识别芯片和模组开发及产业化项目以及研发中心建设。上述项目的开展有利于进一步保持并提升公司的技术研发优势和产品创新能力

力，丰富产品种类，改进产品性能并提高产品的竞争力，从而增强公司盈利能力，促进公司更快发展。但如果投资项目未能实现预期收益，公司收入下降或增长较小，研发费用、折旧摊销等固定费用将对公司未来盈利能力产生一定影响。

（五）公司薪酬水平分析

报告期内，与公司签订劳动合同的董事、监事、高级管理人员与普通员工各期平均薪酬情况如下表所示：

单位：元/年

	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	薪酬	人数	薪酬	人数	薪酬	人数
董监高	470,601	9	423,720	9	440,989	9
普通员工	220,015	650	201,987	404	162,438	291
平均	223,437		206,819		170,794	
深圳地区 在职员工 平均薪酬	N.A.		73,492		77,721	

*注：员工人数取期末在册人数；董监高相关数据统计不包括外部董事、独立董事与外部监事；深圳地区在职员工平均薪酬来源于国家统计局网站，2015 年数据尚未公布。

2013 年度和 2014 年度，公司员工平均薪酬、普通员工薪酬均显著高于深圳地区在职员工平均薪酬。

报告期内，公司行政管理人员、研发人员与销售人员的各期平均薪酬情况如下表所示：

单位：元/年

	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	薪酬	人数	薪酬	人数	薪酬	人数
行政管理人员	252,516	72	253,494	58	210,480	57
研发人员	214,874	544	194,139	311	153,987	200
销售人员	283,081	43	234,914	44	196,360	43
平均	223,437		206,819		170,794	

报告期内，公司研发人员与销售人员的薪酬均持续增长，与公司经营规模和收入的增长相适应。

公司未来薪酬制度的主体框架将延续目前的薪酬制度，但为了更好地吸引和留住骨干人员，充分发挥员工积极性，公司将进一步完善绩效考核制度，并充分保障绩效考核制度的有效执行

公司目前全部岗位平均薪酬水平高于深圳市在职员工平均水平。随着公司经营规模的逐渐扩大以新产品的不断推出，公司从 2013 年起开始大幅引进技术型人才，其薪酬回报已有大幅度的提高。公司在未来将继续坚持推进建立具有市场竞争力的薪酬和福利体系，逐步提高各岗位员工的年均收入水平，不断吸引优秀人才，为公司业务的长期持续发展打下基础，但公司的薪酬总体安排不会因发行上市与否而有所改变。

三、资本性支出

（一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司的资本性支出主要为预购房产、购置固定资产、无形资产（土地使用权以及外购软件）和办公室装修支出，具体支出明细如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
其他非流动资产（预购房产）	122.81	-	13,042.98
购置固定资产	1,467.31	7,104.27	483.00
购置无形资产	4,800.65	122.73	419.20
办公室装修	45.66	28.28	38.61
合计	6,436.43	7255.28	13,983.79

（二）未来重大资本性支出计划及资金需求情况

截至本招股说明书签署之日，除本次发行募集资金有关投资外，公司未来无可预见的重大资本性支出计划。其中，本次发行募集资金投资项目详细情况参见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。

四、现金流量分析

（一）现金流量情况

公司报告期内现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	22,847.27	33,465.85	25,165.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,897.79	-7,296.44	-13,803.72
筹资活动产生的现金流量净额	-10,161.53	-8,307.74	-1,705.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,046.85	86.40	-321.31
现金及现金等价物净增加额	10,834.80	17,948.07	9,335.17

（二）经营活动现金流量

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	108,398.12	86,856.05	70,854.03
收到的税费返还	4,469.98	3,498.14	1,866.91
收到其他与经营活动有关的现金	984.20	886.80	1,543.37
经营活动现金流入小计	113,852.30	91,240.99	74,264.31
购买商品、接受劳务支付的现金	57,142.33	33,877.69	28,925.68
支付给职工以及为职工支付的现金	12,825.81	7,986.37	4,307.20
支付的各项税费	11,628.89	10,832.65	9,801.74
支付其他与经营活动有关的现金	9,407.99	5,078.43	6,064.38
经营活动现金流出小计	91,005.03	57,775.15	49,098.99
经营活动产生的现金流量净额	22,847.27	33,465.85	25,165.32
净利润	37,807.77	38,357.55	25,663.69
经营活动产生的现金流量净额/净利润	60.43%	87.25%	98.06%

2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 25,165.32 万元、33,465.85 万元和 22,847.27 万元。公司 2013 年度经营活动产生的现金流量净额与净利润水平基本一致。

2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 22,847.27 万元，同期净利润为 37,807.77 万元，两者的差额为-14,960.50 万元，主要原因是：（1）2015 年公司销售额

增长较快，且新产品指纹识别芯片于年底交货，导致期末应收账款和应收票据共增加 15,659.04 万元，而应付账款增加 4,074.11 万元；（2）为及时满足客户需求，公司根据销售情况进行备货，期末存货增加 3,789.74 万元。

2014 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 33,465.85 万元，同期净利润为 38,357.55 万元，两者的差额为-4,891.70 万元，主要原因是：（1）2014 年公司销售额增长较快，且新推出的指纹识别芯片于年底交货，导致期末应收账款和应收票据共增加 6,940.17 万元，而应付账款增加 4,213.62 万元；（2）为及时满足客户需求，公司根据销售情况进行备货，期末存货增加 4,015.89 万元。

（三）投资活动现金流量

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	0.07
收到其他与投资活动有关的现金	1,918.07	-	125.00
投资活动现金流入小计	1,918.07	-	125.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,427.86	7,296.44	13,923.79
投资支付的现金	1,388.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	5.00
投资活动现金流出小计	4,815.86	7,296.44	13,928.79
投资活动产生的现金流量净额	-2,897.79	-7,296.44	-13,803.72

2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司投资活动现金流量净额分别为-13,803.72 万元、-7,296.44 万元和-2,897.79 万元。2013 年度的投资活动现金净流出主要是公司预购房产支付现金；2014 年度的投资活动现金净流出主要是公司购买房产所支付的现金；2015 年度投资活动现金净流出主要是购建固定资产、无形资产和投资支付现金。

（四）筹资活动现金流量

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
吸收投资收到的现金	-	-	-

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
筹资活动现金流入小计	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,900.00	8,250.00	1,590.02
支付其他与筹资活动有关的现金	261.53	57.74	115.09
筹资活动现金流出小计	10,161.53	8,307.74	1,705.12
筹资活动产生的现金流量净额	-10,161.53	-8,307.74	-1,705.12

2013 年度、2014 年度和 2015 年度筹资活动的现金流出主要为公司进行现金分红支付的现金 1,590.02 万元、8,250.00 万元和 9,900.00 万元。

五、财务状况和盈利能力的趋势

报告期内，公司主营业务稳步成长，收入快速增长，盈利能力强劲，资产质量和主营业务现金流量状况良好，为未来可持续发展打下了坚实的基础。

（一）财务状况趋势分析

公司目前主营业务和市场竞争优势突出，资产质量和经营业绩良好，预计公司财务状况和盈利能力未来将持续趋好。因公司采取 Fabless 运营模式，专注于芯片设计研发，公司资产结构呈现出以流动资产为主的“轻资产”特点，流动资产占总资产的比重较高，资产周转能力较好。未来随着募集资金投资项目的实施，公司流动资产占总资产的比重将有所下降。

报告期内，公司负债主要为流动负债。随着本次公开发行股票并上市，公司的权益性资金将得到充实，募集资金投资项目的资金需求将得到满足。预计未来几年，公司以流动负债为主的负债结构不会有较大程度变化。

（二）盈利能力趋势分析

公司从事智能人机交互技术的研究与开发，主要向市场提供面向手机、平板电脑等智能终端的电容屏触控芯片，公司产品目前已在平板电脑及智能手机电容屏触控芯片领域有了较强的竞争力，占据了一定的市场份额，并已经成功推出指纹识别芯片产品，搭载于众多国内知名品牌手机。未来公司将持续加大研发投入，紧密跟随市场需求，保持核心技术先进性和新型产品性能的优势。公司主要定位于消费类电子产品市场，通过保

持自身技术的领先，产品的不断升级换代，以及工艺的不断优化，依靠在市场定价、产品性能、成本控制等方面的优势，持续拓展产品种类及应用领域，公司业务规模和盈利能力预计将持续增长。

通过募集资金投资项目的实施，公司在现有智能手机、平板电脑触控芯片技术和产品的基础上，进入超极本、近场通信、指纹识别等更加广阔的应用领域，并在提升现有技术能力的同时，前瞻性的开发 In-cell、Sensor Hub 等新技术。公司持续加大技术研发投入、进行产品更新换代，为公司未来扩大品牌影响力、拓展市场份额打下了坚实的基础，加快向国际一流集成电路设计公司迈进的步伐。

六、股东未来分红回报分析

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，公司董事会和股东大会审议通过了《深圳市汇顶科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划》（以下简称“《未来三年分红回报规划》”）和《深圳市汇顶科技股份有限公司长期股东分红回报规划》（以下简称“《长期分红回报规划》”）。

（一）公司股东未来分红回报规划

1、公司制定《长期分红回报规划》的原则

公司应着眼于长远和可持续发展，牢固树立回报股东的意识，综合考虑公司实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性、连续性和稳定性。

公司制定的股东回报规划应充分重视对投资者的合理回报，综合分析公司所处行业特点、企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、发展所处阶段、经营发展规划、是否有重大资金支出安排等因素制定。

公司制定或调整股东回报规划应符合《公司章程》确定的有关利润分配政策的相关条款。公司应努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红政策。

2、股东回报规划的周期

公司应当强化回报股东的意识，以每三年为一个周期，制定周期内股东分红回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。公司董事会应根据具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定股东回报规划，并经公司股东大会表决通过后实施。

3、分红监督约束机制

公司董事会在年度报告中应披露利润分配预案，独立董事应对分红预案发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，发表专项说明和意见。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司应当在年度报告中对下列事项进行专项说明：（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等；（6）对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

（二）未来三年分红回报规划

《未来三年分红回报规划》对未来三年的具体回报规划作了如下约定：

- 1、在符合上述现金分红条件的前提下，公司应当积极推行现金分配方式。
- 2、在符合现金分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分配。
- 3、在符合现金分红条件情况下，公司未来三年每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进

行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司目前发展阶段属于成长期且未来三年内有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会对提高现金分红在本次利润分配中的最低比例进行表决。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

4、公司分配现金股利，以人民币计价。应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。公司分派股利时，按有关法律和行政法规代扣代缴股东股利收入的应纳税金。

5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会通过后两个月内完成股利或股份的派发事项。

（三）公司制定股东回报规划考虑的主要因素及合理性分析

1、公司的盈利能力和现金流量

公司从事智能人机交互技术的研究与开发，主要向市场提供面向手机、平板电脑等智能终端的电容屏触控芯片。报告期内，公司收入规模和利润总额持续稳定增长，经营性现金流良好。随着自身的成长和发展，公司将根据每年的实际盈利情况，采取积极、稳健的利润分配政策，重视投资者合理的投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

2、公司经营发展规划

公司以“创新技术、丰富生活”为使命，旨在通过自主研发、纵横扩展进一步提高公司产品的竞争力和知名度，最终实现“成为世界级的芯片及软件技术设计公司”的企

业愿景。未来，公司将进一步加大研发投入，持续进行技术创新，巩固并加强公司产品在智能手机、平板电脑等应用领域的市场地位，抓住超极本、近场通信、指纹识别等新兴市场机遇，快速抢占市场先机。公司的股东分红回报规划应与公司经营发展规划相适应，满足公司经营发展的资金需求。

3、股东回报

公司的利润分配政策将充分考虑股东，特别是中小股东实现稳定的现金投资回报的预期和要求，也兼顾投资者对公司持续发展的期望，在保证公司正常经营的发展的前提下，将采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式进行利润分配，积极回报投资者，履行社会责任，树立良好的企业形象，建立投资者对公司发展前景的信心。

4、社会资金成本

公司制定现金分红计划时，将充分考虑社会融资成本，特别是银行贷款成本。当融资利率低于净资产收益率时，适当增加现金分红比例；当融资利率高于净资产收益率时，适当减少现金分红比例，保证股东资金使用效率和回报最大化。为了实现公司持续发展，公司将适当保证留存收益，可以满足公司经营发展的需要，有利于兼顾公司长远发展和股东现时利益。

5、外部融资环境

目前公司财务状况良好，经营现金流充沛。但集成电路设计行业具有资金密集型特征，主要表现在前期需要耗费大量资金用于技术研发和产品开发，以及行业研发人员工资水平较高，需要较多的人力成本投入。故公司未来研发新产品，需要大量的资金投入。公司将持续维护好外部融资渠道，并将结合公司未来发展的战略目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合力筹集、安排和使用资金以保证资金需求；如未来外部融资环境恢复宽松，公司将视实际情况考虑进一步提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。

综上，经公司董事会和股东大会审批，公司充分考虑全体股东的利益，并根据公司目前及未来的盈利能力和现金流量、经营发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素，对本次发行完成后的股利分配政策进行了上述积极、稳妥的规划，有助于进一步增强公司盈利能力，为股东创造更多的利润，与股东分享公司成长收益。

七、本次发行对即期回报的影响及发行人拟采取措施

（一）本次发行对发行人每股收益的影响

公司本次拟发行不超过 1 亿股新股，发行后总股本不超过 5 亿股。鉴于公司主营业务产品之一的电容触控芯片销量增速已经放缓，指纹识别芯片产品未来的市场竞争格局存在一定的不确定性，根据公司的谨慎预估，不考虑指纹识别芯片产品可能的快速增长，公司 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2015 年度增幅不超过 5%。假定本次发行于 2016 年 6 月底之前实施完毕，则 2016 年度公司每股收益较 2015 年度将有所摊薄。（注：上述假设分析及关于本次发行前后公司即期回报指标的测算不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。）

（二）本次发行的必要性和合理性

1、突出和提高公司的核心竞争力

公司募集资金投资项目投产后，将提升原有产品的技术含量和市场竞争力，开发电容式近场通信微控制器、指纹识别芯片和模组等新产品，从而进一步提升公司的研发能力，开拓新的利润增长点。本次发行将进一步突出和提高公司的核心业务竞争能力，为本公司在国内和国际市场进一步确立更加稳定的竞争地位奠定基础。

2、提高公司的经营规模和盈利能力

本次募集资金项目经过充分论证，具有良好的发展前景。在募集资金项目建设期，由于项目尚未达产，公司净资产收益率在短期内将有所下降，但随着项目陆续投产和业务规模的扩大，公司盈利水平将大幅提升，公司的经营规模和盈利能力将得到进一步的提升。

3、改善公司财务状况

本次发行完成后，公司的净资产规模将大幅提高，账面价值将显著上升。随着资产规模的提高，公司的资产负债率将得到进一步改善，有利于公司间接融资能力和抵御财务风险能力的提升。

（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金运用均围绕公司主营业务进行，符合公司的发展规划。募集资金投资项目是公司发展战略的具体实施步骤，募集资金项目的实施将巩固公司在触控芯片领域的技术和市场优势，实现在智能手机、平板电脑和超极本等高成长领域触控芯片的技术和产品升级；加强对 On-cell 触摸屏控制芯片、主动式电容触控笔芯片产品的开发能力和公司技术研发能力；对电容式近场通信微控制器和指纹识别芯片产品进行开发，拓展产品线，从而进一步提高盈利水平，持续增强公司整体竞争能力。

（四）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

自 2007 年以来，公司始终致力于电容屏触控芯片产品的研发与设计，在该领域获得了深厚的技术积累：在业内较早实现了 10 点触控芯片、智能手机用单层多点触控芯片的量产，以及触摸屏上支持去除屏蔽层、将触控芯片放置在整机主板（COB）的新型生产工艺或设计方式；同时，公司的电容屏触控芯片产品在抗 TFT 显示器干扰、电磁干扰、水膜干扰、共模干扰和悬浮干扰等方面表现优异，为实施“大、中、小尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目”、“On-cell 触摸屏控制芯片开发项目”和“主动式电容触控笔芯片技术升级项目”提供了扎实的技术保障。此外，电容触控领域的很多核心技术，例如互电容检测技术、跳频技术、降噪处理算法同时也是实施“指纹识别芯片和模组开发及产业化项目”和“电容式近场通信微控制器开发及产业化项目”所需的核心技术，这些技术的积累也为公司实施上述三个新产品项目奠定了坚实的技术基础。

公司拥有一支优秀、高效的研发团队。截至 2015 年末，公司研发人员达到 544 人，占员工总人数的 82.55%，其中包括多名自国外引进的高层次技术人才。公司通过提供行业内有竞争力的薪酬以及员工持股计划对研发团队进行激励，极大地提高了研发团队的归属感和稳定性。稳定的技术团队为募集资金投资项目的实施提供了可靠的人才保证。

公司组建了市场营销部，该部门主要负责对市场信息的及时收集和营销策略的制定，跟踪了解市场竞争对手及产品价格走势情况，并利用直销和经销两种销售模式对公司产品进行有效的推广。公司还建立了完善的技术支持服务体系，致力于向下游客户提供高效、完善的技术支持和周到快捷的客户服务。公司的销售网络和技术服务体系有利

于募集资金投资项目产品的市场推广、新客户的拓展和降低产品应用成本，有利于募集资金投资项目的顺利实施。

（五）公司对保证此次募集资金有效使用、防范本次发行摊薄即期回报拟采取的措施

1、公司现有业务板块运营状况

公司从事智能人机交互技术的研究与开发，主要向市场提供面向手机、平板电脑等智能终端的电容屏触控芯片和指纹识别芯片，通过卓越的科研技术、优质的产品逐渐发展成为中国电容屏触控芯片和指纹识别芯片两大市场的主要竞争者。

在电容屏触控芯片领域，公司在业内较早实现了 10 点触控芯片、智能手机用单层多点触控芯片的量产，以及触摸屏上支持去除屏蔽层、将触控芯片放置在整机主板（COB）的新型生产工艺或设计方式；同时，公司的电容屏触控芯片产品在抗 TFT 显示器干扰、电磁干扰、水膜干扰、共模干扰和悬浮干扰等方面表现优异。自 2010 年至 2014 年，公司向市场陆续推出了 GT80 系列、GT8 系列、GT9 系列、GT9P 系列等触控芯片产品。

在指纹识别芯片领域，公司于 2014 年推出了指纹传感器技术、指纹匹配算法两项核心技术，并利用这两项技术研发出业内领先的指纹芯片产品 GF9 系列，主要应用于智能手机等终端。

2、面临的主要风险

公司面临的主要风险主要包括行业风险、经营风险、财务和税收风险、募集资金投资项目相关风险，具体情况请参见本招股说明书“第四节 风险因素”。

3、改进措施

为保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力，公司将采取以下措施提高公司未来的盈利能力和回报能力：

（1）积极稳妥的实施募集资金投资项目。本次募集资金项目经过充分论证，从中长期来看，具有良好的发展前景，若募集资金项目能按时顺利实施，将进一步巩固公司在触控芯片和指纹芯片领域的技术和市场优势，实现现有产品的技术升级和推出新产品，显著提升中长期的盈利能力及对投资者的回报能力。

(2) 提高营运资金规模和运营效率，提升公司经营业绩。公司将进一步提高资金运营效率，降低公司运营成本，通过加快新产品研发、市场推广提升公司经营业绩，应对行业波动给公司经营带来的风险，保证公司长期的竞争力和持续盈利能力。

(六) 相关承诺

1、公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

2、公司控股股东、实际控制人张帆承诺：将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

上述填补摊薄即期回报的措施已经公司第二届董事会第四次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司提请投资者注意，公司制定的上述填补摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利润做出保证。公司将在未来上市后定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

第十二节 业务发展目标

一、公司发展战略

本公司以“创新技术、丰富生活”为使命，旨在通过自主研发进一步提高公司产品的竞争力和知名度，最终实现“成为世界一流的芯片及软件技术设计公司”的企业愿景，为员工创造更大的职业发展平台，为客户创造更大价值，为股东提供持续增长的回报。

具体来说，本公司在技术上将深化电容检测技术的研究并扩大这项技术的市场应用范围。目前，本公司在国内的智能手机和平板电脑的触控芯片市场上获得较高的市场占有率，除了进一步加大研发投入，持续进行技术创新，采用更先进的工艺，提升现有产品的性能外，还将开发应用于笔记本电脑和桌面一体机的触控芯片产品；同时开发基于电容检测技术的近场通信芯片和指纹识别芯片，扩大公司技术和产品的应用范围，在市场上，本公司将充分发挥自身具备的技术优势、产品优势以及服务优势，不仅要巩固并加强与国内智能手机、平板电脑品牌生产厂商的合作，还需要大力开拓包括笔记本电脑和桌面一体机在内的国际品牌市场，并开始拓展电容式近场通信、指纹识别等新技术的市场应用。为此，公司需要不断加强品牌建设，增强公司的市场影响力。在服务上，本公司将基于多年来的服务基础和经验，继续加强对客户项目管理和技术支持的力度，并通过向客户提供更高效率的开发工具，测试工具和量产品质检测工具等技术手段，提高客户项目开发效率，缩短客户项目时间。

二、公司发展目标

（一）整体发展目标

基于公司当前及未来的发展战略，通过本次募集资金投资项目的顺利实施，本公司将在现有电容屏触控芯片的技术基础上，大力研发高性能 32 位微控制器技术、低功耗设计技术、高信噪比互容检测技术，不断推动国产触控芯片的技术突破；重点提高公司在智能手机、平板电脑、On-cell、主动式电容触控笔为代表的高成长性领域的触控芯片升级，进一步扩大公司产品在市场上的领先优势，巩固并加强公司的市场竞争地位，并将触控芯片产品覆盖市场范围扩展到尺寸更大的应用如笔记本电脑和桌面一体机电脑；

基于公司在触控芯片领域的技术积淀，积极拓展与触控技术紧密相关的电容式近场通信触控芯片和微控制器、指纹识别芯片等新兴市场，改变公司产品线较为单一的格局，为公司业务发展提供新的增长点；通过研发中心的建设，为公司未来长远发展做好技术储备；不断完善和优化研发体系、销售体系和管理流程，积极开拓国际市场，进一步拓展国产芯片的应用领域并将国产芯片推广到更多国家和地区。

（二）具体发展目标

针对不同的市场领域，公司的具体发展目标如下：

1、触控芯片产品线

本公司不仅将针对智能手机和平板电脑终端消费者对触控体验的需求提升，推出运算速度更快、信噪比更高、多点识别更灵敏、具有接近感应、支持被动式及主动式电容触控笔应用等更多附加功能的高性能芯片产品；同时还将触摸屏的新工艺、新材料适应性作为芯片改进的动力，推出适应单层 On-cell、Metal Mesh、In-cell 等新技术的触控芯片；公司还将推出适应笔记本电脑和桌面一体机电脑触摸屏的触控芯片，扩展公司触控产品的应用领域。

2、电容式近场通信芯片产品线

本公司将在现有触控芯片技术的基础上，在智能手机、平板电脑、笔记本电脑等市场上推出电容式近场通信触控芯片，提升在该领域的市场占有率；同时，推出面向智能穿戴设备等市场的电容式近场通信微控制器芯片，拓宽公司所拥有的电容检测技术的产品和市场应用领域。

3、指纹识别产品线

公司将依靠现有触控芯片领域的技术积累，开发指纹识别芯片，拓宽公司的产品线，并迅速抢占国内智能手机用指纹识别芯片市场，为公司带来新的利润增长点。

三、实现发展目标的计划与措施

为了更好地实现公司的发展战略与发展目标，公司拟采取以下具体的计划与措施：

（一）技术升级和产品线拓展计划与措施

1、触控芯片产品线

为巩固和增强本公司在电容屏触控芯片领域的竞争优势，更好地满足客户对电容屏触控芯片产品的差异化需求，推动中国电容屏触控芯片研发设计企业在全球的整体技术竞争实力，本公司将持续开发新一代的触控芯片，推动产品的更新换代速度。公司拟通过高效 MCU 平台、研发中心的建设、提升模拟电路的信噪比、采用更先进的 65nm 工艺、提高检测电路动态范围、提升阻抗适应能力、自容与互容在线动态切换、On-cell 等具体技术的突破，使新一代的电容触控芯片成本更低、性能更好。

2、电容式近场通信芯片产品线

公司拟在现有电容触控芯片技术的基础上，通过蓝牙技术、数据加密技术、触摸传感器与天线复用技术、自适应传输速度技术、低功耗技术等关键技术的突破，针对智能手机、平板电脑、笔记本、智能穿戴设备等热点市场开发出电容式近场通信触摸芯片和微控制器，给用户带来便捷传输数据的舒适体验。

3、指纹识别产品线

公司拟在现有电容触控芯片技术的基础上，通过高信噪比的电容检测技术、悬浮地技术、消噪技术、指纹特征及匹配算法等关键技术的突破，针对智能手机市场开发出国际领先的指纹识别芯片；同时通过外购和定制设备，与国内领先的封装厂、模组厂合作，解决指纹识别产品组装的关键工艺，使公司的指纹识别芯片能够成为公司新的利润增长点。

（二）市场开拓计划与措施

在市场开拓方面，公司将从打造明星品牌、拓宽营销渠道、加强与产业链上下游厂商的战略合作等方面，不断提高公司芯片产品的市场知名度和占有率。

1、加大公司品牌宣传力度

本公司的电容屏触控芯片在性能方面表现优异，具备较高的市场占有率。下一步公司将不断向高端市场进军，抢占国际知名电容屏触控芯片企业的市场份额。为此，公司将通过参加国际、国内电容屏触控芯片专业展会及技术研讨大会向业界展示公司的产品

优势，同时加强网站、新媒体、行业杂志专刊等渠道的市场宣传力度，提高公司产品的市场知名度和品牌影响力，为公司的市场开拓营造良好的市场氛围。

2、拓展和加强营销渠道

目前，公司芯片产品的国内客户主要集中在上海、深圳和北京周边区域，未来公司将在加强深圳、上海和北京地区营销渠道建设工作的基础上，进一步拓展营销渠道覆盖范围，增加国际营销网点，更好地满足市场与客户的本地化需求。

3、加强与产业链上下游厂商的战略合作

未来，随着公司业务的快速增长及出货量的不断增加，公司将加强与产业链上下游厂商的战略合作。对上游的晶圆供应商，本公司将增加供应商数量，加强与晶圆厂的沟通交流，保证晶圆供应的质量、数量及速度；对芯片封装、测试厂商，本公司将从技术层面加强对其的辅导与技术支持，提高其技术水平，有效降低芯片成本，增强产品的市场竞争力。

同时，为更好地满足客户对产品定制化、个性化的需求，提高公司产品的市场占有率，本公司将加强与下游整机厂、模组厂、方案商的战略合作关系，通过及时、频繁的沟通交流，了解客户的最新需求动向，保证公司研发的产品能够最大程度满足客户的需求。

（三）人才培养计划与措施

IC 设计企业属技术密集型企业，其长远发展离不开专业技术研发团队的支持。为此，本公司将根据未来技术发展规划和现有人才储备状况，加强人才队伍的建设工作。

1、人才招聘与培养

公司将采用校园招聘与社会招聘相结合的人才招聘机制，根据公司业务发展需求，制定中短期年度人力资源规划及具体实施办法，并确保核心人才的招聘与稳定。建立、健全公司科学化、规范化的人力资源管理系统，满足公司发展的人力资源需求。注重国外高端专业技术人才的引进，强化研发团队的力量。

同时，组织并实施年度培训需求调查、制定培训计划、组织实施培训和培训评估等工作，促进员工综合素质及业务水平的提高。

2、企业文化建设

本公司的愿景是打造世界级的芯片及软件技术设计公司。为实现这一目标，公司将持续建立和营造积极向上的企业文化氛围，鼓励团队合作，致力于集体成功，同时注重员工之间、员工与领导之间的坦诚沟通与高效配合，信任、尊重并主动帮助团队中的每一个人，增强员工的企业归属感及团队的凝聚力，打造优秀的研发管理团队，让每一位员工在本公司快速发展的业务中实现自己的人生价值。

（四）管理计划与措施

有效的企业管理是公司持续、快速发展的必备条件之一。为实现公司战略发展目标，打造世界级的芯片及软件技术设计公司，本公司将从以下两个方面提升管理水平：

1、内部管理

推行以客户需求为导向的集成产品开发流程，整合市场需求、产品开发、技术支持、生产管理、质量控制及财务管理等主干流程的运作，形成各个流程的无缝连接，并集成到内部的现代化 IT 管理系统中，提高内部运营效率；鼓励创新，不断通过技术进步来提升产品的性能和创造更新颖的功能，不断增强用户体验，保持竞争力；制定短期、中期和长期相结合的员工激励机制，以绩效为导向，建立科学的薪酬管理制度和绩效管理制度，奖优罚劣，调动员工的积极性。

2、外部管理

外部管理主要分为三个部分。第一，加强对供应商的评估与管理。除主要供应商外，增添备用供应商，督促晶圆生产厂家缩短生产周期，按时交货，保证晶圆供货的顺畅。第二，加强对委外加工厂商的评估与管理。与委外加工厂商建立良好及有效的沟通渠道，加强委外加工厂商的定期评审和考核工作，监督委外加工厂商质量体系的执行。根据生产计划预测，有计划和针对性地要求委外加工厂商提高和保障公司所需产能，同时与供应商谈判，有计划地为公司生产运作降低成本。第三，加强重大质量问题的跟踪工作，定期进行客户满意度调查并分析调查结果，制定改进计划。

（五）资金筹备计划与措施

公司业务发展规划的顺利实施离不开充足的资金保障。未来，随着募集资金的到位，公司将围绕业务发展规划，制定各阶段的行动计划与目标，基于计划与目标合理配置人

力资源、财务资源，确保资金、技术、人才、渠道的最优化分配，争取早日实现新产品的量产及推广，为公司创造利润。

此外，本公司将发挥在业界的知名度和信誉优势，密切接触金融机构、产业投资机构等，从多个渠道为公司的业务发展筹措资金。通过多种资本运作方式，扩大直接融资比例，降低融资成本，为公司未来的业务发展提供充足的资金保障。

四、拟定上述计划所依据的假设条件

- 1、国民经济保持增长态势，集成电路行业未发生重大不利调整；
- 2、公司业务所遵循的国家及地方的现行法律、法规等无重大改变；
- 3、集成电路行业政策无重大不利变动；
- 4、公司本次股票发行取得成功，募集资金及时到位；
- 5、公司执行的财务、税收政策无重大不利改变；
- 6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素带来的重大不利影响。

五、实施上述计划面临的主要困难以及拟采用的措施

1、公司的资本实力和业务规模偏小，业务的进一步拓展面临资本规模的限制。而本次发行和募集资金的到位时间具有不确定性，如果公司整个战略发展计划的某个环节中断或进程延迟，将会影响整个计划的实施。

2、根据公司的未来发展规划，未来几年内，公司资产规模、业务规模、资金运用规模都将有较大幅度增长。在此背景下，公司在战略规划、组织体制、管理模式、运行机制等方面将面临更大挑战。公司将尽快提高各领域、各专业、各个部门的应对能力，确保各项业务发展计划和目标的顺利实现。

3、公司各领域人才数量需进一步增加，结构需进一步完善，以确保公司可持续发展。

六、业务发展规划与现有业务的关系

前述业务发展规划是公司以现有主营业务为基础，结合国家产业政策、行业发展趋势及本公司的核心竞争优势制定的，经过了全面、审慎的分析，有利于本公司保持技术领先优势、扩大业务规模和提升市场占有率。因此，未来几年的发展规划是现有业务的提升和完善，有助于公司跨上更高、更广阔的发展平台。

七、本次募集资金运用对实现上述目标的作用

本次募集资金的成功运用将优化公司的资本结构，增强公司再融资能力，扩大企业规模，提升产品层次，巩固公司在行业内的地位，提高产品的市场占有率，进一步增强公司的核心竞争力，有利于公司更好更快地实现上述发展目标。

1、本次公开发行股票将为实现业务发展目标提供充足的资金，进一步加强公司研发能力，优化公司产品结构，提升公司整体竞争力，使公司得以继续保持并巩固行业优势地位。

2、本次公开发行股票将使本公司由非公众公司变成公众公司，公司将会受到来自监管部门、机构投资者、社会公众投资者等多方面的监督，有利于公司法人治理结构的进一步完善，有利于实现决策的科学化和民主化，实现管理水平的升级。

3、本次公开发行股票有利于公司吸引并留住优秀人才，有利于公司人才发展战略和人才资源开发计划的实现，确立公司在同行业中的人才竞争优势。

4、本次公开发行股票有利于提高本公司的社会知名度和市场影响力，对实现上述业务发展目标具有较大的促进作用。

八、公司关于未来发展与规划的声明

本次成功发行并上市后，本公司将根据法律、法规及中国证监会相关规范性文件的要求，对上述发展规划的实施情况进行真实、准确、完整的披露。

第十三节 募集资金运用

一、募集资金运用概述

(一) 募集资金数额及用途

本次股票发行募集资金净额依轻重缓急用于以下项目建设：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资额	拟投入募集资金	时间进度		项目核准情况
				第1年	第2年	
1	小尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目	13,893	13,893	8,646	5,247	深发改核准[2012]0423号
2	中尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目	11,748	11,748	7,449	4,299	深发改核准[2012]0420号
3	大尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目	12,004	12,004	7,292	4,712	深发改核准[2012]0422号
4	On-cell 触摸屏控制芯片开发项目	12,269	12,269	7,435	4,834	深发改核准[2013]0341号
5	主动式电容触控笔芯片技术升级项目	13,484	13,484	8,531	4,953	深发改核准[2013]0342号
6	电容式近场通信微控制器开发及产业化项目	23,203	23,203	18,668	4,535	深发改核准[2014]0080号
7	指纹识别芯片和模组开发及产业化项目	39,403	39,403	26,516	12,887	深发改核准[2014]0078号
8	研发中心建设项目	9,325	9,325	9,325	-	深发改核准[2012]0421号
合计		135,329	135,329	93,862	41,467	

注：上表时间进度第1年、第2年以项目建设首日为起始日

在不改变拟投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际情况，对上述项目的投入顺序及拟投入募集资金金额进行适当调整。如本次新股发行募集资金净额（扣除对应的新股发行费用后）不能满足募投项目所需资金总额的，不足部分由公司自筹解决。为把握市场机遇，使项目更快建成产生效益，本次发行上市的募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况暂以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据募集资金使用的有关规定并经履行相关法定程序后予以置换。

本次发行募集资金投资项目的实施不会产生同业竞争，且不会对发行人的独立性产生不利影响。

（二）募集资金专项存储制度的建立及执行情况

本次募集资金投向，已经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施。公司建立了募集资金专项存储制度，本次募集资金到位后，将存放于公司董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。

（三）募集资金投资项目与公司业务发展规划的关系

本次募集资金运用均围绕公司主营业务进行，符合公司的发展规划。募集资金投资项目是公司发展战略的具体实施步骤，募集资金项目的实施将巩固公司在触控芯片领域的技术和市场优势，实现在智能手机、平板电脑和超极本等高成长领域触控芯片的技术和产品升级；加强对 On-cell 触摸屏控制芯片、主动式电容触控笔芯片产品的开发能力和公司技术研发能力；对电容式近场通信微控制器和指纹识别芯片产品进行开发，拓展产品线，从而进一步提高盈利水平，持续增强公司整体竞争能力。

（四）募集资金投资项目的合规性分析

1、本次发行募集资金投资项目符合《指导外商投资方向规定》以及《外商投资产业指导目录（2015 年修订）》等国家产业政策的相关规定。

2、募集资金投资项目主要内容为研发设计及研发办公场地、研发设备软件的购置以及研发人员的投入，不涉及生产加工，符合环境保护的要求。

3、募集资金投资项目实施地为广东省深圳市南山高新区深圳市软件产业基地，公司已通过购买方式取得了相关房产的所有权。

综上，保荐机构和发行人律师认为，本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

二、募集资金投资项目的必要性分析和市场前景

（一）必要性分析

1、国家产业政策支持

作为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，集成电路行业历来受到国家的鼓励和支持。自 2000 年 6 月《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干

政策》发布并实施以来，国家颁布了多项鼓励支持集成电路行业的产业政策及措施，例如《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（2008）》（财税[2008]1号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》、《集成电路产业“十一五”专项规划》及《集成电路产业“十二五”发展规划》等，为行业发展创造了有利的投融资、税收、出口环境。

2、募集资金投资项目是集成电路行业国产自主化的需要

与国外发达国家与地区相比，中国集成电路产业起步相对较晚，技术积累与高端人才积累方面有所欠缺，芯片设计技术尚存在一定的差距。以触控芯片市场为例，中国电容屏触控芯片市场集中度较高，主要由资金及研发实力雄厚的国际大厂主导，如 Synaptics（新突思）、Atmel（爱特梅尔）、Cypress（赛普拉斯）等，根据 2014 年电容屏触控芯片产品的出货量统计，本公司是中国电容屏触控芯片市场前五大厂商中唯一一家国内企业。

本次发行募集资金投资项目有利于汇顶科技集中优势力量研发新技术，提高公司在技术及产品应用方面的竞争实力，进而推动中国集成电路设计行业的整体发展，缩短中国集成电路产业与国外发达国家及地区的差距。

3、募集资金投资项目是市场发展及公司产品升级的需要

集成电路设计行业属技术密集型行业，公司的市场竞争力很大程度上取决于产品技术的领先程度。公司研发的电容式触摸屏控制芯片产品主要用于手机、平板电脑及导航仪等智能终端产品的触摸屏控制领域，而智能终端产品的更新换代周期较短，且随着用户需求的不断变化，产品的性能也需要不断优化升级。同时，随着行业内企业数量的增加，市场竞争压力日益提升。触控芯片设计厂商只有紧跟市场需求趋势，不断采用新技术、研发新产品、丰富产品功能，才能脱颖而出，保持强有力的市场竞争地位。

4、募集资金投资项目有利于进一步提升公司研发能力

公司作为高新技术企业，依托在电容触控技术方面的长期积累，开发出具有自主知识产权和国际领先水平的多点电容屏触控芯片及整体解决方案，并已拥有技术专利 82 项。本次发行募集资金投资项目的建设将使得公司在智能人机交互领域投入更大的人

力、物力和财力，研发行业尖端技术，开拓出适用于更多应用领域的芯片产品，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位。

（二）市场前景

1、全球电容屏触控芯片市场空间快速提升

近年来，随着智能手机、平板电脑等电子消费品全球普及率的迅速提升，以及触摸屏技术在电子设备中的广泛应用，全球电容屏触控芯片市场也得到迅速发展。赛迪顾问的统计数据显示，2014年全球电容屏触控芯片销售量为177,588万颗，同比增长13.20%，预计2017年的销售量将达到226,801万颗。

作为全球电子产品的制造基地，中国电容屏触控芯片市场表现出了巨大的增长潜力。赛迪顾问的统计数据显示，2014年中国电容屏触控芯片的销售量达到了72,980万颗。其中，2014年中国智能手机、平板电脑电容屏触控芯片的销售量分别达到了60,549万颗、9,594万颗。预计到2017年，中国电容屏触控芯片的销售量将达到99,838万颗，智能手机、平板电脑电容屏触控芯片的销售量也将分别达到82,691万颗、12,389万颗，市场规模将进一步扩大。同时，超极本电容屏触控芯片市场也将呈现快速发展趋势，预计中国超极本电容屏触控芯片的销售量将从2015年的1,443万颗增长至2017年2,380万颗。

公司所处行业的内容参见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（二）行业发展情况”。

2、近场通信应用市场稳步扩大

随着移动互联网技术及市场应用的飞速发展，智能手机、平板电脑、笔记本电脑以及各种可穿戴式移动设备市场成长迅速。特别是以运动手环，智能手表，智能眼镜为代表的智能可穿戴设备市场快速成长，有望继智能手机之后掀起又一波移动互联网的浪潮。除了移动设备之间的数据传输，移动设备与其外围设备如音箱、相机、打印机、家电设备和车载设备之间的数据交换也将具有很大的应用潜力。而且，随着未来移动支付应用技术的发展和市场的进一步成长，移动设备之间的短距离通信，有着巨大的需求空间。目前，这些移动智能终端之间的信息和数据交换除了通过移动通信网络以外，主要采用NFC，Wi-Fi Direct和蓝牙等近距离无线通信技术来实现。

基于电容检测技术的利用电容触摸屏、电容触摸板或电容式 Tag 来实现的近距离通信技术，有着操作简单、低功耗、无需增加外围电路及成本、设计简单、高保密性与安全性等优势。这项技术及其与现有近距离通信技术的组合应用，为移动支付、各种智能移动终端设备信息交换及物联网应用开发者提供了广阔的个性化拓展的可能，顺应了无线互联网发展的潮流，有着较大的市场应用潜力。

3、指纹识别芯片市场将形成应用于智能终端的新兴细分市场

智能终端设备的应用功能日益丰富，除具备基本的通信功能外，还增加了移动支付、个人数据存储、文件处理等。因此，加密功能成为智能终端数据安全、保密的重要保障手段。传统的智能终端加密方式主要为密码，使用数字密码或图形化密码来对智能终端进行加密，用户在进行解锁操作时较为不便。

2013 年 9 月，苹果公司发布新款智能手机 iPhone 5s，其亮点之一是隐藏在 Home 键中的指纹识别模块，该产品为市场提供了智能终端指纹识别应用的范例。目前，智能终端的指纹识别芯片普及率仍然较低。因此，该细分市场有望在未来具备较大的发展空间。

4、募集资金投资项目顺应芯片技术发展趋势和产品发展方向

随着智能终端市场的发展，触控技术应用的领域逐渐由手机、平板电脑扩展到超极本、车载设备等领域。消费者和厂商在终端设备触控操作的体验、精准度、灵敏度、抗干扰性等方面的要求日益提升，终端设备的厚度也逐渐降低；同时，随着终端设备的销售价格水平逐渐下降，产业链各环节需要控制成本，进一步提升盈利能力。

本次发行募集资金投资项目中的“大、中、小尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目”、“On-cell 触摸屏控制芯片开发项目”和“主动式电容触控笔芯片技术升级项目”旨在基于公司现有产品和技术基础上，对应用于手机、平板和超极本等终端设备的触控芯片进行技术升级，开发 On-cell、主动式电容触控笔芯片等产品。上述技术升级和新产品开发项目将有效提升公司在信号检测精度、抗干扰能力、坐标刷新率、设计工艺等技术方面取得突破，持续提高产品的性能，向市场推出全新产品，有效降低下游客户的研发和生产成本。

本次发行募集资金投资项目中的“电容式近场通信微控制器开发及产业化项目”开发的产品和技术将通过可穿戴设备等智能终端自带的触摸屏或触摸按键等来实现近场通信功能。与现有近场通信的技术方案相比，该技术无需增加额外的芯片和天线成本，可有效降低成本。同时，搭载微控制器的设备可通过其蓝牙功能，与其他智能终端、配件进行连接，实现设备间的数据传输、操作控制等。该募投项目提供了一种更加智能和简便的人机交互接口，为智能配件、可穿戴设备及物联网应用开发者提供个性化拓展的可能，顺应了移动互联网产品发展的潮流。

本次发行募集资金投资项目中的“指纹识别芯片和模组开发及产业化项目”旨在开发用于智能手机、平板电脑等智能终端的指纹识别芯片和模组。该产品可实现作用于高硬度、高介电常数盖板材料的指纹图像采集、特征提取、特征比对等功能，具有响应速度快、识别准确度高等优势，能够为智能终端用户提供更加便捷、安全的安全保障措施。

（三）董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见

1、公司已经具备实施募集资金投资项目所需的技术实力、人才储备、销售网络和技术服务体系

自 2007 年以来，公司始终致力于电容屏触控芯片产品的研发与设计，在该领域获得了深厚的技术积累：在业内较早实现了 10 点触控芯片、智能手机用单层多点触控芯片的量产，以及触摸屏上支持去除屏蔽层、将触控芯片放置在整机主板（COB）的新型生产工艺或设计方式；同时，公司的电容屏触控芯片产品在抗 TFT 显示器干扰、电磁干扰、水膜干扰、共模干扰和悬浮干扰等方面表现优异，为实施“大、中、小尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目”、“On-cell 触摸屏控制芯片开发项目”和“主动式电容触控笔芯片技术升级项目”提供了扎实的技术保障。此外，电容触控领域的很多核心技术，例如互电容检测技术、跳频技术、降噪处理算法同时也是实施“指纹识别芯片和模组开发及产业化项目”和“电容式近场通信微控制器开发及产业化项目”所需的核心技术，这些技术的积累也为公司实施上述三个新产品项目奠定了坚实的技术基础。

公司拥有一支优秀、高效的研发团队。截至 2015 年末，公司研发人员达到 544 人，占员工总人数的 82.55%，其中包括多名自国外引进的高层次技术人才。公司通过提供行业内有竞争力的薪酬以及员工持股计划对研发团队进行激励，极大地提高了研发团队

的归属感和稳定性。稳定的技术团队为募集资金投资项目的实施提供了可靠的人才保证。

公司组建了市场营销部，该部门主要负责对市场信息的及时收集和营销策略的制定，跟踪了解市场竞争对手及产品价格走势情况，并利用直销和经销两种销售模式对公司产品进行有效的推广。公司还建立了完善的技术支持服务体系，致力于向下游客户提供高效、完善的技术支持和周到快捷的客户服务。公司的销售网络和技术服务体系有利于募集资金投资项目产品的市场推广、新客户的拓展和降低产品应用成本，有利于募集资金投资项目的顺利实施。

2、本次发行募集资金投资项目与公司经营规模、财务状况和管理能力相适应

得益于电容触控芯片市场规模的持续增长和市场地位的进一步提升，2013至2015年公司主营业务收入年复合增长率为27.57%，2015年公司营业收入和净利润分别为111,575.99万元和37,807.77万元，净利润率达到33.89%，资产负债率始终保持较低水平，整体财务状况良好。为了适应经营规模的快速发展，公司持续加强对内外部的管理，建立科学的管理制度和激励机制，保证管理人才的招聘与培养，运营管理水平得到大幅提升。因此，公司的经营规模、财务状况和管理能力能够适应本次募集资金投资规模。

三、募集资金投资项目简介

(一) 小尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目

1、项目概要

本项目将在公司已推出的小尺寸用电容屏触控芯片产品的基础上进行技术改造与升级，开发以GT10系列为代表的下一代小尺寸用触控芯片产品，保持产品更新换代的速度。该项目的产品将主要应用于智能手机。

2、项目选址及用地

本项目拟通过购置700平方米办公场所实施，地址为广东省深圳市南山高新区深圳市软件产业基地。2013年4月27日及2014年4月24日，公司作为买受人与出卖人深圳市投资控股有限公司分别签订了房屋预售合同。相关房屋的交付验收手续于2014年6月27日完成。

3、项目投资情况

本项目总投资 13,893 万元，具体投资构成如下表所示：

单位：万元

名称	总计	占比
1、工程费用	5,225.80	37.61%
1.1 办公场地购置费	2,240.00	16.12%
1.2 设备及软件购置费	2,985.80	21.49%
1.2.1 设备购置费	2,019.30	14.53%
1.2.2 软件购置费	966.50	6.96%
2、工程建设其他费用	5,515.33	39.70%
2.1 办公场地装修费	105.00	0.76%
2.2 办公家具购置费	10.50	0.08%
2.3 人员费用	2,789.00	20.08%
2.4 培训费	77.40	0.56%
2.5 产品试制费用	533.43	3.84%
2.6 软件使用费	1,955.00	14.07%
2.7 可行性研究费	15.00	0.11%
2.8 研讨及咨询费	20.00	0.14%
2.9 知识产权登记费用	10.00	0.07%
3、预备费	1,074.11	7.73%
4、铺底流动资金	2,077.64	14.95%
投资总额	13,892.89	100.00%

本项目购置的自用设备主要包括开发示波器、FPGA 开发板、服务器、办公电脑等，具体情况如下表所示：

序号	名称	数量	金额（万元）
1	光强测试仪	1	2.00
2	色温测试仪	1	0.10
3	白平衡测试仪	1	1.00
4	示波器	10	430.00
5	主动式探针	8	16.00
6	万用表	42	14.70
7	高精度万用表	4	12.00

序号	名称	数量	金额（万元）
8	RLC 测试仪	3	66.00
9	阻抗分析仪	3	105.00
10	FPGA 开发板	5	15.00
11	频谱仪	3	66.00
12	信号发生器	4	390.00
13	逻辑分析仪	3	60.00
14	网络分析仪	4	72.00
15	I ² C 总线测试仪	5	250.00
16	多点电容屏测试仪	4	160.00
17	服务器	2	16.00
18	办公电脑	70	70.00
19	公用设备分摊	-	273.50
合计		-	2,019.30

注：公用设备分摊是指除自用设备外，本项目与其他募集资金投资项目共同使用的设备购置费按项目数量平均分摊的金额，该等设备主要包括环境试验箱、RF 信号屏蔽房、探针台、芯片测试机等，后同。

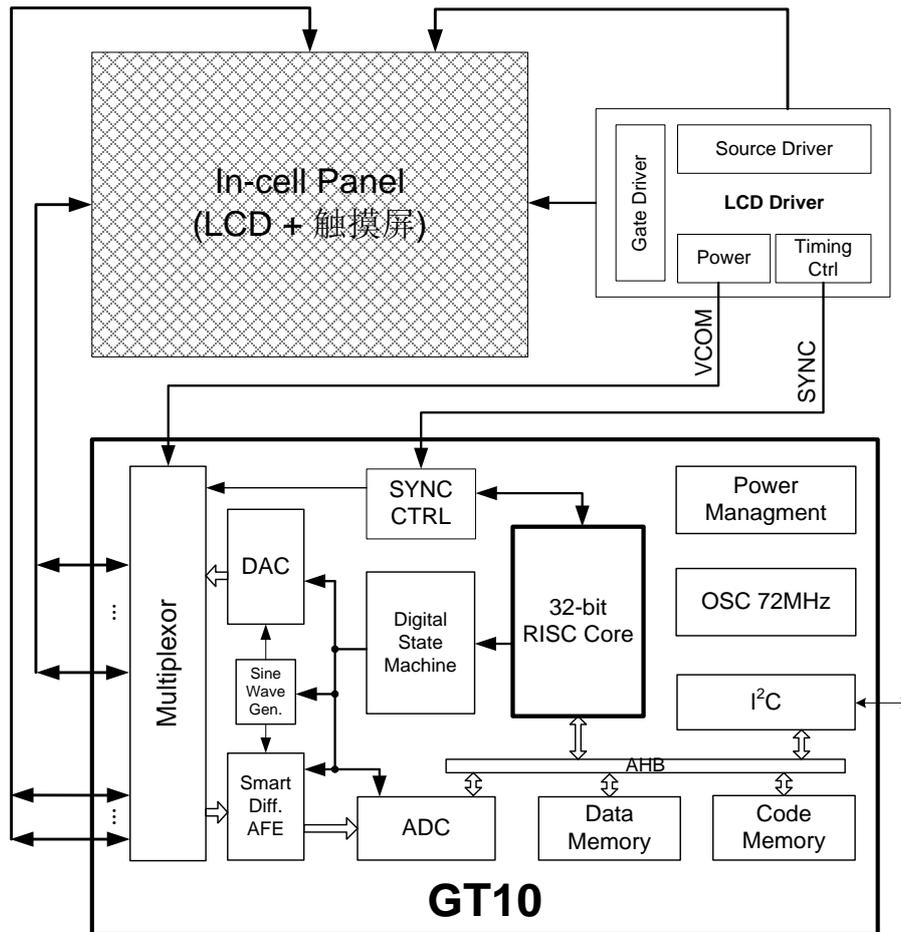
本项目购置的自用软件包括 Windows 8、Office 2010、Visio、Project、OrCAD、PCB Editor、PADS、CAM350、Visual Studio、UltraEdit、Source Insight、Beyond Compare、Keil、ISE 等，购置的与其他项目共用的软件包括 Synopsis、Cadance、Mentor、ModelSim、Maxwell 等。

4、项目建设内容

公司 2010 年至今，已推出多款针对智能手机电容触摸屏的控制芯片，在芯片的制作工艺、功耗、充电器共模干扰、LCD 干扰、模组成本、模组厚度等方面实现技术升级。为更好地满足用户差异化需求，公司计划在已有的智能手机触控芯片技术基础上，研发设计以 GT10 系列为代表的新一代小尺寸用触控芯片产品。

（1）新一代 GT10 系列触控芯片基本情况

本项目计划研发的新一代 GT10 系列触控芯片的系统框图如下：



GT10 系列新一代小尺寸触控芯片产品将支持 In-cell 触摸屏，填补这一产品线的空白。

与之相对应的技术改进点主要有：1) 采用窄带差分前端模拟电路，提高信号增益和检测电路动态范围；2) 设计主动式噪声抑制算法，大幅缩窄检测电路通频带；3) 增加与 LCD 驱动芯片的同步机制，实现触摸控制芯片与 LCD 驱动芯片对 In-cell 触摸屏的分时复用；4) 整合自电容与互电容检测电路，做到自容与互容可以在线动态切换；5) 改进基准更新算法；6) 将处理器升级为 32-bit RISC 内核。

由于省去了外置的触摸屏，GT10 可使整机成本下降，生产工序简化，同时可以设计出更轻薄、更窄边框且显示效果更佳的终端产品。

(2) 项目开发思路

本项目的开发思路如下：

第一阶段，模拟电路的单元设计与仿真：主要涉及窄带差分放大器以及 16-bit ADC 等单元电路的设计与仿真。

第二阶段，In-cell 结构传感器及 LCD 阵列的电场仿真与开模制作：该阶段主要是为了保证后续的开发有真实负载作为输入基础，使第三阶段的仿真结果与实际应用更吻合。

第三阶段，模拟电路的系统设计与仿真：依据第一阶段和第二阶段的工作成果，将模拟部分修改的单元电路整合进系统电路，同时结合实际输入条件进行系统仿真，以确定模拟电路的性能指标是否能够满足软件处理的要求。

第四阶段，数字电路的开发与设计：GT10 系列将采用技术授权的方式引进 32-bit RISC 内核，完成内核的移植，同时完成 GT10 与 LCD 驱动芯片同步模块的设计。

第五阶段，芯片的整合设计：在前阶段的基础上，加入其他数字部分的外设，如 Timer（计时器）、I²C、电源管理单元等，进行整个芯片的整合设计及仿真，FPGA + 模拟电路仿真板的系统仿真验证。

第六阶段，版图设计与仿真：根据系统仿真的结果进行版图设计，设计完成后验证是否与产品规格吻合。

第七阶段，芯片投片与验证平台构建：在完成版图后进行投片，同时构建验证芯片规格及可靠性的验证平台。

第八阶段，固件开发：此阶段开始基于 FPGA 仿真系统进行固件开发，重点完成新增功能部分的算法设计与实现。

第九阶段：芯片验证：对芯片的性能指标及可靠性进行验证，验证完成后进行小批量试产。

（3）产品主要技术指标

本项目拟研发的升级产品与现有产品的技术指标比较如下表所示：

类别	芯片型号	通道数	支持尺寸	最大检测通道电阻	信噪比	触摸屏类型	处理器	工艺	处理器速度
现有产品	GT800	15×10	≤ 4.3"	< 50 kohm	30	传统双层	8-bit	0.35μm	20MHz
	GT818	16×10	≤ 4.5"	< 50 kohm	30	传统双层	8-bit	0.18μm	20MHz
	GT968	18×10	≤ 4.5"	< 50 kohm	60	单层	8-bit	0.11μm	60MHz

类别	芯片型号	通道数	支持尺寸	最大检测通道电阻	信噪比	触摸屏类型	处理器	工艺	处理器速度
升级产品	GT10 系列	22×13	≤ 5.5”	< 100 kohm	120	In-cell	32-bit	65nm	72MHz

本项目中体现的技术创新点涉及多个方面，如下表所示：

序号	技术创新点	具体描述
1	窄带差分前端模拟电路	针对每个触控面板的分布参数不同，动态调整差分放大器的参考电压，从而提高检测电路的动态范围，大幅提高信噪比
2	软件解调和主动噪声抑制算法	利用 32 位处理器直接对 ADC 原始数据进行解调，并根据输入信号的特点，自动调整滤波算法的各项参数，主动抑制噪声
3	自容互容动态切换	在驱动输出端与检测输入端设计双向多路切换器，使 IC 引脚可以自由切换到不同的外设电路
4	智能基准更新算法	以自容检测数据作为参考，识别有水的状态，在此情形下，加快基准更新速度，及时适应触摸屏表面环境的变化，从而提高有水条件下检测的精准度

5、项目实施进度

本项目建设工期为 2 年。为适应业务需求，抓住市场契机，公司计划先期投入部分软硬件进行研发工作，待募集资金到位后再予以置换。

6、环保情况

本项目主要通过知识创新和智力劳动获得效益，在项目实施过程中的技术开发、产品测试等环节中均不产生废气、废水和废渣，对环境不产生污染。

(二) 中尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目

1、项目概要

本项目将对公司原有的中尺寸用触控芯片进行功能升级换代，研发成本更低、封装更小、性能更好的 GT20 系列产品。公司将通过高效率 MCU 平台的建设，全面提升芯片的运算效率；通过提升检测精度实现对主动式电容笔和被动式电容笔的支持；并将采用 65nm 工艺的芯片设计，减少芯片面积、降低芯片成本。该项目的产品将主要应用于平板电脑。

2、项目选址及用地

本项目拟通过购置 500 平方米办公场所实施，地址为广东省深圳市南山高新区深圳市软件产业基地。2013 年 4 月 27 日及 2014 年 4 月 24 日，公司作为买受人与出卖人深

圳市投资控股有限公司分别签订了房屋预售合同。相关房屋的交付验收手续于 2014 年 6 月 27 日完成。

3、投资概算

本项目总投资 11,748 万元，具体投资构成如下表所示：

单位：万元

名称	总计	占比
1、工程费用	4,507.70	38.37%
1.1 办公场地购置费	1,600.00	13.62%
1.2 设备及软件购置费	2,907.70	24.75%
1.2.1 设备购置费	2,130.00	18.13%
1.2.2 软件购置费	777.70	6.62%
2、工程建设其他费用	5,048.42	42.97%
2.1 办公场地装修费	75.00	0.64%
2.2 办公家具购置费	7.50	0.06%
2.3 人员费用	2,008.25	17.09%
2.4 培训费	54.60	0.46%
2.5 产品试制费用	903.07	7.69%
2.6 软件使用费	1,955.00	16.64%
2.7 可行性研究费	15.00	0.13%
2.8 研讨及咨询费	20.00	0.17%
2.9 知识产权登记费用	10.00	0.09%
3、预备费	955.61	8.13%
4、铺底流动资金	1,236.68	10.53%
投资总额	11,748.41	100.00%

本项目购置的自用设备主要包括基于 Windows 8 操作系统的人机交互在线测试仪、FPGA 开发板、服务器、办公电脑等，具体情况如下表所示：

序号	名称	数量	金额（万元）
1	基于 Windows 8 操作系统的人机交互在线测试仪	1	30.00
2	形变测量仪	1	5.00
3	无线通信测试仪	1	100.00
4	小型电波暗室	1	300.00
5	示波器	8	296.00

序号	名称	数量	金额（万元）
6	主动式探针	6	12.00
7	万用表	40	14.00
8	高精度万用表	4	12.00
9	RLC 测试仪	3	66.00
10	阻抗分析仪	3	105.00
11	FPGA 开发板	6	14.00
12	频谱仪	4	66.00
13	信号发生器	5	316.50
14	逻辑分析仪	3	60.00
15	网络分析仪	3	54.00
16	I ² C & USB 总线测试仪	3	180.00
17	多点电容屏测试仪	4	160.00
18	服务器	2	16.00
19	办公电脑	50	50.00
20	公用设备分摊	-	273.50
合计			2,130.00

购置的与其他项目共同使用的公用设备包括环境试验箱、RF 信号屏蔽房、探针台、芯片测试机（模拟测试+200MHz 速度）、X 光机、扫描电子显微镜、ESD 实验室、EMI 实验室等。

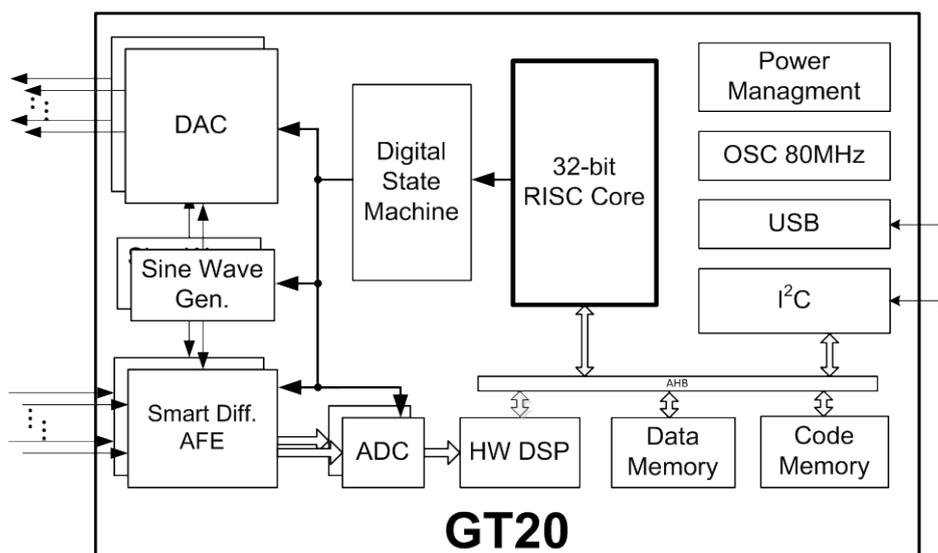
本项目购置的自用软件包括 Bus Hound、Windows 8、Office 2010、Visio、Project、OrCAD、PCB Editor、PADS、CAM350、Visual Studio、UltraEdit、Source Insight、Beyond Compare、Keil、ISE 等，购置的与其他项目共用的软件包括 Synopsis、Cadance、Mentor 、ModelSim、Maxwell 等。

4、项目建设内容

本项目计划对公司现有的中尺寸用触控芯片进行功能升级换代，研发出成本更低、封装更小、性能更好的 GT20 系列产品，以便适应 Android 和 Windows 8 操作系统对触控芯片需求的变化。GT20 系列产品可适应新一代触摸屏结构，相比之前的结构省掉一层 ITO，适应终端产品轻薄化的需求，并降低了触摸屏系统的成本。

（1）新一代 GT20 系列触控芯片基本情况

计划研发的新一代中尺寸用触控芯片 GT20 系列系统框图如下：



GT20 产品主要对现有产品进行技术升级，重点改进以下几项性能：1) 全面支持全 ITO 单层触摸屏；2) 支持 0.3mm 超薄玻璃面板触摸屏；3) 支持与 LCD 模组直接贴合；4) 支持被动笔；5) 内置 USB 通信接口。

与之相对应的技术改进点主要有：1) 采用窄带差分前端模拟电路，提高信号增益，提高检测电路动态范围；2) 设计主动式噪声抑制算法，缩窄检测电路通频带，压缩扫描时间；3) 设计软件增益补偿算法，修正高阻抗造成的数据差异，提高坐标精度；4) 改善手掌抑制算法；5) 改进基准更新算法；6) 将处理器升级为 32-bit RISC 内核。

升级改进之后，GT20 将更好地满足客户需求，降低客户的生产成本，单层结构的触摸屏将简化模组生产工艺，同时也提升触摸屏的透光率，改善用户体验。

(2) 项目开发思路

本项目的开发思路如下：

第一阶段，模拟电路的单元设计与仿真：主要涉及窄带差分放大器、驱动与感应切换电路以及 16-bit ADC 等单元电路的设计与仿真，进行单元仿真确定其基本性能是否满足设计规格。

第二阶段，单层结构传感器的电场仿真与开模制作：该阶段主要是为了保证后续的开发有真实负载作为输入基础，使第三阶段的仿真结果与实际应用结果更吻合。

第三阶段，模拟电路的系统设计与仿真：依据第一阶段和第二阶段的工作成果，将模拟部分修改的单元电路整合进系统电路，同时结合实际输入条件进行系统仿真，以确定模拟电路的仿真输出结果是否能够满足软件处理的数据条件。

第四阶段，数字电路的设计与开发：GT20 系列将采用技术授权的方式引进 32-bit RISC 内核，这一阶段完成内核移植。为了更实时、更省电的处理 ADC 采样数据，将设计一个专用的硬件 DSP 模块，主要实现信号的解调以及主动式的噪声抑制算法，同时将数据的存储方式改为 DMA 模式，以进一步提升效率。

第五阶段，进行芯片的整合设计与仿真。

第六阶段，版图设计与仿真：根据系统仿真的结果进行版图设计，设计完成后验证是否与产品规格吻合。

第七阶段，芯片投片与验证平台构建：在完成版图后进行投片，同时构建验证芯片规格及可靠性的验证平台。

第八阶段，固件开发：基于 FPGA 仿真系统进行固件开发，重点完成改进算法的实现，如基准更新算法、手掌抑制算法等。

第九阶段，芯片验证：对芯片的性能指标及可靠性进行验证，验证完成后进行小批量试产。

(3) 产品主要技术指标

本项目拟研发的升级产品 GT20 系列与现有产品的技术指标比较如下表所示：

序号	具体指标	升级前	升级后
1	工艺	0.18 μ m	65nm
2	处理器类型	Turbo 51	32 bit RISC Core
3	ADC 精度	12bit	16bit
4	信噪比	60	120
5	通信接口	I ² C	I ² C 、 USB
6	检测电极阻抗	50k ohm	200k ohm
7	刷新率	100Hz	150Hz
8	处理器主频	60MHz	80MHz
9	触摸屏类型	双层结构	双层结构及单层结构

序号	具体指标	升级前	升级后
10	被动式电容笔	不支持	支持

本项目中体现的技术创新点涉及多个方面，如下表所示：

序号	技术创新点	具体描述
1	主动式噪声抑制算法	根据输入信号的特点，通过硬件 DSP 方式实现自动调整滤波算法的各项参数
2	增益补偿算法	通过软件算法，自动补偿由于触摸屏电极阻抗引起的数据差异，并做补偿，使数据达到一致
3	检测数据智能监控	在硬件 DSP 模块中，设计检测数据监控算法，在检测数据发生突变时，会自动发出中断信号，唤醒 CPU，使得 CPU 在空闲时段可以最大限度进入睡眠模式，降低能耗
4	手掌抑制算法	在电容笔使用过程中，用户将手掌和电容笔同时放在电容屏上时，触控芯片将会通过软件分析两者的不同数据特征，区分两者的不同，从而达到抑制手掌保证电容笔操作的目的
5	动态基准自动更新算法	由于手指或手掌放置于触摸屏表面时，会造成局部温度和湿度的变化以及检测点之间的串扰，从而影响坐标计算的准确性，特别是采用被动笔输入的时候，影响尤为严重。为确保在变化的环境中可以实现用户操作的可靠性，保证被动笔输入的准确性，本项目将采用基准局部动态更新算法，可及时补偿局部温湿度差异造成的数据漂移，确保坐标输出的准确性

5、项目实施进度

本项目建设工期为 2 年。为适应业务需求，抓住市场契机，公司计划先期投入部分软硬件进行研发工作，待募集资金到位后再予以置换。

6、环保情况

本项目主要通过知识创新和智力劳动获得效益，在项目实施过程中的技术开发、产品测试等环节中均不产生废气、废水和废渣，对环境不产生污染。

（三）大尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目

1、项目概要

本项目将进行应用于大尺寸用触摸屏的 GT30 系列触控芯片的研发，拓展公司产品在超极本等大尺寸触摸屏市场的应用，全面解决电容式触摸屏在大屏幕应用时遇到的信号衰减、LCD 干扰以及运算量大等问题，为超极本等大尺寸电子产品提供信号强、抗干扰强、运算快的高性能电容屏触控芯片。该项目的产品将主要应用于超极本。

2、项目选址及用地

本项目拟通过购置 490 平方米办公场所实施，地址为广东省深圳市南山高新区深圳市软件产业基地。2013 年 4 月 27 日及 2014 年 4 月 24 日，公司作为买受人与出卖人深圳市投资控股有限公司分别签订了房屋预售合同。相关房屋的交付验收手续于 2014 年 6 月 27 日完成。

3、投资概算

本项目总投资 12,004 万元，具体投资构成如下表所示：

单位：万元

名称	总计	占比
1、工程费用	4,394.82	36.14%
1.1 办公场地购置费	1,568.00	13.06%
1.2 设备及软件购置费	2,826.82	23.08%
1.2.1 设备购置费	1,994.25	16.61%
1.2.2 软件购置费	776.32	6.47%
2、工程建设其他费用	4,876.68	45.80%
2.1 办公场地装修费	73.50	0.61%
2.2 办公家具购置费	7.35	0.06%
2.3 人员费用	1,973.25	16.44%
2.4 培训费	53.40	0.44%
2.5 产品试制费用	990.26	8.25%
2.6 软件使用费	2,355.00	19.62%
2.7 可行性研究费	15.00	0.12%
2.8 研讨及咨询费	20.00	0.17%
2.9 知识产权登记费用	10.00	0.08%
3、预备费	983.63	8.19%
4、铺底流动资金	1,184.15	9.86%
投资总额	12,004.11	100.00%

本项目购置的自用设备主要包括基于 Windows8 操作系统的人机交互在线测试仪、FPGA 开发板、服务器、办公电脑等，具体情况如下表所示：

序号	名称	数量	金额（万元）
1	基于 Windows8 操作系统的人机交互在线测试仪	1	30.00
2	形变测量仪	1	5.00

序号	名称	数量	金额（万元）
3	小型绑定机	1	20.00
4	示波器	16	370.00
5	主动式探针	9	18.00
6	万用表	40	15.75
7	高精度万用表	4	12.00
8	RLC 测试仪	3	66.00
9	阻抗分析仪	3	105.00
10	FPGA 开发板	10	17.00
11	频谱仪	3	66.00
13	信号发生器	19	390.00
14	逻辑分析仪	3	60.00
17	网络分析仪	3	54.00
18	I ² C & USB 总线测试仪	3	180.00
19	多点电容屏测试仪	5	200.00
20	拆焊台+植球机	3	60.00
21	服务器	3	24.00
22	办公电脑	49	49.00
23	公用设备分摊	-	252.50
合计			1,994.25

本项目购置的自用软件包括 Bus Hound、Windows 8、Office 2010、Visio、Project、OrCAD、PCB Editor、PADS、CAM350、Visual Studio、UltraEdit、Source Insight、Beyond Compare、Keil、ISE 等，购置的与其他项目共用的软件包括 Synopsis、Cadance、Mentor、ModelSim、Maxwell 等。

4、项目建设内容

公司将在现有产品的基础上进行 GT30 系列产品的研发，以期在大尺寸触摸屏苛刻的应用环境下，满足 Windows 8 系统要求、实现流畅真实的 10 点触控操作，满足多人同时操作的应用需求。

(1) 新一代 GT30 系列触控芯片基本情况

计划研发的新一代 GT30 系列触控芯片系统框图如下：

本项目的开发思路如下：

第一阶段，模拟电路的单元设计与仿真：主要涉及窄带差分放大器、高压驱动单元电路，进行单元仿真确定其基本性能是否满足设计规格。

第二阶段，传感器的电场仿真与开模制作：该阶段主要是为了保证后续的开发有真实负载作为输入基础，使第三阶段的仿真结果与实际应用更吻合。

第三阶段，模拟电路的系统设计与仿真：依据第一阶段和第二阶段的工作成果，将模拟部分修改的单元电路整合进系统电路，同时结合实际输入条件进行系统仿真，以确定模拟电路的性能指标是否能够满足软件处理的要求。

第四阶段，数字电路的开发与设计：GT30 系列将采用技术授权的方式引进 32-bit RISC 内核以及 USB 模块，这一阶段要完成内核的移植。

第五阶段，进行芯片的整合设计与仿真。

第六阶段，版图设计与仿真：根据系统仿真的结果进行版图设计，设计完成后验证是否与产品规格吻合。

第七阶段，芯片投片与验证平台构建：在完成版图后进行投片，同时构建验证芯片规格及可靠性的验证平台。

第八阶段，固件开发：此阶段开始基于 FPGA 仿真系统进行固件开发。

第九阶段，芯片验证：对芯片的性能指标及可靠性进行验证，验证完成后进行小批量试产。

(3) 产品主要技术指标

GT30 系列芯片产品的规格如下表所示：

产品	通道数	支持屏幕	检测通道最大 ITO 阻抗	信噪比	支持刷新率
GT30 单芯片应用	70×40	Windows 8 ≤ 21”	< 200k ohm	120	>100Hz
GT30 双芯片应用	140×80	Windows 8 ≤ 30”	< 200k ohm	120	>100Hz

本项目中体现的技术创新点涉及多个方面，如下表所示：

序号	技术创新点	具体描述
1	支持高阻抗大分布电容触摸面板	提高前端模拟电路增益，并在后续数据处理中增加智能增益补偿算法，以增加对笔记本电脑、一体机、显示器等大尺寸

序号	技术创新点	具体描述
		触摸屏高阻抗、高分布电容的适应
2	支持悬空手势操作	通过在触摸屏四周增加电容式远距离感应传感器，搭配高信噪比的检测电路，以及手势识别算法，实现悬空的手势操作
3	COG	设计适用于玻璃基材的芯片绑定管脚，将触摸芯片直接绑定在触摸屏上
4	低功耗设计	采用深亚微米芯片制程、智能型电源控制电路、触摸感测硬件电路等技术来大幅降低功耗
5	软件通道规划跳接功能	芯片内部脚位设计多功控制器，实现芯片引脚功能自由切换

5、项目实施进度

本项目建设工期为 2 年。为适应业务需求，抓住市场契机，公司计划先期投入部分软硬件进行研发工作，待募集资金到位后再予以置换。

6、环保情况

本项目主要通过知识创新和智力劳动获得效益，在项目实施过程中的技术开发、产品测试等环节中均不产生废气、废水和废渣，对环境不产生污染。

（四）On-cell 触摸屏控制芯片开发项目

1、项目概要

本项目将在公司智能手机、平板电脑触控芯片领域深厚的技术积淀基础上，针对 On-cell 触摸屏的技术特点，开发应用于 On-cell 触摸屏的触控芯片产品。该项目的产品将主要应用于搭载 On-cell 触摸屏的智能手机和平板电脑。

2、项目选址及用地

本项目拟通过购置 800 平方米办公场所实施，地址为广东省深圳市南山高新区深圳市软件产业基地。2013 年 4 月 27 日及 2014 年 4 月 24 日，公司作为买受人与出卖人深圳市投资控股有限公司分别签订了房屋预售合同。相关房屋的交付验收手续于 2014 年 6 月 27 日完成。

3、项目投资情况

本项目总投资 12,269 万元，具体投资构成如下表所示：

单位：万元

名称	总计	占比
----	----	----

名称	总计	占比
1、工程费用	4,826.40	39.34%
1.1 办公场地购置费	2,560.00	20.87%
1.2 设备及软件购置费	2,266.40	18.47%
1.2.1 设备购置费	1,799.00	14.66%
1.2.2 软件购置费	467.40	3.81%
2、工程建设其他费用	5,256.10	42.84%
2.1 办公场地装修费	120.00	0.98%
2.2 办公家具购置费	9.75	0.08%
2.3 人员费用	2,510.25	20.46%
2.4 培训费	69.00	0.56%
2.5 产品试制费用	312.10	2.54%
2.6 软件使用费	2,190.00	17.85%
2.7 可行性研究费	15.00	0.12%
2.8 研讨及咨询费	20.00	0.16%
2.9 知识产权登记费用	10.00	0.08%
3、预备费	1,008.25	8.22%
4、铺底流动资金	1,178.59	9.61%
投资总额	12,269.34	100.00%

本项目购置的自用设备主要包括示波器、LCD 驱动设备、服务器、办公电脑等，具体情况如下表所示：

序号	名称	数量	金额（万元）
1	示波器	16	430.00
2	LCD 驱动设备	4	40.00
3	主动式探针	8	16.00
4	万用表	40	14.00
5	高精度万用表	4	12.00
6	RLC 测试仪	3	66.00
7	阻抗分析仪	3	105.00
8	FPGA 开发板	10	15.00
9	频谱仪	3	66.00
10	信号发生器	19	390.00
11	逻辑分析仪	3	60.00

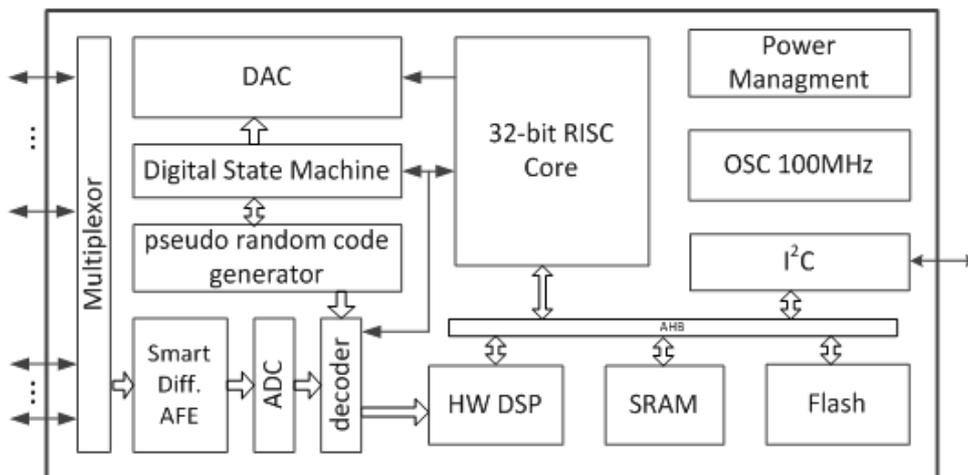
序号	名称	数量	金额（万元）
12	网络分析仪	3	54.00
13	I ² C 总线测试仪	5	250.00
14	多点电容屏测试仪	5	200.00
15	服务器	2	16.00
16	办公电脑	65	65.00
合计			1,799.00

本项目购置的软件包括 Windows 8、Office 2010、protel、source insight、PADS、Project、Visio、OrCAD、PCB Editor、CAM350、Visual Studio、UltraEdit、Beyond Compare 和 Keil 等。

4、项目建设内容

(1) On-cell 触控芯片基本情况

公司计划研发的 On-cell 触控芯片的系统框图如下：



本项目开发的 On-cell 触控芯片将重点实现以下几项性能：1) 支持 COG 应用；2) 支持单层传感器设计；3) 支持悬空操作和手套操作；4) 支持全贴合和框贴工艺；5) 解决高清 LCD 干扰问题；6) 支持带水操作；7) 盖板形变抑制。

(2) 项目开发思路

本项目的开发思路如下：

第一阶段，完成项目的调研和分析：重点进行产品的功能规格定义，进行所需设备的招标采购工作。

第二阶段，进行前端模拟电路的架构设计与仿真：重点完成智能差分电路建模与仿真验证，以及窄带信号检测电路的设计与仿真。

第三阶段，数字电路的开发与设计：为了更实时，更省电的处理 ADC 采样数据，将在这一阶段设计一个专用的硬件 DSP 模块，主要实现信号的解调以及主动式的噪声抑制算法。

第四阶段，进行芯片的整合设计：此阶段将在前两阶段的基础上，加入其他数字部分的外设，如：Timer（计时器）、I²C、电源管理单元等，进行整个芯片的整合设计及仿真、FPGA + 模拟电路仿真板的系统仿真验证，并完成投片。

第五阶段，固件开发。此阶段开始基于以上 FPGA 仿真系统进行固件开发：重点完成新增功能部分的算法设计与实现，如时域差分算法、动态斜率消除算法等。

第六阶段，工程样片验证：经过完整的芯片设计，仿真验证，并在晶圆委外加工厂商完成第一批工程样片之后，便进行芯片的性能验证，可靠性测试。

第七阶段，产品小批量验证及量产：这一阶段将基于实际的芯片进行固件的开发与验证，在完成包含固件的产品质量验证之后，开始投入量产。

（3）产品主要技术指标

本项目中体现的技术创新点涉及多个方面，如下表所示：

序号	技术创新点	具体描述
1	时域差分算法解决防水问题	根据相邻多帧数据进行差分处理区分带水状态和手指触摸状态
2	动态斜率消除算法解决重压坐标不准确问题	重压条件下，手指触摸时，数据包络斜率会变缓，依据原有数据包络的大小判断斜率小于某值时的数据，将该部分剔除形成新的包络以准确计算手指坐标
3	自容互容动态切换	在驱动输出端与检测输入端设计双向多路切换器，让 IC 引脚可以自由切换到不同的外设电路
4	检测数据智能监控	在硬件 DSP 模块中，设计了检测数据监控算法，但检测数据发生突变时，会自动发出中断信号，唤醒 CPU，使得 CPU 在空闲时段可以最大限度进入睡眠模式，降低能耗
5	智能差分技术	采用智能差分信号采样技术，根据应用条件差分处理噪声信号和基准信号，可明显提升信号检测的灵敏度

5、项目实施进度

本项目建设工期为 2 年。为适应业务需求，抓住市场契机，公司计划先期投入部分软硬件进行研发工作，待募集资金到位后再予以置换。

6、环保情况

本项目主要通过知识创新和智力劳动获得效益，在项目实施过程中的技术开发、产品测试等环节中均不产生废气、废水和废渣，对环境不产生污染。

（五）主动式电容触控笔芯片技术升级项目

1、项目概要

在原有主动笔电容芯片的基础上，公司将通过技术升级提高产品性能和用户体验，推动主动笔电容芯片在智能终端的应用和普及。

2、项目选址及用地

本项目拟通过购置 800 平方米办公场所实施，地址为广东省深圳市南山高新区深圳市软件产业基地。2013 年 4 月 27 日及 2014 年 4 月 24 日，公司作为买受人与出卖人深圳市投资控股有限公司分别签订了房屋预售合同。相关房屋的交付验收手续于 2014 年 6 月 27 日完成。

3、项目投资情况

本项目总投资 13,484.38 万元，具体投资构成如下表所示：

单位：万元

名称	总计	占比
1、工程费用	5,696.00	42.24%
1.1 办公场地购置费	2,560.00	18.98%
1.2 设备及软件购置费	3,136.00	23.26%
1.2.1 设备购置费	1,626.00	12.06%
1.2.2 软件购置费	1,510.00	11.20%
2、工程建设其他费用	5,529.65	41.01%
2.1 办公场地装修费	120.00	0.89%
2.2 办公家具购置费	9.00	0.07%
2.3 人员费用	2,731.75	20.26%
2.4 培训费	66.00	0.49%
2.5 产品试制费用	367.90	2.73%
2.6 软件使用费	2,190.00	16.24%
2.7 可行性研究费	15.00	0.11%

名称	总计	占比
2.8 研讨及咨询费	20.00	0.15%
2.9 知识产权登记费用	10.00	0.07%
3、预备费	1,122.57	8.32%
4、铺底流动资金	1,136.16	8.43%
投资总额	13,484.38	100.00%

本项目购置的自用设备主要包括示波器、FPGA 开发板、频谱仪等，具体情况如下表所示：

序号	名称	数量	金额（万元）
1	示波器	8	215.00
2	FPGA 开发板	10	15.00
3	频谱仪	1	22.00
4	环境试验箱	2	10.00
5	信号发生器	7	10.00
6	Chroma	1	40.00
7	Probe Station	1	20.00
8	芯片测试机（模拟测试+200MHz 速度）	1	260.00
9	扫描电子显微镜	1	200.00
10	激光金属粉末烧结设备	1	460.00
11	3D 打印机	1	170.00
12	服务器	2	16.00
13	办公电脑	60	60.00
合计			1,626.00

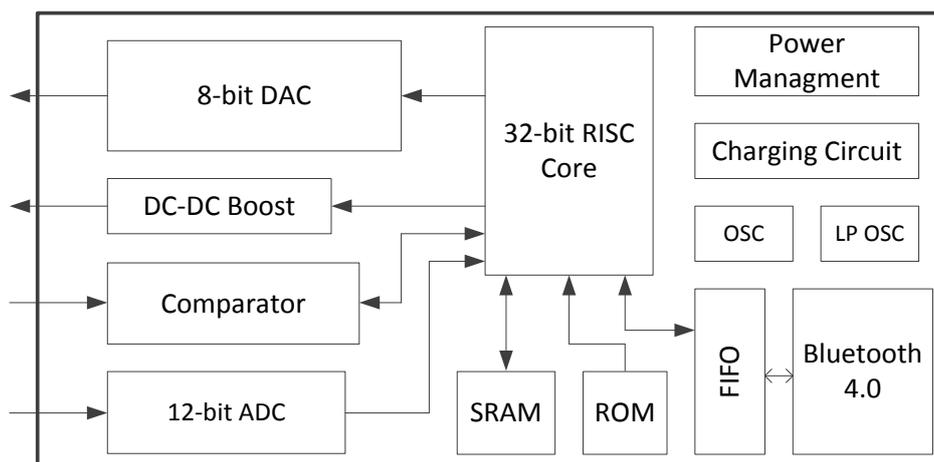
本项目购置的软件包括 Windows 8、Office 2010、protel、source insight、PADS、32 bit RISC Core licence、Project2007、蓝牙 4.0 IP、Visio、OrCAD、PCB Editor、Visual Studio、UltraEdit、Beyond Compare 和 Keil 等。

4、项目建设内容

公司将基于现有产品 GT930 进行主动式电容触控笔芯片的技术改造升级。

（1）主动式电容触控笔芯片 GT930S 基本情况

公司计划研发的主动式电容触控笔芯片触控芯片的系统框图如下：



本项目开发的主动式电容触控笔芯片将重点实现以下几项性能：1) 支持 10mm 悬空操作；2) 支持跳频技术，增强抗干扰能力；3) 支持电量检测及充电控制；4) 延长电池续航能力；5) 提高笔的灵敏度，精准度，使之更接近真实的笔写效果，改善用户体验。

(2) 项目开发思路

本项目的开发思路如下：

第一阶段，开展市场调研：完成项目的市场调研和分析，并进行产品的性能和功能规划与定义。

第二阶段，根据产品规划进行预研工作：设计完成芯片架构，对低功耗 MCU 核，蓝牙 4.0 模块，ADC 的 IP 进行考察与选型。制定项目实施方案与工作计划，提出所需设备和资产的招标采购需求。

第三阶段，芯片前端和后端电路设计，系统应用开发设计：芯片前端电路设计包括模拟电路前端设计和数字电路前端设计。模拟电路前端设计包括模拟电路的架构设计与仿真，低功耗电源管理设计，ADC 和 DAC 设计，蓝牙模块集成等。数字电路前端设计包括数字电路的架构设计与仿真、MCU 核集成、MCU 外设设计、蓝牙内核集成等。芯片后端电路设计包括版图设计，数字与模拟电路的集成联合仿真调试。系统应用开发设计包括芯片原型平台开发、芯片架构验证、接口电路调试、触摸笔机械结构与电气联合开发、用户体验仿真调试等。芯片在此阶段完成时提交流片。

第四阶段，芯片应用方案设计与封装开发，芯片固件开发：设计参考应用方案，并进行芯片封装的开发。基于产品原型平台进行固件开发。如：触摸笔与触摸屏交互模式，10mm 触摸笔悬空操作，抗干扰处理，蓝牙协议栈移植、调试。

第五阶段，工程样片验证：对晶圆委外加工厂商完成的第一批工程样品进行完整的功能，性能测试，可靠性测试。基于工程样品完善固件的开发与验证，完善系统应用方案。

第六阶段，产品小批量验证及量产：完成最后的产品质量验证之后，便开始投入量产。

(3) 产品主要技术指标

本项目拟研发的升级产品与现有产品的技术指标比较如下表所示：

产品	Core	电源管理	DC-DC	ADC	DAC	无线模块	ROM	SRAM
GT930	8-bit RISC	无	无	10-bit	无	无	2kB	128B
GT930S	32-bit RISC	有	有	12-bit	8-bit	蓝牙 4.0	64kB	8kB

本项目中体现的技术创新点涉及多个方面，如下表所示：

序号	技术创新点	具体描述
1	蓝牙 SoC	将蓝牙 4.0 与 32-bit MCU、电源管理等模块整合，为智能终端外设提供低功耗的集成电路平台
2	手掌抑制算法	通过触摸屏的检测数据，拟合触摸物的三维形状，并根据形状特征判断是否为手掌触摸，是则不上报坐标
3	跳频技术	主机通过与笔配套的触摸屏控制芯片检测当前环境下的噪声分布情况，选择噪声最小点作为触摸屏的工作频率，并将该频率通过蓝牙通知电容笔，从而实现笔与屏的同步跳频，提高抗干扰能力
4	低功耗技术	MCU 分级唤醒机制、蓝牙 4.0 低功耗模块、高效电源管理模块

5、项目实施进度

本项目建设工期为 2 年。为适应业务需求，抓住市场契机，公司计划先期投入部分软硬件进行研发工作，待募集资金到位后再予以置换。

6、环保情况

本项目主要通过知识创新和智力劳动获得效益，在项目实施过程中的技术开发、产品测试等环节中均不产生废气、废水和废渣，对环境不产生污染。

（六）电容式近场通信微控制器开发及产业化项目

1、项目概要

本项目将开发电容式近场通信微控制器芯片。该产品内置蓝牙模块、电容式近场通信模块，在智能终端产品与智能终端配件和可穿戴设备之间实现信息的交互功能。该项目的产品将主要应用于智能终端配件和可穿戴设备。

2、项目选址及用地

本项目拟通过购置 650 平方米办公场所实施，地址拟选在广东省深圳市南山高新区深圳市软件产业基地。

3、项目投资情况

本项目总投资 23,203 万元，具体投资构成如下表所示：

单位：万元

名称	总计	占比
1、工程费用	9,702.40	41.82%
1.1 办公场地购置费	2,275.00	9.80%
1.2 设备及软件购置费	7,427.40	32.01%
1.2.1 设备购置费	4,518.00	19.47%
1.2.2 软件购置费	2,909.40	12.54%
2、工程建设其他费用	9,683.10	41.73%
2.1 办公场地装修费	97.50	0.42%
2.2 办公家具购置费	9.75	0.04%
2.3 人员费用	3,046.75	13.13%
2.4 培训费	72.00	0.31%
2.5 产品试制费用	312.10	1.35%
2.6 软件使用费	4,760.00	20.51%
2.7 可行性研究费	15.00	0.06%
2.8 研讨及咨询费	20.00	0.09%
2.9 知识产权登记费用	10.00	0.04%
2.10 认证费	1,340.00	5.78%
3、预备费	1,938.55	8.35%
4、铺底流动资金	1,878.61	8.10%

名称	总计	占比
投资总额	23,202.66	100.00%

本项目购置的自用设备主要包括示波器、数字及混合信号示波器、矢量信号发生器、音频分析仪、净化电源、数据发生器分析仪、IQ 信号记录仪等，具体情况如下表所示：

序号	名称	数量	金额（万元）
1	示波器	13	250.00
2	数字及混合信号示波器	3	600.00
3	矢量信号发生器	1	16.00
4	音频分析仪	1	13.00
5	净化电源	4	12.00
6	数据发生器分析仪	2	122.00
7	IQ 信号记录仪	1	16.00
8	下变频器	1	6.00
9	信号采集卡	2	26.00
10	无线通信测试仪	1	28.00
11	噪声分析仪	1	43.00
12	FPGA 开发板	10	15.00
13	频谱仪	1	22.00
14	环境试验箱	2	10.00
15	信号发生器	19	390.00
16	Chroma	1	40.00
17	Probe Station	1	20.00
18	芯片测试机	1	260.00
19	扫描电子显微镜	1	200.00
20	电波暗室	1	2,100.00
21	前置放大器	2	40.00
22	EMI 分析仪	2	186.00
23	近场接收天线	2	22.00
24	服务器	2	16.00
25	办公电脑	65	65.00
合计		-	4,518.00

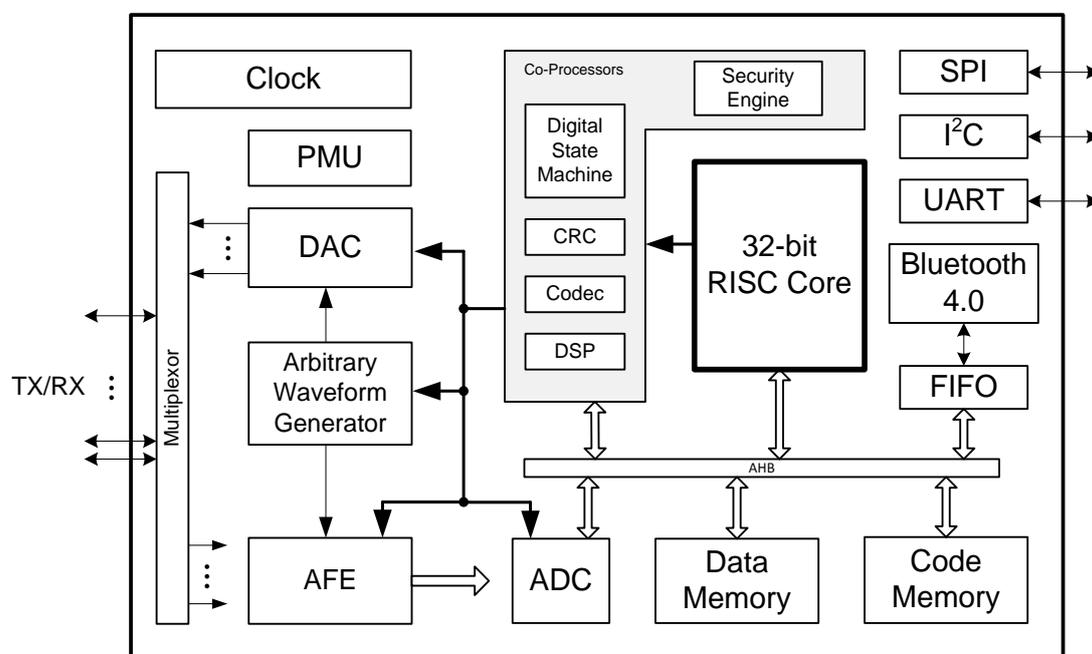
本项目购置的自用软件包括 Windows8、Office2010、Protel、32 bit RISC Core licence、Co-processors licence 等。

4、项目建设内容

基于公司在智能手机、平板电脑等触控芯片领域深厚的技术积淀，进行电容式近场通信微控制器的开发，该产品将借助于电容触摸屏、触控按键等实现近场通信，在智能终端产品与智能终端配件和可穿戴设备之间实现信息的交互功能，而无需增加额外的芯片和天线成本。该产品具备蓝牙功能，可支持 2 吋单点电容式触摸屏或 16 个触摸按键。

(1) 电容式近场通信微控制器基本情况

本项目计划研发的电容式近场通信微控制器的系统框图如下：



本项目开发的电容式近场通信微控制器将重点实现以下几项性能：1) 支持电量检测及充电控制；2) 延长电池续航能力；3) 支持近场通信功能；4) 支持 2 吋单点电容屏或 16 个触摸按键；5) 支持驱动、接收通道相互切换；6) 内置安全引擎模块；7) 内置 CRC 模块；8) 内置 32 位处理器；9) 提升 ADC 和 DAC 采样率；10) 内置任意波形产生器模块；11) 提升模拟前端电路的信噪比。

(2) 项目开发思路

本项目的开发思路如下：

第一阶段，开展市场调研：完成项目的市场调研和分析，并进行产品的性能和功能规划与定义。

第二阶段，根据产品规划进行预研工作：设计完成芯片架构，对低功耗 MCU 核、蓝牙 4.0 模块、ADC 的 IP 进行考察与选型。制定项目实施方案与工作计划，提出所需设备和资产的招标采购需求。

第三阶段，芯片前端和后端电路设计，系统应用开发设计：芯片前端电路设计包括模拟电路前端设计和数字电路前端设计。模拟电路前端设计包括模拟电路的架构设计与仿真、低功耗电源管理设计、ADC 和 DAC 设计、蓝牙模块集成等。数字电路前端设计包括数字电路的架构设计与仿真、MCU 核集成、MCU 外设设计、蓝牙内核集成等。芯片后端电路设计包括版图设计、数字与模拟电路的集成联合仿真调试。系统应用开发设计包括芯片原型平台开发，芯片架构验证，接口电路调试，近场通信原型验证，用户体验仿真调试等。芯片在此阶段完成时提交流片。

第四阶段，芯片应用方案设计与封装开发，芯片固件开发：设计参考应用方案，并进行芯片封装的开发；基于产品原型平台进行固件开发，如：近场通信协议开发、调试，抗干扰处理，蓝牙协议栈移植、调试。

第五阶段，工程样片验证：对晶圆代工厂完成的第一批工程样品进行完整的功能、性能测试及可靠性测试；基于工程样品完善固件的开发与验证，完善系统应用方案。

第六阶段，产品小批量验证及量产：完成最后的产品质量验证之后，便开始投入量产。

(3) 产品主要技术指标

本项目中体现的技术创新点涉及多个方面，如下表所示：

序号	技术创新点	具体描述
1	蓝牙 SoC	将蓝牙 4.0 与 32-bit RISC 内核、电源管理等模块整合，为智能终端外设提供低功耗的集成电路平台
2	触摸传感器与天线复用技术	借助电磁仿真软件、EMI 实验设备等工具，优化触摸屏传感器设计，使得触摸屏传感器既保证良好的触控性能，又保证良好的近场通信性能
3	近场通信抗干扰技术	采用高压驱动及智能选频技术，每次通信能自动选择噪声较低的频点作为载波，从而使通信可靠性大幅度提升
4	近场通信传输速率自适应技术	根据环境噪声情况，自动调整通信速率，确保通信可靠性

序号	技术创新点	具体描述
5	低功耗技术	采用多种低功耗技术：MCU 分级唤醒机制、 蓝牙 4.0 低功耗模块、高效电源管理模块

5、项目实施进度

本项目建设工期为 2 年。为适应业务需求，抓住市场契机，公司计划先期投入部分软硬件进行研发工作，待募集资金到位后再予以置换。

6、环保情况

本项目主要通过知识创新和智力劳动获得效益，在项目实施过程中的技术开发、产品测试等环节中均不产生废气、废水和废渣，对环境不产生污染。

（七）指纹识别芯片和模组开发及产业化项目

1、项目概要

本项目将针对智能手机、平板电脑等智能终端进行指纹识别芯片和模组的研发。该项目的产品将主要应用于智能手机和平板电脑等智能终端。

2、项目选址及用地

本项目拟通过购置 750 平方米办公场所实施，地址拟选在广东省深圳市南山高新区深圳市软件产业基地。

3、项目投资情况

本项目总投资 39,403 万元，具体投资构成如下表所示：

单位：万元

名称	总计	占比
1、工程费用	24,831.40	63.02%
1.1 办公场地购置费	2,625.00	6.66%
1.2 设备及软件购置费	22,206.40	56.36%
1.2.1 设备购置费	21,424.20	54.37%
1.2.2 软件购置费	782.20	1.99%
2、工程建设其他费用	8,040.40	20.41%
2.1 办公场地装修费	112.50	0.29%
2.2 办公家具购置费	11.25	0.03%

名称	总计	占比
2.3 人员费用	2,927.50	7.43%
2.4 培训费	81.00	0.21%
2.5 产品试制费用	103.15	0.26%
2.6 软件使用费	4,760.00	12.08%
2.7 可行性研究费	15.00	0.04%
2.8 研讨及咨询费	20.00	0.05%
2.9 知识产权登记费用	10.00	0.03%
3、预备费	3,287.18	8.34%
4、铺底流动资金	3,243.99	8.23%
投资总额	39,402.97	100.00%

本项目购置的设备主要包括公司自用的研发设备和提供给封装厂商专门为公司生产指纹识别芯片模组的生产设备。

公司自用的研发设备具体情况如下表所示：

序号	名称	数量	金额（万元）
1	示波器	16	430.00
2	主动式探针	8	16.00
3	万用表	40	14.00
4	高精度万用表	4	12.00
5	RLC 测试仪	3	66.00
6	阻抗分析仪	3	105.00
7	FPGA 开发板	10	15.00
8	频谱仪	3	66.00
9	信号发生器	19	390.00
10	逻辑分析仪	3	60.00
11	网络分析仪	3	54.00
12	I ² C 总线测试仪	5	250.00
13	多点电容屏测试仪	5	200.00
14	服务器	2	16.00
15	办公电脑	75	75.00
合计		-	1,769.00

本项目提供给封装厂商专门为公司生产指纹识别芯片模组的生产设备的具体情况如下表所示：

序号	名称	数量	金额（万元）
1	晶圆贴膜机	2	660.00
2	晶圆背面研磨机	2	206.00
3	晶圆揭膜机	2	820.00
4	晶圆贴蓝膜机	2	380.00
5	晶圆切割机	2	300.00
6	芯片贴装机	4	36.40
7	烤箱	9	1,566.50
8	丝球焊线机	50	950.00
9	三光检验机	2	122.00
10	等离子清洗机	4	964.00
11	塑封机	2	18.20
12	电子去胶机	1	120.00
13	电镀机	1	717.00
14	镭射刻印机	2	100.00
15	植球机	1	240.00
16	切割/成型	4	1,520.00
17	引脚扫描仪	3	1,320.00
18	O/S 检测仪	4	17.20
19	最终目检显微镜	8	7.20
20	包装	6	7.20
21	探针	6	284.00
22	探测头	1	2.70
23	测试 Handler	64	1,420.00
24	晶柱切片机	2	48.00
25	划片机	6	120.00
26	倒角机	8	232.00
27	仿形磨边机	6	48.00
28	CNC 雕刻机	6	48.00
29	研磨机	10	188.00

序号	名称	数量	金额（万元）
30	金属压合机	2	30.00
31	镭射雕刻机	2	36.00
32	Laser Tooling	2	60.00
33	FAI 测试机台	2	140.00
34	高速贴片机	2	260.00
35	SMT 传输系统	2	240.00
36	回流烤箱 ASB300	3	345.00
37	COB Bonding 机	40	3,200.00
38	贴蓝宝石镜片点胶机	4	800.00
39	ACF 贴附机	20	26.00
40	ACF 压合机	20	68.00
41	显微镜	12	10.80
42	超声波扫描显微镜	2	330.00
43	X-光检测系统	2	248.00
44	X-光测量系统	1	3.80
45	水珠角度量测仪 ACA-501	1	13.00
46	焊线拉力测量仪	2	54.00
47	焊球推力测量仪	2	54.00
48	散热片贴片机（HHM-505）	1	120.00
49	热冲击试验箱	2	62.10
50	温湿试验箱	1	13.70
51	高温试验箱	1	3.30
52	高压试验箱	1	18.80
53	温度循环试验箱	1	53.60
54	PC-422R7 HAST 试验箱	1	23.40
55	可程式恒温湿试验机	1	7.40
56	Network 分析仪	1	45.20
57	加热平台	1	0.30
58	Thermal Analyze & Event Detector	1	149.70
59	探测机台 + TDA	1	36.00
60	TDR 示波器	1	31.30

序号	名称	数量	金额（万元）
61	IR-500A & PL-500A System	1	12.40
62	电子检测显微镜	1	47.50
63	超声波清洗机	1	0.40
64	扫描电镜	1	180.30
65	Hypervision Visionary 2000 Series Beams	1	234.30
66	开盖分析器	1	30.40
67	温度&湿度控制系统	1	8.10
68	显微图像系统工作站	1	5.10
69	Charged Plate 分析仪	1	6.20
70	FX 系列自动曲线测绘仪	1	26.30
71	ISOMET 5000 精密线切割机	1	27.90
72	ES371 反应式腐蚀系统（RIE）	1	57.70
73	FX 系列液晶显微镜（LC VIWE）	1	19.20
74	Workstation for Liquid Crystal Inspection Controlling	1	2.10
75	手持式温湿度测试表	1	0.40
76	金属探测门	1	2.80
77	酸碱度计	1	0.40
78	变频器	1	0.30
79	电阻率监控仪器	1	0.50
80	液压升降平台车	1	0.30
81	水泵	2	2.40
82	加湿器	5	9.70
83	微压差表	1	0.30
84	温湿度传感器	1	0.80
85	真空泵	2	1.20
86	川井除湿机	3	2.50
87	12 Points recorder marker	1	2.90
88	露点测试仪	1	2.70
89	离子风扇	1	2.30
90	氮气柜	20	22.00
合计		-	19,655.20

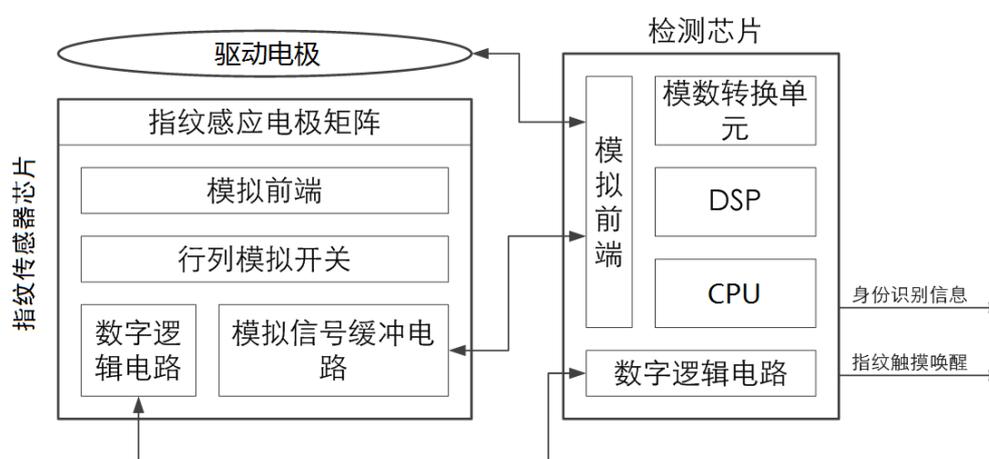
本项目购置的自用软件包括 Windows 8、Office 2010、Protel、Source Insight、PADS 等。

4、项目建设内容

本项目将研发针对智能手机、平板电脑等智能终端的指纹识别芯片，与封装厂商合作，为其提供生产指纹识别模组的相关设备，以便其专门为汇顶科技提供指纹识别模组的生产。

(1) 指纹识别芯片基本情况

本项目计划研发的指纹识别芯片的系统框图如下：



本项目开发的指纹识别芯片将重点实现以下几项性能：1) 匹配时间 $\leq 50\text{ms}$ ；2) 96×96 分辨率，256 级灰度的指纹传感器；3) 可对 360 度范围内旋转的图像进行识别；4) 可储存 5 个以上手指的特征数据；5) 拒真率 $\leq 1\%$ ；6) 认假率 $\leq 0.002\%$ 。

(2) 项目开发思路

本项目的开发思路如下：

第一阶段，完成项目的调研和分析：重点进行产品的功能规格定义，进行所需设备的招标采购工作。

第二阶段，完成技术预研和项目系统架构设计：完成结构建模与电场仿真；完成基于 wire bond 工艺的模组组装设计及其应力仿真；完成系统架构设计。

第三阶段，完成检测电路的设计与仿真；完成 DSP 与 32-bit RISC 内核整合；完成定制设备的外包设计及确认工作。

第四阶段，进行芯片的整合设计及定制设备的生产采购：此阶段将在前两阶段的基础上，加入其他数字部分的外设，如：Timer（计时器），SPI，电源管理单元等，进行整个芯片的整合设计及仿真，FPGA + 模拟电路仿真板的系统仿真验证，并完成投片；同时完成定制设备的生产采购。

第五阶段，固件开发及模组生产工艺的模拟验证：此阶段开始基于以上 FPGA 仿真系统进行固件开发。重点完成指纹识别的算法设计与实现，如去噪、清晰化、指纹特征提取算法等。同时，采用其它芯片来模拟实际芯片来对模组生产工艺模拟验证。

第六阶段，工程样片及模组验证：经过完整的芯片设计、验证，并在晶圆代工厂完成第一批工程样片之后，完成组装，对组装后的模组进行性能验证，可靠性测试。

第七阶段，产品小批量验证及量产：这一阶段将基于实际的芯片进行固件的开发与验证和组装，在完成包含固件及模组的产品质量验证之后，开始投入量产。

（3）产品主要技术指标

本项目中体现的技术创新点涉及多个方面，如下表所示：

序号	技术创新点	具体描述
1	窄带抗干扰技术	采用高速 ADC 和数字滤波器技术实现窄带信号检测，提升抗干扰能力
2	低电压驱动技术	指纹芯片采用小于 3V 的驱动信号，降低指纹模组电极与人体之间的电压，避免人手操作的不适感
3	自适应消除噪声算法	动态检测噪声与信号基准，自适应调整信号相关性参数，动态的对图像进行最优化处理
4	指纹识别算法	设计不同于传统的指纹识别与特征提取方法，可在小面积传感器上实现高水平的认假率，拒真率性能，同时可降低对处理器运算能力的要求
5	平面 wire bond 技术	创新设计模组机构，采用 wire bond 传统工艺解决指纹芯片平面封装难题，降低生产工艺难度

5、项目实施进度

本项目建设工期为 2 年。为适应业务需求，抓住市场契机，公司计划先期投入部分软硬件进行研发工作，待募集资金到位后再予以置换。

6、环保情况

本项目主要通过知识创新和智力劳动获得效益，在项目实施过程中的技术开发、产品测试等环节中均不产生废气、废水和废渣，对环境不产生污染。

（八）研发中心建设项目

1、项目概要

为了保持公司核心技术的领先优势，加强在智能人机交互技术领域的竞争力，公司将利用本次募集资金进行研发中心的建设，建立芯片设计、In-cell 触控技术、车载电子触控芯片、传感器技术四个研发中心，培养一支规模在 60 人左右的研发团队，从而巩固公司在行业内的技术领先地位。

2、项目选址及用地

本项目拟通过购置 660 平方米办公场所实施，地址为广东省深圳市南山高新区深圳市软件产业基地。2013 年 4 月 27 日及 2014 年 4 月 24 日，公司作为买受人与出卖人深圳市投资控股有限公司分别签订了房屋预售合同。相关房屋的交付验收手续于 2014 年 6 月 27 日完成。

3、投资概算

本项目总投资 9,325 万元，具体投资构成如下表所示：

单位：万元

名称	总计	占比
1、工程费用	6,758.33	72.47%
1.1 办公场地购置费	2,112.00	22.65%
1.2 设备及软件购置费	4,646.33	49.83%
1.2.1 设备购置费	1,767.88	18.96%
1.2.2 软件购置费	2,878.45	30.87%
2、工程建设其他费用	2,122.75	22.76%
2.1 办公场地装修费	99.00	1.06%
2.2 办公家具购置费	9.00	0.10%
2.3 人员费用	1,038.75	11.14%
2.4 培训费	36.00	0.39%
2.5 软件使用费	895.00	9.60%
2.6 可行性研究费	15.00	0.16%
2.7 研讨及咨询费	20.00	0.21%
2.8 知识产权登记费用	10.00	0.11%
3、预备费	444.05	4.76%

名称	总计	占比
投资总额	9,325.13	100.00%

本项目购置的自用设备主要包括磁场测量仪、加速度计、高精度电表等，具体情况如下表所示：

序号	名称	数量	金额（万元）
1	磁场测量仪	1	0.20
2	加速度计	1	0.20
3	示波器	10	26.10
4	高阶示波器	6	143.76
5	逻辑分析仪	3	76.89
6	频谱分析仪	3	115.80
7	网络分析仪	2	36.00
8	主动式探针	8	16.32
9	Pattern Generator	4	16.96
10	精密电表	65	20.80
11	高精度电表	5	13.30
12	FPGA	10	15.00
13	RLC meter	1	19.85
14	阻抗分析仪	1	31.20
15	LCD 光学量测	2	100.00
16	FDP 电性量测	2	100.00
17	COG bonding 机	1	40.00
18	FPC bonding 机	1	23.00
19	TEM cell	10	10.00
20	USB protocol analyzer	4	16.00
21	PCI-E protocol analyzer	4	20.00
22	MIPI protocol analyzer	4	20.00
23	Agilent B1500A 电性测试	2	80.00
24	晶圆探针台	1	30.00
25	车载电子环境模拟室	1	100.00
26	65nm 实验 mask	2	180.00
27	90nm 实验 mask	2	144.00
28	LCD mask for In-cell	3	120.00

序号	名称	数量	金额（万元）
29	公用设备分摊	-	252.50
合计		-	1,767.88

本项目购置的自用软件包括 Bus Hound、Windows 8、Office 2010、Visio、Project、OrCAD、PCB Editor、PADS、CAM350、Visual Studio、UltraEdit、Source Insight、Beyond Compare、Keil、ISE 等，购置的与其他项目共用的软件包括 Synopsis、Cadance、Mentor、ModelSim、Maxwell 等。

4、项目建设研究方向

研发中心将重点建立芯片设计研发中心、In-cell 触控技术研发中心、车载电子触控芯片研发中心和传感器技术研发中心，各研发中心的具体研发内容如下：

（1）芯片设计研发中心

芯片设计中心的主要工作包括建立快速且严谨的芯片设计流程，积累基本设计模块以及 IP，建立完整的芯片功能测试、量产测试、解析以及分析测试、封装应用等设备及技术。

芯片设计研发中心的研发方向包括：1) 建立自上而下的完整芯片设计流程；2) 开发 8 位、16 位、32 位低功耗高性能 MCU 核；3) 先进混合信号电路设计与整合技术；4) 高速高精度模数转换器、数模转换器、增益可调放大器、锁相环电路设计；5) 高速低功耗存储器电路设计及应用；6) 65nm、90nm 深亚微米工艺技术应用。

（2）In-cell 触控技术研发中心

该中心拟开展的 In-cell 电容触控技术研究分为两个方面，一方面是将触控所需要的传感器电路整合进现有的 LCD 显示单元中，使触控模组变得更轻薄、成本更低，并能支持 7-10 吋的显示屏幕；另一方面是将触控芯片与 LCD 驱动芯片进行整合，提供单片式且同时具有显示驱动和触控功能的芯片。虽然当前已有众多其他厂商对 In-cell 技术进行了一定研究，但由于技术难度较大，产品良率较低，目前能够真正实现量产的产品几乎没有。

公司针对 In-cell 技术的研究方向主要包括：1) 建立先进仿真模型，做 LCD 驱动信号、触控屏驱动信号、触控屏感应信号的定性定量分析；2) LCD 驱动信号、触摸屏

驱动信号、触摸屏感应信号的结合研究；3) 实现理想的 In-cell touch LCD 架构；4) 整合电容屏触控芯片与 LCD 驱动芯片，提供单芯片 In-cell 触摸屏解决方案。

(3) 车载电子触控芯片研发中心

目前汽车逐步向自动化、智能的方向发展，本公司拟设立车载电子触控芯片研发中心进行汽车电子的研究，开发智能型汽车触控平台的全方位解决方案。车载电子的研究重点包括：1) 车用电子的芯片质量规格设计；2) 车用高精度抗干扰传感器设计与研究；3) 车用 MCU 平台设计与应用。

(4) 传感器技术研发中心

电容式触控检测属于微弱信号的检测技术，公司在这一领域已有多年的技术积累，而这一技术除了应用于多点电容屏的检测以外，还可以搭配不同的传感器，拓展出更多不同的产品。传感器技术研发中心将专注于开发各种用于感知人体生理信号、精密物理信号的传感器。智能移动设备可以通过这些传感器所提供的数据，分析和学习用户的行为习惯，记录用户的各项生理指标，为用户提供更智能、更人性化的服务，如根据用户的行动轨迹，帮助寻找遗失物品、泊车的位置；根据用户的生理指标，提供急救报警、保健意见等。

该中心的具体研发方向包括：高灵敏度高适应性人体触控传感器技术；结合显示屏的 In-cell/On-cell 触控传感器技术；人体表层（皮肤层）信号测量与分析；人体中层（肌肉层）信号测量与分析；人体深层（骨骼、内脏）信号测量与分析；虚拟电子触觉回馈；地磁测量；电场测量；气压及高度测量；加速度测量；重力测量；3D 陀螺仪传感器；声音讯号的测量、分析、处理与合成；MEMS 传感器设计与研发；传感器适应性自动校正演算法。

5、项目实施进度

本项目建设期 1 年，主要建设工作包括办公场地装修、设备及软件采购、调试与安装、研发人员的招聘和培训等。

6、环保情况

本项目主要通过知识创新和智力劳动获得效益，项目实施过程中不产生废气、废水和废渣，对环境不产生污染。

四、募集资金运用对发行人未来财务状况及经营成果的影响

（一）突出和提高公司的核心竞争力

公司募集资金投资项目投产后，将提升原有产品的技术含量和市场竞争力，开发电容式近场通信微控制器、指纹识别芯片和模组等新产品，从而进一步提升公司的研发能力，开拓新的利润增长点。募集资金投资项目的实施将进一步突出和提高公司的核心业务竞争能力，为本公司在国内和国际市场进一步确立更加稳定的竞争地位奠定基础。

（二）提高公司的经营规模和盈利能力

本次募集资金项目经过充分论证，具有良好的发展前景。在募集资金项目建设期，由于项目尚未达产，公司净资产收益率在短期内将有所下降，但随着项目陆续投产和业务规模的扩大，公司盈利水平将大幅提升，公司的经营规模和盈利能力将得到进一步的提升。

（三）改善公司财务状况

本次发行完成后，公司的净资产规模和每股净资产将大幅提高，公司的净资产和全面摊薄的每股净资产大幅度增长，公司账面价值将显著上升。随着资产规模的提高，公司的资产负债率将得到进一步改善，有利于公司间接融资能力和抵御财务风险能力的提升。

（四）新增折旧和摊销费用对未来经营成果的影响

本次募集资金投资项目涉及办公场地、设备与软件的购置，项目建设完成后公司的折旧和摊销费用将有所增加。根据募集资金投资项目可行性研究报告，募投项目投入运营后新增息税折旧摊销前利润将大幅超过新增折旧和摊销费用，因此新增折旧和摊销费用对公司未来经营成果不会产生重大不利影响。

第十四节 股利分配政策

一、发行人报告期内股利分配政策及实际股利分配情况

(一) 报告期内股利分配政策

1、汇顶有限的股利分配政策

2011年至股份公司设立之前，按照当时有效的《公司章程》，汇顶有限的股利分配政策如下：

“公司依法缴纳所得税、弥补亏损和提取法定公积金后的利润，按各方出资额在注册资本中的比例进行分配。公司按法律规定提取法定公积金。法定公积金在公司依法缴纳所得税后的利润中提取，提取的比例为当年利润的10%。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%，可不再提取。

公司上一个会计年度亏损未弥补前，不得分配利润。上一个会计年度未分配的利润，可并入本会计年度利润分配。

公司每年分配利润一次。每个会计年度后三个月内公布利润分配方案及各方应分的利润额。”

2、股份公司的股利分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》，公司利润分配的有关规定如下：

“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司的利润分配政策为：

(一) 公司利润分配的总原则：

公司将牢固树立回报股东的意识，每年结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，选择有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的利润分配方案，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的一致性、合理性、连续性和稳定性。

(二) 公司利润分配的政策：

1、公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配；

2、公司在该年度盈利且累计未分配利润为正，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，原则上每年至少进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司可以根据公司的盈利状况及资金状况进行中期现金分红，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（三）公司利润分配的决策程序：

1、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；相关议案需经董事会全体董事过半数表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过；

2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

3、独立董事应对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；

4、董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权；股东大会审议现金分红具体方案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，公司的股东大会除现场会议外，还应当采取有利于全体股东参与表决的方式召开。

（四）利润分配政策的调整：

公司若因外部经营环境和自身经营状态发生重大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上交所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事的意见，并需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，且相关制度需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并在公司定期报告中就现金分红政策的调整进行详细的说明。

（五）完善公司分红政策的监督约束机制：

1、公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、盈利能力、经营发展规划、股东回报、外部融资环境以及是否有重大资金支出安排等因素，制定未来三年股东回报规划，明确各期利润分配的具体安排和形式、现金分红规划及其期间间隔等；

2、独立董事应对分红预案独立发表意见，对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应发表独立意见；

3、监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：（1）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；（2）未严格履行现金分红相应决策程序；（3）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况等；

4、公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。年度盈利但未提出现金分红预案的，还将说明未分红原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。其中，公司应当在年度报告中对下列事项进行专项说明：

(1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

(2) 分红标准和比例是否明确和清晰；

(3) 相关的决策程序和机制是否完备；

(4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

(5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等；

(6) 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

(二) 报告期内股利分配情况

公司报告期内股利分配情况如下：

1、2014年2月21日，公司召开2013年度股东大会，会议决议：以2013年12月31日公司总股本16,500万股为基数，将公司截至2013年12月31日可供分配的利润向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），合计派发现金股利8,250万元；剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次分红已发放完毕。

2、2015年4月18日，公司召开2014年度股东大会，会议决议：以2014年12月31日公司总股本16,500万股为基数，将公司截至2014年12月31日可供分配的利润向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计派发现金股利9,900万元，同时向全体股东每10股送红股13股，共计送红股21,450万股，并以资本公积转增股本2,050万股。利润分配方案实施完毕后，公司总股本将增加至40,000万股。公司本次分红已发放完毕。

3、2016年2月26日，公司召开2015年度股东大会，会议决议：以2015年12月31日公司总股本400,000,000股为基数，将公司截至2015年12月31日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计派发现金股利10,000万元。公司本次分红尚未发放完毕。

二、本次发行上市后的股利分配政策

根据《公司章程（草案）》、《未来三年分红回报规划》及《长期分红回报规划》，本次发行后，公司的股利分配政策为：

（一）公司股利分配的总原则

公司将牢固树立回报股东的意识，每年结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，选择有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的利润分配方案，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的一致性、合理性、连续性和稳定性。

（二）公司股利分配的形式及期间间隔

1、公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

2、在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金状况进行中期现金分红。

（三）公司股利分配的条件及方式

公司每年的税后利润，按下列顺序和比例分配：

（1）弥补以前年度亏损；

（2）提取法定公积金。按税后利润的 10% 提取法定公积金，当法定公积金累积额已达到公司注册资本的 50% 以上时，可以不再提取；

（3）提取任意公积金。公司从税后利润提取法定公积金后经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金，具体比例由股东大会决定；

（4）支付普通股股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，普通股股利按股东持有股份比例进行分配。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向股东分配。

（四）公司现金分红的条件及比例

1、在满足下列条件时，公司应积极推行现金分红：

(1) 公司该年度盈利且累计未分配利润为正值；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

2、在符合现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司可以根据公司的盈利状况及资金状况进行中期现金分红，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(五) 公司未来三年具体股利分配计划

1、在符合现金分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分配。

2、在符合现金分红条件情况下，公司未来三年每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

3、公司目前发展阶段属于成长期且未来三年内有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会对提高现金分红在本次利润分配中的最低比例进行表决。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司

股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（六）公司股利分配的决策及调整程序

1、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见，相关议案需经董事会全体董事过半数表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过。

2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；独立董事应对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。

3、董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权；股东大会审议现金分红具体方案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。

4、公司若因外部经营环境和自身经营状态发生重大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上交所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事的意见，并需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，且相关制度需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并在公司定期报告中就现金分红政策的调整进行详细的说明。

（七）完善公司分红政策的监督约束机制

1、公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、盈利能力、经营发展规划、股东回报、外部融资环境以及是否有重大资金支出安排等因素，制定未来三年股东回报规划，明确各期利润分配的具体安排和形式、现金分红规划及其期间间隔等。

2、独立董事应对分红预案独立发表意见，对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应发表独立意见并公开披露。

3、监事会需对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：（1）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；（2）未严格履行现金分红相应决策程序；（3）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况等。

4、公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。年度盈利但未提出现金分红预案的，还将说明未分红原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。其中，公司应当在年度报告中对下列事项进行专项说明：（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等；（6）对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

三、本次发行完成前滚存利润的分配政策

公司于2014年4月12日召开2014年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，同意本次发行上市前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，发行人的利润分配政策注重投资者稳定回报，有利于保护投资者合法权益；《公司章程（草案）》及本招股说明书对利润分配事项的规定和信息披露符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人股利分配决策机制健全、有效，有利于保护公众股东权益。

第十五节 其他重要事项

一、信息披露及投资者关系管理

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，公司制定《信息披露事务管理制度（草案）》及《投资者关系管理制度（草案）》。

本公司负责信息披露和协调投资者关系的部门：董事会办公室

主管负责人：廖崇清

电话：0755-33338828-886

传真：0755-33338787

电子邮件：ir@goodix.com

二、重大合同

截至本招股说明书签署之日，本公司正在履行及将要履行的重大合同包括金额在 500 万元以上的或虽然金额未达到 500 万元但对发行人有重要影响的采购合同（发行人与委外供应商签订的合同）、销售合同（发行人与主要客户签订的合同）以及其他重要合同，具体如下：

（一）采购合同

1、2015 年 4 月 28 日，发行人与日月光封装测试（上海）有限公司（以下简称“日月光”）签署了《封装加工协议》，协议约定：发行人提供需委托加工的芯片图、脚位排列图（压焊图）、Marking SPEC 等资料，由日月光进行封装加工。委托产品单价由日月光提供各个型号产品正式报价单为准，双方签字确认。付款方式为月结 30 天，协议有效期 1 年，如协议届满前 30 日，任何一方未以书面形式通知对方本协议期满终止，则本协议自动延期，每次延期 1 年。

2、2014年5月21日，发行人与北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易科技”）签署了《物料采购协议》，协议约定：发行人向兆易科技采购物料，物料的料号、描述、规格型号、品牌、数量等均以订单的约定为准；单价按照双方确认的报价单及采购订单为准；付款方式为月结60天；合同有效期为一年，如协议届满前30日任何一方未以书面通知对方协议期满终止，则协议自动延期一年。

3、2015年8月1日，发行人与华天科技（西安）有限公司（以下简称“华天科技”）签署了《封装加工协议》，协议约定：发行人向华天科技提供所需委工产品的片图、脚位排列图（压焊图）、Marking SEPC等资料。华天科技收到发行人的资料后5日内提供封装加工所需资料，包括但不限于POD、BD图、印章图，供发行人确认。委工产品单价由华天科技提供各个型号产品正式报价单为准。付款方式为月结30天，合同有效期为1年，如协议届满前30日任何一方未以书面通知对方协议期满终止，则协议自动延期1年。

4、2012年10月8日，发行人与X-FAB签署了《质量保证协议》，协议约定：发行人委托X-FAB按协议规定生产、测试晶圆产品；协议对发行人委托X-FAB生产、测试的晶圆的技术参数、质量标准等进行了约定；协议双方应对对方提供的与协议有关的所有信息或文件遵守保密义务；与协议有关的法律关系适用德国实体法；协议无限期有效，协议一方可提前三个月通知对方终止协议。

5、2015年9月16日，发行人与广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“广东利扬”）签署《CP测试加工协议》，协议约定：发行人提供晶圆或集成电路委托广东利扬测试加工，具体产品的型号、价格、数量等由双方议定并记载于订单上；协议有效期为一年，如协议届满前30日，任何一方未以书面通知对方协议期满终止，则协议自动延期，每次延期一年。

6、2015年9月16日，发行人与广东利扬签署《FT加工协议》，协议约定：发行人提供晶圆或集成电路委托广东利扬FT加工，具体产品的型号、价格、数量等由双方议定并记载于订单上；协议有效期为一年，如协议届满前30日，任何一方未以书面通知对方协议期满终止，则协议自动延期，每次延期一年。

7、2013年5月29日，发行人与南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“富士通”）签署了《合同》，约定：发行人委托富士通封装其提供的IC芯片；IC芯片拟发出日期、

品名、数量、发行人交付产品的品名、交货期、交货地点、交货方式等以具体订单为准，具体单价由双方另行商定；付款方式为月结 30 天；合同有效期为三年，到期前或续期期满前两个月内，合同一方未通知另一方终止或修改合同，则自动续期一年，其后嗣同。

2013 年 7 月 25 日，汇芯科技与富士通签署了《合同》，约定：汇芯科技委托富士通封装其提供的 IC 芯片；IC 芯片拟发出日期、品名、数量、发行人交付产品的品名、交货期、交货地点、交货方式等以具体订单为准，具体单价由双方另行商定；付款方式为月结 30 天；合同有效期为三年，到期前或续期期满前两个月内，合同一方未通知另一方终止或修改合同，则自动续期一年，其后嗣同。

8、2014 年 8 月 29 日，发行人与京隆科技（苏州）有限公司（以下简称“京隆科技”）签署《FT 加工协议》，协议约定：发行人提供晶圆或积体电路委托京隆科技加工，具体产品的型号、价格、数量等由双方议定并记载于订单上；协议有效期为一年，如协议届满前 30 日，任何一方未以书面通知对方协议期满终止，则协议自动延期，每次延期一年。

9、2015 年 3 月 12 日，发行人与华天科技（昆山）电子有限公司（以下简称“昆山华天”）签署《采购框架合同》，合同约定：发行人与昆山华天进行进料加工贸易，昆山华天购买发行人原材料，按照双方签订的销售合同，由发行人向昆山华天回购加工后的成品晶圆，材料采购款从回购成品晶圆价款中扣除；原材料具体以每次发出的订单为准，晶圆机种、数量、芯片价格由发行人在装箱单和发票上标注；合同期限为一年。依据发行人与昆山华天签署并于上述《采购框架合同》同日生效的《补充协议》，约定在昆山华天使用发行人卖出的晶圆加工的芯片，如符合发行人的性能、参数要求，由且只能由发行人进行回购；昆山华天暂不支付晶圆的货款，按照双方约定的芯片电路销售合同，在发行人购买的芯片货款中扣除。

2015 年 3 月 12 日，发行人与昆山华天签署《销售框架合同》，合同约定：昆山华天提供加工后的成品，由发行人回购；具体电路型号、数量、成品价格由昆山华天在装箱单和发票上标注；付款期限为发行人收到货物后 60 天内；合同期限为一年。

（二）销售合同

公司对外销售分为直销和经销两种方式，公司通常是与直销客户或者经销商签订框架协议，协议项下的具体交易事项在订单中进行约定。截至本招股说明书签署之日，公司正在履行的重要销售合同如下表所示：

序号	客户名称	合同名称	合同标的、价款、数量	签署时间	有效期
1	深圳欧菲光科技科技股份有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲显示科技有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司、苏州欧菲光科技有限公司	深圳市汇顶科技股份有限公司合作框架协议	按双方确认的订单执行	2014-4-24	二年
2	深圳市德沃尔实业有限公司、	经销框架协议	按双方确认的订单执行	2016-1-1	一年
	德沃尔半导体（香港）有限公司	经销框架协议	按双方确认的订单执行	2016-1-1	一年
3	深圳市海威思科技有限公司	经销框架协议	按双方确认的订单执行	2016-1-1	一年
	德思达（香港）有限公司	经销框架协议	按双方确认的订单执行	2016-1-1	一年
4	深圳市华信科科技有限公司	经销框架协议	按双方确认的订单执行	2016-1-1	一年
	科通无线科技（香港）有限公司	经销框架协议	按双方确认的订单执行	2016-1-1	一年
5	亿莱科技（深圳）有限公司	经销框架协议	按双方确认的订单执行	2016-1-1	一年
	恒智科技股份有限公司	经销框架协议	按双方确认的订单执行	2016-1-1	一年
6	厦门弘汉智能科技有限公司	经销框架协议	按双方确认的订单执行	2016-1-1	一年
7	东莞金卓通信科技有限公司	深圳市汇顶科技股份有限公司合作框架协议	按双方确认的订单执行	2014-11-6	二年
8	东莞市金铭电子有限公司	深圳市汇顶科技股份有限公司合作框架协议	按双方确认的订单执行	2014-10-11	二年
9	深圳市金鼎泰电子有限公司	合作框架协议	按双方确认的订单执行	2015-12-29	二年
	金鼎泰（香港）电子有限公司	合作框架协议	按双方确认的订单执行	2015-12-29	二年
10	承益电子有限公司	合作框架协议	按双方确认的订单执行	2016-2-22	二年
	承益电子（深圳）有限公司	合作框架协议	按双方确认的订单执行	2016-2-22	二年
11	维沃移动通信（重庆）	合作框架协议	按双方确认的订单执行	2014-11-1	二年

序号	客户名称	合同名称	合同标的、价款、数量	签署时间	有效期
	有限公司、维沃移动通信有限公司				
	广东步步高电子科技有限公司	合作框架协议	按双方确认的订单执行	2014-11-1	二年
12	SAMSUNG DISPLAY CO., LTD	Purchase and Sale Agreement	按双方确认的订单执行	2014-12-3	三年，双方无异议，期满自动续期一年

（三）其他重大合同

1、2015年1月1日，发行人与联想移动通信科技有限公司（以下简称“联想通信”）签署《服务外包框架协议》，约定自该协议生效之日起2年，凡联想通信指定的TP厂应用发行人芯片产品的所有项目，均由联想通信提供技术服务。双方确定以季度作为一个服务周期，每期外包费用的结算金额依据当期联想通信提供服务的发行人产品的数量乘以服务单价。

2、2014年10月10日，发行人与深圳市臻科达科技有限公司（以下简称“臻科达”）签署《房屋租赁合同》，约定发行人将其所有位于深圳市南山区深圳市软件产业基地4栋B座9层901-902号房（整层）出租给臻科达用于办公，租赁面积为2,069.46平方米，月租金为186,251.40元，租赁期限自2014年10月13日至2017年10月12日。2014年10月10日，上述双方就前述租赁协议达成《租赁合同补充协议》，协议约定2014年10月13日至2016年10月12日，租赁房屋月租金为186,251.40元；2016年10月13日至2017年10月12日，租赁房屋月租金为197,426.48元。合同期满，双方协商一致时，发行人可以续约5年合约给予臻科达。

三、对外担保情况

截至本招股说明书签署之日，本公司不存在对外担保情况。

四、诉讼及仲裁事项

（一）美国国际贸易委员会调查案

1、基本情况

依据美国博钦律师事务所（Perkins Coie LLP）（以下简称“美国律师”）于 2016 年 2 月 17 日出具的法律意见书（以下简称“美国法律意见书”），Synaptics（以下均简称“新突思”）作为起诉方于 2015 年 4 月 21 日向美国国际贸易委员会（以下简称“ITC”）提起诉讼，该诉讼的应诉方包括发行人、汇顶美国（以下统称“汇顶”）及 BLU Products, Inc.（以下简称“BLU”），美国博钦律师事务所作为本案中汇顶的代理人。

新突思认为汇顶的触控芯片产品（例如 GT915 芯片）以及 BLU 使用汇顶触控芯片的产品（例如 BLU Studio 5.0C HD 手机）已进口至美国，并侵犯其四项美国专利（专利号分别为 7,868,874、8,338,724、8,558,811、8,952,916），新突思认为汇顶与 BLU 曾进口至美国，以进口为目的销售，或于进口后在美国销售新突思声称的侵权产品，因此违反美国 1930 年关税法 337 条款及其修正案 19 U.S.C. § 1337。

据此，新突思请求 ITC 作出如下判决：（1）依 19 U.S.C. § 1337（d）之规定，对各应诉方发出有限排除令（Limited Exclusion Order）；（2）依 19 U.S.C. § 1337（f）之规定发出禁制令（Cease and Desist Order）；（3）依 19 U.S.C. § 1337（j）之规定，要求各应诉方在 60 日的总统审查期间提交保证金；（4）在 ITC 职权范围内，给予起诉方各项其他救济。截至美国法律意见书出具之日，该案正在进行中；新突思与汇顶均已完成取证程序；2015 年 11 月 4 日至 5 日举行了关于权利要求属于含义法律解释的 Markman 听证会；庭审定于 2016 年 2 月 22 日至 26 日举行，预计 ITC 将于 2016 年 9 月 26 日作出最终判决。

2、案件对发行人的影响

依据美国法律意见书，该案件所涉汇顶产品具体类别为进口至美国的涉案 BLU 产品中使用的汇顶触屏控制芯片。**截至美国法律意见书出具日**，新突思仅指认了汇顶的 GT915 和 GT910 芯片是被使用于涉案 BLU 产品中的，以及 GT9158 芯片有可能被使用于 BLU 产品中。

若 ITC 调查的最终判决判定汇顶未违反 337 条款，则汇顶涉案产品以及使用汇顶涉案产品的 BLU 下游产品将可进口至美国，可于进口后在美国内销售，或以进口美国为目的而被销售。

若 ITC 调查的最终判决认为汇顶违反 337 条款，则：（1）ITC 将会发出有限排除令，禁止侵犯涉案专利的汇顶触控芯片及应诉方 BLU 含有汇顶侵权芯片的下游产品进口至美国；（2）也有可能发出禁制令，要求汇顶停止从事违反 337 条款的活动。

依据汇顶提供的信息，（1）汇顶从未向 BLU 的国内供货商深圳市天珑移动技术有限公司（以下简称“天珑公司”）提供过 GT910 和 GT9158；（2）汇顶现在没有通过天珑公司向 BLU 销售 GT915 等涉及新突思专利中的“同时施加”或“同时传输”调制信号的权利要求的结构与功能的触控芯片产品；且（3）天珑公司现正在生产 BLU 新开发的机型，其采用逐次施加或传输（sequentially applies or transmits）调制信号的功能与结构的汇顶触控芯片。逐次施加或传输调制信号的功能和结构并未被控侵权，且不会被认定为侵犯涉案专利，因为涉案专利要求同时施加或传输调制信号。因此，基于上述信息，美国律师认为即使在 2016 年 9 月 26 日前后发出的 ITC 的最终判决判定汇顶及 BLU 违反 337 条款，该最终判决应不会妨碍 BLU 进口至美国，于进口后在美国销售，或以进口至美国为销售目的销售那些使用逐次施加或传输调制信号的功能与结构的汇顶触控芯片的 BLU 产品。并且，该最终判决应不会妨碍汇顶进口至美国，于进口后在美国销售，或以进口至美国为目的销售那些使用逐次施加或传输调制信号的功能与结构的汇顶触控芯片。此外，即使 ITC 判定有违法情况存在，ITC 也不会判予新突思任何经济赔偿，因为 ITC 不能提供该救济方式。

3、美国律师对案件结果的判断及理由

美国律师认为，依据汇顶提供的信息，汇顶（1）没有进口美国，没有进口至美国后在美国内销售，没有以进口美国为目的而销售、侵犯涉案专利的汇顶触控芯片产品，例如但不限于新突思声称侵权的 GT915 芯片；（2）没有诱使或有助于他人侵犯涉案专利的权利要求。截至美国法律意见书出具日，基于该案的现有档案，新突思并未尽其举证责任以证明并非如此。

截至美国法律意见书出具日，基于该案的现有档案，新突思并未尽其举证责任来证实每个涉案专利的至少一项权利要求已有或正在建立国内产业，或已有产品实施每个涉案专利的至少一项权利要求。如果新突思最终未能向 ITC 证实以上事项，则 ITC 将会判决汇顶与 BLU 并不违反 337 条款。

此外，根据汇顶于 2015 年 8 月 17 日在美国专利局公开递交的专利无效行政诉讼状中关于新突思专利的现有文献及论证，美国律师认为新突思所主张的四项涉案专利均无效。并且，美国律师认为 ITC 应该根据汇顶的专利无效行政诉讼状中关于新突思专利无效的证据宣布新突思涉案专利无效，并因此而判定汇顶和 BLU 没有违反 337 条款。

根据上述原因，美国律师认为汇顶的产品未侵犯新突思涉案专利，并且新突思所主张的四项涉案专利均无效。

4、汇顶败诉时的救济手段

依据美国法律意见书，如果 ITC 判决汇顶违反 337 条款，可供汇顶选择的其它救济手段包括：（1）对 ITC 发出的最终判决提请总统审查。美国总统或其委派的美国贸易代表可能基于政策原因而否决 ITC 的最终判决或其救济令；（2）将 ITC 的最终判决上诉至美国联邦巡回上诉法院；（3）实施不侵犯专利权的芯片更改设计；（4）与美国海关合作，在执行有限排除令时限制其实施范围；（5）从新突思获得专利使用许可；或（6）若美国专利商标局在汇顶提起的专利无效行政诉讼中判决新突思的涉案专利无效，则提请 ITC 修改其有限排除令。

（二）地方法院诉讼

1、基本情况

依据美国法律意见书，新突思作为原告于 2015 年 4 月 17 日向美国加州北区联邦地方法院（以下简称“地方法院”）提起诉讼，该诉讼的被告包括发行人、汇顶美国及 BLU，美国博钦律师事务所作为本案中汇顶的代理人。

新突思认为汇顶的触控芯片产品（例如 GT915 芯片）以及 BLU 使用汇顶触控芯片的产品（例如 BLU Studio 5.0C HD 手机）侵犯其四项美国专利（专利号分别为 7,868,874、8,338,724、8,558,811、8,952,916），因此新突思认为汇顶与 BLU 违反了美国专利法 35 U.S.C. § 271。

据此，新突思请求地方法院作出如下判决：（1）判决新突思胜诉，判决各被告直接和间接侵犯上述涉案专利并违反专利法 35 U.S.C. § 271；（2）发出临时和永久禁制令，禁止各被告直接或间接制造、使用、销售、进行许诺销售、进口、或已进口至美国侵权产品，或诱使或有助于他人侵犯上述涉案专利；（3）依 35 U.S.C. § 284 之规定，

要求各被告对其侵犯涉案专利造成的损害进行赔偿，包括利息（含判决前与判决后的利息），办案成本以及支出；（4）判决此案为 35 U.S.C. § 285 款下的特殊案件，并判令各被告支付新突思合理的律师费用；并且（5）给予新突思其他应获的法律与衡平救济。

截至美国法律意见书出具之日，该案已被暂停，将在上述美国国际贸易委员会调查案做出终审判决之后重新启动。根据上述美国国际贸易委员会调查案的时间表以及地方法院审理专利诉讼案所需的大致时间，并假设 ITC 做出的最终判决将被上诉至联邦巡回上诉法院，美国律师认为，地方法院很可能在美国法律意见书出具之日后至少五年以后才会对本案作出判决。

2、案件对发行人的影响

依据美国法律意见书，该案件所涉汇顶产品的具体类别为汇顶的触屏控制芯片，例如 GT915。

若地方法院判决汇顶胜诉，则汇顶的触控芯片将可在美国内制造、使用、进行许诺销售、销售、或进口美国。

若地方法院判决汇顶侵犯上述涉案专利的任一专利要求并判定涉案专利有效，则地方法院可能会判令汇顶做出经济赔偿及发出禁制令。

依据汇顶提供的信息，由于汇顶产品生命周期的缘故，汇顶将提供其他不采用新突思所称侵犯四项涉案专利权利要求的功能与结构的触控芯片产品，特别的，对于新突思所称的，满足每一涉案专利的权利要求都必须的“同时施加”或“同时传输”调制信号要件的功能与结构，将会被逐次施加或传输（sequentially applies or transmits）该调制信号的功能与结构而替代。逐次施加或传输调制信号的功能与结构并未被控侵权，且不会被认定为侵犯涉案专利，因为涉案专利要求同时施加或传输调制信号。因此，基于上述信息，新突思在地方法院可能获得的禁令救济将不会影响汇顶以及那些使用不含新突思所称侵犯四项涉案专利权利要求的功能与结构的汇顶触控芯片产品的汇顶客户。

3、美国律师对案件结果的判断及理由

基于汇顶提供的信息，美国律师认为（1）汇顶没有在美国内制造、使用、进行许诺销售、销售、或进口至美国汇顶的触控芯片产品，例如但不限于新突思声称侵权的

GT915 芯片；（2）汇顶对其客户是否在美国内制造、使用、进行许诺销售、销售、或进口美国使用了汇顶的触控芯片的客户产品一无所知。

基于 BLU 在中国的出货商天珑公司提供的信息，BLU 销往中国以外地区的产品中仅仅使用总数约为 200,000 颗起诉状中特别指控的芯片。美国律师认为，涉案的汇顶产品并不侵犯涉案专利的任何有效的权利要求。即使地方法院作出相反的判决，判令汇顶对新突思所作的经济赔偿金额将考量新突思可证实的，曾在美国内制造、使用、进行许诺销售、销售、或进口至美国的，直接或间接使用于下游产品的汇顶芯片数量。基于天珑公司提供的上述信息，满足上述条件的汇顶芯片数量对于涉案的 BLU 产品来说不超过 200,000 颗，且新突思最终可证实的数量可能将会少很多。而且截至美国法律意见书出具日，新突思未指控其他公司的产品曾在美国内制造、使用、进行许诺销售、销售、或进口至美国，并使用涉案的汇顶芯片。因此，对于涉案的 BLU 产品来说，任何经济赔偿判决不应超过新突思因 200,000 颗起诉状中特别指控的芯片所损失的利润，或基于汇顶 200,000 颗芯片的营业收入的合理权利金。若地方法院判决故意侵权，则经济赔偿金额将最多增加至三倍赔偿额。但基于现有证据，美国律师不认为新突思可以尽到其证实故意侵权所需的举证责任。

对于新突思所主张的办案成本以及支出的律师费，从美国相关法律规定及司法实践上看，新突思很难达到获得上述费用所需的“极其特殊的案件”（依据 35 U.S. Code § 285 – 律师费：法院在极其特殊的情况下可能会判决败诉方支付合理的律师费给胜诉方）的法律要求。因此，此项主张很难得到地方法院支持，尤其是考虑到汇顶的辩护是具有合理理据的。

综上所述，美国律师认为汇顶未侵犯新突思专利，并且新突思司所主张的四项涉案专利无效。

4、汇顶被认定侵权时的救济手段

如果地方法院经简易程序审理批准认定汇顶侵权的动议，或陪审团认定汇顶侵权，其他可供汇顶选择的救济手段包括：（1）将地方法院的判决上诉至美国联邦巡回上诉法院；（2）从新突思公司获得专利使用许可；（3）实施不侵犯专利权的芯片更改设计，从而避免交付专利许可金。

（三）专利无效行政诉讼（**Inter Partes Review**（“**IPR**”）**Petitions**）

1、基本情况

依据美国法律意见书，发行人作为诉讼提起人于 2015 年 8 月 17 日向美国专利商标局专利审判与上诉委员会（以下简称“PTAB”）提交第一组 5 份诉状（案件编号分别为 IPR2015-01739，IPR2015-01740，IPR2015-01741，IPR2015-01742 和 IPR2015-01743），并于 2016 年 2 月 1 日、3 日和 4 日提交第二组 4 份诉状（案件编号分别为 IPR2016-00463、IPR2016-00464、IPR2016-00465、IPR2016-00463），汇顶美国被列为利害关系人，新突思为该案件的专利权人，美国博钦律师事务所作为本案中汇顶的代理人。发行人请求 PTAB 立案审查并宣布新突思四项美国专利（专利号分别为 7,868,874、8,338,724、8,558,811、8,952,916）的所有权利要求均为无效。截至美国法律意见书出具之日，该案件正在进行中。对 2015 年 8 月提交的第一组共 5 项 IPR 案，新突思于 2015 年 11 月 23 日对 5 份 IPR 诉状各自提交了专利权人初步应答书；PTAB 在 2016 年 2 月 16 日对 5 份 IPR 诉状做出立案裁定；决定对新突思的涉案四项专利进行 IPR 审查。PTAB 将于立案日起 12 个月内对上述 5 份 IPR 案完成诉讼程序并作出最终书面判决，最终书面判决不晚将于 2017 年 2 月 16 日。对 2016 年 2 月提交的第二组共 4 项 IPR 案，新突思的专利权人初步应答书需于大致 2016 年 5 月上旬或中旬提交；PTAB 需于大致 2016 年 8 月中旬前对 4 份 IPR 案做出立案裁定；一旦立案，PTAB 将于立案日起 12 个月内做出最终书面判决，预计为 2017 年 8 月。

2、案件对发行人的影响

若发行人在 IPR 诉讼中胜诉，PTAB 判决四项涉案专利的所有权利要求均为无效且最终被美国专利局撤销，则 ITC 于 ITC 调查案中可能发出的任何有限排除令和禁制令均将无效。考虑到地方法院诉讼案中的延迟，若涉案专利最终被美国专利局撤销，则地方法院将会撤销新突思提起的该诉讼案。

若 PTAB 判决涉案专利的部分而非所有权利要求无效，则新突思将不能在地方法院案件中主张那些已被宣布无效的权利要求。

若新突思提出修改权利要求的动议以尝试修改权利要求，而且 PTAB 批准了新突思修改权利要求的动议，则那些权利要求将会以修改后的形式颁布于最终书面判决。修改后的权利要求只能比原有的权利要求范围更窄，而不能更宽。新突思可以在地方法院案件中向汇顶主张那些修改后的权利要求。

若 PTAB 的最终书面判决确认上述涉案专利的某些或全部权利要求，且上诉维持原判，则新突思可以在地方法院案件中向发行人汇顶主张这些权利要求。

一旦 PTAB 最终书面判决发出，依 35 U.S.C. §315 (e) 款规定，汇顶将不能在地方法院诉讼，之后的 ITC 案件，和美国专利商标局中使用曾经在 IPR 中使用过的，或在合理范围内应该提出过的无效理由来主张涉案权利要求是无效的。但是，汇顶仍可基于其它在已结案的 IPR 不能提出或在合理范围内无法提出的原因挑战新突思专利权利要求的有效性，包括过往的公开使用、欠缺书面描述或欠缺可实施性，或新突思所犯不公平行为等等。

3、美国律师对案件结果的判断

综上所述，根据目前收集的证据，美国律师认为新突思所主张的四项涉案专利均无效。

4、发行人败诉时的救济手段

(1) 如果发行人对 PTAB 的立案裁定不满，则发行人可向 PTAB 提交复审请求。

(2) 如果发行人对 PTAB 的最终书面判决不满，则发行人可向 PTAB 提交复审请求，也可上诉至美国联邦巡回上诉法院。

综上，上述诉讼并不会对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景产生重大影响。截至本招股说明书签署之日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署之日，本公司的主要股东、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。本公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未涉及刑事诉讼事项。

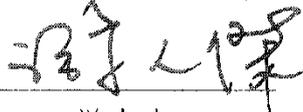
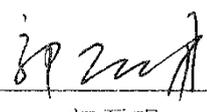
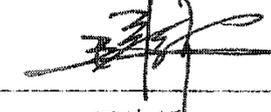
截至本招股说明书签署之日，除本招股说明书已披露的上述重要事项外，尚无其他重要事项发生。

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构 声明

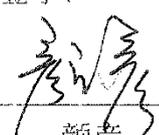
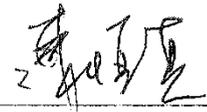
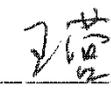
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

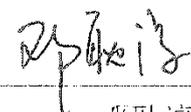
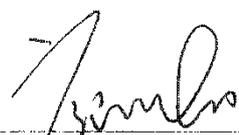
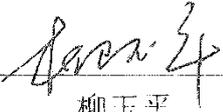
全体董事签字：

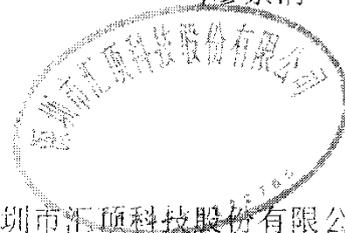
 张帆	 朱星火	 杨奇志
 游人杰	 郭磊明	 王建新
 张波		

全体监事签字：

 颜彦	 陈恒真	 王莹
---	--	---

其他高级管理人员签字：

 龙华	 邓耿淳	 廖崇清
 柳玉平		



深圳市汇源科技股份有限公司

2016年2月28日

二、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：



黄 钦



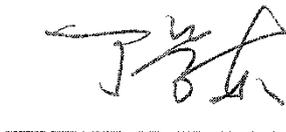
章志皓

项目协办人：



周 玉

法定代表人：



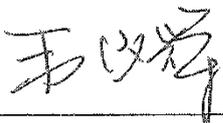
丁学东



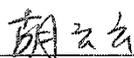
三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

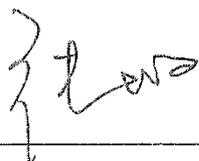


韦少辉



胡云云

律师事务所负责人：



张 炯



2016年2月28日

四、会计师事务所声明

大华特字[2016]000980 号

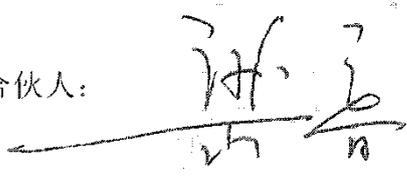
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的深圳市汇顶科技股份有限公司大华审字[2016]001315 号审计报告、大华核字[2016]000698 号内部控制鉴证报告及经本所核验的深圳市汇顶科技股份有限公司大华核字[2016]000700 号非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


周珊珊


程 纯

执行事务合伙人：



梁 春

大华会计师事务所（特殊普通合伙）



五、验资机构声明

大华特字[2016]000981 号

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的深圳市汇顶科技股份有限公司大华验字[2012]100 号、大华验字[2013]000164 号、大华验字[2015]000039 号验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书及其摘要不致因上述内容而不能出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


周珊珊


程纯

执行事务合伙人：



梁春

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2016年2月28日



六、验资情况专项复核机构声明

大华特字[2016]000982 号

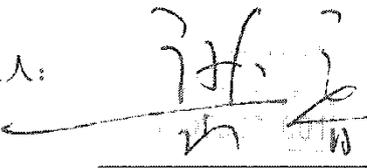
本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的大华核字[2012]3594 号《关于对深圳市汇顶科技股份有限公司申报期内非证券从业资格会计师事务所出具的验资报告股东出资到位情况的专项复核报告》无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资专项复核报告的内容无异议，确认招股说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


周珊珊


程纯

执行事务合伙人：


梁春

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



七、资产评估机构声明

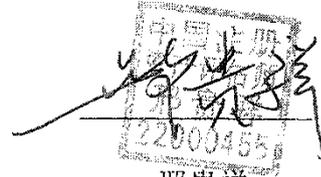
本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：



中国注册
资产评估师
37080806

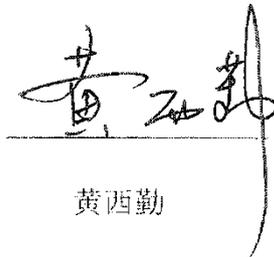
王文涛



中国注册
资产评估师
22000455

邢贵祥

法定代表人：



黄西勤

深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司

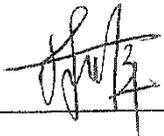


2016年2月28日

八、资产评估复核机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：

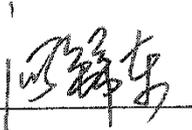


林巧萍



肖浩

法定代表人：



汤锦东

广东中广信资产评估有限公司



第十七节 备查文件

一、本招股说明书的备查文件

- 1、发行保荐书；
- 2、发行保荐工作报告；
- 3、财务报表及审计报告；
- 4、内部控制鉴证报告；
- 5、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- 6、法律意见书及律师工作报告；
- 7、公司章程（草案）；
- 8、中国证监会核准本次发行的文件；
- 9、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点

投资者可于本次发行承销期间赴本公司和保荐机构（主承销商）办公地点查阅。

三、查阅时间

除法定节假日以外的每日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00。

四、查阅网址

上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。